

科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



江苏鑫华半导体科技股份有限公司

Jiangsu Xinhua Semiconductor Technology Co.,Ltd.

徐州经济技术开发区杨山路 66 号

首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书

（申报稿）

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

CMS 招商证券

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者声明

公司深耕半导体核心材料领域，聚焦半导体产业用电子级多晶硅研发、生产与销售，以自主创新突破行业垄断，重塑全球市场竞争格局。高纯电子级多晶硅作为半导体产业链核心基础原材料，其生产技术长期被德国、美国、日本的少数企业垄断，对我国半导体产业供应链安全与自主发展形成严重制约。公司历经多年技术攻坚，成功实现国产电子级多晶硅大规模量产，为我国半导体制造所需核心原材料的自主可控与稳定供应做出重要贡献。根据中国电子材料行业协会半导体材料分会数据，**2025 年**公司在国内集成电路用高纯电子级多晶硅市场占有率超过 **60%**。国内市场其余份额及国际市场目前仍基本由境外厂商占据。本次上市募集资金将聚焦先进技术攻坚、高端产能建设及研发体系升级，进一步巩固公司在半导体核心材料领域的龙头地位，强化技术与产能双重竞争壁垒，为推动我国半导体产业高质量发展、助力国家科技自立自强战略落地贡献力量。

一、发行人上市的目的

（一）践行国家战略，筑牢半导体制造产业链安全根基

在半导体产业向自主可控加速迈进的背景下，电子级多晶硅是保障国家科技安全、稳固产业链根基的核心支撑。半导体制造产业链始于电子级多晶硅，至半导体硅片和晶圆制造，最终产出集成电路芯片用于终端产品，公司生产的电子级多晶硅是支撑整个半导体制造产业的关键基础材料。长期以来，国外企业凭借技术先发优势垄断市场，导致我国半导体产业在核心原材料供应环节受制于人，成为产业升级与自主发展的关键瓶颈。

公司自 2015 年成立以来，始终肩负以核心材料自主创新打破国外垄断、助力民族半导体自立自强、护航国家科技战略实施的使命，全力投身于电子级多晶硅的研发与产业化工作。经过持续技术攻关，公司攻克成套稳定量产的核心工艺难题，建成 5,000 吨/年的大规模产线，成为国内规模最大、技术领先的电子级多晶硅生产企业。公司产品关键指标全面达到国际先进水平，部分核心指标实现超越，产品应用覆盖 12 英寸硅片、6-8 英寸硅片、小尺寸硅片及硅部件的全覆盖，已被西安奕材、沪硅产业、TCL 中环、立昂微、Ferrotec、有研硅、中晶科技等国内几乎所有领先的半导体硅片企业验证和采用，并签署长期供应协议。

本次上市募集资金将为电子级多晶硅高端产能建设提供坚实保障，推动公司发展与我国半导体制造能力迭代升级同频共振，进一步筑牢产业链核心原材料自主供应的安全屏障，为国家科技自立自强战略落地提供关键支撑。

（二）布局高端产品，提高半导体制造前沿材料自主可控程度

超高纯电子级多晶硅是电子级多晶硅中的尖端产品，也是半导体基础材料的全球前沿领域。全球半导体技术向先进制程迭代升级，必须依托超高纯电子级多晶硅，其技术突破与自主供应已成为我国半导体产业向高端化迈进的关键。其中，超高阻电子级多晶硅凭借超高电阻率与极低杂质含量，已成为 AI 芯片、硅光子芯片等尖端集成电路实现性能跃升的关键基础材料，为我国集成电路制造向先进制程及高端化方向发展提供重要支撑；区熔用多晶硅以 13N 以上的高纯度，在 IGBT 功率器件、高端射频器件、微电子机械系统以及各类高精度探测器、传感器等战略领域具有不可替代的作用，直接影响高端装备国产化进程。

长期以来，国外企业垄断超高纯电子级多晶硅核心技术，构建技术壁垒与市场封锁，导致国内高端半导体产业对该类材料长期依赖进口，制约前沿芯片研发与产业升级节奏。面对产业痛点与国家战略需求，公司前瞻性布局超高纯电子级多晶硅研发赛道，聚焦超高阻与区熔用高端产品的技术创新。目前，公司在超高阻电子级多晶硅和区熔用多晶硅的产品技术研发及生产方面已取得突破性进展，相关产品通过部分国内外主流客户验证，并实现小批量出货，填补国内前沿需求与细分领域的供应空白，实现我国高端电子级多晶硅领域里程碑式跨越。

本次上市募集资金将进一步加大超高纯电子级多晶硅的研发与产能投入，努力满足国内半导体产业对高端核心材料的迫切需求，打破国外技术封锁与市场垄断，为我国半导体产业向先进制程和高端化自主发展提供核心保障。

（三）整合产业资源，增强产业链协同效能

立足自身技术积累与行业引领地位，公司积极践行产业链协同发展责任，通过资源整合与协同创新提升电子级多晶硅产业链整体效能。在技术研发层面，与国内高校、科研院所建立深度合作，聚焦行业关键技术瓶颈，加速前沿技术成果的产业化转化，助力行业技术迭代；在生产制造层面，深化上下游协同，与核心设备及原材料供应商建立稳定合作关系，通过技术交流、使用反馈助力上游企业

提升产品质量与供应稳定性，培育优质国产供应商集群，强化产业链供应链韧性。

本次上市融资后，公司将依托行业影响力与示范效应，持续带动上游设备及原材料的国产替代，提升国内电子级多晶硅产业链整体竞争力，为产业链自主可控与高质量发展注入持续动力。

（四）提升经营质量，实现股东与产业共赢

立足电子级多晶硅主业与行业使命，公司拟通过上市融资夯实发展基础，全面提升经营管理与可持续发展能力。上市后，公司将持续优化生产运营流程，提升生产效率与精益管理水平，增强核心产品的市场竞争力与供应稳定性，为核心材料自主可控供应筑牢根基；同时加大技术研发投入，深化前沿技术与产品创新，推出满足市场多样化、高端化需求的新产品，助力突破半导体产业关键材料技术瓶颈。

在此过程中，公司将持续提升盈利能力与经营质量，为股东创造长期稳定回报，增强投资者对公司及行业发展的信心，实现公司成长、股东回报与产业发展的良性互动，助力半导体产业链供应链自主可控与高质量发展。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，构建了完善的法人治理结构，治理规范、制度执行到位。为维护全体股东合法权益，公司制定了明确的股东分红回报规划，建立兼顾长远发展与股东合理回报的利润分配机制，保障股东知情权与监督权，稳定投资者预期。未来，公司将持续规范运作，深耕主业，严格履行分红承诺，让全体投资者共享发展成果，实现公司稳健发展与股东长期受益的良性循环。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金聚焦主营业务，主要投资于 10,000 吨/年高纯电子级多晶硅产业集群、1,500 吨/年超高纯多晶硅、1,500 吨/年区熔用多晶硅及高纯硅材料研发基地项目。通过募投项目实施，公司将实现先进产能规模化扩张，加速高端产品推广应用，深化核心技术创新，进一步巩固全球市场地位、提升综合竞争力，为国家半导体产业自主可控战略提供坚实支撑。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

（一）公司具备良好的持续经营能力

一方面，公司核心产品市场前景广阔，增长空间充足。全球半导体产业向先进制程迭代，叠加国内硅片产能加速扩张，电子级多晶硅作为核心基础原材料，市场需求快速攀升。公司凭借技术积累、品质稳定、产能充足、成本领先等产业优势，能够精准契合国产化需求，把握战略机遇期。另一方面，作为国内行业龙头，公司产品历经市场严苛验证，获得国内外众多领先半导体硅片厂商的广泛认可与批量采用，客户合作粘性强。当前公司在手订单充足，为生产经营连续性与稳定性提供坚实保障，确保收入稳定，同时为后续产能释放与市场份额提升奠定基础，进一步巩固行业领先地位。

（二）公司未来发展规划

公司锚定“硅+高纯”核心技术特征，以构建多元化产品矩阵为支撑，致力于成为全球一流硅基材料供应商。一是持续强化主业优势，迭代优化电子级多晶硅生产工艺，夯实规模化量产能力，力争在产品质量与成本控制上赶超国际领军企业，增强核心产品市场竞争力；二是加大新产品研发与工艺改进投入，聚焦超高阻电子级多晶硅、区熔用多晶硅等高端产品技术攻坚，加速关键技术突破与成果转化，推动规模化生产与市场化推广，填补国内高端产能空白；三是前瞻性布局硅基半导体材料领域，拓展产品应用边界，构建覆盖多场景的多元化产品体系，为长期可持续发展注入强劲动力。

董事长签字：



聂 巍

江苏鑫华半导体科技股份有限公司



本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A 股）
发行股数	本次公开发行股票采用公开发行新股方式，公开发行不低于 16,507.9366 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于发行后总股本的 10.00%。本次发行中，公司股东不进行公开发售股份。公司与主承销商可行使超额配售选择权，超额配售选择权不得超过首次公开发行股票数量的 15%。
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	【】元/股
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	不低于【】万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）
保荐人、主承销商	招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

目录

发行人声明	1
致投资者声明	2
一、发行人上市的目的.....	2
二、发行人现代企业制度的建立健全情况.....	4
三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.....	4
四、发行人持续经营能力及未来发展规划.....	5
本次发行概况	6
目录.....	7
第一节 释义	11
一、一般术语释义.....	11
二、专业术语释义.....	15
第二节 概览	17
一、重大事项提示.....	17
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....	21
三、本次发行概况.....	22
四、发行人的主营业务经营情况.....	23
五、发行人符合科创板定位相关情况.....	28
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.....	28
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.....	29
八、发行人选择的具体上市标准.....	29
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.....	30
十、募集资金运用与未来发展规划.....	30
十一、其他对发行人有重大影响的事项.....	30
第三节 风险因素	31
一、与发行人相关的风险.....	31
二、与行业相关的风险.....	36
三、其他风险.....	37
第四节 发行人基本情况	39

一、发行人基本情况.....	39
二、发行人设立情况、报告期内的股本和股东变化情况、成立以来重要事件及在其他证券市场的上市/挂牌情况	39
三、发行人股权结构.....	46
四、发行人的控股子公司、参股公司及分公司的基本情况.....	46
五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况	50
六、发行人的特别表决权股份或类似安排、协议控制架构.....	54
七、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为.....	54
八、发行人股本情况.....	55
九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的情况.....	65
十、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排.....	81
十一、发行人员工及社会保障情况.....	92
第五节 业务与技术	95
一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况.....	95
二、发行人所处行业基本情况.....	106
三、发行人销售和主要客户情况.....	130
四、发行人采购和主要供应商情况.....	133
五、发行人主要固定资产、无形资产及其他资源要素.....	137
六、发行人核心技术与研发情况.....	150
七、发行人生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力	164
八、公司境外经营情况.....	166
第六节 财务会计信息与管理层分析	167
一、财务报表.....	167
二、审计意见、关键审计事项、重要性水平及财务报表的编制基础	175
三、合并财务报表范围、变化情况及分部信息.....	177
四、重要会计政策和会计估计	178
五、主要税种税率和享受的主要税收优惠政策.....	202
六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.....	205
七、主要财务指标.....	206

八、经营成果分析.....	208
九、资产质量分析.....	225
十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....	243
十一、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并.....	254
十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项.....	254
十三、盈利预测.....	254
第七节 募集资金运用与未来发展规划	255
一、募集资金运用概况.....	255
二、公司战略规划.....	260
第八节 公司治理与独立性	263
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.....	263
二、公司内部控制情况.....	263
三、报告期内存在的违法违规行为及处罚情形.....	265
四、报告期内资金占用和对外担保的情况.....	265
五、直接面向市场独立持续经营情况.....	265
六、同业竞争.....	267
七、关联方、关联关系和关联交易.....	269
第九节 投资者保护	291
一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序.....	291
二、发行人的股利分配政策.....	291
三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业关于投资者保护的措施.....	295
第十节 其他重要事项	296
一、重大合同.....	296
二、对外担保情况.....	301
三、重大诉讼和仲裁事项.....	301
四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项.....	302

第十一节 声明	303
一、发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明.....	303
二、发行人第一大股东声明.....	313
三、保荐人（主承销商）声明.....	314
四、律师声明.....	316
五、审计机构声明.....	317
六、评估机构声明.....	318
七、验资机构声明.....	320
七、验资机构声明.....	321
八、验资复核机构声明.....	322
第十二节 附件	323
一、本招股说明书附件.....	323
二、查阅时间及地点.....	323
三、与投资者保护相关的承诺.....	324
四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.....	348
五、股东会、董事会、监事会/审计委员会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.....	350
六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.....	352
七、募集资金具体运用情况.....	352

第一节 释义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

一、一般术语释义

发行人、公司、股份公司、本公司、鑫华半导体	指	江苏鑫华半导体科技股份有限公司
鑫华有限	指	江苏鑫华半导体材料科技有限公司，发行人前身
内蒙古鑫华	指	内蒙古鑫华半导体科技有限公司，发行人子公司
徐州产线	指	发行人徐州生产基地，发行人母公司江苏鑫华半导体科技股份有限公司为徐州产线法人主体
内蒙产线	指	发行人内蒙古生产基地，发行人子公司内蒙古鑫华半导体科技有限公司为内蒙产线法人主体
湖北鑫阳	指	湖北鑫阳半导体科技有限公司，发行人子公司
徐州泛半导体	指	徐州金龙湖泛半导体材料研究有限公司，发行人子公司
徐州鑫华销售	指	徐州鑫华销售管理有限公司，发行人子公司
鑫华特种气体	指	徐州鑫华特种气体有限公司，发行人子公司
扬州鑫华	指	扬州鑫华半导体科技有限公司，曾为发行人子公司，已注销
合肥国材叁号	指	合肥国材叁号企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
中能硅业	指	江苏中能硅业科技发展有限公司，曾为发行人股东
集成电路基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司，发行人股东
沪硅产业	指	上海硅产业集团股份有限公司，A股上市公司，股票代码 688126，发行人股东
国投创业基金	指	国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙），发行人股东
厦门鼎峰	指	厦门鼎峰启融创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
科创新兴	指	深圳科创新兴投资合伙企业（有限合伙），原名深圳建信鹏城五号投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
嘉兴金硅	指	嘉兴金硅股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
北京瑞智	指	北京瑞智股权投资基金（有限合伙），发行人股东
嘉兴嘉亭	指	嘉兴嘉亭投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
中州旭诺	指	中州旭诺（舟山）股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
嘉兴嘉榭	指	嘉兴嘉榭投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
金浦瑞思	指	上海金浦瑞思企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
创东方	指	共青城创东方华鑫投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
允泰七号	指	苏州允泰七号股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
允泰六号	指	苏州允泰六号股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东

芯行壹	指	青岛芯行壹股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
苏州三行	指	苏州三行智祺创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
中欣晶圆	指	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司，发行人股东
宁波瑞芯泓	指	宁波瑞芯泓创业投资合伙企业（有限合伙），原名衢州瑞芯企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
长兴清风	指	长兴清风股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
同创致创	指	青岛同创致创创业投资中心（有限合伙），发行人股东
石溪产恒	指	合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
浦东新兴	指	上海浦东新兴产业投资有限公司，发行人股东
允泰芯材	指	允泰芯材股权投资（青岛）合伙企业（有限合伙），原名青岛鼎通福达股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
济南华岳	指	济南华岳投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
徐州臻芯	指	徐州臻芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
北京海震	指	北京海震铁路装备投资有限公司，发行人股东
蓉兴创芯	指	蓉兴创芯兴蓉（成都）企业管理中心（有限合伙），发行人股东
中建材新材料基金	指	中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
华舆转型	指	华舆（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），原名中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
苏州毅辉	指	苏州毅辉创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
天津泓生	指	天津泓生安泰股权投资合伙企业（有限合伙），曾为发行人股东
共青城泓生	指	共青城泓生华芯创业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
常州瑞良	指	常州瑞良创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
三亚御海	指	海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
南通元禾	指	南通元禾厚望创新成长一期股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
中金启兆	指	中金启兆睿泓（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
泰州建兴	指	泰州建兴科技创新投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
青岛融源	指	青岛融源轨道科技中心（有限合伙），发行人股东
鑫之同	指	新沂鑫之同企业管理合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台
鑫之同一号	指	新沂鑫之同一号企业管理合伙企业（有限合伙），系鑫之同有限合伙人，发行人员工持股平台
鑫之志	指	新沂鑫之志企业管理合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台
鑫之齐	指	新沂鑫之齐企业管理合伙企业（有限合伙），系鑫之志有限合伙人，发行人员工持股平台
鑫之道	指	新沂鑫之道企业管理合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台

鑫之源	指	新沂鑫之源企业管理合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台
鑫之合	指	新沂鑫之合企业管理合伙企业（有限合伙），发行人员工持股平台
ESOP 平台	指	鑫之志、鑫之同、鑫之道、鑫之合、鑫之源等五家企业
上海鑫澈	指	上海鑫澈科技发展有限公司
A 轮增资投资方	指	国投创业基金、厦门鼎峰、嘉兴金硅、北京瑞智、中州旭诺、嘉兴嘉榭、金浦瑞思、创东方、允泰七号、允泰六号、芯行壹
A 轮老股受让方	指	苏州三行、中欣晶圆、宁波瑞芯泓、长兴清风、同创致创、石溪产恒、浦东新兴、嘉兴嘉亨、允泰芯材
A 轮投资方	指	A 轮增资投资方与 A 轮老股受让方合称“A 轮投资方”
A+轮增资投资方	指	科创新兴和沪硅产业
B 轮增资投资方	指	济南华岳、徐州臻芯、北京海震、蓉兴创芯、中建材新材料基金、华舆转型、苏州毅辉、天津泓生、常州瑞良、三亚御海、南通元禾、中金启兆、泰州建兴、青岛融源、浦东新兴、允泰芯材
B 轮融资	指	B 轮增资投资方向发行人增资
天津硅石	指	天津硅石材料科技有限公司，公司子公司内蒙古鑫华的股东
深云智合	指	北京深云智合科技有限公司，公司参股公司
硅研新材	指	北京硅研新材科技有限公司，公司曾经的参股公司，现为公司参股公司深云智合的子公司
武汉立膜	指	武汉立膜科技有限公司，公司参股公司
协鑫控股	指	协鑫（集团）控股有限公司（Golden Concord Holdings Limited），注册于中国香港
协鑫苏州	指	协鑫集团有限公司，注册于苏州
协鑫集团	指	协鑫集团有限公司（Golden Concord Group Limited），注册于中国香港
江苏协鑫硅材料	指	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司
协鑫特材	指	江苏协鑫特种材料科技有限公司
协鑫高科纳米	指	协鑫高科纳米新材料（徐州）有限公司
TCL 中环	指	TCL 中环新能源科技股份有限公司，原名“天津中环半导体股份有限公司”，A 股上市公司，股票代码 002129
TCL 科技	指	TCL 科技集团股份有限公司
内蒙古中环领先	指	内蒙古中环领先半导体材料有限公司
中晟芯科	指	广东中晟芯科半导体有限公司
中环领先徐州	指	中环领先（徐州）半导体材料有限公司，原名徐州鑫晶半导体科技有限公司
天津中环领先	指	天津中环领先材料技术有限公司
天津环睿	指	天津环睿电子科技有限公司
上海新昇	指	上海新昇半导体科技有限公司
上海新昇晶睿	指	上海新昇晶睿半导体科技有限公司
晋科硅材料	指	太原晋科硅材料技术有限公司

凯圣氟化学	指	浙江凯圣氟化学有限公司
内蒙古鑫环	指	内蒙古鑫环硅能科技有限公司
立昂微	指	杭州立昂微电子股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 605358
西安奕材	指	西安奕斯伟材料科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 688783
有研硅	指	有研半导体硅材料股份公司，A 股上市公司，股票代码 688432
济南科盛	指	济南科盛电子有限公司
中晶科技	指	浙江中晶科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代码 003026
申和新材料	指	宁夏申和新材料科技有限公司
Ferrotec	指	株式会社フェローテックホールディングス（Ferrotec Holdings Corporation），日本磁性控股株式会社及其控股子公司
JM	指	J Materials Co., LTD
申和新材料	指	宁夏申和新材料科技有限公司
国家电网	指	国家电网有限公司
德国瓦克	指	Wacker Chemie AG，瓦克化学股份有限公司
美国 Hemlock	指	Hemlock Semiconductor Corporation，美国多晶硅生产企业
日本德山	指	Tokuyama Corporation，日本德山株式会社
三菱材料	指	Mitsubishi Materials Corporation，三菱材料株式会社
韩国 OCI	指	OCI Company Ltd，韩国综合性化学工业企业
科峰电器	指	苏州科峰电器成套有限公司
源宝莱	指	镇江源宝莱物资有限公司
金山桥	指	徐州金山桥热电有限公司
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计组织
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体产业协会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏鑫华半导体科技股份有限公司章程》及其历次修订版本
《公司章程（草案）》	指	经发行人 2025 年第六次临时股东会审议通过的《江苏鑫华半导体科技股份有限公司章程（草案）》，将于公司首次公开发行股票并在科创板上市后生效实施
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构、主承销商、保荐人、招商证券	指	招商证券股份有限公司
律师、发行人律师	指	北京市竞天公诚律师事务所

毕马威、审计机构	指	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、报告期内、报告期各期	指	2023 年、2024 年、2025 年
报告期末、审计基准日	指	2025 年 12 月 31 日
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、专业术语释义

半导体材料	指	导电能力介于导体和绝缘体之间的材料
硅	指	一种化学元素，元素符号 Si
晶硅	指	晶体硅材料，包括多晶硅和单晶硅等形式
多晶硅、硅料	指	单质硅的一种形态，由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同，多晶硅是光伏电池与半导体的主要原材料。根据纯度，多晶硅可分为太阳能级（光伏级）多晶硅与电子级（半导体级）多晶硅
电子级多晶硅	指	是以工业硅为原料经一系列的物理化学反应提纯后达到一定纯度的电子材料，纯度需达到 11N 以上
太阳能级多晶硅、光伏硅料	指	是以工业硅为原料经一系列的物理化学反应提纯后达到一定纯度的光伏材料，纯度一般达到 6N-9N
单晶硅	指	整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶硅，是用高纯度多晶硅为原料加工而成的产品
硅棒、单晶硅棒	指	由多晶硅通过直拉法、区熔法生长成的棒状的硅单晶体
工业硅粉、硅粉	指	由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素
超高纯多晶硅、超高纯电子级多晶硅	指	分为直拉用超高纯多晶硅及区熔用超高纯多晶硅，直拉用超高纯多晶硅因电阻率更高，又称超高阻电子级多晶硅
直拉法、CZ 法	指	直拉法是指通过热场给高纯度石英坩埚中的多晶硅加热，使其熔化，并熔接籽晶，转动籽晶，反转坩埚，缓慢提升籽晶，经过引晶、放大、转肩、等径生长、收尾等过程，得到单晶硅
直拉用多晶硅	指	采用直拉法制备单晶硅的多晶硅原料
区熔法、FZ 法	指	区熔法利用高频线圈在半导体棒料的一端产生一熔区，再熔接单晶籽晶。调节高频线圈使熔区缓慢地向棒的另一端移动，通过整根棒料，生长成一根单晶，晶向与籽晶相同
区熔用多晶硅	指	采用区熔法制备单晶硅的多晶硅原料
硅基电子特气	指	通过吸附、精馏的方式进行提纯，达到电子级要求后的四氯化硅、三氯氢硅、二氯二氢硅、六氯乙硅烷等气体产品
硅部件	指	以高纯度硅制成的半导体加工机械部件
分立器件	指	采用特殊的半导体制备工艺，实现特定单一功能的半导体器件，且该功能往往无法在集成电路中实现或在集成电路中实现难度较大、成本较高，主要包括功率二极管、功率三极管、晶闸管、金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）等
西门子法	指	西门子法为生产多晶硅的工艺，以氢气还原高纯度三氯氢硅，在

		加热到 1,100°C 左右的硅芯上沉积多晶硅的生产工艺
改良西门子法	指	改良西门子工艺是在传统的西门子工艺的基础上，同时具备节能、降耗、回收利用生产过程中伴随产生的大量 H_2 、 HCl 、 $SiCl_4$ 等副产物以及大量副产热能的配套工艺
三氯氢硅	指	由工业硅粉与氯化氢合成而得的硅化合物，能在 1,100°C 左右被氢还原为单质硅，化学式为 $SiHCl_3$
四氯化硅	指	是一种无机化合物，西门子法制造电子级多晶硅的中间产物，化学式为 $SiCl_4$
二氯二氢硅	指	改良西门子法工艺体系的中间产物，提纯后可用于电子气、外延、化学气相沉积，化学式为 SiH_2Cl_2
氯硅烷	指	泛指含氯、硅的化合物，一般指三氯氢硅、四氯化硅和二氯二氢硅
化学气相沉积、CVD	指	在基底表面发生化学反应或化学分解来产生沉积。英文名称“Chemical Vapor Deposition”，简称 CVD
冷氢化	指	将四氯化硅在流化床中转化为三氯氢硅的相关技术
歧化	指	氧化作用和还原作用发生在同一分子内部处于同一氧化态的元素上，使该元素原子（或离子）一部分被氧化，另一部分被还原的氧化还原反应
精馏	指	利用混合物中各组分挥发度不同而将各组分加以分离的一种分离过程
还原	指	化学上把物质氧化数降低（得电子）的反应
硅片、半导体硅片	指	由单晶硅棒切割形成的圆形片
痕量	指	一般指某种物质的含量在百万分之一以下
ppbw、pptw	指	以质量计的浓度单位，ppbw 为十亿分之一质量比，pptw 为万亿分之一质量比
ppba、ppta	指	以原子数计的浓度单位，ppba 为十亿分之一原子比，ppta 为万亿分之一原子比
N	指	英文 Nine 的缩写，表示纯度百分比中有几个“9”，如 6N 为 99.9999%，11N 为 99.999999999%
施主杂质	指	多晶硅中以给出电子方式贡献导电性的一种杂质，主要指磷、砷、锑等 V 族元素
受主杂质	指	多晶硅中以提供空穴方式贡献导电性的一种杂质，主要指硼、铝、镓等 III 族元素
碳含量	指	多晶硅材料中碳元素含量
基体金属含量	指	多晶硅材料基体金属杂质含量
表面金属含量	指	多晶硅材料表面金属杂质含量

除特别说明外，本招股说明书所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和与尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

本重大事项提示仅对发行人特别事项及重大风险做扼要提示。公司提请投资者应认真阅读本招股说明书正文内容，对本公司做全面了解。如无特别说明，本招股说明书“重大事项提示”部分简称或名词的释义与本招股说明书“第一节释义”一致。

（一）本公司特别提醒投资者关注的“风险因素”

本公司特别提醒投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本招股说明书第三节披露的风险因素，审慎作出投资决定。发行人特别提醒投资者关注以下风险因素：

1、公司在国内乃至国际市场与国际厂商竞争面临的不确定性风险

公司目前主要竞争对手为德国瓦克、美国 Hemlock、日本德山等国际厂商，该等国际厂商已经历数十年乃至上百年的积累和发展，在技术积淀、产品品类、客户议价能力、经营规模、资本实力等方面具有优势，在全球市场已形成寡头垄断竞争格局。公司目前是国内主要的半导体产业用电子级多晶硅生产企业，也是 12 英寸硅片领域电子级多晶硅大规模稳定供应的唯一国产供应商，国内市场占有率超过 60%，国内市场其余份额和国际市场目前仍基本由境外厂商占据。截至目前，公司已成功进入国际一线硅片厂商供应链，但销售规模仍较小。

在国内，公司要继续提升市场占有率，面临国际厂商更强阻力；在国外，电子级多晶硅国际厂商已与全球五大硅片厂商长期深度合作（包括销售长单、控参股关系、持续产品开发磨合等），公司面临不利竞争态势。此外，公司还需要不断扩充产品品类，并持续经历客户验证、市场开拓的过程。在上述竞争过程中，如果公司不能持续维持技术优势、有效保持和开拓境内外战略客户、降低成本、扩充产品品类，可能导致公司竞争力下降，而无法在国内市场维持优势，或在国际市场提升收入规模，从而难以实现公司经营目标。

2、经营业绩波动的风险

（1）经营业绩受半导体行业波动影响的风险

公司所在半导体行业受宏观经济形势、下游终端需求等因素影响而具有一定的周期波动。根据 WSTS 统计，2024 年全球半导体市场销售额为 6,305.49 亿美元；2025 年，随着新兴市场需求增加、全球经济形势企稳、通胀有所放缓，以及各国持续出台半导体产业支持政策，全球半导体市场回暖，预计全年销售总额为 7,008.74 亿美元，同比增长 11.15%。半导体行业的周期性波动受多种因素综合影响，具有一定不确定性，若由于宏观经济低迷、下游行业需求持续放缓、半导体行业政策出现不利变化、市场竞争加剧等因素而出现主要产品价格或销量下降等不利情况，公司收入、利润存在受半导体行业整体波动而降低的风险。

（2）经营业绩受副产品市场价格波动影响的风险

公司业绩受到副产品太阳能级多晶硅价格波动的影响，公司在生产电子级多晶硅过程中，由于生产工艺特征，不可避免会产生部分副产品，等级未达到电子级，但可以应用于新能源领域，因此作为太阳能级多晶硅销售。公司副产品收入核算为其他业务收入，公司不会主动拓展副产品销售市场，主要由客户主动询购，公司参考市场公开价格进行销售。太阳能级多晶硅市场价格波动较大，在 2022 年至 2023 年经历了较为罕见的价格大幅波动。2022 年太阳能级多晶硅市场价格处于历史高位，且远高于历史均值，导致公司当年净利润基数较高；2023 年太阳能级多晶硅市场价格快速下跌，较 2022 年最大跌幅近 80%。因而，公司副产品相关收入及利润波动较大，进而可能导致整体业绩波动。

公司通过技术提升已将徐州产线副产品产出率降至较低水平，且副产品太阳能级多晶硅市场价格已处于历史低位。公司内蒙产线于 2024 年底正式投产，在产能及良率爬坡阶段，副产品产出率相对较高。如果未来副产品太阳能级多晶硅市场价格再次出现大幅波动，或内蒙产线副产品产出率无法稳定在较低水平，仍可能在一定程度上影响公司整体业绩的波动，提醒投资者关注相关风险。

（3）募集资金投资项目投产后，新增折旧和摊销影响经营业绩的风险

公司本次募集资金投资项目计划新增投资金额较大，投产后将新增折旧和摊销，可能影响经营业绩。其中，内蒙 10,000 吨/年电子级多晶硅产线投产后，

2025 年月平均折旧额为 1,622.37 万元，对归母净利润影响额为每月-973.42 万元。其他募集资金投资项目建设完成投产后，公司折旧和摊销将增加约 7,200 万元/年。若未来产业政策或市场环境等因素发生重大不利变化，则新增折旧摊销可能对本次募集资金投资项目效益造成不利影响，继而对公司未来的经营业绩产生不利影响。

3、毛利率波动的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 15.63%、22.44%和 24.91%，主营业务毛利率分别为 16.84%、23.10%和 25.07%，存在一定波动。

公司毛利率受到产品售价、产品结构、单位成本等因素影响。公司电子级多晶硅产品中，质量要求更高的 P 级产品价格相对稳定，而 S 级产品价格受行业影响有所下降。公司电子级多晶硅副产品的价格主要跟随太阳能级多晶硅市场价格而波动，报告期内持续处于较低水平。报告期内，随着 P 级产品收入占比提升，单位成本下降，公司毛利率呈现上升趋势。但未来若公司不能保持较好的技术研发、成本控制和客户开发能力，产品竞争力有所下降，产品结构无法持续优化，或半导体市场景气度下行，将影响公司主营业务毛利率；若副产品太阳能级多晶硅市场价格持续下降或保持低位，公司将面临其他业务毛利率继续下滑或持续较低的风险。前述因素均会导致公司综合毛利率波动，进而可能给公司生产经营活动带来不利影响。

4、无实际控制人风险

公司无控股股东和实际控制人。截至本招股说明书签署日，公司第一大股东合肥国材叁号及其一致行动人中建材新材料基金持股比例合计为 25.55%，第二大股东集成电路基金持股比例为 20.62%，均未超过 30.00%，并且合肥国材叁号和集成电路基金之间不存在一致行动关系。公司的单一股东依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东会的决议产生决定性影响，单一股东在董事会中提名的董事不足以对董事会的决议产生决定性影响，无法单独控制公司的董事会，也无法单方面决定公司及其下属公司的经营决策。充分制衡的股权结构有利于提高决策的科学性，但也可能影响公司的决策效率，在公司需要迅速做出重大经营、投资决策时，可能导致贻误发展机遇。此外，公司股权相对分散，使得公司未来有

可能成为被收购对象，不排除上市后现有或新增股东通过增持公司股票导致公司股权结构发生变化，并可能导致董事会成员构成发生变化，甚至导致公司控制权发生变化。该等公司治理结构的变化可能会对公司经营管理和业绩的稳定性等带来不利影响。

5、关联采购金额较大的风险

报告期内，发行人向中能硅业购买商品及接受劳务金额分别为 20,891.72 万元、16,019.91 万元和 **19,586.54** 万元，占报告期各期营业成本比重分别为 26.17%、18.62%和 **14.56%**。发行人目前拥有 8,000 吨/年徐州产线和 10,000 吨/年内蒙产线两大生产基地，报告期内发行人与中能硅业之间的采购主要是发行人的徐州产线向其委托加工三氯氢硅、采购电力等。

报告期期初，发行人徐州产线生产所需三氯氢硅主要委托中能硅业加工，2023 年向中能硅业采购三氯氢硅金额为 3,384.69 万元，占当期营业成本的比例为 4.24%。发行人徐州产线自建三氯氢硅生产线于 2022 年底建设完成并开始投入使用，2023 年三氯氢硅关联采购金额及占比大幅下降。随着发行人徐州产线的三氯氢硅生产线逐渐达到稳定满产状态，2023 年 5 月后已不再委托中能硅业加工三氯氢硅。2025 年 9 月至 11 月，因公司冷氢化产线停产检修，公司临时向中能硅业采购少量三氯氢硅，采购金额 **1,452.99** 万元。

发行人徐州产线建设时，由中能硅业和集成电路基金共同出资，中能硅业以实物产线注资，出资产线配套的原始电力设计方案和电力配套设施已固定。因此，发行人徐州产线的部分电力通过中能硅业采购，报告期内采购金额分别为 14,264.94 万元、12,633.81 万元和 **14,946.53** 万元，占报告期内发行人营业成本比重分别为 17.87%、14.68%和 **11.11%**。发行人徐州产线向中能硅业采购电力价格参照中能硅业向国家电网采购的电度用电价格（加成一定金额容/需量费）确定，定价公允。如果未来由于不可抗力等因素，导致前述中能硅业电力供应出现不稳定波动甚至中断情形，发行人需进行供电系统切换并重新配置电力设备等，可能导致徐州产线在一定期间内生产稳定性受到影响，并导致未来用电成本有所上升。发行人与中能硅业目前签署的能源供应合同有效期至 2036 年底。

（二）相关重要承诺

公司及相关责任主体已按照中国证监会及上海证券交易所等监管机构的要求，就股份限售安排、业绩下滑延长股份锁定期限、股东持股及减持意向、稳定股价等重要事项作出相关承诺。具体承诺事项详见本招股说明书之“第十二节、三、与投资者保护相关的承诺”。

（三）本次发行上市后的利润分配政策

发行人已制定并披露了切实可行的发行上市后的利润分配政策、现金分红、上市后三年内利润分配计划及长期回报规划，请投资者予以关注。具体情况请参见本招股说明书之“第九节、二、发行人的股利分配政策”相关内容。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况

发行人名称	江苏鑫华半导体科技股份有限公司	有限公司成立日期	2015年12月11日
		股份公司成立日期	2022年3月30日
注册资本	148,571.4288 万元	法定代表人	田新
注册地址	徐州经济技术开发区杨山路66号	主要生产经营地址	徐州经济技术开发区杨山路66号
控股股东	无	实际控制人	无
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无

（二）本次发行的有关中介机构

保荐人	招商证券股份有限公司	主承销商	招商证券股份有限公司
审计机构	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	发行人律师	北京市竞天公诚律师事务所
评估机构	上海东洲资产评估有限公司	其他承销机构	无
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关	截至2026年5月11日，保荐人（主承销商）招商证券（1）通过其全资子公司招商证券投资有限公司间接持有石溪产恒合伙份额；（2）通过其持股45%的招商基金管理有限公司之全资子公司招商财富资产管理有限公司间接持有苏州三行合伙份额；（3）招商证券衍生品业务持有沪硅产业股份。通过前述路径，招商证券合计间接持有发行人0.03%的股份。除前述路径之外，招商证券衍生品业务在发行人间接股东层面持股极少（间接持有发行人股份比例低于万分之一）。该等情况均为相关投资主体的市场化行为，不属于法律法规禁止持股的情形或利益冲突情形。除上述相关情况外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服		

系或其他利益关系	务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。
----------	---

（三）本次发行其他有关机构

股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	收款银行	招商银行深圳分行深纺大厦支行
其他与本次发行有关的机构	无		

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	1.00元		
发行股数	不低于16,507.9366万股	占发行后总股本比例	不低于10.00%
其中：发行新股数量	不低于16,507.9366万股	占发行后总股本比例	不低于10.00%
股东公开发售股份数量	无	占发行后总股本比例	无
发行后总股本	不低于165,079.3654万股		
每股发行价格	【】元/股		
发行市盈率	【】倍（每股收益按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）		
	【】倍（每股收益按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	【】元/股	发行前每股收益	【】元/股
发行后每股净资产	【】元/股	发行后每股收益	【】元/股
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算）		
	【】倍（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）		
预测净利润	无		
发行方式	采用网下向询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、上交所认可的其他方式		
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	10,000吨/年高纯电子级多晶硅产业集群项目		
	1,500吨/年超高纯多晶硅项目		

	1,500吨/年区熔用多晶硅项目
	高纯硅材料研发基地项目
	补充流动资金
发行费用概算	(1) 保荐费用【】万元 (2) 承销费用【】万元 (3) 审计费用【】万元 (4) 律师费用【】万元 (5) 用于本次发行的信息披露费【】万元 (6) 发行手续费和其他【】万元 （注：本次发行各项费用均为不含增值税金额）
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	公司高级管理人员及核心员工拟参与本次发行的战略配售，后续公司及相关人员将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并在提交董事会审议后向上交所提交相关文件
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构将安排子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则	无

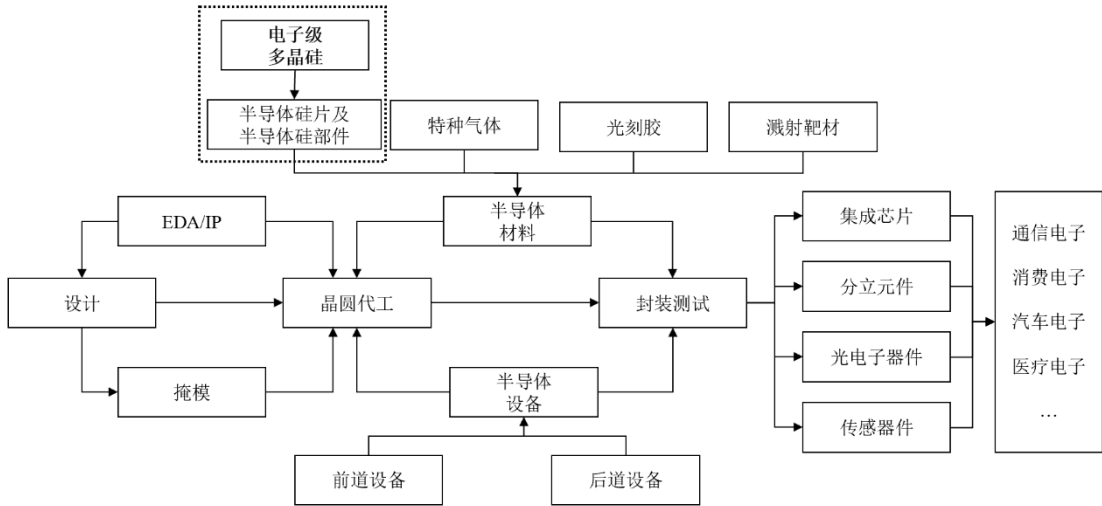
（二）本次发行上市的重要日期

序号	内容	日期
1	刊登发行公告的日期	【】年【】月【】日
2	开始询价推介的日期	【】年【】月【】日
3	刊登定价公告的日期	【】年【】月【】日
4	申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
5	股票上市日期	【】年【】月【】日

四、发行人的主营业务经营情况

（一）主营业务情况

公司主要从事半导体产业用电子级多晶硅的研发、生产与销售。半导体制造产业链始于电子级多晶硅，至半导体硅片和晶圆制造，最终产出集成电路芯片用于终端产品。作为我国实现高水平科技自立自强的重要产业领域，半导体制造产业具有重大战略意义。公司生产的电子级多晶硅是支撑整个半导体制造产业的关键基础材料，直接应用于半导体硅片与半导体用硅部件生产。



半导体硅材料产业市场规模占半导体制造材料市场规模的 30%左右，是半导体制造中占比最高的主材料。普通工业硅纯度为 98%左右，而半导体制造对电子级多晶硅技术指标要求十分严苛，当硼、磷或其他金属元素作为杂质存在于多晶硅中时，制成的硅片产品质量难以控制，因此需要极高的多晶硅纯度，对纯度要求需达到 11N（即 99.999999999%）以上，施主杂质含量和受主杂质含量均需达到 ppta（万亿分之一原子比）级别，且需在万吨级大规模生产中维持技术指标的高度一致性。自 20 世纪 80 年代以来，高纯电子级多晶硅作为行业基础原材料，技术被德国、美国、日本少数企业所垄断，全球具备成熟技术、能够大规模稳定供应的厂商在 5 家以内，国内市场化供应能力几乎为零，严重制约中国半导体产业的发展。为了解决国产化替代难题，公司自成立以来，便以“填补国内半导体级多晶硅国产化空白”战略目标为指导，坚持以科技创新为核心，致力于关键技术的研究和开发，先后建成徐州 5,000 吨/年（后扩产至 8,000 吨/年）和内蒙 10,000 吨/年电子级多晶硅生产线，成功实现半导体产业用电子级多晶硅的大规模稳定生产，打破了国外在技术与市场上的双重垄断，填补了国内相关领域的空白。公司电子级多晶硅各项关键指标已全面达到国际先进水平，顺利通过国内外主流客户验证，产品应用领域实现了从 12 英寸硅片、6-8 英寸硅片至小尺寸硅片及硅部件的全覆盖，保障国产硅片及硅部件产业的正常运行和发展。

目前，公司正在继续加大投入以攻克超高纯电子级多晶硅技术。超高纯电子级多晶硅是电子级多晶硅中的全球前沿产品，包括超高阻电子级多晶硅和区熔用多晶硅，纯度可达到 13N（即 99.9999999999%）以上。其中，超高阻电子级多晶硅较普通电子级多晶硅电阻率更高、杂质含量更低，是先进制程集成电路的核

心基材，其超高纯度与极低杂质特性直接决定芯片性能与功耗水平，是 AI 芯片、硅光子芯片等尖端集成电路性能跃升的重要基础，为我国集成电路制造领域向先进制程和高端化发展提供关键支撑。区熔用多晶硅是电子级多晶硅中占比相对较小但不可或缺、技术难度更高的部分，在 IGBT 功率器件、高端射频器件、微电子机械系统以及各类高精度探测器、传感器等战略领域具有关键应用价值。公司目前在超高阻电子级多晶硅和区熔用多晶硅的产品技术研发及生产方面均已取得突破性进展，相关产品通过部分国内外主流客户验证，并实现小批量出货。

此外，基于多年电子级多晶硅研发生产所积累的高纯硅基产品技术，公司正在积极进行硅基电子特气和高纯石英砂等围绕高纯硅基材料的多元化产品研究开发工作。

公司依托在电子级多晶硅领域的技术积累，积极承担国家及地方重大科技攻关任务。公司是国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》（02 专项）中《电子级多晶硅材料研发》的具体实施单位；公司承接的工业和信息化部“国家工业强基工程”项目，已顺利通过验收；同时，公司还承担了“江苏省工业和信息产业转型升级项目”“江苏省关键核心技术攻关项目”以及“江苏省重点研发计划项目”等多项省级重点科技专项。此外，公司积极参与国家及行业标准体系建设，作为牵头单位完成了最新版《电子级多晶硅》（GB/T 12963-2022）国家标准的修订，并参与多项国家标准、行业标准的制定和修订工作。公司是国家级专精特新“小巨人”企业。

公司电子级多晶硅产品质量等级如下：

产品类别		主要应用	产品特征	示意图
区熔用多晶硅		主要用于生产区熔单晶，应用于 IGBT 功率器件、高端射频器件、微电子机械系统以及各类高精度探测器、传感器等战略领域	产品形态为棒状多晶硅，杂质含量较 P 级更低，且在内应力等指标上与直拉用电子级多晶硅有所区别	
直拉用多晶硅	J 级	主要用于生产先进制程用 12 英寸硅片、高阻硅片等产品	杂质含量较 P 级更低	
	P 级	主要用于生产大尺寸硅片、高等级硅部件	杂质含量极低，指标波动极小	
	S 级	主要用于生产中小尺寸硅片、硅部件等	杂质含量低，指标波动小	

报告期内，发行人主营业务收入根据产品类别分类情况如下：

单位：万元

产品类别		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
区熔用多晶硅		1,858.43	1.07%	1,325.57	1.24%	84.74	0.10%
直拉用多晶硅	P 级	144,986.52	83.26%	81,918.37	76.77%	67,256.26	77.75%
	S 级	26,430.39	15.18%	22,250.02	20.85%	18,488.90	21.37%
其他主营业务		863.40	0.50%	1,207.74	1.13%	669.02	0.77%
合计		174,138.73	100.00%	106,701.69	100.00%	86,498.92	100.00%

注 1：公司其他主营业务产品包括碳化硅硅粉、电子特气、高纯石英砂等新产品，下同；
注 2：公司超高阻电子级多晶硅（J 级）目前实现小批量出货，金额较小，故与 P 级合并列示，下同。

（二）市场竞争地位

公司是目前国内主要的半导体产业用电子级多晶硅生产企业，也是国内极少已完整覆盖 12 英寸硅片、8 英寸硅片、4-6 英寸硅片、硅部件等各等级应用领域的电子级多晶硅企业。公司电子级多晶硅产品在国内已经取得了较高市场地位，被国内几乎全部领先的半导体硅片企业验证和采用，并签署长期供应协议，前十大客户涵盖了西安奕材、沪硅产业、TCL 中环、立昂微、Ferrotec、有研硅、中晶科技等。根据中国电子材料行业协会半导体材料分会统计，2025 年公司在国内集成电路用高纯电子级多晶硅市场占有率超过 60%。国内市场其余份额目前仍主要由境外厂商占据。

在公司下游硅片市场，12 英寸硅片是目前市场最主流规格的硅片，也是目前全球晶圆厂扩产的主要方向。根据 SEMI 统计，12 英寸硅片贡献了 2024 年全球总硅片出货面积的 75%以上。12 英寸硅片核心应用于消费电子、高性能计算、人工智能及云计算领域，具体涵盖智能手机、平板电脑、PC、服务器芯片、GPU/CPU、AI 加速器等高端集成电路产品。目前公司是 12 英寸硅片领域电子级多晶硅大规模稳定供应的唯一国产供应商。

在国际市场上，电子级多晶硅及其下游 12 英寸硅片市场均呈现寡头垄断格局，电子级多晶硅供应完全被德国瓦克、美国 Hemlock、日本德山等少数国际厂商垄断，下游 12 英寸硅片市场基本被前五大硅片厂商所占据（产能占比超过 70%）。国际硅片厂商对电子级多晶硅的技术指标和稳定性要求更为严苛，供应

链进入壁垒极高。经多年技术积累和反复验证，公司已成功进入国际一线硅片厂商供应链，在全球高纯电子级多晶硅供应体系中打开了更为广阔的市场空间。

在技术难度更高、质量指标更为严苛的超高纯电子级多晶硅领域，全球技术成熟、能够稳定供应的厂商数量更少，该领域已成为全球半导体关键材料的尖端领域。在该领域能否取得技术突破与自主供应，关系到能否支撑国产集成电路制造领域向先进制程和高端化发展，能否满足各类高端功率半导体战略领域及相关高端装备国产化的需求，公司目前已经在超高纯电子级多晶硅的技术研发和生产方面取得突破性进展，相关产品已通过国内外部分主流客户验证并实现小批量出货，具备了向技术成熟应用、大规模生产出货推进的关键基础。

（三）主要经营模式

公司主要产品为电子级多晶硅，主要采取直销模式销售。客户覆盖众多国内外一线半导体硅片厂商，对于境内客户，公司主要采取直销模式向客户提供产品；对于部分境外客户及少数境内客户，公司通过贸易商向客户提供产品。公司销售及重要客户具体情况请参见本招股说明书之“第五节、三、发行人销售和主要客户情况”的相关内容。

公司对外采购主要可分为原材料和能源两种采购类型。公司原材料主要包括三氯氢硅、硅粉等。报告期期初，三氯氢硅主要委托中能硅业加工，2023 年开始公司由委托加工逐步转为购买硅粉后自产。公司能源采购主要包括电力和蒸汽。

作为电子级多晶硅龙头企业，公司基于产业链需求牵引，聚焦上游国产材料与设备的产业化应用验证，推动供应链自主可控。在耗材端，公司完成高纯石墨件、半导体级洁净包装材料等基础材料的国产替代方案验证，并实现规模化导入；在设备端，公司完成多晶硅沉积环节大型还原炉的国产化产线验证，并在后处理阶段实现酸洗设备的工艺适配与稳定运行。目前，国产化耗材与设备已通过公司产线验证并批量应用，系统性降低供应链风险，为上游国产技术产业化落地提供关键场景支撑。公司原材料及主要供应商具体情况请参见本招股说明书之“第五节、四、发行人采购和主要供应商情况”的相关内容。

公司生产部门根据与客户签订的长期供货协议、具体合同及订单、公司产能、对市场的预期判断、年度检修计划等综合考虑制定年度生产计划、季度生产计划

和月度生产计划，并组织生产。报告期内，公司生产模式具体情况请参见本招股说明书之“第五节、一、（二）、1、主要经营模式”的相关内容。

五、发行人符合科创板定位相关情况

（一）发行人符合科创行业领域要求

公司所属行业领域	☐ 新一代信息技术	根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，公司所属行业属于“鼓励类”，第九条第4款“新材料”中“半导体、芯片用电子级多晶硅（包括区熔用多晶硅材料）”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“C3985 电子专用材料制造”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业属于“3 新材料产业”之“3.4 先进无机非金属材料”之“3.4.3 人工晶体制造”之“3.4.3.1 半导体晶体制造”
	☐ 高端设备	
	☒ 新材料	
	☐ 新能源	
	☐ 节能环保	
	☐ 生物医药	
	☐ 符合科创板定位的其他领域	

（二）发行人符合科创属性相关指标要求

公司符合《科创属性评价指引（试行）》和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》相关科创属性指标要求，具体情况如下：

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上，或最近三年研发投入金额累计在 8000 万元以上	☒ 是 ☐ 否	2023 年至 2025 年，公司累计研发投入 23,163.54 万元，占最近三年累计营业收入比例为 6.02%，超过 8,000 万元，并超过 5%
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	☒ 是 ☐ 否	2025 年 12 月 31 日，公司研发人员 136 人，占当期末员工总数比例为 14.51%，超过 10%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	☒ 是 ☐ 否	截至本招股说明书签署日，应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 56 项，超过 7 项
最近三年营业收入复合增长率达到 25%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元	☒ 是 ☐ 否	2025 年度营业收入 179,107.43 万元，大于 3 亿元

六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

根据经毕马威审计的财务报表（审计报告号为毕马威华振审字第 2621643 号），公司报告期内的主要财务数据及财务指标如下：

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
资产总额（万元）	600,206.80	577,871.33	561,314.64

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
归属于母公司所有者权益（万元）	299,715.40	269,070.68	260,271.93
资产负债率（母公司）	25.33%	26.80%	27.56%
营业收入（万元）	179,107.43	110,964.15	94,626.92
主营业务收入（万元）	174,138.73	106,701.69	86,498.92
主营业务毛利（万元）	43,663.08	24,650.23	14,563.92
净利润（万元）	13,973.03	6,228.10	3,633.08
归属于母公司所有者的净利润（万元）	18,584.92	6,862.32	4,554.03
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	14,657.00	6,400.78	3,239.80
基本每股收益（元）	0.13	0.05	0.03
稀释每股收益（元）	0.13	0.05	0.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.27	2.43	1.91
经营活动产生的现金流量净额（万元）	24,393.16	15,304.28	5,748.98
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	5.98%	6.46%	5.59%

七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息

公司财务报告审计截止日为 2025 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营情况良好，经营环境未发生重大不利变化，经营模式、采购、生产、销售未发生重大变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

公司未作盈利预测。

八、发行人选择的具体上市标准

基于公司 2025 年实现营业收入超过 3 亿元，并结合报告期内的股权融资情况、可比 A 股上市公司二级市场估值情况，公司选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2 条款的第四项上市标准，即“预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。

十、募集资金运用与未来发展规划

本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	10,000 吨/年高纯电子级多晶硅产业集群项目	282,832.22	18,000.00
2	1,500 吨/年超高纯多晶硅项目	40,025.46	24,000.00
3	1,500 吨/年区熔用多晶硅项目	50,870.33	50,000.00
4	高纯硅材料研发基地项目	20,388.05	20,000.00
5	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		414,116.06	132,000.00

注：1,500 吨/年超高纯多晶硅项目为直拉用超高纯多晶硅，下同。

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行上市实际募集资金（扣除发行费用后）低于募集资金项目投资额，不足部分公司将通过自筹资金解决；若本次募集资金（扣除发行费用后）超过募集资金项目投资额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。

募集资金项目的具体内容，详见本招股说明书之“第十二节、七、募集资金具体运用情况”。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在其他有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。以下风险因素的披露根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序不表示风险因素会依次发生。

一、与发行人相关的风险

（一）无实际控制人风险

具体请参见本招股说明书之“第二节、一、（一）、4、无实际控制人风险”相关内容。

（二）经营风险

1、公司在国内乃至国际市场与国际厂商竞争面临的不确定性风险

具体请参见本招股说明书之“第二节、一、（一）、1、公司在国内乃至国际市场与国际厂商竞争面临的不确定性风险”相关内容。

2、原材料价格波动风险

公司生产用主要原材料包括三氯氢硅、硅粉等。报告期各期，公司主营业务成本中原材料占比分别为 24.14%、22.21%和 **18.99%**。2023 年开始，生产成本中原材料占比有所下降，主要系公司自建三氯氢硅生产线于 2022 年底建设完成并投用，冷氢化生产环节由委托加工变更为自主生产，导致成本核算口径变化，且主要原材料硅粉价格有所下降。主要原材料价格的变化直接影响公司的利润水平，如果未来原材料价格大幅度上涨，且公司主要产品销售价格不能同步上调，将对公司的盈利能力产生不利影响。

3、供应商集中度较高的风险

报告期内，发行人向合并口径前五名供应商采购的金额占当期采购总金额比例分别为 79.56%、78.59%和 **76.40%**，供应商集中度较高。原材料及时、稳定供应是保证公司稳定生产的必要条件。由于外部环境变动、市场波动或不可抗力等因素，原材料供应可能会出现限制供应、延迟交货或提高价格的情况。如果出现不能及时获得足够的原材料供应或者需高于正常价格获取原材料的情况，公司的

正常生产经营可能会受到不利影响。

4、产品单一的风险

发行人现阶段主要从事电子级多晶硅的研发、生产和销售，聚焦于电子级多晶硅产品，产品类型单一。发行人未来目标是依靠“硅+高纯”的技术特征，形成互补多元化产品体系，如果未来发行人未能拓展其他硅基产品的生产和销售，可能导致未来成长空间受限，如果现有电子级多晶硅产品的优势地位被其他材料所替代，则可能对发行人的生产经营产生不利影响。

5、产品质量风险

公司下游客户半导体硅片制造企业对多晶硅材料有极高的质量、性能和稳定性的要求，对供应商有着严格的资格认证，只有研发能力、质量控制等方面均表现良好的优质企业才能进入其合格供应商名录。若未来公司产品纯度或质量不稳定，可能会影响客户的产品品质，严重质量问题可能导致客户取消后续订单或终止未来持续合作，影响公司市场形象，从而对公司整体盈利能力产生不利影响。

6、客户集中风险

报告期内发行人向合并口径前五大客户销售比例合计分别为 66.18%、66.58% 和 71.49%，客户集中度相对较高，与下游行业集中度较高特征相符。如果未来公司主要客户的采购、经营战略发生较大变化，或主要客户资信情况发生重大不利变化，或因公司产品质量问题与客户发生纠纷，或因技术原因等因素无法满足客户的需求，则公司经营业绩将面临下降或增速放缓的风险。

（三）技术风险

1、技术迭代风险

半导体硅材料是半导体产业的关键材料。公司是国内主要的半导体产业用电子级多晶硅生产企业，采用的电子级多晶硅生产工艺为较为先进的改良西门子法。改良西门子法是目前行业通用的技术路线。除改良西门子法外，行业内部分企业也在使用其他的生产方法与技术，如硅烷流化床法等。随着行业竞争的加剧、其他技术路线的发展，不排除未来硅烷流化床法或新出现的其他技术路线替代改良西门子法工艺。如果公司目前所采用的生产技术因为技术迭代而被淘汰或者产品

竞争力减弱，将会对公司的经营造成不利的影响。

2、核心技术泄密风险

公司所处的半导体硅材料行业具有技术密集型的特点，核心技术对公司提高产品质量和关键指标以及保持公司在行业内的竞争优势有着至关重要的作用，是公司核心竞争力的具体体现。公司存在因核心技术人员流失或工作失误，导致核心技术泄露的风险，若潜在竞争企业获悉公司核心技术，将对公司的生产经营和发展产生不利影响。

3、核心技术人员流失风险

发行人的核心技术人员是发行人持续保持技术优势、市场竞争力和提升发展潜力的保障。半导体硅材料行业对技术人才需求较高，企业与地区之间高端人才竞争较为激烈。如果发行人不能为核心技术人员提供优秀的研发条件、具有前景的发展平台及有竞争力的薪酬，可能面临核心技术人员流失的风险，进而对发行人的持续经营能力产生不利影响。

（四）财务风险

1、经营业绩波动的风险

（1）经营业绩受半导体行业波动影响的风险

具体请参见本招股说明书之“第二节、一、（一）、2、（1）经营业绩受半导体行业波动影响的风险”相关内容。

（2）经营业绩受副产品市场价格波动影响的风险

具体请参见本招股说明书之“第二节、一、（一）、2、（2）经营业绩受副产品市场价格波动影响的风险”相关内容。

（3）募集资金投资项目投产后，新增折旧和摊销影响经营业绩的风险

具体请参见本招股说明书之“第二节、一、（一）、2、（3）募集资金投资项目投产后，新增折旧和摊销影响经营业绩的风险”相关内容。

2、毛利率波动的风险

具体请参见本招股说明书之“第二节、一、（一）、3、毛利率波动的风险”

相关内容。

3、经营活动现金流量净额波动的风险

报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为 5,748.98 万元、15,304.28 万元和 **24,393.16** 万元，存在一定波动。2023 年经营活动现金流量净额**相对较低**，主要系公司 2023 年销售规模下降导致现金流入减少、备货增加、收到的税费返还减少等因素综合所致。如果未来公司销售规模不能持续增长或客户支付方式变化，公司经营活动现金流量净额存在波动的风险。

4、存货减值风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 18,200.63 万元、26,066.05 万元和 **40,352.64** 万元，占流动资产的比重分别为 9.32%、13.94%和 **17.88%**，主要包括原材料、在产品、产成品以及低值易耗品等；公司计提的存货跌价准备余额分别为 521.95 万元、5,315.38 万元和 **11,049.58** 万元，存货跌价准备占存货余额比例分别为 2.79%、16.94%和 **21.50%**，主要系公司内蒙产线投产初期副产品产出率较高等因素所致。受太阳能级多晶硅市场行情低迷影响，2024 年末以来公司副产品存货跌价准备计提金额大幅上升，如果未来因工艺波动导致副产品产出率上升、副产品太阳能级多晶硅市场价格持续处于低位或继续下跌，或出现市场竞争加剧、产品和技术更新迭代、公司存货管理水平下降，引致公司存货出现积压、毁损、减值等情况，将增加公司计提存货跌价准备的风险，可能对公司经营业绩产生不利影响。

5、关联资金拆借风险

报告期内，发行人存在关联资金拆借的情形。虽然发行人已对上述问题进行了整改，拆借资金及利息已结清，并且发行人已建立了防止关联资金拆借的相关内部控制制度。但如果未来发行人不能严格执行相关内部控制制度，则仍存在因关联资金拆借而损害发行人及中小股东利益的风险。

6、固定资产减值风险

公司所处行业属于资金密集型的重资产行业。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 116,282.09 万元、342,359.64 万元和 **319,580.54** 万元，占总资产的比例分别为 20.72%、59.24%和 **53.25%**，固定资产规模和占比均较大。未来

如果出现固定资产运营效率降低、行业技术路线发生根本变化、下游市场需求大幅变动等情形，将可能存在公司现有生产线可变现净值出现较大幅度降低，导致公司固定资产大额计提减值准备的风险。

7、税收优惠政策变化的风险

公司于 2025 年 12 月 19 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202532016017 的高新技术企业证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，报告期内公司作为高新技术企业可享受 15% 的所得税优惠税率。若国家所得税相关政策发生重大变化或公司的高新技术企业资格在有效期满后未能顺利通过重新认定，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

（五）关联交易风险

1、关联采购金额较大的风险

具体请参见本招股说明书之“第二节、一、（一）、5、关联采购金额较大的风险”相关内容。

2、关联销售风险

报告期内，公司关联销售金额分别为 13,307.71 万元、19,810.43 万元和 26,060.49 万元，与比照关联销售披露的交易金额合计分别为 34,477.83 万元、44,144.52 万元和 67,114.38 万元，占当期营业收入的比例合计分别为 36.44%、39.78%和 37.47%，主要是向沪硅产业、TCL 中环及其下属公司销售电子级多晶硅。在全球电子级多晶硅产业和下游半导体硅片产业中，目前均已形成寡头垄断竞争格局，上下游行业巨头出于保障供应稳定性、提升合作效率等考虑，会通过参股甚至控股关系形成紧密的合作关系，例如德国世创（Siltronic AG, WAF.DF）与德国瓦克、信越化学（Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., 4063.T）与美国 Hemlock、SUMCO（SUMCO Corporation, 3436.T）收购日本三菱旗下电子级多晶硅子公司等。发行人是国内电子级多晶硅的主要供应方，下游国产半导体硅片厂商通过向发行人或其子公司参股以加深合作，符合国际惯例，但同时形成了一定规模关联销售或比照关联销售披露的交易。报告期内公司关联销售及比照关联销售披露的交易金额占营业收入的比例较高，如果未来公司未能严格履行关联交易决策、审

批程序，则可能存在通过关联交易损害公司或其他股东利益的风险。

（六）环境保护及生产安全风险

公司在生产过程中会产生一定的废水、废气、固体废物和噪声。自成立以来，公司一直重视环境保护工作，注重工艺的改进，减少生产中污染物的排放。截至本招股说明书签署日，公司环保设施运行正常，各项污染物均能实现达标排放和治理，不存在因环保问题被相关监管部门限制生产的情形，未因违反环境保护有关法律法规受到相关环保部门的行政处罚。随着社会对环境保护的意识不断增强、国家和地方政府对环境保护的要求日益严格，政府在将来可能会出台新的法律法规，进一步加强环保监管。公司在未来可能需要进一步加大环保投入，导致经营成本提高，对公司业绩产生一定的影响。

此外，报告期内公司未发生重大安全事故，但不排除未来因设备老化、物品保管及操作不当、自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。

二、与行业相关的风险

（一）行业景气程度下降风险

公司主要从事半导体产业用电子级多晶硅材料的生产与销售，公司的经营状况与下游行业的发展密切相关，如果未来半导体行业景气程度受到行业政策变化、国际局势变化、下游行业需求减少等因素影响，进而导致产能过剩、产品销售受阻等情况，可能会对公司经营业绩造成不利影响。

（二）国际贸易摩擦风险

近年来国际贸易环境不确定性增加，尤其是在半导体等高科技领域，各国对自身产业发展的保护加剧，给公司上下游业务合作以及国际化布局带来一定风险。如果相关国家与中国的贸易摩擦持续升级，公司可能面临无法与受限的上下游合作伙伴继续合作等风险，从而对公司经营发展产生一定的不利影响。

三、其他风险

（一）募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目导致关联交易增加的风险

本次募集资金投资项目“10,000 吨/年高纯电子级多晶硅产业集群项目”及“1,500 吨/年超高纯多晶硅项目”由发行人子公司内蒙古鑫华实施，内蒙古鑫华由发行人持股 60%，天津硅石持股 40%。天津硅石是 TCL 科技的全资子公司，报告期内，TCL 科技控制的 TCL 中环是发行人重要客户。本次募集资金投资项目“10,000 吨/年高纯电子级多晶硅产业集群项目”及“1,500 吨/年超高纯多晶硅项目”投产后，TCL 科技如果向内蒙古鑫华采购产品，则存在募集资金投资项目导致关联交易增加的风险。

2、公司未来规模扩张引发的管理风险

本次发行完成后，随着募投项目的实施，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，员工人数将相应增加，需要公司在资源整合、市场开拓、技术研发与质量管理、内部控制等诸多方面进行调整优化，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。公司经营决策、组织管理、风险控制的难度也随之加大。如果公司未来管理能力不能及时有效提高，将可能引发相应的管理风险。

3、资产折旧、摊销增加的风险

本次募集资金投资项目计划新增投资金额较大，上述项目建设完成后公司固定资产折旧额、无形资产摊销额将增加。若募投项目建成后产品销售不顺畅，或由于其他原因导致项目收益不及预期，则公司存在因折旧、摊销费用增加而导致经营业绩下滑的风险。

（二）发行失败风险

本次发行结果将受到证券市场整体情况、投资者对公司价值的判断、投资者对本次发行方案的认可程度等多种因素的影响。公司股票发行价格确定后，如果公司预计发行后总市值不满足其在招股说明书中明确选择的上市标准，或网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，应当根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的相关规定中止发行。中止发行后，在中国证监

会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，公司需经向上海证券交易所备案，才可重新启动发行。如果公司未在中国证监会同意注册决定的有效期内完成发行，公司将面临股票发行失败的风险。

（三）对赌相关风险

根据 2022 年 1 月签署的《江苏鑫华半导体材料科技有限公司股东协议之补充协议》、2025 年 9 月签署的《合资经营合同之补充协议 V》《关于江苏鑫华半导体科技股份有限公司之股东协议 III》等，由发行人承担回购义务的约定已于 2022 年 1 月彻底终止且自始无效；涉及中能硅业的回购义务及其他股东特殊权利自公司向有关证券监督管理机构递交首次公开发行股票申请文件时终止，但申请未获受理、主动撤回、被终止审查、被否决/驳回、未获得审核通过或因其他原因导致公司未能在获准注册上市批文有效期内完成合格上市的，在中国法律法规允许的范围内，上述特殊权利条款应自动、自始恢复效力。

上述对赌安排不存在导致公司控制权变化的约定，也不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，但仍可能对公司股权结构产生影响。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

注册中文名称	江苏鑫华半导体科技股份有限公司
注册英文名称	Jiangsu Xinhua Semiconductor Technology Co., Ltd.
注册资本	148,571.4288 万元
法定代表人	田新
有限公司成立日期	2015 年 12 月 11 日
股份公司成立日期	2022 年 3 月 30 日
住所	徐州经济技术开发区杨山路 66 号
邮政编码	221000
电话号码、传真号码	0516-83958888
互联网网址	www.sinvar.com
电子信箱	ir@sinvar.com
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
负责信息披露和投资者关系的负责人	方世琼
负责信息披露和投资者关系的负责人电话号码	0516-87536666

二、发行人设立情况、报告期内的股本和股东变化情况、成立以来重要事件及在其他证券市场的上市/挂牌情况

（一）发行人设立情况

1、有限公司设立

2015 年 12 月 10 日，中能硅业与集成电路基金签署了《关于设立江苏鑫华半导体材料科技有限公司之合资经营合同》，约定双方共同出资设立鑫华有限，注册资本 102,000.0098 万元。其中，中能硅业以实物方式出资 52,000.0098 万元，占注册资本 50.98%；集成电路基金以货币出资 50,000.00 万元，占注册资本 49.02%。

2015 年 12 月 11 日，鑫华有限领取了徐州工商行政管理局经济技术开发区分局核发的《营业执照》。

鑫华有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	中能硅业	52,000.0098	50.98%
2	集成电路基金	50,000.0000	49.02%
合计		102,000.0098	100.00%

以上注册资本出资情况的验资情况如下：

2015 年 12 月 25 日，徐州正大会计师事务所有限公司出具《验资报告》（徐正会所验字〔2015〕第 029 号），对集成电路基金以货币方式出资情况进行了审验。

2016 年 4 月 25 日，徐州正大会计师事务所有限公司出具《验资报告》（徐正会所验字〔2016〕第 11 号），对中能硅业以实物方式出资情况进行了审验。

2022 年 9 月 9 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具《实收情况验资复核报告》（毕马威华振验字第 2201107 号），对鑫华有限设立时上述验资报告所述的出资事项进行了复核。

2、股份公司设立

2022 年 3 月 4 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（毕马威华振审字第 2201854 号），截至 2022 年 1 月 31 日，鑫华有限经审计的净资产为 137,339.41 万元。

2022 年 3 月 10 日，上海东洲资产评估有限公司出具《资产评估报告》（东洲评报字〔2022〕第 0389 号），确认截至 2022 年 1 月 31 日，鑫华有限净资产评估值为 189,006.01 万元。

2022 年 3 月 23 日，鑫华有限召开了 2022 年第四次股东会，审议通过《关于江苏鑫华半导体材料科技有限公司整体变更设立股份有限公司及其相关事宜的议案》，同意鑫华有限以截至 2022 年 1 月 31 日经审计的净资产 137,339.41 万元按照 1.056457:1 的比例折成 130,000.00 万股，整体变更设立股份有限公司。净资产值超过股份公司注册资本的部分共计 7,339.41 万元，计入股份公司资本公积。同日，鑫华有限的全体股东，作为拟整体变更设立的股份有限公司的发起人，共同签署了《发起人协议》。

2022年3月24日，发行人召开创立大会暨2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于江苏鑫华半导体科技股份有限公司筹办情况的报告及公司创立的议案》等与鑫华半导体设立相关的议案。

2022年4月2日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（毕马威华振验字第2200706号），对上述出资情况进行了审验。

2022年3月30日，公司取得了徐州市行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为91320301MA1MCPLL8F）。

股份公司设立时，公司各发起人持股情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中能硅业	36,467.4294	28.05%
2	集成电路基金	30,629.3439	23.56%
3	国投创业基金	8,387.0971	6.45%
4	厦门鼎峰	8,387.0971	6.45%
5	科创新兴	7,045.1616	5.42%
6	嘉兴金硅	4,193.5486	3.23%
7	北京瑞智	4,193.5486	3.23%
8	嘉兴嘉亭	3,564.5160	2.74%
9	中州旭诺	2,935.4840	2.26%
10	嘉兴嘉榭	2,096.7743	1.61%
11	金浦瑞思	1,887.0969	1.45%
12	鑫之同	1,780.5734	1.36%
13	鑫之志	1,732.6841	1.33%
14	创东方	1,677.4194	1.29%
15	允泰七号	1,467.7420	1.13%
16	沪硅产业	1,341.9355	1.03%
17	鑫之道	1,309.9979	1.00%
18	鑫之源	1,258.1902	0.96%
19	允泰六号	1,258.0645	0.97%
20	芯行壹	1,258.0645	0.97%
21	苏州三行	1,258.0645	0.97%
22	中欣晶圆	838.7097	0.65%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
23	宁波瑞芯泓	838.7097	0.65%
24	长兴清风	838.7097	0.65%
25	同创致创	838.7097	0.65%
26	石溪产恒	838.7097	0.65%
27	浦东新兴	838.7097	0.65%
28	允泰芯材	629.0323	0.48%
29	鑫之合	208.8760	0.16%
合计		130,000.0000	100.00%

3、发行人整体变更设立股份有限公司时存在累计未弥补亏损的情况

截至股改基准日 2022 年 1 月 31 日，鑫华有限未分配利润为-74,931.74 万元，公司整体变更设立股份有限公司时存在累计未弥补亏损。

（1）整体变更设立股份公司时存在累计未弥补亏损的原因

公司前期亏损主要与公司所处发展阶段相关，公司早期尚处于产能爬坡和市场开拓阶段，营业收入不能覆盖同期发生的研发、生产、人力等较大的成本费用支出。

（2）整体变更后的变化情况和的发展趋势

整体变更设立股份有限公司后，在报告期前期产品陆续通过认证基础上，公司收入和利润呈现快速上升趋势，盈利能力不断增强。报告期各期末，公司合并报表未分配利润分别为 17,230.35 万元、23,276.33 万元和 **39,326.70** 万元，母公司报表未分配利润分别为 19,509.55 万元、26,856.65 万元和 **49,667.55** 万元。公司改制为股份公司基准日为 2022 年 1 月 31 日，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为 **39,326.70** 万元，未分配利润为负的情形已消除。

（3）与报告期内盈利水平变动的匹配关系

公司累计未弥补亏损与报告期内盈利水平变动相匹配，具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
上期期末未分配利润/（未弥补亏损）	23,276.33	17,230.35	13,272.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,584.92	6,862.32	4,554.03

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
股东同比例减资	-	-	-
整体变更股份有限公司折股影响	-	-	-
提取法定盈余公积	-2,534.54	-816.34	-596.44
期末未分配利润	39,326.70	23,276.33	17,230.35

（4）对未来盈利能力的影响分析

报告期内，公司快速发展，整体经营情况明显改善，公司整体变更为股份有限公司时累计未弥补亏损对公司业务拓展、团队稳定性、研发投入、生产经营可持续性和未来盈利能力不构成重大不利影响，不属于重大风险。

（二）发行人报告期内的股本和股东变化情况

发行人报告期初至今的股本和股东变化情况如下：

序号	时间	变更类型	变化情况
1	2022年1月	增资	引入2家A+轮融资投资方，注册资本由147,900.0170万元增加至158,100.0186万元
2	2022年3月	减资	注册资本由158,100.0186万元减少至130,000.0000万元
3	2022年3月	整体变更	鑫华有限改制为股份公司
4	2023年3月	增资	引入14家新增B轮融资投资方，2家A轮投资方跟投，注册资本由130,000.0000万元增加至148,571.4288万元
5	2023年6月	股权转让	天津泓生将其所持0.62%的股权转让给共青城泓生
6	2025年9月	股权转让	中能硅业将其所持24.55%的股权转让给合肥国材叁号

1、报告期期初发行人的股权结构

2022 年 1 月 1 日，鑫华有限股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	股权比例
1	中能硅业	44,350.0098	29.99%
2	集成电路基金	37,249.9988	25.19%
3	国投创业基金	10,200.0016	6.90%
4	厦门鼎峰	10,200.0016	6.90%
5	嘉兴金硅	5,100.0008	3.45%
6	北京瑞智	5,100.0008	3.45%
7	嘉兴嘉亭	4,335.0004	2.93%
8	中州旭诺	3,570.0006	2.41%

序号	股东名称	出资额	股权比例
9	嘉兴嘉榭	2,550.0004	1.72%
10	金浦瑞思	2,295.0004	1.55%
11	鑫之同	2,165.4516	1.46%
12	鑫之志	2,107.2107	1.42%
13	创东方	2,040.0003	1.38%
14	允泰七号	1,785.0003	1.21%
15	鑫之道	1,593.1593	1.08%
16	鑫之源	1,530.1530	1.03%
17	允泰六号	1,530.0002	1.03%
18	芯行壹	1,530.0002	1.03%
19	苏州三行	1,530.0001	1.03%
20	中欣晶圆	1,020.0001	0.69%
21	宁波瑞芯泓	1,020.0001	0.69%
22	长兴清风	1,020.0001	0.69%
23	同创致创	1,020.0001	0.69%
24	石溪产恒	1,020.0001	0.69%
25	浦东新兴	1,020.0001	0.69%
26	允泰芯材	765.0001	0.52%
27	鑫之合	254.0254	0.17%
合计		147,900.0170	100.00%

2、2022 年 1 月，注册资本增加至 158,100.0186 万元

2022 年 1 月 27 日，鑫华有限召开股东会，全体股东一致同意，鑫华有限注册资本由 147,900.0170 万元增加至 158,100.0186 万元，科创新兴出资 16,800.00 万元认购鑫华有限 8,568.0014 万元的新增注册资本，沪硅产业出资 3,200.00 万元认购鑫华有限 1,632.0002 万元的新增注册资本。

3、2022 年 3 月，减资至 130,000.0000 万元

2022 年 1 月 29 日，鑫华有限召开股东会，全体股东一致同意鑫华有限的注册资本由 158,100.0186 万元变更为 130,000.0000 万元，减少的 28,100.0186 万元由本次股东会召开时股东名册登记在册的全体股东，按照 1.2162:1 的比例进行同比例减资。本次减资前后鑫华有限的净资产不发生变化。

4、2022 年 3 月，股份公司设立

2022 年 3 月 30 日，鑫华有限改制为股份公司，股本变更为 130,000.0000 万元，股东持股比例不变。鑫华有限整体变更为股份公司的具体情况详见本招股说明书之“第四节、二、（一）、2、股份公司设立”。

5、2023 年 3 月，注册资本增加至 148,571.4288 万元

2023 年 3 月 29 日，股份公司召开 2023 年第三次临时股东大会，全体股东一致同意，股份公司注册资本由 130,000.0000 万元增加至 148,571.4288 万元，具体情况如下：

序号	股东名称	认购股数（万股）	出资额（万元）
1	济南华岳	3,714.2857	20,000.00
2	徐州臻芯	3,714.2857	20,000.00
3	北京海震	1,857.1429	10,000.00
4	蓉兴创芯	1,857.1429	10,000.00
5	中建材新材料基金	1,485.7143	8,000.00
6	华舆转型	1,448.5714	7,800.00
7	苏州毅辉	928.5714	5,000.00
8	天津泓生	928.5714	5,000.00
9	常州瑞良	557.1429	3,000.00
10	三亚御海	557.1429	3,000.00
11	南通元禾	371.4286	2,000.00
12	中金启兆	371.4286	2,000.00
13	泰州建兴	371.4286	2,000.00
14	允泰芯材	250.7143	1,350.00
15	浦东新兴	120.7143	650.00
16	青岛融源	37.1429	200.00

6、2023 年 6 月，股权转让

2023 年 6 月 26 日，天津泓生与共青城泓生签署了《股权转让协议》，天津泓生将其持有的发行人 0.62% 的股份，对应注册资本 928.5714 万元，以 5,000.00 万元的价格转让给其关联方共青城泓生。天津泓生与共青城泓生的执行事务合伙人均为泓生投资管理有限公司。

7、2025 年 9 月，股权转让

2025 年 9 月 11 日，中能硅业与合肥国材叁号签署了《有关江苏鑫华半导体科技股份有限公司之股份转让协议》，中能硅业将其持有的发行人 24.55%的股份，对应注册资本 36,467.4294 万元，以 147,200.00 万元的价格转让给合肥国材叁号。

本次股权转让后至本招股说明书签署日，发行人未再发生其他股本变动情况。

（三）成立以来重要事件

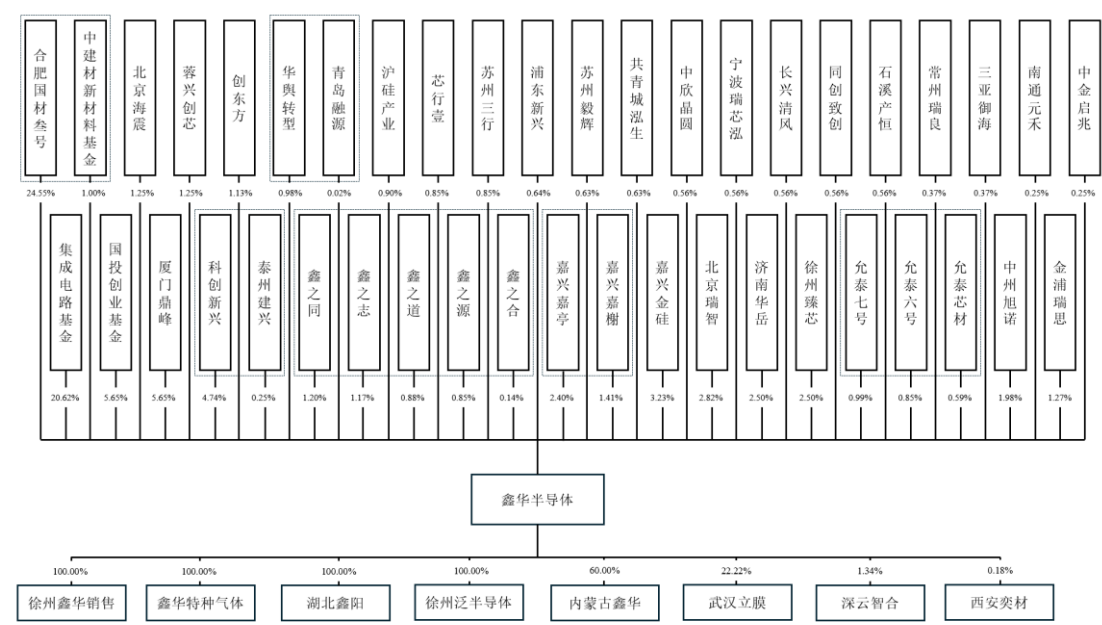
发行人报告期内不存在重大资产重组。公司成立以来重要事件详见本招股说明书之“第四节、二、（一）发行人设立情况”及“第四节、二、（二）发行人报告期内的股本和股东变化情况”。

（四）发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

截至本招股说明书签署日，公司未在其他证券市场上市/挂牌。

三、发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：



四、发行人的控股子公司、参股公司及分公司的基本情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有 5 家控股子公司、3 家参股公司，无分

公司。公司报告期内曾拥有 1 家控股子公司，其中扬州鑫华已于 2024 年 12 月注销。

（一）子公司

1、内蒙古鑫华

名称	内蒙古鑫华半导体科技有限公司	
成立日期	2022 年 4 月 29 日	
注册资本	180,000 万元	
实收资本	180,000 万元	
注册地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 9 号	
主要生产经营地	内蒙古自治区	
股东构成	发行人持股 60%，天津硅石持股 40%	
主营业务及在发行人业务板块中定位	发行人主营业务的重要组成部分，目前具备 10,000 吨/年高纯电子级多晶硅产能	
最近一年主要财务数据（注）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（万元）
	总资产	308,577.57
	净资产	165,104.54
	营业收入	60,057.76
	净利润	-10,809.03

注：上述财务数据已按照企业会计准则编制并包含在公司的合并财务报表中，该合并财务报表已经毕马威审计，下同。

2、湖北鑫阳

名称	湖北鑫阳半导体科技有限公司	
成立日期	2023 年 6 月 13 日	
注册资本	1700 万元	
实收资本	1700 万元	
注册地址	湖北省十堰市郧阳区茶店镇大运路 8 号	
主要生产经营地	湖北省十堰市	
股东构成	发行人持股 100%	
主营业务及在发行人业务板块中定位	发行人高纯石英砂等项目的孵化和研发中心	
最近一年主要财务数据	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（万元）
	总资产	5,214.75
	净资产	-540.06

	营业收入	296.49
	净利润	-773.82

3、徐州泛半导体

名称	徐州金龙湖泛半导体材料研究有限公司	
成立日期	2023 年 10 月 23 日	
注册资本	1,000 万元	
实收资本	1,000 万元	
注册地址	江苏省徐州经济技术开发区凤凰湾集成电路产业园 5 号楼	
主要生产经营地	江苏省徐州市	
股东构成	发行人持股 100%	
主营业务及在发行人业务板块中定位	拟围绕泛半导体产业进行技术研发、项目孵化、成果转化，并建设相应的检测中心，为发行人未来发展提供技术储备	
最近一年主要财务数据	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（万元）
	总资产	1,567.90
	净资产	683.12
	营业收入	488.66
	净利润	-284.47

4、徐州鑫华销售

名称	徐州鑫华销售管理有限公司	
成立日期	2025 年 1 月 14 日	
注册资本	600 万元	
实收资本	600 万元	
注册地址	江苏省徐州经济技术开发区大黄山街道杨山路 66 号 101 号二层 201 室	
主要生产经营地	江苏省徐州市	
股东构成	发行人持股 100%	
主营业务及在发行人业务板块中定位	发行人为实现销售统一集中管理的平台	
最近一年主要财务数据	项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（万元）
	总资产	7,221.55
	净资产	490.61
	营业收入	742.27
	净利润	-134.36

5、鑫华特种气体

名称	徐州鑫华特种气体有限公司	
成立日期	2025 年 7 月 30 日	
注册资本	3,000 万元	
实收资本	500 万元	
注册地址	江苏省徐州经济技术开发区杨山路 66 号 101 号 2 层 211 室	
主要生产经营地	江苏省徐州市	
股东构成	发行人持股 100%	
主营业务及在发行人业务板块中定位	发行人特种气体等项目的孵化和研发中心	
最近一年主要财务数据	项目	2025 年 12 月 31 日 / 2025 年度（万元）
	总资产	496.25
	净资产	496.12
	营业收入	-
	净利润	-3.88

（二）参股公司

序号	名称	注册资本	股权结构	发行人出资金额/持股数	首次入股时间	控股股东	主营业务情况
1	深云智合	401.0271 万元	刘宇宙持股 35.00%，海南松云科技中心（有限合伙）持股 15.76%，北京攸宁新材料有限公司持股 15.20%，宿迁兴寰创业投资合伙企业（有限合伙）持股 11.56%，嘉兴阳通股权投资合伙企业（有限合伙）持股 7.41%，上海铜程新材料科技中心（有限合伙）持股 5.34%，发行人持股 1.34%，其他股东合计持股 8.39%	5.376 万元	2022 年 7 月	刘宇宙	化学反应计算及技术开发
2	武汉立膜	128.5714 万元	黎明持股 77.78%，发行人持股 22.22%	28.5714 万元	2023 年 12 月	黎明	推动阴离子交换膜相关技术的产业化
3	西安奕材	403,780.00 万元	已上市（688783.SH）	7,260,383 股	2024 年 6 月	北京奕斯伟科技集团有限公司	硅片的研发、生产和销售

（三）报告期初至今转让或注销的子公司及参股公司

序号	名称	认缴出资额	出资比例	首次入股时间	转让/注销时间	控股股东	主营业务情况
1	扬州鑫华	46,000.00 万元	100.00%	2024 年 1 月	2024 年 12 月注销	发行人	原拟作为发行人新型硅基半导体材料项目的实施主体，后因计划改变而注销

五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）公司无控股股东及实际控制人

最近两年内，公司无控股股东且无实际控制人。

1、公司不存在控股股东

截至本招股说明书签署日，公司第一大股东合肥国材叁号及其一致行动人中建材新材料基金持股比例合计为 25.55%，第二大股东集成电路基金持股比例为 20.62%，公司不存在持股比例超过 30%的股东，且单个股东依其持有的股份所享有的表决权均不足以对股东会的决议产生决定性影响。因此，公司不存在控股股东。

2、公司不存在实际控制人

截至本招股说明书签署日，公司的单一股东依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东会或股东大会的决议产生决定性影响，单一股东在董事会中提名的董事不足以对董事会的决议产生决定性影响，无法单独控制公司的董事会，也无法单方面决定公司及其下属公司的经营决策。因此，公司不存在实际控制人。

（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，公司无控股股东和实际控制人，不存在公司控股股东、实际控制人控制其他企业的情况。

（三）其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，持有发行人 5%以上（含）股份或表决权的股东包括合肥国材叁号及其一致行动人中建材新材料基金、集成电路基金、国投创业基金和厦门鼎峰。

1、合肥国材叁号及其一致行动人中建材新材料基金

（1）合肥国材叁号

合肥国材叁号持有公司 24.55%的股份，为发行人第一大股东。

截至本招股说明书签署日，合肥国材叁号的出资人构成及出资比例如下：

单位：万元

序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例
1	中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	41,000.00	27.78%
2	中建材联合投资有限公司	40,000.00	27.10%
3	杭州毅鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	30,800.00	20.87%
4	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	24,300.00	16.46%
5	诚通科创投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）	6,500.00	4.40%
6	宁波上融物流有限公司	5,000.00	3.39%
7	合肥国材贰号企业管理咨询有限责任公司	10.00	0.01%
合计		147,610.00	100.00%

合肥国材叁号不属于私募基金，无需履行私募基金备案程序。合肥国材叁号无实际控制人。

（2）中建材新材料基金

中建材新材料基金持有公司 1.00% 的股份。

截至本招股说明书签署日，中建材新材料基金的出资人构成及出资比例如下：

单位：万元

序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例
1	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	295,000.00	19.67%
2	中国国新控股有限责任公司	250,000.00	16.67%
3	中国建材股份有限公司	210,000.00	14.00%
4	安徽海螺水泥股份有限公司	160,000.00	10.67%
5	国家制造业转型升级基金股份有限公司	150,000.00	10.00%
6	中建材联合投资有限公司	150,000.00	10.00%
7	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	100,000.00	6.67%
8	安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司	76,000.00	5.07%
9	芜湖产业投资基金有限公司	40,000.00	2.67%
10	蚌埠市产业引导基金有限公司	24,000.00	1.60%
11	浙江上峰建材有限公司	20,000.00	1.33%
12	深圳市创新投资集团有限公司	10,000.00	0.67%
13	中信证券投资有限公司	10,000.00	0.67%
14	中建材（安徽）新材料基金管理有限公司	2,000.00	0.13%

序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例
15	合肥纬聿股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500.00	0.10%
16	中建材私募基金管理（北京）有限公司	1,500.00	0.10%
合计		1,500,000.00	100.00%

中建材新材料基金系私募股权投资基金，已于 2021 年 10 月 11 日完成私募基金备案登记，基金备案编号为 SSG288。中建材新材料基金无实际控制人。

2、集成电路基金

集成电路基金持有公司 20.62% 的股份，基本情况如下：

公司名称	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	
成立时间	2014 年 9 月 26 日	
注册资本	8,072,000 万元	
实收资本	8,072,000 万元	
企业住所	北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 718 室	
主要生产经营地	北京市	
主营业务及与发行人主营业务的关系	为促进国家集成电路产业发展而设立，主营业务为运用多种形式投资集成电路产业链上下游的企业，包括了集成电路制造、芯片设计、封装测试、设备和材料等产业，其主营业务与发行人主营业务无直接竞争关系	
最近一年主要财务数据（未审计）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（万元）
	总资产	21,391,436.87
	净资产	19,157,604.62
	营业收入	18,552.18
	净利润	11,24,230.17

截至本招股说明书签署日，集成电路基金股东构成及出资比例如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中华人民共和国财政部	2,943,598.06	36.47%
2	国开金融有限责任公司	1,798,865.48	22.29%
3	中国烟草总公司	899,432.74	11.14%
4	北京亦庄国际投资发展有限公司	817,666.13	10.13%
5	上海国盛（集团）有限公司	408,833.06	5.06%
6	武汉金融控股（集团）有限公司	408,833.06	5.06%
7	中国移动通信集团有限公司	408,833.06	5.06%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
8	中国联合网络通信集团有限公司	114,473.26	1.42%
9	中国电信集团有限公司	114,473.26	1.42%
10	武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司	40,883.31	0.51%
11	中电科投资控股有限公司	40,883.31	0.51%
12	中国电子信息产业集团有限公司	40,883.31	0.51%
13	华芯投资管理有限责任公司	9,811.99	0.12%
14	福建三安集团有限公司	8176.66	0.10%
15	北京紫光通信科技集团有限公司	8176.66	0.10%
16	上海武岳峰浦江股权投资合伙企业（有限合伙）	8176.66	0.10%
合计		8,072,000.00	100.00%

集成电路基金系私募股权投资基金，已于 2015 年 3 月 25 日完成私募基金备案登记，基金编号为 SD5797。

3、国投创业基金

国投创业基金持有公司 5.65% 的股份。

截至本招股说明书签署日，国投创业基金出资人构成及出资比例如下：

单位：万元

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
1	国家开发投资集团有限公司	有限合伙人	268,516.16	26.85%
2	宁波梅山保税港区乾平涌顺投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	193,602.96	19.36%
3	宁波梅山保税港区珞佳熙明投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	144,375.00	14.44%
4	上海科技创业投资（集团）有限公司	有限合伙人	127,864.84	12.79%
5	中国人寿保险股份有限公司	有限合伙人	102,291.87	10.23%
6	长江养老保险股份有限公司	有限合伙人	77,000.00	7.70%
7	西藏藏财投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	38,500.00	3.85%
8	中国太平洋人寿保险股份有限公司	有限合伙人	21,455.93	2.15%
9	南通信达中金接续股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	15,000.00	1.50%
10	国投（上海）创业投资管理有限公司	普通合伙人	6,393.24	0.64%
11	国信资本有限责任公司	有限合伙人	5,000.00	0.50%
合计		-	1,000,000.00	100.00%

国投创业基金系私募股权投资基金，已于 2016 年 12 月 22 日完成私募基金

备案登记，基金备案编号为 SN9420。国投创业基金无实际控制人。

4、厦门鼎峰

厦门鼎峰持有公司 5.65%的股份。

截至本招股说明书签署日，厦门鼎峰出资人构成及出资比例如下：

单位：万元

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
1	中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	44,183.28	87.48%
2	厦门亦盛信启股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,816.72	11.52%
3	嘉兴鼎峰合志投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	505.05	1.00%
合计		-	50,505.05	100.00%

厦门鼎峰系创业投资基金，已于 2020 年 12 月 31 日完成私募基金备案登记，基金备案编号为 SNN169。厦门鼎峰无实际控制人。

（四）持有发行人 5%以上股份的主要股东直接或间接持有发行人的股份是否存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形

截至本招股说明书签署日，持有发行人 5%以上股份的主要股东直接或间接持有发行人的股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

六、发行人的特别表决权股份或类似安排、协议控制架构

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排，亦不存在协议控制架构。

七、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为

公司不存在控股股东、实际控制人，不涉及控股股东、实际控制人存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

八、发行人股本情况

（一）本次发行前后股本情况

本次发行全部为新股，股东不公开发售股份。本次发行前公司总股本为 148,571.4288 万股，本次拟发行人民币普通股不低于 16,507.9366 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后公司总股本的比例不低于 10.00%，最终发行数量根据发行情况确定。

假定本次发行新股 16,507.9366 万股，本次发行前后公司的股权结构如下表所示：

单位：万股

序号	股东名称	公开发行前		公开发行后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	合肥国材叁号	36,467.4294	24.55%	36,467.4294	22.09%
2	集成电路基金	30,629.3439	20.62%	30,629.3439	18.55%
3	国投创业基金	8,387.0971	5.65%	8,387.0971	5.08%
4	厦门鼎峰	8,387.0971	5.65%	8,387.0971	5.08%
5	科创新兴	7,045.1616	4.74%	7,045.1616	4.27%
6	嘉兴金硅	4,193.5486	2.82%	4,193.5486	2.54%
7	北京瑞智	4,193.5486	2.82%	4,193.5486	2.54%
8	济南华岳	3,714.2857	2.50%	3,714.2857	2.25%
9	徐州臻芯	3,714.2857	2.50%	3,714.2857	2.25%
10	嘉兴嘉亨	3,564.5160	2.40%	3,564.5160	2.16%
11	中州旭诺	2,935.4840	1.98%	2,935.4840	1.78%
12	嘉兴嘉榭	2,096.7743	1.41%	2,096.7743	1.27%
13	金浦瑞思	1,887.0969	1.27%	1,887.0969	1.14%
14	北京海震	1,857.1429	1.25%	1,857.1429	1.13%
15	蓉兴创芯	1,857.1429	1.25%	1,857.1429	1.13%
16	鑫之同	1,780.5734	1.20%	1,780.5734	1.08%
17	鑫之志	1,732.6841	1.17%	1,732.6841	1.05%
18	创东方	1,677.4194	1.13%	1,677.4194	1.02%
19	中建材新材料基金	1,485.7143	1.00%	1,485.7143	0.90%
20	允泰七号	1,467.7420	0.99%	1,467.7420	0.89%
21	华舆转型	1,448.5714	0.98%	1,448.5714	0.88%

序号	股东名称	公开发行前		公开发行后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
22	沪硅产业	1,341.9355	0.90%	1,341.9355	0.81%
23	鑫之道	1,309.9979	0.88%	1,309.9979	0.79%
24	鑫之源	1,258.1902	0.85%	1,258.1902	0.76%
25	允泰六号	1,258.0645	0.85%	1,258.0645	0.76%
26	芯行壹	1,258.0645	0.85%	1,258.0645	0.76%
27	苏州三行	1,258.0645	0.85%	1,258.0645	0.76%
28	浦东新兴	959.4240	0.64%	959.4240	0.58%
29	苏州毅辉	928.5714	0.63%	928.5714	0.56%
30	共青城泓生	928.5714	0.63%	928.5714	0.56%
31	允泰芯材	879.7466	0.59%	879.7466	0.53%
32	中欣晶圆	838.7097	0.56%	838.7097	0.51%
33	宁波瑞芯泓	838.7097	0.56%	838.7097	0.51%
34	长兴清风	838.7097	0.56%	838.7097	0.51%
35	同创致创	838.7097	0.56%	838.7097	0.51%
36	石溪产恒	838.7097	0.56%	838.7097	0.51%
37	常州瑞良	557.1429	0.37%	557.1429	0.34%
38	三亚御海	557.1429	0.37%	557.1429	0.34%
39	南通元禾	371.4286	0.25%	371.4286	0.23%
40	中金启兆	371.4286	0.25%	371.4286	0.23%
41	泰州建兴	371.4286	0.25%	371.4286	0.23%
42	鑫之合	208.8760	0.14%	208.8760	0.13%
43	青岛融源	37.1429	0.02%	37.1429	0.02%
本次公开发行股票		-	-	16,507.9366	10.00%
合计		148,571.4288	100.00%	165,079.3654	100.00%

（二）本次发行前的前十名股东

截至本招股说明书签署日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	合肥国材叁号	36,467.4294	24.55%
2	集成电路基金	30,629.3439	20.62%
3	国投创业基金	8,387.0971	5.65%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
4	厦门鼎峰	8,387.0971	5.65%
5	科创新兴	7,045.1616	4.74%
6	嘉兴金硅	4,193.5486	2.82%
7	北京瑞智	4,193.5486	2.82%
8	济南华岳	3,714.2857	2.50%
9	徐州臻芯	3,714.2857	2.50%
10	嘉兴嘉亭	3,564.5160	2.40%

（三）本次发行前的前十大自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股说明书签署日，公司无自然人股东。

（四）发行人国有股份及外资股份的情况

截至本招股说明书签署日，集成电路基金和浦东新兴为国有股东，符合《上市公司国有股权监督管理办法》第三条规定的情形。根据财政部 2025 年 12 月 24 日出具的《财政部关于确认国家集成电路产业投资基金股份有限公司江苏鑫华半导体科技股份有限公司项目国有股权管理方案的函》（财建函〔2025〕50 号），股东标注“SS”标识情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股东性质
1	集成电路基金	30,629.3439	20.62%	国有股东（SS）
2	浦东新兴	959.4240	0.64%	国有股东（SS）

截至本招股说明书签署日，公司不存在外资股东。

（五）发行人申报前十二个月新增股东的情况

1、新增股东的股份变动情况

发行人申报前十二个月新增的股东主要为合肥国材叁号。合肥国材叁号因为其看好公司的发展前景，因而通过股权转让取得发行人股份，自取得公司股份至本招股说明书签署日，上述股东的持股数量未发生变化。

序号	股权转让时间	转让股东名称	受让股东名称	投资金额（万元）	认购股本（万股）	股权转让价格（元/每股）	定价依据
1	2025 年 9 月 11 日	中能硅业	合肥国材叁号	147,200.00	36,467.4294	4.04	以评估值为依据协商确定转股价格

上述股权转让双方已于 2025 年 9 月 11 日签署相关股权转让协议，受让方已于 2025 年 9 月 17 日支付股权转让款，发行人于 2025 年 9 月 17 日出具《股东名册》，确认上述股权转让受让方的股东身份。本次变更完成后至本招股说明书签署日，发行人股权结构未发生变动。

除上述情况外，发行人申报前十二个月不存在新增股东，不存在其他与新增股东相关的异常情况。

2、最近 12 个月新增股东的基本情况

发行人申报前十二个月新增的股东为合肥国材叁号。合肥国材叁号的基本情况详见本招股说明书之“第四节、五、（三）、1、（1）合肥国材叁号”。

3、新增股东的关联关系

发行人申报前十二个月新增的股东合肥国材叁号共有 7 名合伙人。其中，发行人直接股东中建材新材料基金（于 2023 年 3 月入股发行人）直接持有合肥国材叁号 27.78%的合伙份额，并持有合肥国材叁号之执行事务合伙人合肥国材贰号企业管理咨询有限责任公司 70%的股权。此外，合肥国材叁号向发行人提名两名非独立董事、一名独立董事并推荐一名高级管理人员。

除上述情况外，发行人申报前 12 个月新增股东与发行人其他股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员均不存在关联关系。

4、新增股东不存在股份代持等情形

新增股东系以其自身名义持有发行人股份，不存在委托第三方代为持有或代第三方持有发行人股份的情形。

（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例

截至本招股说明书签署日，本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股比例	关联关系
1	合肥国材叁号	24.55%	中建材新材料基金直接持有合肥国材叁号 27.78%的

序号	股东名称	持股比例	关联关系
	中建材新材料基金	1.00%	合伙份额，并持有合肥国材叁号之执行事务合伙人合肥国材贰号企业管理咨询有限责任公司 70%的股权，二者构成一致行动关系
2	集成电路基金	20.62%	集成电路基金持有沪硅产业 15.49%股份并向沪硅产业提名董事
	沪硅产业	0.90%	
3	鑫之源	0.85%	执行事务合伙人同为上海鑫澈
	鑫之志	1.17%	
	鑫之同	1.20%	
	鑫之道	0.88%	
	鑫之合	0.14%	
4	嘉兴嘉亭	2.40%	基金管理人同为中建投资本管理（天津）有限公司
	嘉兴嘉榭	1.41%	
5	允泰七号	0.99%	允泰六号和允泰七号的基金管理人同为北京允泰投资管理有限公司；北京允泰投资管理有限公司是允泰新动能股权投资基金（枣庄）合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，且持有其 72.5%的合伙份额，允泰新动能股权投资基金（枣庄）合伙企业（有限合伙）持有允泰芯材 91.51%的合伙份额
	允泰六号	0.85%	
	允泰芯材	0.59%	
6	科创新兴	4.74%	基金管理人同为建信（北京）投资基金管理有限责任公司
	泰州建兴	0.25%	
7	厦门鼎峰	5.65%	厦门鼎峰的有限合伙人中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）与中金启兆的基金管理人同为中金资本运营有限公司
	中金启兆	0.25%	
8	华舆转型	0.98%	青岛融源为华舆转型的跟投平台
	青岛融源	0.02%	

注：嘉兴嘉亭上层有限合伙人之一正在转让其所持有的合伙份额，尚未办理工商变更，受让其合伙份额的有限合伙企业的有限合伙人之一亦持有发行人股东中州旭诺的合伙份额，嘉兴嘉亭与中州旭诺不存在一致行动关系。

除上述关联关系之外，截至本招股说明书签署日，公司各股东间不存在其他关联关系。

（七）发行人股东公开发售股份的情况

本次公开发行股票不涉及本次公开发行前的公司股东所持公司股份的转让，全部为发行新股。

（八）发行人与股东之间的特殊权益安排及解除情况

1、特殊权益安排

发行人历史上曾与股东签订相关协议涉及特殊权益安排及其解除，具体情况如下所示：

序号	签署日期	协议名称	协议签署方	特殊权益或其解除安排概述
1	2015年12月10日	《江苏中能硅业科技发展有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司关于设立江苏鑫华半导体材料科技有限公司之合资经营合同》	中能硅业、集成电路基金	以中能硅业为回购义务人的回购权、股权锁定、优先认购权、优先购买权、反稀释权、保留事项同意权、董事会一票否决权、特别审计权、自动恢复条款等
2	2020年12月30日	《合资经营合同之补充协议》	中能硅业、集成电路基金	修改了集成电路基金的回购权的相关约定
3	2021年1月22日	《关于江苏鑫华半导体材料科技有限公司之股东协议》	发行人、中能硅业、集成电路基金、A轮投资方	1、集成电路基金的回购权按照原合资经营合同及后续补充协议中的约定执行； 2、以发行人为回购义务人的回购权、股权锁定、优先认购权、优先购买权、反稀释权、共同出售权、优先清算权、最惠条款、保留事项同意权、董事会一票否决权、特别审计权、自动恢复条款等内容
4	2021年7月23日	《合资经营合同之补充协议 II》	中能硅业、集成电路基金	修改了集成电路基金的回购权的相关约定
5	2021年12月16日	《合资经营合同之补充协议 III》	中能硅业、集成电路基金	修改了集成电路基金转让发行人股权时间的约定
6	2021年12月16日	《关于江苏鑫华半导体材料科技有限公司之股东协议 II》	发行人、中能硅业、集成电路基金、A轮投资方、ESOP 平台	1、集成电路基金的回购权按照原合资经营合同及后续补充协议中的约定执行； 2、以发行人为回购义务人的回购权、股权锁定、优先认购权、优先购买权、反稀释权、共同出售权、优先清算权、最惠条款、保留事项同意权、董事会一票否决权、特别审计权、自动恢复条款等内容
7	2022年1月27日	《江苏鑫华半导体材料科技有限公司股东协议之补充协议》	发行人、中能硅业、集成电路基金、A轮投资方、ESOP 平台、	各方确认该协议签署前对赌协议中的回购条款和优先清算权条款从未触发，并约定以发行人为回购义务主体的相关回购权条款自始至终且不附恢复条款
8	2022年1月28日	《关于江苏鑫华半导体材料科技有限公司之 A+轮股东协议》（以	发行人、中能硅业、集成电路基金、A轮投资	以中能硅业为回购义务人的回购权、股权锁定、优先认购权、优先购买权、反稀释权、共同出

序号	签署日期	协议名称	协议签署方	特殊权益或其解除安排概述
		下简称“A+轮股东协议”）	方、ESOP平台、A+轮投资方	售权、优先清算权、最惠条款、保留事项同意权、董事会一票否决权、特别审计权、自动恢复条款等
9	2022年6月10日	《关于解除特殊股东权利的股东协议》	发行人、A轮投资方、A+轮投资方、ESOP平台、中能硅业、集成电路基金	股东特殊权利（包括以中能硅业为回购义务人的权利）自发行人提交首发上市申请材料时终止；与公司治理相关的特殊权利约定自该协议签署日起终止；发行人上市未成功的，前述安排自动恢复效力
10	2023年3月29日	《关于江苏鑫华半导体科技股份有限公司之B轮股东协议》	发行人、中能硅业、集成电路基金、A轮投资方、ESOP平台、A+轮投资方、B轮投资方	以中能硅业为回购义务人的回购权、股权锁定、优先认购权、优先购买权、反稀释权、共同出售权、优先清算权、最惠条款、特别审计权、自动恢复条款等
11	2024年12月30日	《合资经营合同之补充协议IV》	中能硅业、集成电路基金	修改了集成电路基金的回购权的相关约定
12	2025年9月2日	《合资经营合同之补充协议V》	中能硅业、集成电路基金	对于中能硅业股权转让后集成电路基金的回购权进行了约定
13	2025年9月11日	《关于江苏鑫华半导体科技股份有限公司之股东协议III》	发行人、发行人全体股东	明确相关股东享有的注册资本的优先认缴权、反稀释权、优先购买权及转股限制、共同出售权、股权变动知情权、优先清算权、最惠条款、知情权、自动恢复条款等内容，并明确该协议取代各方此前关于股东权利义务所达成的任何协议、投资意向书、谅解备忘录、陈述或其他义务等，任何其他有关股东权利义务安排的协议与该协议约定有冲突的，以该协议为准

2、特殊权利条款的终止

（1）涉及发行人为回购义务主体、优先清算权的特殊权利终止

2022年1月27日，鑫华有限与中能硅业、集成电路基金、A轮投资方、ESOP平台签署了A轮股东协议之补充协议，各方确认该协议签署前对赌协议中的回购条款和优先清算权条款从未触发，并约定以发行人为回购义务主体的相关回购权条款自始至终且不附恢复条款。

（2）其他特殊权利

2025年9月2日，中能硅业与集成电路基金签署了《合资经营合同之补充

协议 V》（下称“《补充协议 V》”），本协议为《合资经营合同》的补充协议，对合资经营合同及原补充协议的组成部分，与合资经营合同即原补充协议具有同等法律效力。该协议对中能硅业转让后与集成电路基金的相关特殊权利条款进行了约定。相关集成电路基金的特殊权利自公司向有关证券监督管理机构递交首次公开发行股票申请文件时终止，但若公司的首次公开发行股票申请未获受理、主动撤回、被终止审查、被否决/驳回、未获得审核通过或因其他原因导致公司未能在获准注册上市批文有效期内完成合格上市的（以较早者为准），在中国法律法规允许的范围内，上述特殊权利条款应自公司的首次公开发行股票申请未被受理、被撤回、被终止审查、被否决/驳回、被通知审核未通过之日，或公司获准注册上市批文有效期届满之日（以较早者为准），自动、自始恢复效力。如果公司再次向有关证券监督管理机构递交首次公开发行股票申请文件时，上述特殊股东权利条款自动终止事项另行商议。

2025 年 9 月 11 日，公司与各股东签署了《关于江苏鑫华半导体科技股份有限公司之股东协议 III》（下称“《股东协议 III》”），该协议就中能硅业股份转让交易交割后公司的治理、各方的权利义务等事宜作出约定。该协议同时约定，上述特殊权利条款自公司向有关证券监督管理机构递交首次公开发行股票申请文件时终止，但若公司的首次公开发行股票申请未获受理、主动撤回、被终止审查、被否决/驳回、未获得审核通过或因其他原因导致公司未能在获准注册上市批文有效期内完成合格上市的（以较早者为准），在中国法律法规允许的范围内，上述特殊权利条款应自公司的首次公开发行股票申请未被受理、被撤回、被终止审查、被否决/驳回、被通知审核未通过之日，或公司获准注册上市批文有效期届满之日（以较早者为准），自动、自始恢复效力。如果公司再次向有关证券监督管理机构递交首次公开发行股票申请文件时，上述特殊股东权利条款自动终止事项另行商议。

3、股东特殊权利条款解除安排符合《监管规则适用指引——发行类第 4 号》的要求

（1）发行人不作为对赌协议当事人

1) 发行人承担回购义务的条款在财务报告出具日之前已彻底终止且自始无效

由发行人承担回购义务的约定已于 2022 年 1 月 27 日由《A 轮股东协议之补充协议》彻底终止且自始无效，该协议现行有效，未被后续签署的协议所替代。

2) 发行人作为股东协议的签署方，但非义务履行方

根据《补充协议 V》《股东协议 III》，若公司未能完成上市，则可能恢复效力的股东权利已在《补充协议 V》《股东协议 III》中进行约定。《补充协议 V》签署方不包括公司，公司不承担协议相关义务。《股东协议 III》的签署方包括公司，但根据约定，公司不作为回购义务的责任方，公司作为股东协议签署方仅是投融资市场的惯常操作，发行人不作为对赌义务的履行主体，不承担任何对赌义务或连带责任。

（2）对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定

发行人自成立以来无实际控制人，中能硅业的回购义务自发行人成立以来亦未实际执行；若发行人首次公开发行股票并上市申请材料被上交所受理，则发行人现有股东的特殊权利条款的效力将一直处于终止状态；发行人上市后，上述特殊权利条款将彻底终止，且不会恢复法律效力，中能硅业不承担任何回购义务，不会导致发行人控制权发生变化。

（3）对赌协议不与市值挂钩

中能硅业对集成电路基金回购义务的触发条件包括：1) 公司由于境内外政府政策等外部原因（国家暂停 IPO 等不可抗力原因除外）导致合资公司无法在限定期（2026 年 12 月 31 日前）实现合资公司在一家集成电路基金认可的证券交易所上市或 2) 合资公司未能在 2026 年 12 月 31 日前完成合格 IPO 或中能硅业在股份转让完成前或股份转让完成后的任何时间出现严重违约、严重损害合资公司利益或其他对合资公司造成严重不利影响的情形并在集成电路基金提出的合理期限内未能补救。因此，对赌协议不存在与市值挂钩的情况。

（4）对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形

未来恢复执行的特殊权利主要涉及中能硅业承担的回购义务及优先认购权等股东特殊权利，不涉及发行人承担回购义务，发行人不作为对赌协议的当事人，因此不会对发行人的持续经营能力产生严重影响；在发行人如期完成上市的情况

下，对赌协议将不会恢复效力并保持终止状态，亦不会产生其他严重影响投资者权益的情形。

（九）持有发行人股份的私募投资基金等金融产品纳入监管的情况

截至本招股说明书签署日，发行人 43 名非自然人股东中存在 26 名性质为私募投资基金的股东，私募投资基金股东均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的规定办理私募投资基金备案手续，具体情况如下：

序号	股东名称	私募基金备案编码	私募基金管理人	管理人登记编号
1	集成电路基金	SD5797	华芯投资管理有限责任公司	P1009674
2	厦门鼎峰	SNN169	嘉兴武岳峰投资管理有限公司	P1060152
3	国投创业基金	SN9420	国投（上海）创业投资管理有限公司	P1032007
4	科创新兴	STE751	建信（北京）投资基金管理有限责任公司	P1001087
5	泰州建兴	SXQ613		
6	嘉兴金硅	SQG496	天津建银国际金禾股权投资管理有限公司	P1015284
7	北京瑞智	SGL959	北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司	P1068932
8	徐州臻芯	SZL275	江苏金璞私募基金管理有限公司	P1073903
9	嘉兴嘉亭	STD954	中建投资本管理（天津）有限公司	P1000731
10	嘉兴嘉榭	SNG264		
11	中州旭诺	SY8506	宁波旭诺创业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	P1002887
12	创东方	SNP236	深圳市创东方投资有限公司	P1000508
13	中建材新材料基金	SSG288	中建材私募基金管理（北京）有限公司	P1072218
14	允泰七号	SNN553	北京允泰投资管理有限公司	P1067079
15	允泰六号	SLY367		
16	华舆转型	SQM687	中车（北京）转型升级基金管理有限公司	P1071664
17	芯行壹	SLX177	青岛泰和顺股权投资管理有限公司	P1033802
18	苏州三行	SCT692	北京三行资本管理有限责任公司	P1031588
19	苏州毅辉	SXX217	苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司	P1069021
20	共青城泓生	SB0002	泓生投资管理有限公司	P1065428
21	同创致创	SNA844	深圳同创锦绣资产管理有限公司	P1010186

序号	股东名称	私募基金备案编码	私募基金管理人	管理人登记编号
22	石溪产恒	SQL939	北京石溪清流投资有限公司	P1068420
23	瑞良创业	SVF644	江苏瑞华创业投资管理有限公司	P1025801
24	三亚御海	SXL850	海南三亚御海私募基金管理有限公司	P1073164
25	中金启兆	SZP063	中金资本运营有限公司	PT2600030375
26	南通元禾	SXM967	元禾厚望（苏州）私募基金管理有限公司	P1066725

除上述股东外，其余股东均不属于私募投资基金，不需要办理私募投资基金备案手续。

九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的情况

（一）发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简历

1、董事会成员

本公司董事会现由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，均具有符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，全体董事均由公司股东会选举产生。董事任期届满，可连选连任，独立董事连任时间不得超过 6 年。

截至本招股说明书签署日，本公司董事会成员情况如下表所示：

姓名	现在发行人的职务	任期	提名人
聂巍	董事长	2025年9月至2028年3月	合肥国材叁号
蒋文武	副董事长	2025年11月至2028年3月	职工代表大会
安帅	董事	2025年9月至2028年3月	合肥国材叁号
张昊玳	董事	2025年3月至2028年3月	集成电路基金
舒恺	董事	2025年3月至2028年3月	集成电路基金
邓志红	董事	2025年3月至2028年3月	国投创业基金
李炜	董事	2025年3月至2028年3月	沪硅产业
林爱梅	独立董事	2025年3月至2028年3月	ESOP平台
蒋阳波	独立董事	2025年3月至2028年3月	合肥国材叁号
石璜	独立董事	2025年3月至2028年3月	集成电路基金
许军	独立董事	2025年3月至2028年3月	科创新兴

（1）聂巍先生简历

聂巍，男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士

学位，经济师、政工师。2003年7月参加工作，2003年6月加入中国共产党。2008年7月至2020年12月，历任中国建材股份有限公司投资发展部总经理助理、副总经理；2021年至2025年3月，历任西南水泥党委委员、纪委书记、党委副书记、董事；2025年4月至今，任中建材联合投资有限公司副总经理。2025年9月至今，任鑫华半导体董事长。

（2）蒋文武先生简历

蒋文武，男，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，辽宁石油化工大学化学工程领域专业硕士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。1985年9月至1989年9月，任吉林长山化肥厂车间主任；1989年10月至2006年9月，历任抚顺石化公司生产处长、副厂长、项目部经理；2006年10月至2007年6月，任协鑫（集团）控股有限公司高级经理；2007年6月至2021年3月，历任江苏中能硅业科技发展有限公司生产副总经理、总经理、董事长；2015年1月至2021年6月，历任协鑫科技控股有限公司多晶硅料事业部总裁、高级副总裁、执行董事；2018年1月至2021年3月，历任新疆戈恩斯能源科技有限公司工程常务副总指挥、董事长。2015年12月至2022年3月，历任鑫华有限董事、总经理、董事长；2022年3月至2025年9月，任鑫华半导体董事长；2025年9月至今，任鑫华半导体副董事长。

（3）安帅先生简历

安帅，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，圣路易斯华盛顿大学（Washington University in St. Louis）金融学硕士，中国人民大学金融工程学士学位。2005年加入中国共产党，2011年5月参加工作。2011年5月至2012年10月，任中国建银投资有限公司分析员；2012年10月至2017年1月，任建投投资有限责任公司副总裁；2017年1月至2022年2月，任中国建银投资有限公司直接投资部股权投资处处长；2022年2月至今，任中建材私募基金管理（安徽）有限公司（原名：中建材（安徽）新材料基金管理有限公司）投资二部负责人。2025年9月至今，任鑫华半导体董事。

（4）张昊玳女士简历

张昊玳，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。2012年4月至2016年5月，任中航国际航空发展有限公司财务处主管，2016年6月至今，任华芯投资管理有限责任公司投资三部资深主管。2024年8月至今，任鑫华半导体董事。

（5）舒恺先生简历

舒恺，男，1991年出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，2014年毕业于英国曼彻斯特大学发展金融学专业，硕士研究生学历。2015年6月至2023年3月，任国家开发银行北京市分行客户二处一级经理；2023年3月至今，任华芯投资管理有限责任公司投资三部资深主管；2024年8月至今，任鑫华半导体董事。

（6）邓志红先生简历

邓志红，男，1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学核科学与技术专业，博士研究生学历。2013年7月至2017年7月，任华能核电开发有限公司主管；2017年8月至今，历任国投创业投资管理有限公司投资副总裁、投资总监。2021年12月至2022年3月，任鑫华有限监事；2022年3月至今，任鑫华半导体董事。

（7）李炜先生简历

李炜，男，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院上海微系统与信息技术研究所微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历。2000年7月至2007年7月，历任中科院上海微系统所助理研究员、副研究员；2001年7月至今，历任上海新傲科技股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书、董事长兼总经理；2015年1月至今，历任上海新昇董事、首席执行官、董事长；2015年12月至今，历任沪硅产业执行副总裁、董事会秘书、常务副总裁。2022年1月至3月，任鑫华有限董事；2022年3月至今，任鑫华半导体董事。

（8）林爱梅女士简历

林爱梅，女，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学，博士研究生学历。1989年8月至今，历任中国矿业大学管理学院助教、讲师、副教授、经济管理学院教授；2014年12月至2021年6月，任徐工

集团工程机械股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年9月，任江西晨光新材料股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年11月，任江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事；2023年1月至今，任徐州恒鑫金融租赁股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任国晟世安科技股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任广东东阳光药业股份有限公司独立董事。2022年12月至今，任鑫华半导体独立董事。

（9）蒋阳波先生简历

蒋阳波，男，1979年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，硕士研究生学历。2001年7月至2003年7月，任苏拿（广州）树脂镜片有限公司工程师；2003年8月至2012年12月，任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司工程师、技术经理；2013年1月至2013年8月，任武汉新芯集成电路制造有限公司技术经理；2013年9月至2016年2月，任恩力能源科技有限公司运营总监；2016年3月至今，历任长江存储科技有限责任公司总经理特助、战略规划及专项负责人、项目高级总监。2022年3月至今，任鑫华半导体独立董事。

（10）石瑛女士简历

石瑛，女，1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学商学院工商管理专业，硕士研究生学历。2004年5月至2014年12月，任有研半导体材料股份有限公司总经理助理；2013年1月至今，任集成电路材料产业技术创新联盟秘书长；2015年1月至2017年2月，任有研新材料股份有限公司总经理助理；2017年3月至2023年7月，任上海正帆科技股份有限公司独立董事；2017年9月至2023年11月，任唐山三孚硅业股份有限公司独立董事；2019年3月至2024年12月，任宁波施捷电子有限公司董事；2019年3月至2025年8月，任河北中瓷电子股份有限公司独立董事；2019年5月至2025年6月，任江苏长电科技股份有限公司独立董事；2019年5月至2025年4月，任天水华天科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任上海强华实业股份有限公司董事；2022年1月至今，任北京盛芯盛科技有限责任公司执行董事兼总经理；2023年7月至今，任上海盛芯通泰科技发展有限公司执行董事兼总经理；2024年3月至今，任稀美资源控股有限公司独立非执行董事；2025年6月

至今，任无锡迪思微电子股份有限公司董事。2022 年 3 月至今，任鑫华半导体独立董事。

（11）许军先生简历

许军，男，1963 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学无线电电子学系，博士研究生学历。1994 年 9 月至 1996 年 9 月，任清华大学微电子学研究所博士后科研流动站博士后；1996 年 10 月至 1997 年 10 月，任清华大学微电子学研究所助理研究员；1997 年 11 月至 1999 年 11 月，任美国新奥尔良大学先进材料研究院访问学者；1999 年 12 月至 2002 年 11 月，任清华大学微电子学研究所研究员；2002 年 12 月至 2021 年 3 月，任《中国科学：信息科学》编委；2018 年 1 月至今，任浙江清华长三角研究院高可靠功率半导体研究中心主任；2020 年 12 月至今，任思特威（上海）电子科技股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今，任清华大学集成电路学院研究员；2021 年 11 月至今，任中国国际科技促进会副会长。2022 年 3 月至今，任鑫华半导体独立董事。

2、监事会成员

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司于 2025 年 11 月 17 日召开股东会审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及其他制度文件的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

3、高级管理人员

本公司现有高级管理人员 4 名，由董事会聘任。截至本招股说明书签署日，本公司高级管理人员情况如下表所示：

姓名	职务
田新	总经理
朱蓬	副总经理
许继海	副总经理兼财务负责人
方世琼	副总经理兼董事会秘书

（1）田新先生简历

田新，男，1981年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学化学系，**博士研究生学历**，高级工程师。2006年6月至2007年11月，任内蒙古协鑫锡林投资有限公司投资部技术支持；2007年11月至2008年8月，任综能协鑫（内蒙古）煤化工有限公司综合计划部副经理；2008年9月至2015年12月，历任江苏中能硅业科技发展有限公司还原分厂专业工程师、一分厂副厂长和厂长、煤化工项目部主任；2013年4月至2015年9月，任协鑫（集团）控股有限公司新疆项目指挥部助理副总指挥、内蒙古风光电气一体化项目指挥部总工程师。2015年12月至2022年3月，历任鑫华有限副总经理、总经理、董事；2022年3月至2025年9月，任鑫华半导体董事、总经理；2025年9月至今，任鑫华半导体总经理。

（2）朱蓬女士简历

朱蓬，女，1981年6月出生，中国国籍，毕业于山东农业大学会计学专业，本科学历，高级会计师。2001年3月至2022年2月历任中材科技股份有限公司下属企业泰山玻璃纤维有限公司财务部会计、主管、副部长、部长、副总会计师职务；2022年3月至2025年4月，任中材科技股份有限公司财务与数字化部副部长（主持工作）；2025年4月至11月，任中材科技股份有限公司下属企业连云港中复连众复合材料集团有限公司财务总监；2025年11月至今，任江苏鑫华半导体科技股份有限公司副总经理。

（3）许继海先生简历

许继海，男，1968年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师。2002年11月至2007年12月，任香港协鑫（集团）控股有限公司审计部审计经理、电力设备成套财务负责人；2007年12月至2009年9月，任江苏中能硅业科技发展有限公司财务总监；2009年9月至2014年12月，任江苏协鑫硅材料科技发展有限公司财务总监；2015年1月至2021年12月，历任协鑫科技控股有限公司副总裁、高级副总裁。2021年12月至2022年3月，任鑫华有限副总经理；2022年3月至今，任鑫华半导体副总经理兼财务负责人。

（4）方世琼女士简历

方世琼，女，1984年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学，硕士研究生学历，中国注册会计师、美国注册管理会计师。2009年7月至2015年1月，任江苏中能硅业科技发展有限公司总经理秘书、行政部副经理；2015年2月至2018年12月，任协鑫科技控股有限公司总裁工作部总经理助理、战略运营部副总经理。2018年12月至2022年3月，历任鑫华有限计划助理总监、计划总监、副总经理；2022年3月至今，任鑫华半导体副总经理兼董事会秘书。

4、核心技术人员

发行人核心技术人员主要认定标准为：（1）具有深厚的行业技术、专业知识背景，丰富的研发工作经历或项目经验；（2）对各类半导体材料的生产、技术、工艺、模拟和分析具有全面而深入的理解和掌握；（3）对公司的技术创新、工艺创新、产品技术路线、产品的重大改型、新产品的研发规划能产生重大影响；（4）任职期间参与或主导完成相关技术的研发，或新产品、新技术的研发，或带领研发团队完成多项知识产权申请及重大科研项目的执行，或对公司的核心技术有突出贡献；（5）对半导体材料行业整体运营具有深入的理解和丰富的从业经验，并能明显提高公司产品性能、提升公司运营效率、降低运营成本，对公司发展具有显著贡献；（6）在公司研发体系中担任重要职务，在技术研究、产品开发、产业化应用等方面发挥重要作用。

发行人核心技术人员具体情况如下：

姓名	职务
蒋文武	副董事长
田新	总经理
李明峰	内蒙古鑫华常务副总经理兼总工程师
江宏富	研究院执行院长
吴锋	技术研发部经理兼 FAE 副总监

（1）蒋文武先生简历

简历详见本招股说明书之“第四节、九、（一）、1、董事会成员”。

（2）田新先生简历

简历详见本招股说明书之“第四节、九、（一）、3、高级管理人员”。

（3）李明峰先生简历

李明峰，男，1965年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林化工学院，本科学历。1990年5月至2007年3月，历任吉林省长山化肥厂车间技术员、段长、车间主任；2007年3月至2018年4月，任南京高宝合成气有限公司、综能协鑫（内蒙古）煤化工有限公司合成气项目经理；2008年4月至2009年9月，任江苏泰兴中能远东硅业有限公司生产副厂长兼生产部长；2009年9月至2019年7月，历任中能硅业生产运营部主任工程师、三分厂副厂长、四分厂厂长、一分厂厂长。2019年7月至2022年3月，历任鑫华有限技术助理总监、生产总监；2022年3月至2022年8月，任鑫华半导体生产总监。2022年9月至今，任内蒙古鑫华常务副总经理兼总工程师。

（4）江宏富先生简历

江宏富，男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学，博士研究生学历。2007年4月至2010年3月，任中科院大连化学物理研究所任博士后；2010年4月至2019年7月，任中能硅业研究院副院长；2019年8月至2021年7月，任江苏集芯半导体硅材料研究院有限公司研究院副院长。2021年8月至2022年3月，任鑫华有限研究院常务副院长；2022年3月至今，历任鑫华半导体研究院常务副院长、执行院长。

（5）吴锋先生简历

吴锋，男，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生学历，高级工程师。2007年8月至2010年2月，任江苏钟山化工有限公司技术工程师；2010年3月至2016年6月，任中能硅业研发工程师。2016年7月至2022年3月，任鑫华有限 FAE 副总监；2022年3月至2022年10月，任鑫华半导体 FAE 副总监；2022年10月至今，任鑫华半导体技术研发部经理兼 FAE 副总监。

（二）董事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下：

姓名	本公司任职情况	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司的关联关系
聂崑	董事长	中建材联合投资有限公司	副总经理	关联方
蒋文武	副董事长	内蒙古鑫华	董事长	控股子公司
		上海鑫澈	监事	公司员工持股平台的执行事务合伙人
安帅	董事	中建材私募基金管理（安徽）有限公司	投资二部负责人	关联方
		合肥国材贰号企业管理咨询有限责任公司	董事、经理	关联方
		合肥国材叁号	执行事务合伙人委派代表	公司股东
张昊玳	董事	天水华天科技股份有限公司	董事	关联方
		拓荆科技股份有限公司	董事	关联方
		杭州长川科技股份有限公司	董事	关联方
		江苏先科半导体新材料有限公司	董事	关联方
		安徽聚合微电子有限公司	董事	关联方
		通富微电子股份有限公司	董事	关联方
舒恺	董事	中巨芯科技股份有限公司	董事	关联方
邓志红	董事	国投创业投资管理有限公司	投资总监	公司股东国投创业基金的执行事务合伙人国投（上海）创业投资管理有限公司的控股股东
		福建德尔科技股份有限公司	董事	关联方
		苏州润邦半导体材料科技有限公司	董事	关联方
李炜	董事	沪硅产业	董事、常务副总裁	公司股东
		上海新昇	董事长，总经理	关联方
		上海新傲科技股份有限公司	董事长，总经理	关联方
		上海新硅聚合半导体有限公司	董事长，总经理	关联方
		升硅（上海）半导体科技有限公司	执行董事	关联方
		保硅（上海）半导体科技有限公司	执行董事	关联方
		上海硅欧投资有限公司	执行董事	关联方
		上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	董事	关联方

姓名	本公司任职情况	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司的关联关系
		上海集成电路材料研究院有限公司	董事	关联方
		上海上创新微投资管理有限公司	董事	关联方
		上海新昇晶科半导体科技有限公司	董事	关联方
		上海新昇晶睿	董事	关联方
		上海新昇晶投半导体科技有限公司	董事，经理	关联方
		上海新傲芯翼科技有限公司	董事，总经理	关联方
		太原晋科半导体科技有限公司	执行董事	关联方
		太原晋科硅材料技术有限公司	董事长	关联方
		上海拓硅半导体科技有限公司	执行董事，总经理	关联方
林爱梅	独立董事	中国矿业大学	经济管理学院教授	-
		广东东阳光药业股份有限公司	独立非执行董事	-
		国晟世安科技股份有限公司	独立董事	-
		徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	独立董事	-
蒋阳波	独立董事	长江存储科技有限责任公司	项目高级总监	-
石瑛	独立董事	集成电路材料产业技术创新联盟	秘书长	-
		北京盛芯盛科技有限责任公司	董事长，总经理，财务负责人	关联方
		上海盛芯通泰科技发展有限公司	董事长，总经理，财务负责人	关联方
		稀美资源控股有限公司	独立非执行董事	-
		无锡迪思微电子股份有限公司	独立董事	-
		锐立平芯微电子（广州）有限责任公司	董事	-
		江苏南大光电材料股份有限公司	独立董事	-
许军	独立董事	清华大学	集成电路学院研究员	-
		思特威（上海）电子科技股份有限公司	独立董事	-
		江苏华特集成电路股份有限公司	董事	关联方
		江苏苏通华特半导体股份有限公司	董事	-
		江苏集萃集成电路工艺技术研究有限公司	董事	-
		浙江清华长三角研究院高可靠功率半导体研究中心	主任	-
		中国国际科技促进会	副会长	-
田新	总经理	上海鑫澈	执行董事兼总经理	公司员工持股平台的执行事务合伙人
		内蒙古鑫华	董事，经理	控股子公司

姓名	本公司任职情况	兼职单位	兼职职务	兼职单位与本公司的关联关系
		湖北鑫阳	执行董事	控股子公司
		武汉立膜	董事	参股公司
		徐州立膜科技有限公司	董事	参股公司的子公司
		徐州泛半导体	经理，董事	控股子公司
		徐州鑫华销售	董事	控股子公司
		鑫华特种气体	经理，董事	控股子公司
许继海	副总经理兼财务负责人	内蒙古鑫华	董事	控股子公司
江宏富	研究院执行院长	湖北鑫阳	总经理	控股子公司

（三）董事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关系

截至本招股说明书签署日，本公司董事、高级管理人员和核心技术人员之间不存在亲属关系。

（四）发行人董事、高级管理人员和其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况

最近三年，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

（五）董事、高级管理人员及核心技术人员与公司签署协议及承诺情况

截至本招股说明书签署日，公司与内部董事、高级管理人员及核心技术人员均已签订《劳动合同》。除此之外，公司还与核心技术人员签订了《竞业限制协议书》和《保密协议书》。

其他关于股份减持、价格稳定承诺及招股说明书存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述时的赔偿承诺等详见本招股说明书之“第十二节、三、与投资者保护相关的承诺”。

报告期内，上述协议和承诺均得以良好履行。

（六）最近两年发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况

1、董事变动情况及原因

近两年，发行人董事变动情况如下：

序号	时间	董事会人员名单	变动情况
1	2024 年初	蒋文武、胡晓艳、杨柳、郝一阳、邓志红、李炜、田新、林爱梅、蒋阳波、石瑛、许军	-
2	2024 年 8 月	蒋文武、胡晓艳、张昊玳、舒恺、邓志红、李炜、田新、林爱梅、蒋阳波、石瑛、许军	2024 年 8 月 21 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东会，同意杨柳、郝一阳辞去董事职务，选举张昊玳、舒恺为董事
3	2025 年 1 月	蒋文武、胡泽义、张昊玳、舒恺、邓志红、李炜、田新、林爱梅、蒋阳波、石瑛、许军	2025 年 1 月 21 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东会，同意胡晓艳辞去董事职务，选举胡泽义为董事
4	2025 年 9 月	聂崴、蒋文武、安帅、张昊玳、舒恺、邓志红、李炜、林爱梅、蒋阳波、石瑛、许军	2025 年 9 月 25 日，发行人召开 2025 年第四次临时股东会，同意免去胡泽义、田新董事职务，选举聂崴、安帅为董事，并于 9 月 30 日选举聂崴任董事长，蒋文武任副董事长
5	2025 年 11 月	聂崴、蒋文武、安帅、张昊玳、舒恺、邓志红、李炜、林爱梅、蒋阳波、石瑛、许军	2025 年 11 月 17 日，发行人召开 2025 年第五次临时股东会，同意取消监事会，ESOP 平台未提名董事，由职工代表大会提名蒋文武为职工代表董事，任副董事长

报告期内，发行人董事的选任均履行了必要的法律程序，符合法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》的有关规定。最近两年，公司董事变动的主要原因系股东更换提名董事、合肥国材叁号受让中能硅业股份后对应的董事提名变更、ESOP 平台提名的 1 名董事由职工代表董事取代等。上述变更未构成发行人董事重大不利变化，未对发行人的生产经营产生重大不利影响。

2、监事变化情况

近两年，发行人监事变动情况如下：

序号	时间	监事会人员名单	变动情况
1	2024 年初	周国栋、邹非、黄娟娟	-
2	2025 年 9 月	苗晶、邹非、黄娟娟	2025 年 9 月 25 日，发行人召开 2025 年第四次临时股东会，同意

序号	时间	监事会人员名单	变动情况
			免去周国栋监事职务，选举苗晶为监事，并于 9 月 30 日选举苗晶为监事会主席
3	2025 年 11 月	-	2025 年 11 月 17 日，发行人召开 2025 年第五次临时股东会，同意取消监事会，苗晶、邹非、黄娟娟的监事职位相应免除

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司于 2025 年 11 月 17 日召开股东会审议通过了《关于取消监事会暨修订《公司章程》及其他制度文件的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

报告期内，发行人监事的选任均履行了必要的法律程序，符合法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》的有关规定。最近两年，公司监事变动的主要原因系合肥国材叁号受让中能硅业股份后对应的监事提名变更，未对发行人的生产经营产生重大不利影响。

3、高级管理人员的变化

近两年，发行人高级管理人员变动情况如下：

序号	时间	高级管理人员名单	变动情况
1	2024 年初	总经理：田新 副总经理：许继海、方世琼 财务负责人：许继海 董事会秘书：方世琼	-
2	2025 年 11 月	总经理：田新 副总经理：朱蓬、许继海、方世琼 财务负责人：许继海 董事会秘书：方世琼	为进一步完善公司治理，新增副总经理朱蓬

报告期内，发行人高级管理人员的选任均履行了必要的法律程序，符合法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》的有关规定。最近两年，公司高级管理人员未发生重大不利变化，未对发行人的生产经营产生重大不利影响。

4、核心技术人员的变化

近两年，发行人核心技术人员变动情况如下：

序号	时间	核心技术人员名单	变动情况
1	2024 年初	蒋文武、田新、李明峰、江宏富、吴锋、张天雨	-
2	2024 年 3 月	蒋文武、田新、李明峰、江宏富、吴锋	张天雨因个人原因离职

公司历来重视核心技术人员，重视人才的培养，通过为员工提供良好的科研、工作环境、发展空间、员工持股等多种方式确保核心人员稳定，保证核心竞争力的持续。上述核心技术人员变动未对公司产生重大不利影响。

综上，最近两年公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均未发生重大变化，未对公司经营管理构成重大不利影响。

（七）董事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，除公司员工持股平台外，公司董事、高级管理人员及核心技术人员不存在与公司及其业务相关的对外投资情况。

（八）董事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属发行前持股情况

截至本招股说明书签署日，董事、高级管理人员与核心技术人员直接或间接持有本公司股份情况如下：

姓名	公司任职	持股方式	合计持股比例
田新	总经理	间接持股	0.8361%
蒋文武	副董事长	间接持股	0.8304%
安帅	董事	间接持股	0.0004%
李炜	董事	间接持股	0.0004%
许继海	副总经理兼财务负责人	间接持股	0.4428%
方世琼	副总经理兼董事会秘书	间接持股	0.2325%
李明峰	内蒙古鑫华常务副总经理兼总工程师	间接持股	0.1179%
江宏富	研究院执行院长	间接持股	0.0343%
吴锋	技术研发部经理兼 FAE 副总监	间接持股	0.0487%
合计	-	-	2.5434%

注：间接持股比例=持有中间主体股份或份额比例×中间主体持有公司股份比例。

除上述情况外，截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

（九）董事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属所持本公司股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属所持本公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

（十）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

1、薪酬构成、确定依据以及所履行的程序

公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。

公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬、津贴方案如下：

（1）董事薪酬

在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津贴；独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为15万元/年（含税），按季度发放。

（2）取消监事会前在任监事薪酬

报告期内曾在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬，不领取监事津贴；其余不在公司任职的监事，不在公司领取报酬或监事津贴。

（3）高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由工资加奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

（4）核心技术人员薪酬

核心技术人员薪酬由工资加奖金构成，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理标准领取薪酬。

2、最近一年从发行人及其关联企业的领薪情况

公司现任董事中，董事长聂崑、董事安帅、张昊玳、舒恺、邓志红、李炜不在公司领薪；最近一年曾经担任董事的人员中，胡泽义、胡晓艳、杨柳、郝一阳不在公司领薪。

独立董事在本公司只领取独立董事津贴，不享有其他福利待遇。

公司取消监事会前在任监事中，监事会主席苗晶、监事邹非不在本公司领薪；最近一年曾经担任监事的人员中，周国栋不在本公司领薪。

除上述人员外的董事、取消监事会前的监事、高级管理人员和核心技术人员在公司及其子公司领取薪酬，2025 年度从发行人处领取薪酬合计为 2,570.51 万元，具体情况如下：

单位：万元

姓名	职务	2025 年度
蒋文武	副董事长、核心技术人员	749.44
田新	总经理、核心技术人员	644.76
许继海	副总经理兼财务负责人	380.27
方世琼	副总经理兼董事会秘书	322.05
朱蓬	副总经理 (2025 年 11 月入职)	25.81
黄娟娟	职工代表监事 (2025 年 11 月取消监事会)	20.37
李明峰	核心技术人员	225.17
江宏富	核心技术人员	110.78
吴锋	核心技术人员	91.86
薪酬总额		2,570.51

最近一年，除公司无劳动关系的董事、取消监事会前的监事，其余董事、取消监事会前的监事、高级管理人员及核心技术人员均未在公司及其子公司以外的关联企业领取薪酬。

在公司领薪（不含领取津贴的独立董事）的上述董事、取消监事会前的监事、

高级管理人员、核心技术人员，公司按照国家和地方的有关规定，依法为其缴纳失业、养老、医疗、工伤、生育等保险与住房公积金，不存在其他特殊待遇和退休金计划等。

3、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬总额占发行人利润总额的比例

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
薪酬总额	2,570.51	2,360.17	1,663.06
利润总额	12,175.40	6,228.10	3,633.08
占比	21.11%	37.90%	45.78%

注：1、薪酬总额含报告期内曾任董事（不含外部董事和独立董事）、取消监事会前的监事（不含外部监事）、高级管理人员及核心技术人员的薪酬；2、薪酬的计算口径为个人总薪酬金额，包括公司承担的社保、公积金和代扣代缴的个税，不包括股份支付的金额。

十、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

为充分调动公司员工的积极性、创造性，实现员工与公司共同发展，促进公司长期、持续、健康发展，公司对管理人员、核心技术人员、骨干员工实施了股权激励计划。截至本招股说明书签署日，公司共有鑫之同、鑫之志、鑫之道、鑫之源、鑫之合五个员工持股平台，其分别持有公司 1.20%、1.17%、0.88%、0.85%、0.14%的股权。

（一）股权激励实施情况及相关安排

1、员工持股平台基本情况

截至本招股说明书签署日，公司员工持股平台基本情况如下：

（1）鑫之同

企业名称	新沂鑫之同企业管理合伙企业（有限合伙）	成立时间	2020 年 12 月 11 日
执行事务合伙人	上海鑫澈科技发展有限公司		
认缴出资额	1,424.37 万元	实缴出资额	953.51 万元
注册地和主要生产 经营地	新沂市唐店街道工业园 07 栋		
主营业务及与发行 人主营业务的关系	员工持股平台，除股权投资发行人外，未经营其他业务。		

截至本招股说明书签署日，鑫之同出资人构成及出资比例如下：

单位：万元

序号	合伙人名称 /姓名	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
1	上海鑫澈科技发展有限公司	普通合伙人	0.26	0.0183%
2	许继海	有限合伙人	526.24	36.9455%
3	李明峰	有限合伙人	140.11	9.8366%
4	韩锋	有限合伙人	110.51	7.7585%
5	王海豹	有限合伙人	90.74	6.3705%
6	徐玲锋	有限合伙人	57.85	4.0614%
7	吴锋	有限合伙人	57.85	4.0614%
8	孔令群	有限合伙人	21.71	1.5242%
9	高召帅	有限合伙人	21.71	1.5242%
10	王德芸	有限合伙人	21.71	1.5242%
11	李福中	有限合伙人	21.71	1.5242%
12	仝礼	有限合伙人	16.45	1.1549%
13	吴家印	有限合伙人	16.45	1.1549%
14	姜浩	有限合伙人	16.45	1.1549%
15	鑫之同一号	有限合伙人	12.56	0.8818%
16	史言回	有限合伙人	12.50	0.8776%
17	赵金波	有限合伙人	12.50	0.8776%
18	徐汉清	有限合伙人	12.50	0.8776%
19	陈卓	有限合伙人	12.50	0.8776%
20	孟锦	有限合伙人	12.50	0.8776%
21	齐兰兰	有限合伙人	12.50	0.8776%
22	侯杰	有限合伙人	12.50	0.8776%
23	刘永辉	有限合伙人	11.84	0.8312%
24	李祥飞	有限合伙人	9.21	0.6466%
25	单顺林	有限合伙人	9.21	0.6466%
26	姚旺	有限合伙人	9.21	0.6466%
27	丁力	有限合伙人	9.21	0.6466%
28	李兆	有限合伙人	9.21	0.6466%
29	刘松	有限合伙人	9.21	0.6466%
30	侯晓辉	有限合伙人	9.21	0.6466%
31	郭方超	有限合伙人	9.21	0.6466%

序号	合伙人名称 /姓名	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
32	李超刚	有限合伙人	9.21	0.6466%
33	王帅	有限合伙人	9.21	0.6466%
34	孙志东	有限合伙人	9.21	0.6466%
35	万首正	有限合伙人	9.21	0.6466%
36	张波	有限合伙人	9.21	0.6466%
37	李彩凤	有限合伙人	9.21	0.6466%
38	王永超	有限合伙人	9.21	0.6466%
39	张颖	有限合伙人	9.21	0.6466%
40	闫家强	有限合伙人	9.21	0.6466%
41	张旭	有限合伙人	9.21	0.6466%
42	王波涛	有限合伙人	5.26	0.3693%
43	刘永贺	有限合伙人	4.60	0.3229%
44	董丙军	有限合伙人	4.60	0.3229%
45	鲍琳	有限合伙人	4.60	0.3229%
46	胡猛	有限合伙人	1.97	0.1383%
47	董乐	有限合伙人	1.97	0.1383%
48	蒋翰文	有限合伙人	1.97	0.1383%
49	彭忠	有限合伙人	1.97	0.1383%
合计		-	1,424.37	100.0000%

鑫之同一号系公司为增加鑫之同股权平台员工可容纳人数而设立的新平台。
截至本招股说明书签署日，其基本信息如下：

企业名称	新沂鑫之同一号企业管理 合伙企业（有限合伙）	成立时间	2025 年 9 月 22 日
执行事务合伙人	上海鑫澈科技发展有限公司		
认缴出资额	12.56 万元	实缴出资额	12.56 万元
注册地和主要生产 经营地	新沂市锡沂高新技术产业开发区人力资源产业园一楼 101		
主营业务及与发行 人主营业务的关系	员工持股平台，除间接股权投资发行人外，未经营其他业务。		

鑫之同一号出资人构成及出资比例如下：

单位：万元

序号	合伙人名称 /姓名	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
1	上海鑫澈科技发展有	普通合伙人	0.06	0.4777%

序号	合伙人名称 /姓名	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
	限公司			
2	李宪文	有限合伙人	7.90	62.8981%
3	耿兴振	有限合伙人	4.60	36.6242%
合计		-	12.56	100.0000%

(2) 鑫之志

企业名称	新沂鑫之志企业管理合伙企业（有限合伙）	成立时间	2020 年 12 月 11 日
执行事务合伙人	上海鑫澈科技发展有限公司		
认缴出资额	1,385.98 万元	实缴出资额	607.44 万元
注册地和主要生产 经营地	新沂市唐店街道工业园 05 栋		
主营业务及与发行 人主营业务的关系	员工持股平台，除股权投资发行人外，未经营其他业务。		

截至本招股说明书签署日，鑫之志出资人构成及出资比例如下：

单位：万元

序号	合伙人名称 /姓名	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
1	上海鑫澈科技发展有限公司	普通合伙人	0.05	0.0036%
2	田新	有限合伙人	973.54	70.2420%
3	赵培芝	有限合伙人	57.84	4.1732%
4	江宏富	有限合伙人	40.78	2.9423%
5	赵琳迪	有限合伙人	32.89	2.3731%
6	胡永吉	有限合伙人	21.71	1.5664%
7	周复礼	有限合伙人	21.70	1.5657%
8	田晓东	有限合伙人	19.73	1.4235%
9	邹美富	有限合伙人	19.73	1.4235%
10	李貌	有限合伙人	16.45	1.1869%
11	沈梦	有限合伙人	13.16	0.9495%
12	拾艳秋	有限合伙人	13.16	0.9495%
13	姚焕龙	有限合伙人	13.16	0.9495%
14	张春伟	有限合伙人	9.87	0.7121%
15	李成	有限合伙人	9.87	0.7121%
16	胡鹏	有限合伙人	9.87	0.7121%

序号	合伙人名称 /姓名	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
17	孙山虎	有限合伙人	8.55	0.6169%
18	王翠	有限合伙人	6.58	0.4748%
19	李亮亮	有限合伙人	6.58	0.4748%
20	张开端	有限合伙人	5.26	0.3795%
21	王继波	有限合伙人	5.26	0.3795%
22	陈龙	有限合伙人	4.60	0.3319%
23	董彩娟	有限合伙人	4.60	0.3319%
24	孙振宗	有限合伙人	4.60	0.3319%
25	王建	有限合伙人	4.60	0.3319%
26	孙培忠	有限合伙人	4.60	0.3319%
27	孙裕凤	有限合伙人	4.60	0.3319%
28	鑫之齐	有限合伙人	3.77	0.2720%
29	孙皖	有限合伙人	3.29	0.2374%
30	许玉明	有限合伙人	3.29	0.2374%
31	孙天晴	有限合伙人	3.29	0.2374%
32	冯向阳	有限合伙人	3.29	0.2374%
33	刘雨雨	有限合伙人	3.29	0.2374%
34	赵岩岩	有限合伙人	3.29	0.2374%
35	王龙	有限合伙人	3.29	0.2374%
36	赵敏捷	有限合伙人	2.09	0.1587%
37	解鹏	有限合伙人	1.97	0.1421%
38	杨册	有限合伙人	1.97	0.1421%
39	赵海船	有限合伙人	1.97	0.1421%
40	王子文	有限合伙人	1.97	0.1421%
41	张玉豹	有限合伙人	1.97	0.1421%
42	郭玉帅	有限合伙人	1.97	0.1421%
43	杨召	有限合伙人	1.97	0.1421%
44	张兰兰	有限合伙人	1.97	0.1421%
45	陈玉	有限合伙人	1.97	0.1421%
46	张安全	有限合伙人	1.97	0.1421%
47	史振	有限合伙人	1.97	0.1421%
48	赵春梅	有限合伙人	1.97	0.1421%

序号	合伙人名称 /姓名	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
合计		-	1,385.98	100.0000%

鑫之齐系公司为增加鑫之志股权平台员工可容纳人数而设立的新平台。截至本招股说明书签署日，其基本信息如下：

企业名称	新沂鑫之齐企业管理合伙企业（有限合伙）	成立时间	2026年3月20日
执行事务合伙人	上海鑫澈科技发展有限公司		
认缴出资额	3.77万元	实缴出资额	3.77万元
注册地和主要生产 经营地	新沂市锡沂高新技术产业开发区人力资源产业园三楼325室		
主营业务及与发行人 主营业务的关系	员工持股平台，除间接股权投资发行人外，未经营其他业务。		

鑫之齐出资人构成及出资比例如下：

单位：万元

序号	合伙人名称 /姓名	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
1	上海鑫澈科技发展有限公司	普通合伙人	0.05	1.3263%
2	刘韦辰	有限合伙人	1.32	35.0133%
3	嵇伟楠	有限合伙人	1.32	35.0133%
4	张秋颖	有限合伙人	1.08	28.6472%
合计		-	12.56	100.0000%

（3）鑫之道

企业名称	新沂鑫之道企业管理合伙企业（有限合伙）	成立时间	2020年12月11日
执行事务合伙人	上海鑫澈科技发展有限公司		
认缴出资额	1,047.92万元	实缴出资额	871.64万元
注册地和主要生产 经营地	新沂市唐店街道工业园08栋		
主营业务及与发行人 主营业务的关系	员工持股平台，除股权投资发行人外，未经营其他业务。		

截至本招股说明书签署日，鑫之道出资人构成及出资比例如下：

单位：万元

序号	合伙人名称 /姓名	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
1	上海鑫澈科技发展有限公司	普通合伙人	0.10	0.0095%

序号	合伙人名称 /姓名	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
2	方世琼	有限合伙人	276.28	26.3646%
3	廖璞	有限合伙人	100.64	9.6038%
4	张晓东	有限合伙人	87.49	8.3489%
5	神干	有限合伙人	57.85	5.5205%
6	崔会为	有限合伙人	53.94	5.1473%
7	张正阳	有限合伙人	52.58	5.0176%
8	吴鹏	有限合伙人	49.34	4.7084%
9	王付刚	有限合伙人	42.76	4.0805%
10	袁北京	有限合伙人	29.60	2.8246%
11	卢文	有限合伙人	21.71	2.0717%
12	孙江桥	有限合伙人	19.73	1.8828%
13	李亚	有限合伙人	16.45	1.5698%
14	桑九龙	有限合伙人	12.50	1.1928%
15	周海	有限合伙人	12.50	1.1928%
16	张思楠	有限合伙人	12.50	1.1928%
17	刘若超	有限合伙人	12.50	1.1928%
18	黄明明	有限合伙人	12.50	1.1928%
19	徐友为	有限合伙人	11.84	1.1299%
20	李貌	有限合伙人	9.88	0.9428%
21	张建立	有限合伙人	9.87	0.9419%
22	王镇	有限合伙人	6.58	0.6279%
23	庞磊	有限合伙人	6.58	0.6279%
24	王宏宇	有限合伙人	6.58	0.6279%
25	欧明	有限合伙人	6.58	0.6279%
26	耿庆智	有限合伙人	6.58	0.6279%
27	武体伟	有限合伙人	6.58	0.6279%
28	齐丹丹	有限合伙人	6.58	0.6279%
29	李瑞志	有限合伙人	6.58	0.6279%
30	张倩倩	有限合伙人	6.58	0.6279%
31	李峰	有限合伙人	6.58	0.6279%
32	孔福河	有限合伙人	6.58	0.6279%
33	梁稳稳	有限合伙人	6.58	0.6279%

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
34	蒋梦丽	有限合伙人	5.26	0.5019%
35	王玲	有限合伙人	5.26	0.5019%
36	陈肖肖	有限合伙人	5.26	0.5019%
37	张鹏	有限合伙人	5.26	0.5019%
38	冯蒙蒙	有限合伙人	5.26	0.5019%
39	姜皓文	有限合伙人	4.60	0.4390%
40	曹广胜	有限合伙人	4.60	0.4390%
41	周伟生	有限合伙人	4.60	0.4390%
42	吴冬	有限合伙人	4.60	0.4390%
43	杨旭	有限合伙人	4.60	0.4390%
44	赵瑞磊	有限合伙人	3.29	0.3140%
45	王智超	有限合伙人	3.29	0.3140%
46	刘婷	有限合伙人	3.29	0.3140%
47	李波	有限合伙人	3.29	0.3140%
48	王坤	有限合伙人	1.97	0.1880%
49	崔乐	有限合伙人	1.97	0.1880%
合计		-	1,047.92	100.0000%

（4）鑫之源

企业名称	新沂鑫之源企业管理合伙企业（有限合伙）	成立时间	2020年12月11日
执行事务合伙人	上海鑫澈科技发展有限公司		
认缴出资额	1,006.53 万元	实缴出资额	205.10 万元
注册地和主要生产经营地	新沂市唐店街道金唐社区三楼 305		
主营业务及与发行人主营业务的关系	员工持股平台，除股权投资发行人外，未经营其他业务。		

截至本招股说明书签署日，鑫之源出资人构成及出资比例如下：

单位：万元

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
1	上海鑫澈科技发展有限公司	普通合伙人	0.10	0.0099%
2	蒋文武	有限合伙人	986.70	98.0299%
3	田新	有限合伙人	19.73	1.9602%
合计		-	1,006.53	100.0000%

(5) 鑫之合

企业名称	新沂鑫之合企业管理合伙企业（有限合伙）	成立时间	2020 年 12 月 14 日
执行事务合伙人	上海鑫澈科技发展有限公司		
认缴出资额	167.08 万元	实缴出资额	167.08 万元
注册地和主要生产 经营地	徐州市新沂市唐店街道工业园 10 栋		
主营业务及与发行 人主营业务的关系	员工持股平台，除股权投资发行人外，未经营其他业务。		

截至本招股说明书签署日，鑫之合出资人构成及出资比例如下：

单位：万元

序号	合伙人名称 /姓名	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
1	上海鑫澈科技发展有限公司	普通合伙人	0.01	0.0060%
2	宫尾秀一	有限合伙人	65.78	39.3704%
3	刘佳	有限合伙人	40.79	24.4135%
4	于刚	有限合伙人	9.21	5.5123%
5	王斌鸿	有限合伙人	9.21	5.5123%
6	张海洋	有限合伙人	9.21	5.5123%
7	吴湘	有限合伙人	9.21	5.5123%
8	张磊	有限合伙人	4.60	2.7532%
9	刘辉	有限合伙人	4.60	2.7532%
10	陈学辉	有限合伙人	4.60	2.7532%
11	陈冬	有限合伙人	3.28	1.9631%
12	宋昊炜	有限合伙人	1.32	0.7900%
13	赵康乐	有限合伙人	0.56	0.3352%
14	侯力	有限合伙人	0.56	0.3352%
15	吴凯	有限合伙人	0.56	0.3352%
16	赵宝常	有限合伙人	0.56	0.3352%
17	张思庆	有限合伙人	0.56	0.3352%
18	李争元	有限合伙人	0.56	0.3352%
19	朱润	有限合伙人	0.56	0.3352%
20	徐国旺	有限合伙人	0.56	0.3352%
21	程强	有限合伙人	0.56	0.3352%
22	张秋颖	有限合伙人	0.22	0.1317%

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额	出资比例
	合计	-	167.08	100.0000%

上述 ESOP 平台的普通合伙人均为上海鑫澈科技发展有限公司，其上层股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称/姓名	认缴出资额	出资比例
1	田新	0.60	60.00%
2	蒋文武	0.40	40.00%
	合计	1.00	100.00%

2、持股平台人员出现离职等情形后的股份处理

截至本招股说明书签署日，各持股平台的员工均为发行人在职或已退休员工。根据《江苏鑫华半导体科技股份有限公司股权激励管理办法》（“股权激励管理办法”）的规定：

（1）若持股平台人员在服务期届满前离职（退休除外），应在离职之前退还其退出或转让其认购的标的份额时，扣除其对持股平台的实缴出资后取得的收益；若在服务期内退休，则归属该退休人员的份额=其已经完成的服务期年数/服务期×授予其的份额，不归属于其或其不希望保留的份额，转让予符合本办法规定的其他人员，转让该等标的份额的价格原则上与持有人认缴标的份额的价格一致（若公司与退休人员协商一致，达成退休返聘，则计算归属该退休人员的份额时，其已完成的服务期年数含返聘时间）。

（2）若持股平台人员在服务期届满后离职：1）如公司仍未完成首次公开发行股票并上市，所持标的份额可以自行处置；2）如公司实现首次公开发行股票并上市，锁定期届满前，原则上不得退出；锁定期届满后，提出退出或转让申请，持有人可按照转让双方约定的价格将其认购的标的份额转让予普通合伙人或其指定的其他有限合伙人或其他符合本方案规定条件的人员，或通过持股平台在二级市场中减持退出。

3、员工持股平台的锁定期和减持安排

关于员工持股平台出具的股份锁定及减持的承诺，请参见本招股说明书之“第十二节、三、（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、

延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

根据股权激励管理办法的规定，持有人在公司的服务期不低于自持有人取得其认购的标的份额起 5 年。

股权激励对象在公司上市且锁定期届满后，可于每个会计年度的 1 月、7 月向执行事务合伙人申请减持。经执行事务合伙人同意后，按照转让双方约定的价格将其认购的标的份额转让予普通合伙人或其指定的其他有限合伙人或其他符合本方案规定条件的人员；或由持股平台减持相应的公司股票，并将扣除税费等相关费用后的售股所得分配给该激励对象。

股权激励对象在公司上市且锁定期届满后，由执行事务合伙人或持有人会议决定共同减持的，可通过持股平台出售其所持有的公司股票，并将扣除税费等相关费用后的售股所得根据股权激励管理办法的约定向全体对象分配。

4、员工持股平台无需备案

发行人持股平台在设立过程中不存在通过非公开方式向投资者募集资金的情形，合伙人均为公司员工，按照《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律法规的规定及合伙协议的约定行使出资人权利，不存在通过聘请管理人管理其日常经营及对外投资等经营性事宜的情形；除针对发行人的专项投资外，未对外投资其他任何主体。因此，发行人持股平台不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需按照前述规定办理私募投资基金管理人登记手续或私募投资基金备案手续。

（二）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化的影响

1、对公司经营情况的影响

通过实施股权激励计划，公司建立健全了激励机制，充分调动了公司管理人员、核心技术人员、骨干员工的工作积极性，实现了股东目标、公司目标及员工目标的统一，提升了公司经营效率。

2、对公司财务状况的影响

报告期内，发行人因实施股权激励确认计入利润表的股份支付费用分别为

1,859.57 万元、1,853.10 万元和 **2,093.49** 万元，相关费用已计入当期损益，对发行人财务状况不构成重大不利影响。

3、对公司控制权的影响

报告期内，在股权激励实施前后发行人的控制权未发生变化。

（三）上市后的行权安排

截至本招股说明书签署日，公司上述股权激励计划已实施完毕，不涉及上市后行权安排。

十一、发行人员工及社会保障情况

（一）员工人数及构成

报告期各期末，公司员工总数分别为 497 人、802 人、895 人和 **937** 人。

截至报告期末，公司员工专业结构如下：

单位：人

类别	人数	占总人数比例
行政管理人员	88	9.39%
生产人员	667	71.18%
采购人员	32	3.42%
销售人员	14	1.49%
研发人员	136	14.51%
合计	937	100.00%

（二）社保和公积金缴费情况

报告期内，发行人及其境内子公司员工社保、公积金缴纳人数情况如下：

单位：人

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
期末职工人数	937	895	802
参保职工人数	937	886	793
其中：第三方代缴人数	85	91	93
代缴比例	9.07%	10.17%	11.60%
未参保职工人数	6	9	9

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
未参保原因	6 名员工为退休返聘人员无需缴纳	6 名员工为退休返聘人员无需缴纳；3 名当月新入职员工已由原单位缴纳	5 名员工为退休返聘人员无需缴纳；3 名员工于 2024 年 1 月补缴；1 名员工当月 15 号入职，上家公司已缴
住房公积金缴纳人数	932	887	796
其中：第三方代缴人数	85	91	93
代缴比例	9.12%	10.17%	11.60%
未缴纳住房公积金人数	7	8	6
未缴纳住房公积金原因	6 名员工为退休返聘人员无需缴纳；1 名员工非中国大陆居民，不强制要求缴纳公积金	6 名员工为退休返聘人员无需缴纳；1 名员工因当月下旬入职，次月起开始缴纳公积金；1 名员工非中国大陆居民，不强制要求缴纳公积金	5 名员工为退休返聘人员无需缴纳；1 名员工因当月下旬入职，次月起开始缴纳公积金

注：2025 年 12 月，公司缴纳社保员工中有 6 名于当月离职，缴纳公积金员工中有 2 名于当月离职，因此期末人数存在差异。

根据徐州市人力资源和社会保障局、呼和浩特市人力资源和社会保障局、湖北省十堰市郧阳区人力资源和社会保障局出具的证明及《江苏省企业上市合法合规信息核查报告》，发行人报告期内已按规定进行了社会保险登记，不存在因违反劳动和社会保险相关法律、法规、规章和规范性文件而受到行政处罚的情形。根据徐州市住房公积金管理中心、呼和浩特市住房公积金中心和十堰住房公积金中心郧阳办事处出具的证明，发行人报告期内未因违反有关住房公积金法律、法规而受到行政处罚的情形。

（三）劳务派遣情况

报告期内，发行人存在劳务派遣用工的情形，报告期各期末劳务派遣用工具体情况如下：

单位：人

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
劳务派遣人数	9	7	3
正式员工人数	937	895	802
用工总人数	946	902	805
劳务派遣人数占公司用	0.95%	0.78%	0.37%

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
工人数比例			

报告期内，发行人不存在劳务派遣人数超 10%的情况。

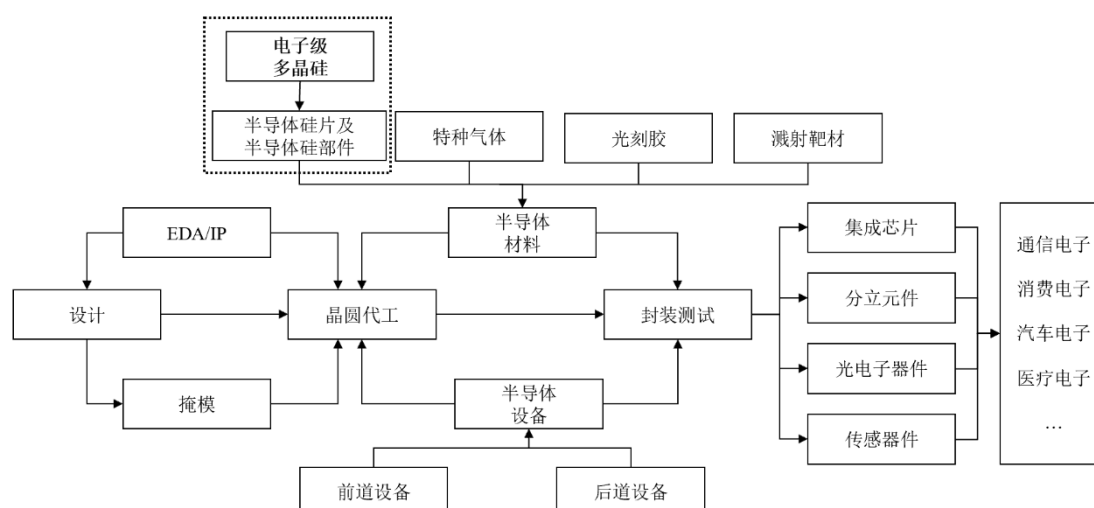
第五节 业务与技术

一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况

（一）发行人主营业务、主要产品或服务

1、主营业务情况

公司主要从事半导体产业用电子级多晶硅的研发、生产与销售。半导体制造产业链始于电子级多晶硅，至半导体硅片和晶圆制造，最终产出集成电路芯片用于终端产品。作为我国实现高水平科技自立自强的重要产业领域，半导体制造产业具有重大战略意义。公司生产的电子级多晶硅是支撑整个半导体制造产业的关键基础材料，直接应用于半导体硅片与半导体用硅部件生产。



目前半导体硅材料产业市场规模占半导体制造材料市场规模的 30%左右，是半导体制造中占比最高的主材料。普通工业硅纯度为 98%左右，而半导体制造对电子级多晶硅技术指标要求十分严苛，当硼、磷或其他金属元素作为杂质存在于多晶硅中时，制成的硅片产品质量难以控制，因此需要极高的多晶硅纯度，对纯度要求需达到 11N（即 99.99999999%）以上，施主杂质含量和受主杂质含量均需达到 ppta（万亿分之一原子比）级别，且需在万吨级大规模生产中维持技术指标的高度一致性。自 20 世纪 80 年代以来，高纯电子级多晶硅作为行业基础原材料，技术被德国、美国、日本少数企业所垄断，全球具备成熟技术、能够大规模稳定供应的厂商在 5 家以内，国内市场化供应能力几乎为零，严重制约中国半导体产业的发展。为了解决国产化替代难题，公司自成立以来，坚持以科技创新为

核心，致力于关键技术的研究和开发，先后建成徐州 5,000 吨/年（后扩产至 8,000 吨/年）和内蒙 10,000 吨/年电子级多晶硅生产线，成功实现半导体产业用电子级多晶硅的大规模稳定生产，打破了国外在技术与市场上的双重垄断，填补了国内相关领域的空白。公司电子级多晶硅各项关键指标已全面达到国际先进水平，顺利通过国内外主流客户验证，产品应用领域实现了从 12 英寸硅片、6-8 英寸硅片至小尺寸硅片及硅部件的全覆盖，保障国产硅片及硅部件产业的正常运行和发展。

目前，公司正在继续加大投入以攻克超高纯电子级多晶硅技术。超高纯电子级多晶硅是电子级多晶硅中的全球前沿产品，包括超高阻电子级多晶硅和区熔用多晶硅，纯度可达到 13N 以上。其中，超高阻电子级多晶硅较普通电子级多晶硅电阻率更高、杂质含量更低，是先进制程集成电路的核心基材，其超高纯度与极低杂质特性直接决定芯片性能与功耗水平，是 AI 芯片、硅光子芯片等尖端集成电路性能跃升的重要基础，为我国集成电路制造领域向先进制程和高端化发展提供关键支撑。区熔用多晶硅是电子级多晶硅中占比相对较小但不可或缺、技术难度更高的部分，在 IGBT 功率器件、高端射频器件、微电子机械系统以及各类高精度探测器、传感器等战略领域具有关键应用价值。公司目前在超高阻电子级多晶硅和区熔用多晶硅的产品技术研发及生产方面均已取得突破性进展，相关产品通过部分国内外主流客户验证，并实现小批量出货。

此外，基于多年电子级多晶硅研发生产所积累的高纯硅基产品技术，公司正在积极进行硅基电子特气和高纯石英砂等围绕高纯硅基材料的多元化产品研究开发工作。

公司依托在电子级多晶硅领域的技术积累，积极承担国家及地方重大科技攻关任务。公司是国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》（02 专项）中《电子级多晶硅材料研发》的具体实施单位；公司承接的工业和信息化部“国家工业强基工程”项目，已顺利通过验收；同时，公司还承担了“江苏省工业和信息产业转型升级项目”“江苏省关键核心技术攻关项目”以及“江苏省重点研发计划项目”等多项省级重点科技专项。此外，公司积极参与国家及行业标准体系建设，作为牵头单位完成了最新版《电子级多晶硅》（GB/T 12963-2022）国家标准的修订，并参与多项国家标准、行业标准的制定和修订工作。公司是国家级专精特新“小巨人”企业。

2、主要产品情况

多晶硅是单质硅的一种形态，是银灰色、有金属色泽的晶体，是以工业硅（纯度一般为 98%左右）为原料经一系列的物理化学反应提纯后达到纯度 6N（99.9999%）以上的非金属材料，具有半导体的特性。按纯度要求及用途不同，可以将多晶硅分为太阳能级多晶硅和电子级多晶硅，太阳能级多晶硅主要用于太阳能电池的生产制造，纯度一般达到 6N-9N（99.9999%-99.9999999%）；电子级多晶硅作为主要的半导体电子材料，广泛应用于人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等领域所需半导体产品，纯度需达到 11N（99.999999999%）以上，超高纯电子级多晶硅达到 13N（99.99999999999%）以上。

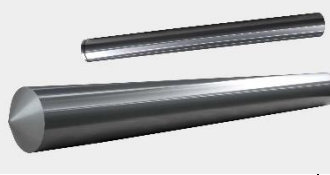
电子级多晶硅按照下游厂商制备单晶硅工艺的不同，可以分为直拉用多晶硅和区熔用多晶硅。

直拉用多晶硅是采用直拉法制备单晶硅的原料。直拉法（CZ 法）又称切克劳斯基法（Czochralski Method），是目前全球制备单晶硅的主要方法。由于在直拉制备单晶棒的过程中需要使用石英坩埚，其不可避免的会引入一定氧杂质。目前全球 85%以上硅片都由直拉法制备，其可用于制造 8 英寸和 12 英寸半导体抛光片、外延片、SOI 等各种硅片，主要应用于低功率的集成电路元件领域。直拉法也是半导体用硅部件的主要制备方法。

区熔用多晶硅是采用区熔法制备单晶硅的原料。区熔法（FZ 法）即悬浮区熔法（Floating Zone Method），在区熔法制备单晶的过程中不会使用石英坩埚，因此具有纯度高、含氧量低、污染度低、电阻率高（杂质分凝和蒸发效应）、耐高压的特性。区熔用电子级多晶硅是电子级多晶硅中占比较小但不可或缺的部分，目前全球约 15%的硅片由区熔法制备，在 IGBT 功率器件、高端射频器件、微电子机械系统以及各类高精度探测器、传感器等战略领域具有不可替代的关键应用价值。

报告期内，公司电子级多晶硅产品类型主要为直拉用多晶硅及区熔用多晶硅，直拉用多晶硅产品形态呈块状，有不同的尺寸规格，公司产品具体规格大小可以根据客户不同的配方需求进行设计。区熔用多晶硅产品形态呈棒状，区熔用多晶硅已通过部分国内外主流客户验证，并实现小批量出货。

公司主要产品介绍如下：

产品类别		主要应用	产品特征	示意图
区熔用多晶硅		主要用于生产区熔单晶，应用于 IGBT 功率器件、高端射频器件、微电子机械系统以及各类高精度探测器、传感器等战略领域	产品形态为棒状多晶硅，杂质含量较 P 级更低，且在内应力等指标上与直拉用电子级多晶硅有所区别	
直拉用多晶硅	J 级	主要用于生产先进制程用 12 英寸硅片、高阻硅片等产品	杂质含量较 P 级更低	
	P 级	主要用于生产大尺寸硅片、高等级硅部件	杂质含量极低，指标波动极小	
	S 级	主要用于生产中小尺寸硅片、硅部件等	杂质含量低，指标波动小	

3、主营业务收入构成

报告期内，发行人主营业务收入根据产品类别分类情况如下：

单位：万元

产品类别		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
区熔用多晶硅		1,858.43	1.07%	1,325.57	1.24%	84.74	0.10%
直拉用多晶硅	P 级	144,986.52	83.26%	81,918.37	76.77%	67,256.26	77.75%
	S 级	26,430.39	15.18%	22,250.02	20.85%	18,488.90	21.37%
其他主营业务		863.40	0.50%	1,207.74	1.13%	669.02	0.77%
合计		174,138.73	100.00%	106,701.69	100.00%	86,498.92	100.00%

注 1：公司其他主营业务产品包括碳化硅硅粉、电子特气、高纯石英砂等新产品，下同；

注 2：公司超高阻电子级多晶硅（J 级）目前实现小批量出货，金额较小，故与 P 级合并列示，下同。

（二）发行人主要经营模式、关键影响因素及未来变化趋势

1、主要经营模式

（1）销售模式

公司主要产品为电子级多晶硅，对于境内客户，公司主要采取直销模式向客户提供产品。对于部分境外客户及少数境内客户，公司通过贸易商向终端客户提供产品。

直销模式下，公司销售人员直接与电子级多晶硅需求企业进行对接，下游企业需要将公司的产品投炉进行长晶测试以及检查产品的相关参数。由于下游客户

的产品类型存在差异，公司产品经下游客户认证周期通常需要3个月至3年不等。客户认证公司产品的主要流程为：公司向客户提供样品→客户对样品进行检测→将样品投炉拉晶试验→对拉晶结果进行检测分析→对拉出的单晶棒进行后道切割、研磨、抛光实验→后道切割、研磨、抛光产品检测→合格样品送至下游 Fab 客户晶圆制造验证→晶圆样品封装芯片测试验证→最终产品端验证。

贸易商模式下，由贸易商与公司沟通多晶硅需求。公司向贸易商提供满足其要求的产品，贸易商再向其下游客户销售。贸易商自行承担销售风险，无质量问题无权退货，该模式下为卖断式销售。

（2）采购模式

公司面向市场独立开展采购业务，并制定了《物资采购管理制度》《供应商管理制度》《物资仓库管理制度》等一系列与采购相关的制度，有较为健全的采购管理制度和相对完善的供应商管理体系。

1）原材料采购的计划管理

公司根据市场和自身情况，制定年度生产计划、季度生产计划和月度生产计划。供应链管理部根据生产计划制定采购计划，并提交管理层审批后执行。

2）采购管理流程

公司建立了严格的采购管理流程。生产运营部依据生产需求提交请购需求。需求部门负责制定采购物资的技术标准。供应链管理部对采购工作实行统一管理，根据请购需求、原材料库存情况、市场供求、运输条件等制定采购计划，并进行询价比价/招投标、合同评审、合同签订以及供应商管理等。品质管理部负责在入库前对主要原材料进行检验，以保证原材料品质符合公司生产要求。原材料入库后，供应链管理部对供应商开具的发票签收并维护发送至审批，同时财经管理部按照采购合同、订单或协议约定的付款条款支付供应商货款。

对于硅粉、三氯氢硅等主要采购物资，公司与主要合格供应商签订年度采购合同，双方就产品规格型号及定价原则、采购量范围、质量标准、质量保证、包装方式及要求、运输和交货、付款方式等条款进行约定，并根据原材料库存情况和采购计划向供应商发出具体订单实施采购。

3）供应商管理

为了确保采购质量、供货的稳定性和价格合理，公司建立了完善的供应商管理制度，对供应商开发与选择、供应商评审、供应商的持续评估均有严格的要求和科学的管理。公司建立了健全的合格供应商开发制度。供应商需逐步通过公司供应商资质审查、送样检测合格、小量试用、中批量试用等开发流程，并通过综合评审后方可成为合格供应商，纳入合格供应商名录。

对于合格供应商，公司建立了日常评估和年度评估相结合的持续评估制度。公司每季度对一定数量的供应商进行评估。公司每年末由供应链管理部牵头各部门，对供应商进行年度综合评估。

（3）生产模式

公司生产部门根据与客户签订的长期供货协议、具体合同及订单、公司产能、对市场的预期判断、年度检修计划等综合考虑制定年度生产计划、季度生产计划和月度生产计划，并组织生产。

报告期内，公司精馏、还原和后处理等生产环节主要采用自主生产的生产模式，在公司冷氢化生产装置建成之前，公司曾委托中能硅业加工生产所需的三氯氢硅，随着 2022 年底公司冷氢化生产装置建成并且产能逐渐爬升、稳定，公司三氯氢硅逐渐从委外加工模式转为自主加工模式。三氯氢硅自主加工模式为：公司直接采购硅粉，通过自建的冷氢化生产装置反应生成三氯氢硅。三氯氢硅委外加工模式为：公司将尾气回收并经分离提纯后的四氯化硅、二氯二氢硅和部分氢气通过管道运分别送至加工方冷氢化和反歧化生产装置，加工方根据原材料类别分别使用冷氢化工艺和反歧化工艺加工三氯氢硅，并通过管道将三氯氢硅返回给公司，公司根据合同约定支付加工费。

2、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

半导体产业属于技术密集型行业，上下游紧密相关，环环相扣，对产品的质量要求高。公司从事半导体产业用电子级多晶硅的生产，下游客户相对集中，对产品的质量要求高，认证周期较长。公司采用上述经营模式是由行业特点决定的。公司已形成稳定成熟的电子级多晶硅生产工艺，其生产模式在可预见的未来发生

重大变化的可能性较小，其采购模式和销售模式可能因上下游市场格局等的变化而发生相应的变化。公司经营模式在报告期内未发生重大变化，预计未来短期内亦不会发生重大变化。

（三）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

公司设立于 2015 年，自设立至今，一直从事电子级多晶硅的研发、制造与销售。公司设立以来的发展阶段演变情况如下：

1、2015 年至 2017 年，研发及产线建设阶段

电子级多晶硅是国家发展集成电路产业的战略性基础原材料，生产技术和市场一直被国外企业所垄断，国内电子级多晶硅材料几乎完全依赖进口，供应长期受制于人。为解决电子级多晶硅长期受制于人的状况，2014 年 6 月，国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，确定其为重点发展方向之一；同年 9 月，国家设立国家集成电路产业投资基金推进纲要实施；2015 年 12 月，国家集成电路产业投资基金与中能硅业共同投资成立鑫华半导体，作为科技部国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》（02 专项）子课题《电子级多晶硅材料研发》课题具体实施单位。

自 2015 年成立以来，公司专注于如何将当时国内多晶硅的太阳能级纯度提升至适用于集成电路制造的超高纯度。公司技术团队经过长达 3 个月的反复推演和讨论，查阅了大量基础研究数据，并翻译研究了超过 100 篇国际公开专利信息及参考了 SEMI、JEITA 标准超 50 项，最终确定了整套提纯系统的工艺路线、核心技术参数和关键操作范围。

在 2016 年至 2017 年间，公司围绕电子级多晶硅“量产工艺—痕量提纯技术—反应控制—产品表面精制技术—智能装备技术”等产业关键环节，依靠国内制造业规模化优势，对大型专用设备进行了多次材料试验验证。公司在产线研发建设方面反复技术攻关，通过超过 300 次生产试验和超过 600 项技术和设备的优化改进，攻克了电子级多晶硅成套稳定量产工艺的业界难题，成功建成了 5,000 吨级的大规模生产线。这一成就标志着公司在电子级多晶硅领域的重大突破，有效缓解了国内对该材料的依赖。

2、2017 年至 2018 年，设备工艺调试、升级，检测能力提升，产品开始验证

2017 年至 2018 年，公司电子级多晶硅开始设备及工艺调试，在产线完善及工艺升级方面持续投入，产品质量逐步、稳定提升。2018 年公司电子级多晶硅产出后，原有太阳能级多晶硅的检测方法已经完全不能满足产品要求，为实现精准表征电子级多晶硅的质量，公司检测团队建立针对高纯多晶硅样品检测方案，经过数月实验，共累积数百组数据，成功突破了超痕量杂质检测的瓶颈，金属杂质的单元素检测限降至 1pptw（万亿分之一质量比），充分发挥检测方法和仪器的极限。公司检测团队不论从仪器选型、团队经验和构成，还是到检测技术论证和环境要求，均全面对标国际先进水平，完全具备表征电子级多晶硅质量的能力，为公司提升产品质量奠定了坚实基础，产品开始在客户验证。

3、2019 年至 2023 年，产品大规模通过验证，市场持续拓展阶段

2019 年至 2020 年，公司持续研发投入进入良率爬坡、指标提升、客户验证关键环节，半导体硅片企业对电子级多晶硅要求严苛，对供应商的选择非常慎重，认证周期可长达 2-3 年，通常不会更换。在国产化背景下，公司产品进入国内硅片产业链进行验证，并通过三年左右时间，凭借逐渐达到国际先进水平的产品指标大规模通过验证，在国内主流硅片厂商逐步形成销售，并在中国台湾、韩国等海外市场形成了规模化销售。2021 年，公司的电子级多晶硅已实现在 12 英寸硅片上的规模化应用，有效替代了进口，为国内高端集成电路产业的安全稳定发展奠定了坚实基础。2022 年至 2023 年，公司电子级多晶硅产品在国内已经取得了较高市场地位，市场占有率较高，被国内几乎全部领先的半导体硅片企业验证和采用。

4、2024 年至今，产能扩充，研发及验证更高要求的产品

为弥补国产替代的产能缺口，公司全力推进内蒙 10,000 吨/年电子级多晶硅产线项目建设。至 2024 年 12 月底，公司成功攻克超大规模产线各项技术难题，完成全部生产装置调试任务，内蒙产线开始正式投产。依托徐州产线技术积淀，内蒙产线在技术工艺、产线现代化、可持续发展等方面均有明显提升。内蒙产线实现满产后，如不考虑区熔用多晶硅对产能的占用，公司电子级多晶硅年产能将

大幅提升，能够更高程度上覆盖国内半导体硅片厂商对电子级多晶硅的需求缺口，极大缓解长期以来国内市场对进口产品的依赖局面，有力推动国内半导体行业在关键原材料领域实现自主可控。

同时，为了满足国内先进制程集成电路、高端半导体器件等产品对超高纯电子级多晶硅的需求，公司正在加大投入以攻克超高纯电子级多晶硅技术，包括超高阻电子级多晶硅和区熔用多晶硅产品技术研发。由于超高纯电子级多晶硅制备难度极大，对过程管控、工艺技术路线及检测分析方法等要求极高，国外对相关技术进行了高度控制和封锁，国内产业在超高纯电子级多晶硅产品研发仍处于显著落后阶段，公司积极布局超高纯电子级多晶硅产品研发及市场开拓，目前已经在技术研发及生产方面取得了突破性进展。

其中，超高阻电子级多晶硅电阻率更高，杂质含量更低，需满足电阻率 $\geq 10000\Omega\cdot\text{cm}$ 的严苛标准，可用于性能、功耗、成本等方面要求更高的 AI 芯片、硅光子芯片等先进制程集成电路产品。公司攻克了超高纯材料制备中的“痕量杂质控制”与“超净加工”双重难题，成功打破国外技术垄断，目前已经实现超高阻电子级多晶硅的小批量出货。区熔用多晶硅的纯度通常需要达到 13N 以上，具有更低氧含量和更高少子寿命、更高电阻率等特性，因此在 IGBT 功率器件、高端射频器件、微电子机械系统以及各类高精度探测器、传感器等战略领域有着关键应用，属于半导体产业链条不可替代的特种原材料。公司自 2021 年起专注于区熔用多晶硅棒的研究，经过多年技术攻关，公司显著提升了区熔用多晶硅棒的拉晶率，使得公司能够稳定产出品质卓越、均匀性极佳的区熔用多晶硅产品，产品性能达到行业先进水平，已通过部分国内外主流客户验证，实现小批量出货。

（四）主要业务经营情况和核心技术产业化情况

公司自设立以来，始终坚持以市场竞争力为导向，以前瞻性战略定位和产业布局为引领，持续开展技术开拓、产品开发与工艺升级，成功实现了从核心技术到产业化产品的高效转化，现已成长为国内知名的电子级多晶硅生产企业。

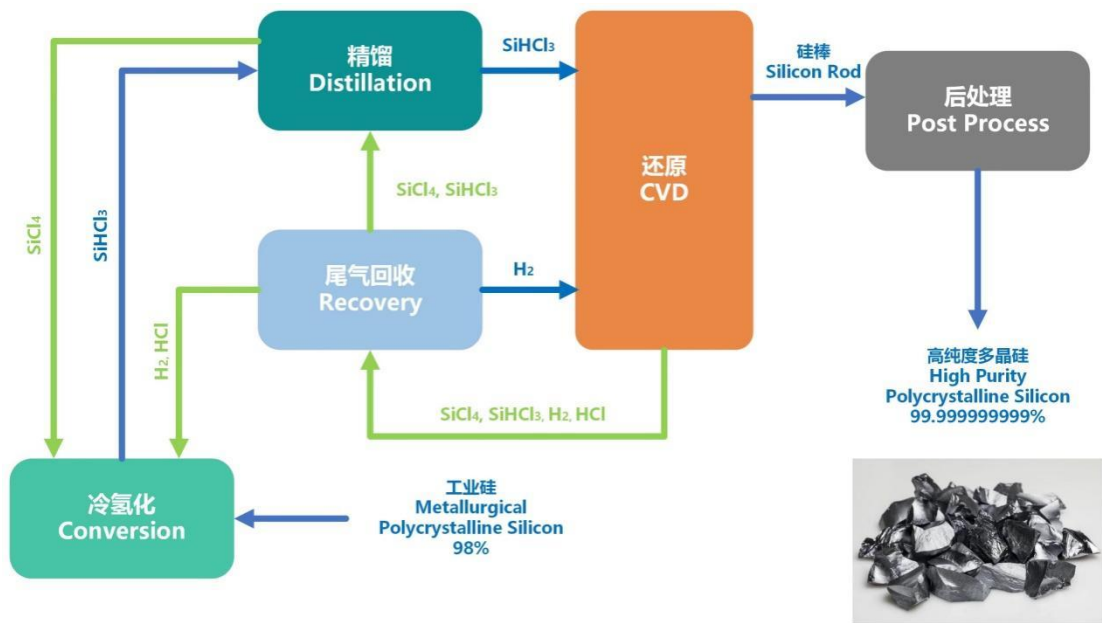
作为半导体制造产业链的关键基础材料供应商，公司产品已通过国内几乎所有主流半导体硅片企业的验证并实现批量应用，客户覆盖西安奕材、沪硅产业、TCL 中环、Ferrotec、立昂微、有研硅、中晶科技等前十大硅片厂商，并已进入

国际一线硅片制造商的供应链体系，有力支撑了国内大尺寸硅片产业链的发展，实现了科技成果与半导体制造环节的深度融合。

报告期内，公司核心技术产品产生的收入分别为 93,448.13 万元、107,312.88 万元和 177,855.24 万元， 占各期营业收入的比例分别达 98.75%、96.71%和 99.30%。根据中国电子材料行业协会半导体材料分会统计数据，2025 年公司在国内集成电路用高纯电子级多晶硅市场占有率位居第一，核心技术产业化成效显著。

（五）发行人主要产品工艺流程图

公司主要产品为半导体产业用电子级多晶硅，主要工艺为改良西门子法。该工艺包括冷氢化、精馏、还原、尾气回收和后处理五个主要工序，工艺流程图如下：



主要工序具体内容如下：

工序	内容
冷氢化	冷氢化工艺作为电子级多晶硅制备的核心工序，通过硅粉与四氯化硅定向合成三氯氢硅，反应过程伴随多组分副产物及痕量杂质生成。为实现杂质精准控制与高效去除，公司构建双重技术保障：基于先进控制系统对反应温度、压力、物料配比及气速进行毫秒级动态优化，确保反应过程处于热力学平衡态；同步建立高洁净材料选型标准及全流程清洁管控体系，从源头抑制杂质渗透风险，保障产品纯度达电子级标准
精馏	针对三氯氢硅中 P、B、C 等沸点近邻杂质的提纯难题，公司开发了“冷凝-吸收-吸附”联用工艺，通过“精馏-吸附”双重作用与“精馏-络合”定向富集技术，实

工序	内容
	现了杂质的高效两级去除，为下一阶段还原工序提供稳定的高纯度三氯氢硅
还原	还原工艺通过三氯氢硅与氢气在还原炉内的化学气相沉积制备电子级多晶硅棒，核心挑战在于沉积均匀性控制、杂质渗透抑制及热应力引发的硅棒断裂。公司创新构建还原炉晶体生长数字孪生模型，结合多物理场仿真技术精准解析炉内温度场、流场及反应动力学特性，优化工艺参数与配方设计，显著提升沉积均匀性并降低杂质浓度，同步攻克热应力分布不均导致的倒棒、棒裂难题
尾气回收	尾气回收工序通过“冷凝-吸收-吸附”联用工艺攻克氢气中磷烷、硼烷等轻杂质脱除难题：针对还原炉转化生成的磷/硼杂质在氢气循环中富集导致多晶硅质量波动的痛点，创新融合气液分离、选择性溶解与高效吸附技术，显著降低氢气杂质含量；同步构建闭环循环体系——分离提纯后的氢气返回还原工序复用，氯硅烷组分（三氯氢硅/四氯化硅）经精馏分级处理，三氯氢硅回用至沉积环节，四氯化硅定向输送至氢化装置再生
后处理	后处理系统通过破碎、酸洗、包装等环节将还原硅棒加工为电子级多晶硅产品，核心挑战在于破碎环节的金属污染控制与酸洗工艺的杂质深度脱除。公司创新开发无接触式高压脉冲破碎技术，通过能量场驱动实现硅棒零机械接触破碎，杜绝铁、锌等金属杂质引入；同步构建多池混酸智能刻蚀体系，采用硝酸/氢氟酸分区协同控制技术，实现刻蚀液配比动态优化与表面反应精准调控，有效消除酸斑并提升杂质去除效率

（六）具有代表性的业务指标

报告期内，公司具有代表性的业务数据，包括产品种类、产销量及收入规模等，整体呈现持续增长态势。相关业务数据的变动情况及原因请详见本节之“三、（一）发行人主要产品的产能、产量、销量、产销率情况”和本招股说明书之“第六节、八、经营成果分析”中的有关内容。

（七）符合产业政策和国家经济发展战略的情况

公司主要从事电子级多晶硅的研发、生产与销售。电子级多晶硅是国家发展集成电路产业的战略性基础原材料，对保障我国半导体产业链安全、推动集成电路产业自主可控具有重要意义。

根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业归属于“3 新材料产业”之“3.4 先进无机非金属材料”之“3.4.3 人工晶体制造”中的“3.4.3.1 半导体晶体制造”，对应《国民经济行业分类（GB/T 4754 - 2017）》中“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”项下的“C3985 电子专用材料制造”。同时，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司业务属于“鼓励类”范畴，具体为第九条第 4 款“新材料”中明确列出的“半导体、芯片用电子级多晶硅（包括区熔用多晶硅材料）”，系国家明确鼓励发展的战略性新兴产业。

近年来，国家陆续出台多项产业政策与战略规划，大力支持电子级多晶硅等关键半导体材料的技术攻关与产业化发展。相关政策内容详见本招股说明书“第五节 二、（二）行业主管部门、行业监管体制、主要法律法规政策及影响”部分。

综上，发行人主营业务及核心产品符合国家产业政策导向和经济发展战略，属于国家明确鼓励发展的重点领域。

二、发行人所处行业基本情况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

公司主要从事半导体产业用电子级多晶硅的研发、生产与销售。根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“C3985 电子专用材料制造”；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业属于“3 新材料产业”之“3.4 先进无机非金属材料”之“3.4.3 人工晶体制造”之“3.4.3.1 半导体晶体制造”；根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司所属行业属于“鼓励类”，第九条第 4 款“新材料”中“半导体、芯片用电子级多晶硅（包括区熔用多晶硅材料）”。

（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策及影响

1、行业主管部门和监管体制

公司所处行业的主管部门为国家发改委、工业和信息化部，行业自律组织为中国半导体行业协会、集成电路材料产业技术创新战略联盟、国际半导体设备与材料协会等。

国家发改委的主要职责是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，指导推进和综合协调经济体制改革以及经济结构战略性调整等。

工业和信息化部主要职责是为研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施，指导工业行业技术法规和行业标准的拟订，对工业日常运行监测等职能。

中国半导体行业协会是由中国半导体领域从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位、专家及其它相关的支撑企、事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织。协会负责贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出半导体行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；做好信息咨询工作；开展国际交流与合作；制订行业标准、国家标准及推荐标准。

2、主要法律法规和产业政策

公司所处电子专用材料制造行业是我国重点鼓励发展的产业，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性和基础性产业。近年来国家陆续出台了一系列促进其健康、有序发展的政策措施，极大加快了我国半导体材料行业发展。行业主要的法规和相关政策包括：

发布时间	发布单位	政策/文件名称	产业相关内容
2024 年	工业和信息化部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	推动有色金属、化工、无机非金属材料升级，发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料，加快超导材料等前沿新材料创新应用
2023 年	工业和信息化部	《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》	区熔用多晶硅材料属于先进半导体材料，被列入指导目录
2023 年	工业和信息化部	《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》	面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G 通信、智能网联汽车等重点领域，推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关；面向数字经济等发展需求，优化集成电路、新型显示等产业布局并提升高端供给水平，增强材料、设备及零配件等配套能力
2023 年	工业和信息化部等六部门	《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	面向光伏、风电、储能系统、半导体照明等，发展新能源用耐高温、耐高压、低损耗、高可靠 IGBT 器件及模块，SiC、GaN 等先进宽禁带半导体材料与先进拓扑结构和封装技术，新型电力电子器件及关键技术
2022 年	国务院	《关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》	提升核心产业竞争力。着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力
2021 年	工业和信息化部	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》	实施重点产品高端提升行动，面向电路类元器件等重点产品，突破制约行业发展的专利、技术壁垒，补足电子元器件发展短板，保障产业链供应链安全稳定
2021 年	十三届全国人大四次会议	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	在事关国家安全和全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

发布时间	发布单位	政策/文件名称	产业相关内容
			其中集成电路行业包括：集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，集成电路先进工艺和绝缘栅双极晶体管（IGBT）等
2020 年	国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	加快新材料产业强弱项。围绕保障微电子制造等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破
2020 年	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》	国家鼓励集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率或减半
2019 年	工业和信息化部	《关于政协十三届全国委员会第二次会议第 2282 号提案答复函》	持续推进工业半导体材料、芯片、器件及 IGBT 模块产业发展，根据产业发展形势，调整完整政策实施细则，更好地支持产业发展
2018 年	财政部、国家税务总局、国家发改委、工业和信息化部	《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》	对满足要求的集成电路生产企业实行税收优惠减免政策，符合条件的集成电路生产企业可享受前五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止的优惠政策

3、相关政策对发行人经营发展的影响

上述政策和法律法规的发布和落实，为公司所处行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，为企业创造了良好的经营环境，促进了行业的发展。公司所处行业为国家鼓励发展的产业，相关产业政策和法律法规的出台，为公司业务的发展提供了良好的政策环境，有效促进了公司的发展经营。

（三）公司所属行业介绍

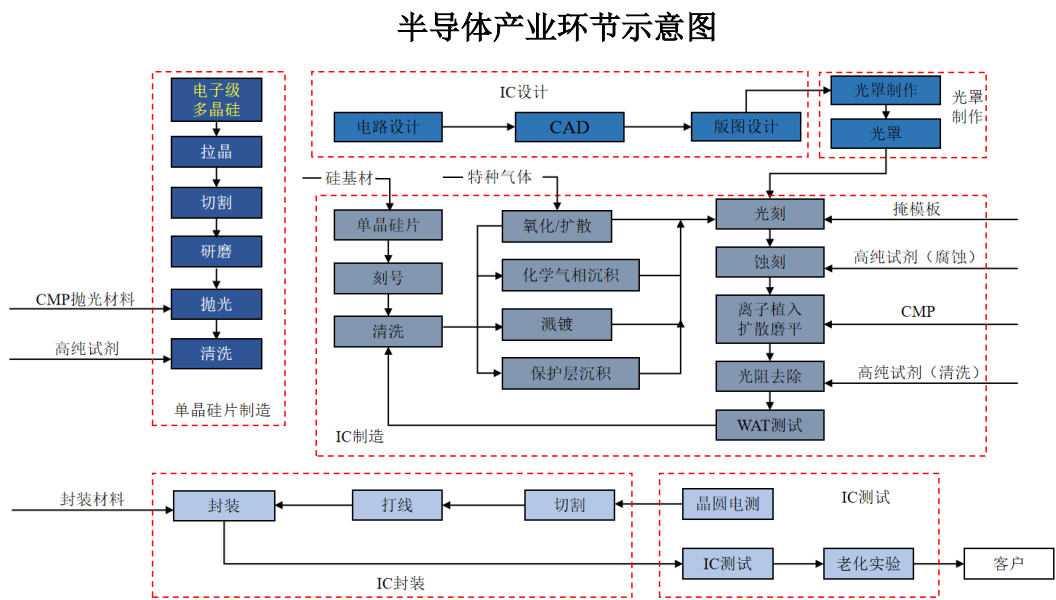
1、半导体行业概况

（1）半导体产业链概况

半导体行业的发展水平和国家科技水平息息相关，其发展情况已成为全球各国经济、社会发展的风向标，是衡量一个国家或地区现代化程度和综合实力的重要标志。

半导体是指在常温下导电性能介于绝缘体与导体之间的材料。常见的半导体包括硅、锗等元素半导体及砷化镓、氮化镓等化合物半导体。半导体产业链可按照主要生产流程进行划分，整体可分为上游半导体支撑产业、中游晶圆制造产业、下游半导体应用产业。上游半导体材料、设备产业为中游晶圆制造产业提供必要

的原材料与生产设备。半导体产品下游应用广泛，涉及通讯技术、消费电子、工业电子、汽车电子、人工智能、物联网、医疗、新能源、大数据等多个领域。下游应用行业的需求增长是中游晶圆制造产业快速发展的核心驱动力，同时也是上游半导体材料、设备需求增长的最终因素。

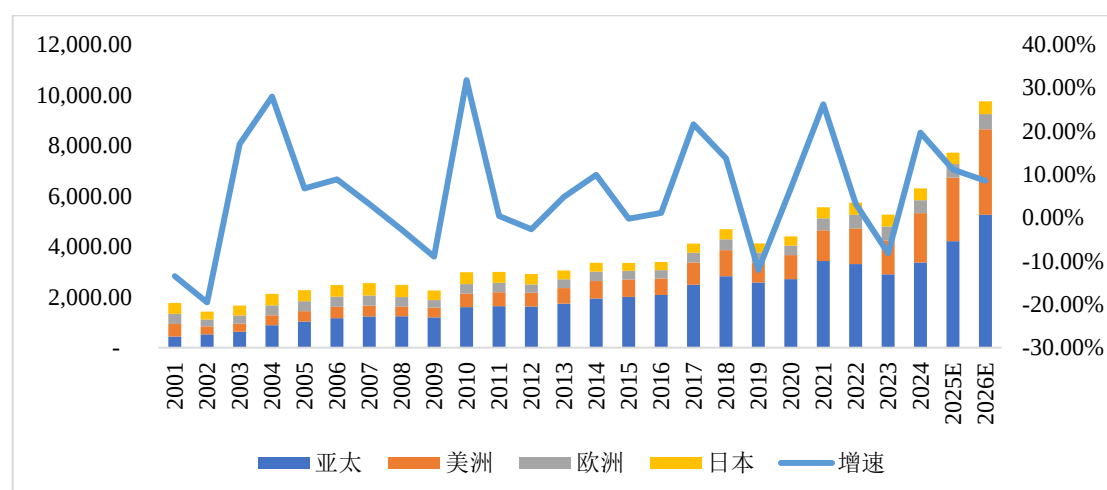


资料来源：《集成电路行业研究》

(2) 半导体行业市场情况

根据 WSTS 统计，2024 年全球半导体市场销售额为 6,305.49 亿美元。2025 年，在新兴市场需求增长、全球经济逐步企稳、通胀放缓以及各国持续出台半导体产业支持政策的推动下，全球半导体市场迎来回暖，预计全年销售额达 **7,722.43 亿美元**，同比增长 **22.47%**。展望 2026 年，市场有望延续增长态势，预计市场规模将攀升至 **9,754.60 亿美元**，较 2025 年增长 **26.32%**。

全球半导体行业销售额（单位：亿美元）



资料来源：WSTS

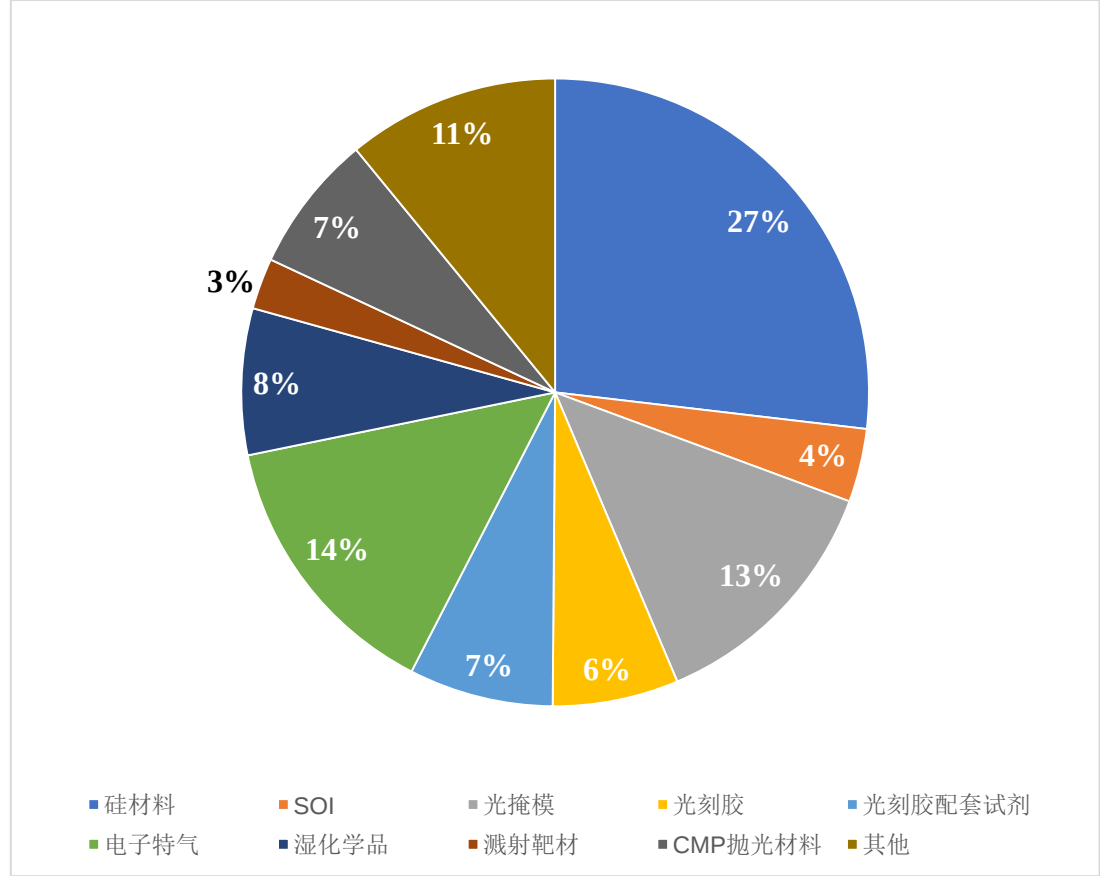
根据 WSTS 统计，2024 年亚太地区（不含日本）是全球最大的半导体消费市场，销售额约占全球总额 53.51%。其中，中国半导体市场销售额达 1,826.2 亿美元，占全球市场 28.96%；美洲、欧洲和日本的市场份额分别为 30.94%、8.13% 和 7.41%。

我国半导体产业发展态势良好，已成为全球半导体市场的重要组成部分。近年来，在国家政策支持和全球半导体产业第三次转移的推动下，我国在芯片设计、制造及上下游配套环节均取得显著进步，市场规模持续扩大，技术创新不断突破，**2025 年中国半导体市场销售额达 2,113.3 亿美元**。在人工智能（AI）赋能和国产替代加速的双重驱动下，我国半导体产业链各环节将迎来新的发展机遇，整体竞争力有望进一步提升。

2、半导体材料行业概况

半导体材料位于半导体产业链的上游，种类繁多，广泛应用于芯片制造的各个环节。每项制造工艺均需配套相应的专用材料。按应用环节划分，半导体材料主要分为制造材料和封装材料两大类。其中，主要的制造材料包括硅片（硅基材料）、光刻胶及配套试剂、高纯试剂、电子气体、抛光材料、靶材和掩模板等；主要的封装材料则包括引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝、包装材料以及芯片粘接材料等。

2024 年全球半导体晶圆制造材料市场规模占比



资料来源：SEMI

根据 SEMI 统计，2024 年全球半导体材料市场规模同比增长 3.81%，达到 674.68 亿美元，其中中国大陆市场销售额增长 5.3%，达 134.58 亿美元。半导体材料主要分为晶圆制造材料和封装材料，其中晶圆制造材料占比约为 64%。半导体硅材料是晶圆制造材料中最重要的组成部分，约占晶圆制造材料的 27%，对应市场规模约为 115 亿美元。

3、半导体硅材料行业概况

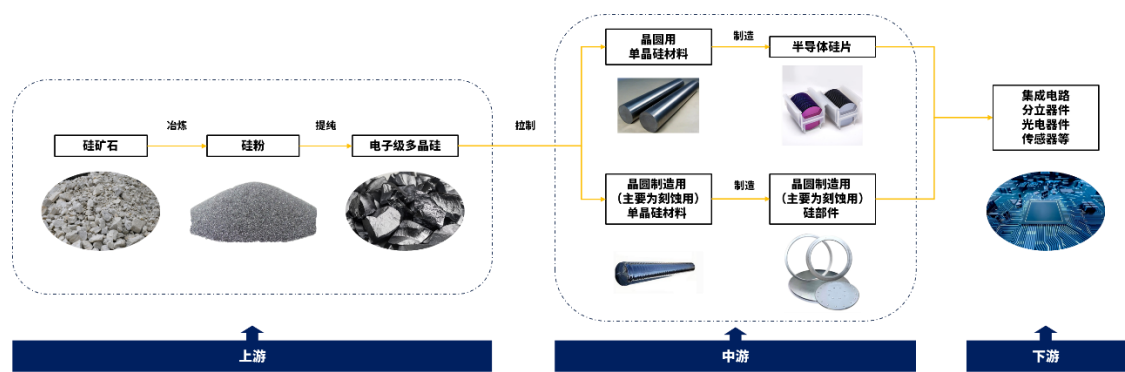
硅是地壳中含量第二丰富的元素，通常以复杂的硅酸盐或二氧化硅形式广泛存在于岩石、砂砾和尘土中，极少以单质形态在自然界中存在。凭借其优异的物理特性、成熟且易于产业化的制备工艺，以及地球上丰富的资源储量，硅已成为当前应用最广泛的半导体材料，超过 90% 的半导体器件和集成电路均采用硅材料制造。

目前，半导体硅材料的市场规模约占半导体晶圆制造材料市场的 27%，是制造环节中占比最高的原材料。硅材料具有单向导电性、热敏性、光电效应及可掺

杂等优良特性，能够生长出大尺寸、高纯度的单晶，且成本相对适中，因而成为全球范围内应用最为广泛的重要集成电路基础材料。

半导体硅材料可根据晶胞排列的有序性分为多晶硅材料和单晶硅材料，二者在力学、光学及电学等物理性质上存在显著差异。多晶硅材料是制备单晶硅材料的基础原材料。根据应用场景的不同，半导体单晶硅材料可分为用于芯片制造的单晶硅材料和用于刻蚀等晶圆制造环节的单晶硅材料。其中，芯片用单晶硅材料是制造半导体器件的核心基础材料。该材料经过一系列晶圆制造工艺，形成微小的电路结构，再经切割、封装、测试等工序后成为芯片，广泛应用于集成电路的下游市场。而用于刻蚀等晶圆制造过程的多晶硅材料，则被加工成多晶硅部件，作为晶圆制造中刻蚀等关键环节的核心耗材，具有重要的工艺支撑作用。

半导体硅材料产业链



根据 TrendForce 统计，2024 年全球晶圆代工市场规模由 1,174.43 亿美元增至 1,402.96 亿美元，同比增长 19.46%。在人工智能持续推动及终端应用库存回补的支撑下，2025 年及 2026 年全球晶圆代工市场有望连续两年实现 20%以上的增长。2024 年，中国大陆晶圆代工产能已占全球总产能的 21%，随着新建产线陆续投产，预计到 2030 年该比例将提升至 30%，在全球晶圆代工市场中占据主导地位。伴随晶圆厂产能逐步爬坡，半导体硅材料需求同步扩张。根据 SEMI 数据，2024 年全球半导体硅材料市场规模约为 114.77 亿美元，其中中国大陆市场规模为 17.93 亿美元，同比小幅下降；受益于下游需求复苏和本土制造能力提升，2025 年全球半导体硅材料市场规模预计将达 126.37 亿美元，中国大陆则有望反弹至 21.24 亿美元，同比增长 18.46%，增速高于全球平均水平。

4、电子级多晶硅行业概况

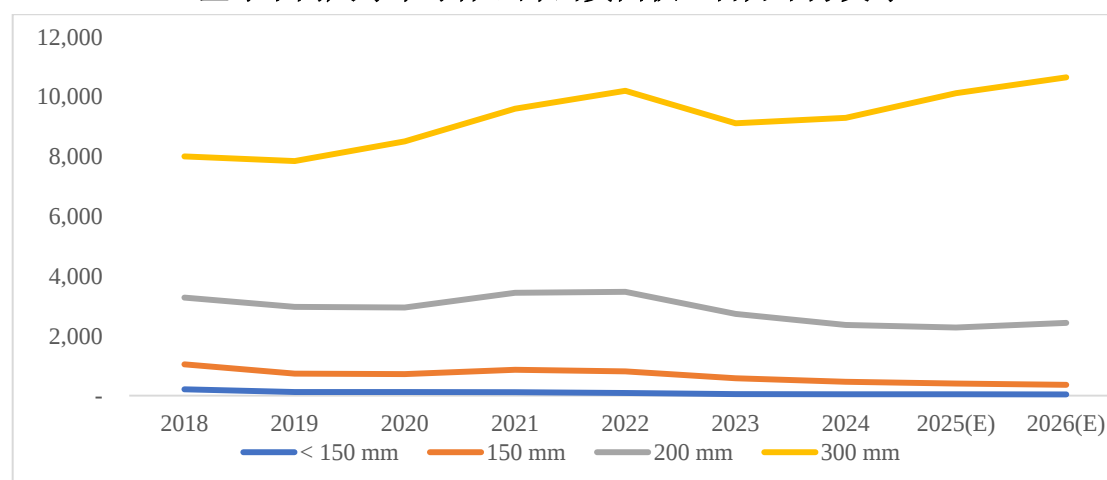
与太阳能级多晶硅相比，电子级多晶硅对产品质量、纯度的要求显著更高，其生产流程对工艺、设备管道选型、仪表选型、洁净室等级都有极为严格的要求，因而生产难度明显更大。长期以来，电子级多晶硅生产技术被德国、美国、日本等企业所垄断，成为制约我国集成电路产业发展的瓶颈之一。

（1）全球电子级多晶硅行业概况

电子级多晶硅需求主要受下游硅片和硅部件市场需求的影响。

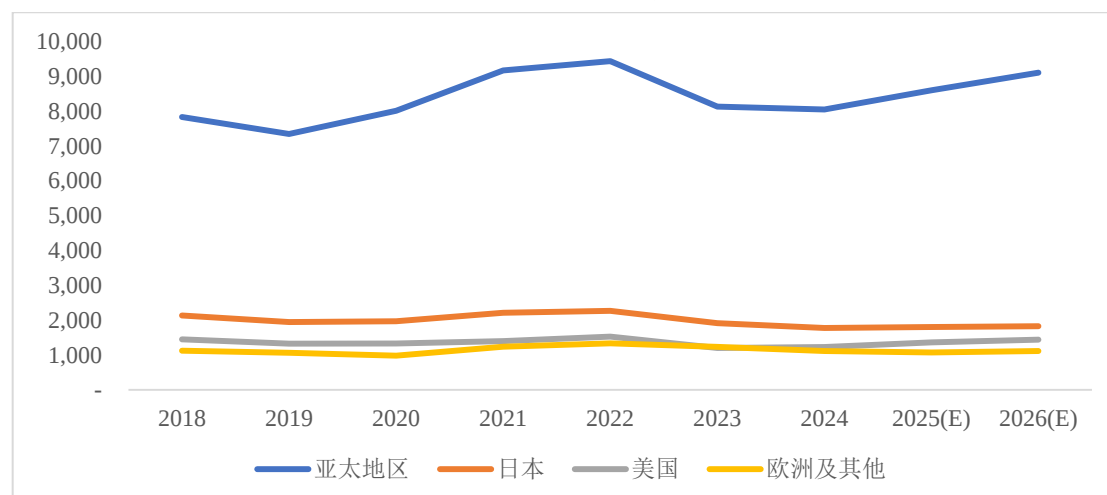
电子级多晶硅的下游硅片市场需求主要由消费电子、汽车电子和通信三大类产业驱动。其中，12 英寸硅片核心应用于消费电子、高性能计算、人工智能及云计算领域，具体涵盖智能手机、平板电脑、PC、服务器芯片、GPU/CPU、AI 加速器等高端集成电路产品；8 英寸硅片主要聚焦于汽车电子、工业控制、通信设备、功率半导体及传感器领域，典型应用包括车载 MCU、充电桩芯片、射频器件、MOSFET、IGBT、指纹识别传感器等。根据 SEMI 数据，从尺寸结构看，2024 年 12 英寸和 8 英寸硅片分别占全球硅片出货面积的 76.39%和 19.45%，合计占比接近 96%。预计到 2026 年，全球 12 英寸半导体硅片出货面积将突破 100 亿平方英寸，市场份额持续扩大，12 英寸与 8 英寸硅片合计占比将进一步提升至约 97%。从区域分布看，亚太地区是全球半导体硅片出货面积最大的市场，2024 年占比达 66.15%，且在全球的份额将持续增长，预计到 2026 年将提升至 67.53%。

全球不同尺寸半导体硅片出货面积（百万平方英寸）



资料来源：SEMI

全球不同地区半导体硅片出货面积（百万平方英寸）



资料来源：SEMI

受宏观经济波动及消费电子产品需求放缓影响，硅片市场规模有所回落。根据 SEMI 统计，2024 年全球硅片市场规模为 115 亿美元。2025 年，随着下游市场需求逐步复苏，半导体行业持续回暖，并逐步向电子级多晶硅等上游材料环节传导。SEMI 数据显示，截至 2024 年末，全球共有 193 座 12 英寸量产晶圆厂，预计到 2026 年将增至 230 座，对 12 英寸硅片形成强劲需求支撑。尽管国际主要半导体硅片厂商已陆续启动扩产计划，但受限于建设周期长、客户认证严格及产能爬坡缓慢等因素，其长期供给能力仍难以完全匹配全球芯片制造企业日益增长的硅片需求。在此背景下，国内半导体硅片行业有望迎来加速发展期，国产替代进程将进一步提速。

在硅部件市场，下游硅部件的需求受芯片产量驱动，与半导体终端市场需求呈正相关。根据 QYResearch 数据，2024 年全球刻蚀用硅部件市场规模为 17.27 亿美元，预计到 2031 年将达到 27.71 亿美元，2025 年至 2031 年间的年均复合增长率为 7.27%。随着刻蚀用硅部件市场的持续扩张，作为其核心原材料的电子级多晶硅市场需求也将相应增长。

考虑到前述硅片、硅部件市场需求及其未来增长趋势，全球电子级多晶硅市场预计长期仍将保持增长趋势。

（2）国内电子级多晶硅行业概况

2015 年至 2024 年，中国大陆半导体硅片销售额从 4.30 亿美元增长至 17.93 亿美元，年均复合增长率达 17.20%，显著高于同期全球半导体硅片市场的增速。

目前，国内已实现 8 英寸硅片的稳定供应，12 英寸大硅片亦进入量产阶段。根据 SEMI 统计，截至 2024 年末，中国大陆地区共有 62 座 12 英寸量产晶圆厂（包括西安三星、无锡 SK 海力士、南京台积电等外资晶圆厂）；预计到 2026 年，12 英寸晶圆厂量产数量将超过 70 座，月产能提升至 321 万片，约占届时全球 12 英寸晶圆总产能的三分之一。其中，以中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储等为代表的内资 12 英寸晶圆厂产能预计将增至约 250 万片/月，成为推动国产半导体材料需求持续增长的核心力量。

根据公开数据统计，国内硅片厂商已披露的 8 英寸硅片总规划产能约为 4,874 万片/年，12 英寸硅片总规划产能约为 5,958 万片/年。依据不同尺寸硅片对电子级多晶硅的单位消耗量测算，上述产能对应的电子级多晶硅年需求量分别约为 5,700 吨和 18,954 吨。在此基础上，结合小尺寸硅片（如 6 英寸及以下）的既有及延续性需求，预计未来中国大陆仅用于硅片制造（不含硅部件）的电子级多晶硅年需求量将不低于 2.5 万吨。若进一步考虑硅部件（如硅环、硅电极、挡板等）生产所带动的额外原材料需求，电子级多晶硅的整体市场需求规模将进一步扩大，为国产高纯多晶硅产品提供持续增长的市场空间。

随着下游半导体硅片及硅部件产能的持续释放，国内对电子级多晶硅的需求将持续增长。近年来，国内电子级多晶硅企业技术能力不断提升，在产品纯度控制、成本优化及本地化服务响应等方面已逐步形成综合竞争优势。作为半导体产业链的关键战略基础材料，电子级多晶硅的国产化是必然趋势，但当前国产供应量与下游实际需求之间仍存在明显缺口，亟需通过规模化量产加以弥补。发行人内蒙产线的投产，将显著提升高纯电子级多晶硅的本土供给能力，进一步满足国内下游客户的稳定采购需求。

在技术门槛更高的超高纯电子级多晶硅领域，尤其是区熔用多晶硅方面，国内产业基础更为薄弱，基本处于空白状态。发行人依托在高纯电子级多晶硅领域的技术积累，经过多年研发攻关，区熔用多晶硅已通过部分国内外主流客户验证并实现小批量出货，成功填补了该细分领域的国产空白，标志着我国在高端电子级多晶硅自主供应能力方面取得关键突破。

（四）所属细分行业技术水平特点、进入本行业的主要壁垒、行业发展态势、面临的机遇与挑战、行业周期性特点

1、所属细分行业技术水平特点

作为一家技术驱动型企业，发行人坚持以技术研发为核心，已取得丰厚的研究成果，自主研发了电子级多晶硅长周期稳定量产产业化技术、ppt 级氯硅烷痕量杂质纯化技术、高效 CVD 可控晶体沉积技术、硅棒洁净破碎、硅块洁净刻蚀等 11 项主要核心技术。截至本招股说明书签署日，发行人已获授权 140 项专利，其中 56 项发明专利，84 项实用新型专利。

公司具体核心技术水平及特点请参见本招股说明书之“第五节、六、（一）核心技术情况”。

2、进入本行业的主要壁垒

（1）技术壁垒

电子级多晶硅对产品纯度和杂质控制要求极为严苛，纯度需达到 11N 以上，以满足单晶硅制备对超高纯度原料的要求。当多晶硅中存在硼、磷或其他金属元素等杂质时，所制备的硅片质量将难以控制，因此必须确保极高的材料纯度。在电子级多晶硅的制造过程中，去除硼、磷及各类金属杂质一直是国内该领域的技术瓶颈。该工艺属于特殊的制造过程，融合了化工生产与高纯物质制备技术，复杂度高。要实现电子级多晶硅的产业化，必须全面掌握这一复杂流程中的各个环节，并通过科学合理的工艺设计将其系统整合。任何一个环节的缺失或技术落后，都可能导致最终产品无法满足高端半导体器件的质量要求。因此，高水平的技术积累和制造工艺构成了新进入企业难以逾越的技术壁垒。

（2）人才壁垒

电子级多晶硅行业属于典型的人才密集型产业，对专业技术人才的需求较高。高素质的技术团队是企业持续保持技术领先、提升市场竞争力和实现长远发展的关键保障，有助于提高生产效率、保障产品质量与生产安全、降低制造成本，并推动新工艺、新设备及新产品的研发与创新。公司高度重视人才培养与研发团队建设，核心技术人员不仅具备良好的学历背景和专业素养，还曾参与多项国家及省级重大核心技术攻关项目，拥有丰富的产业实践经验和工程化能力。由于高端

人才的储备与培养需要长期的投入和较高的成本，新进入企业难以在短期内组建具备核心竞争力的研发与生产团队，从而在人才层面形成显著的进入壁垒。

（3）客户壁垒

半导体硅片企业对电子级多晶硅的质量要求极为严苛，因此在供应商选择上极为审慎。进入芯片制造企业的合格供应商名录，不仅面临较高的技术门槛，还需经历较长的验证周期。通常，硅片制造企业会要求硅料供应商先提供样品用于试生产；在内部工艺验证通过后，再将使用该硅料制成的硅片送至下游客户进行应用测试；只有获得终端客户的认可，硅片企业才会对供应商启动正式认证流程。认证通过后，方可进入批量供货阶段。由于认证程序严格、流程复杂，整个验证周期普遍较长，部分甚至可达 2 至 3 年。因此，一旦供应商通过认证并进入客户的采购体系，合作关系通常较为稳定，客户更换意愿较低，从而对新进入者形成显著的客户壁垒。

（4）资金壁垒

电子级多晶硅行业属于典型的资金密集型行业，在核心技术研发、生产线建设、设备购置、工艺升级及后续产能完善等环节均需持续投入大量资金，且投资回收周期较长。高昂的资金需求对企业资本实力提出了较高要求，只有具备充足的资金支持，企业才有可能完成技术突破、实现规模化生产并占据一定的市场份额。因此，巨大的资金投入门槛对新进入者构成了显著的进入壁垒，限制了缺乏资金实力的企业进入该领域。

3、行业发展态势

鉴于硅片在未来仍将保持其作为半导体主流材料的地位，半导体硅片市场前景广阔，尤其是大尺寸硅片的需求持续增长，不断带动对高品质电子级多晶硅的需求上升。

（1）硅片未来仍将是半导体主流材料

晶圆材料历经六十余年技术演进与产业发展，已形成以硅为主导、新型半导体材料为补充的产业格局。由于硅在物理特性上存在一定局限，难以满足光电子、高频及高功率器件等领域的性能要求，碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等化合物半导体应运而生，有效支撑了电子技术在高温、高功率、高压、高频及抗辐射

等极端工况下的发展需求。化合物半导体目前广泛应用于射频器件、光电器件和功率器件的制造，展现出良好的发展前景；而硅材料则主要应用于逻辑芯片、存储器等主流集成电路领域。两者在应用场景上各有侧重，功能互补，且均具备不可替代性。目前 90% 以上的集成电路芯片是基于硅片制成，充分表明在可预见的未来，硅片仍将保持其作为主流半导体基础材料的主导地位。

（2）半导体硅片市场广阔，国内大硅片需求持续增长

半导体硅片市场具有一定的周期性，整体呈现波动上升趋势。受 2020 年全球“缺芯潮”以及人工智能、高性能计算、5G 通信、汽车电子和工业应用等领域需求强劲增长的推动，芯片需求持续攀升，带动半导体硅片需求快速上升，并于 2022 年达到周期高点。然而，自 2022 年下半年起，随着全球产能逐步释放叠加终端市场需求疲软，下游芯片行业出现库存积压，半导体硅片行业于 2023 年进入周期底部。随着库存水平逐步回归正常，叠加新能源汽车、大数据中心、人工智能等新兴产业的快速发展，半导体产业自 2024 年起重回增长轨道，开启新一轮周期性上升通道。展望未来，半导体硅片市场，尤其是 12 英寸大尺寸硅片市场，仍将保持长期增长态势。

中国大陆半导体硅片市场规模顺应全球趋势稳步扩张，年均复合增长率显著高于全球平均水平。2010 年至 2013 年，中国市场发展节奏与全球基本同步；自 2014 年起，伴随国内多条半导体制造产线陆续建成投产、制造技术水平持续提升以及终端电子产品市场的迅猛发展，中国大陆半导体硅片市场进入跨越式发展阶段。2015 年至 2024 年，中国大陆半导体硅片销售额由 4.30 亿美元增长至 17.93 亿美元，年均复合增长率达 17.20%，显著高于同期全球增速，充分体现出强劲的本土化发展动能与广阔的市场潜力。

（3）大尺寸硅片市场规模将持续增长，进一步提升电子级多晶硅需求

从直径来看，半导体硅片的尺寸规格主要包括 50mm（2 英寸）、75mm（3 英寸）、100mm（4 英寸）、150mm（6 英寸）、200mm（8 英寸）和 300mm（12 英寸）。下一代 450mm（18 英寸）硅片因在设备研发方面面临重大技术挑战，且产业链各方协同推进意愿不足，目前尚未形成规模化发展趋势。为顺应摩尔定律——即集成电路上可容纳的晶体管数量约每 18 个月翻一番，性能提升一倍、

成本降低一半——芯片制造企业持续优化工艺技术，致力于提升单片硅片上的芯片产出数量并降低单位制造成本。由于硅片尺寸越大，单次加工可生产的芯片数量越多，单位芯片的制造成本相应越低，行业整体呈现出向大尺寸硅片演进的明确趋势。

目前，200mm（8 英寸）和 300mm（12 英寸）硅片已成为市场主流产品，12 英寸硅片是目前市场最主流规格的硅片。根据 SEMI 统计，12 英寸硅片贡献了 2024 年全球总硅片出货面积的 75%以上。随着尺寸增大，硅片生产工艺的复杂性和技术门槛显著提高，全球仅有少数领先企业掌握 300mm 硅片的量产能力。除高质量大直径单晶拉制本身存在较高技术壁垒外，300mm 硅片在切片成形、洁净环境控制、清洗、外延生长、表面处理及检测表征等各环节的技术要求均远高于 200mm 硅片。

12 英寸产品也是目前全球晶圆厂扩产的主要方向。根据 SEMI 预测，预计到 2026 年，全球 12 英寸晶圆厂的量产数量将达到 230 座，持续拉动对 12 英寸硅片的强劲需求；其中，中国大陆地区的 12 英寸晶圆厂数量预计将超过 70 座，占全球总产能的约三分之一。在此背景下，由于大尺寸硅片对硅料用量更大，且对材料纯度、晶体完整性及工艺稳定性提出更高要求，随着全球及国内 300mm 晶圆制造产能的持续扩张，具备先进半导体硅材料研发与量产能力的国内企业将迎来重要的市场发展机遇。

4、面临的机遇与挑战

（1）面临的机遇

1) 国家及产业政策对半导体产业大力扶持

半导体行业是现代信息产业的基础和核心，是支撑国民经济社会发展、保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，也是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。近年来，随着我国经济高质量发展的深入推进，半导体产业的战略地位愈发突出，国家及各级政府密集出台多项支持政策，推动产业加速发展。

2021 年，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局联合发布《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，进一步明确了国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、

测试等企业的认定条件，在税收优惠、研发支持、投融资、人才引进等方面给予有力扶持，为集成电路全产业链发展提供了强有力的政策保障。

在国家政策的持续支持下，半导体行业迎来了良好的发展环境，为企业的技术创新和规模化发展奠定了坚实基础。一批国内优质半导体企业依托政策红利，进入快速发展通道，在各自细分领域实现技术突破和国产替代，逐步打破国外垄断，具备了与国际领先企业同台竞争的能力，并在全球市场中占据日益重要的地位。

2）全球半导体产业逐步向中国转移

纵观全球半导体产业的发展历程，已历经从美国向日本，再向韩国、中国台湾地区及中国大陆的多轮产业转移。第一次转移发生在 20 世纪 70 年代，由美国转向日本；第二次为 20 世纪 80 年代，由日本转向韩国和中国台湾地区。目前，中国大陆正处于新一代智能手机、物联网、人工智能、5G 通信等新兴产业快速崛起的进程中，已成为全球最重要的半导体应用和消费市场之一。未来几年，中国大陆半导体产业将进入快速发展期。在半导体产业加速向中国大陆转移以及国家政策大力支持的背景下，中国半导体产业规模持续扩大，随着国际产能不断向中国转移，国内外半导体企业纷纷在华投资建厂，进一步推动了国内半导体材料需求的增长。

（2）面临的挑战

1）外资企业仍占据主导地位，市场竞争程度加剧

虽然国内半导体产业持续发展，但相较于外资企业长期的技术积累和市场布局，国内企业起步较晚，在市场占有率、管理水平和技术储备方面仍存在一定差距，尤其在国际市场的品牌认可度和竞争力相对不足。在国内市场，受益于近年来政策的大力支持，集成电路企业数量不断增多，产业规模逐步扩大，但随之也带来了市场竞争日益加剧的挑战。

2）国际贸易摩擦不断升级

近年来，随着中国经济持续增长，面临的国际贸易摩擦压力日益凸显，尤其是中美贸易摩擦不断加剧。自 2018 年 8 月起，美国商务部陆续将多家中国高科技企业列入“实体清单”，并持续加码对我国集成电路产业的限制措施。这些举

措对国内半导体企业在采购美国生产的原材料，以及获取或使用含有美国技术的知识产权、设备和工具等方面造成一定制约。若未来国际贸易保护主义进一步抬头，各国相继采取提高关税或其他贸易壁垒措施，国际贸易摩擦可能持续升级，半导体级硅材料行业或将面临长期的不利影响。

5、行业周期性特征

公司产品电子级多晶硅主要用于半导体硅片及半导体用硅部件的生产，因此其市场需求与半导体行业周期密切相关，受行业景气度波动的影响较为明显，但不存在显著的季节性特征。

（五）行业竞争格局、行业内主要企业、发行人产品的市场地位、竞争优势与劣势以及发行人与同行业可比公司的比较情况

1、行业竞争格局

电子级多晶硅对产品纯度和杂质控制要求极为严苛，纯度需达到 11N 以上，以满足单晶硅制备对超高纯度原料的要求。当硼、磷或其他金属元素作为杂质存在于多晶硅中时，制成的硅片产品质量难以控制，因此需要极高的多晶硅纯度。制造电子级多晶硅的过程中去除硼、磷或其他金属杂质一直是国内电子级多晶硅材料领域的技术瓶颈。此前，国内高纯度硅料一直处于稀缺状态，并被德国瓦克、美国 Hemlock、日本德山等全球几大厂商常年垄断。

在上述背景下，国内积极推进电子级多晶硅国产化。2018 年底，发行人电子级多晶硅项目正式批量投产，打破了国外技术、市场的垄断，填补了国内半导体级原材料生产的空白。2021 年，发行人的电子级多晶硅已实现在 12 英寸硅片上的规模化应用，彻底改变了此前 12 英寸硅片用电子级多晶硅几乎完全依赖进口的局面。目前，除发行人外，电子级多晶硅生产仍主要集中在德国、美国、日本的少数几家多晶硅企业。在全球科技产业重要性与日俱增的背景下，电子级多晶硅作为支撑整个半导体制造产业的关键基础材料，也获得各国充分重视。例如，2023 年 6 月，德国瓦克宣布将扩建半导体级多晶硅提纯产能，已向欧盟申请“欧洲共同利益重要项目（IPCEI）”资助并得到批准；2024 年 10 月，美国政府宣布将向美国 Hemlock 提供支持资金，以巩固美国在半导体级多晶硅生产领域的领导地位；日本德山与韩国 OCI 合资成立公司，于 2025 年 7 月启动建设半导体

级多晶硅工厂。

按照设计产能，国内电子级多晶硅厂商主要为鑫华半导体 18,000 吨/年（徐州产线 8,000 吨/年、内蒙产线 10,000 吨/年）。发行人是目前国内主要的电子级多晶硅厂商，随着内蒙 10,000 吨/年电子级多晶硅产线逐步释放产能，发行人在全球电子级多晶硅领域排名将进一步提升。

2、行业内主要企业

（1）瓦克化学股份有限公司（Wacker Chemie AG，WCH.DF）

德国瓦克（Wacker Chemie AG，WCH.DF）成立于 1914 年，作为现代化学领域的先锋企业，拥有四大业务领域，包括有机硅、多晶硅、聚合物、生物技术，在全球设有 27 个生产基地、26 个技术中心，供货种类当中包含 3,200 多种产品，客户的专业领域覆盖几乎所有行业。德国瓦克是全球电子级多晶硅产业的龙头企业，也是近年来扩建产能较为迅速的国际厂商，未来数年内其电子级多晶硅产能预估可达到 1.5-2 万吨/年。

（2）Hemlock Semiconductor Corporation

美国 Hemlock 成立于 1961 年，总部位于美国密歇根州，是高纯度多晶硅和其他硅基产品的领先供应商。美国 Hemlock 是美国上市公司康宁（GLW.N）的控股子公司，并由全球五大硅片厂商之一信越化学（东京证券交易所上市，4063.JP）参股。美国 Hemlock 电子级多晶硅产能约 1 万吨/年。

（3）日本德山株式会社（Tokuyama Corporation，4043.T）

日本德山（Tokuyama Corporation，4043.T）成立于 1918 年，公司产品主要覆盖化学药品、建筑材料、电子信息、生命科学以及环境保护等行业，产品主要销往日本、美国、亚洲、欧洲。日本德山电子级多晶硅产能约 6,000-8,000 吨/年。

（4）其他企业

除上述三家行业主流厂商外，还包括 SUMCO 子公司高纯度硅株式会社和韩国 OCI。高纯度硅株式会社此前为三菱材料旗下子公司，负责半导体级多晶硅业务，2022 年 10 月全球五大硅片厂商之一 SUMCO 收购三菱材料子公司高纯度硅株式会社。韩国 OCI 成立于 1959 年，是一家综合性化学工业供应商，也是韩国

的化工巨头之一，主营业务包括无机化工、精细化工、石油化学、多晶硅等，并拥有煤炭化学和材料加工等事业。

3、发行人产品的市场地位

公司是目前国内主要的半导体产业用电子级多晶硅生产企业，也是国内极少已完整覆盖 12 英寸硅片、8 英寸硅片、4-6 英寸硅片、硅部件等各等级应用领域的电子级多晶硅企业。公司电子级多晶硅产品在国内已经取得了较高市场地位，被国内几乎全部领先的半导体硅片企业验证和采用，并签署长期供应协议，前十大客户涵盖了西安奕材、沪硅产业、TCL 中环、立昂微、Ferrotec、有研硅、中晶科技等。根据中国电子材料行业协会半导体材料分会统计，**2025 年公司在国内集成电路用高纯电子级多晶硅市场占有率超过 60%**。国内市场其余份额目前仍主要由境外厂商占据。

在公司下游硅片市场，12 英寸硅片是目前市场最主流规格的硅片，也是目前全球晶圆厂扩产的主要方向。根据 SEMI 统计，12 英寸硅片贡献了 2024 年全球总硅片出货面积的 75%以上。12 英寸硅片核心应用于消费电子、高性能计算、人工智能及云计算领域，具体涵盖智能手机、平板电脑、PC、服务器芯片、GPU/CPU、AI 加速器等高端集成电路产品。目前公司是 12 英寸硅片领域电子级多晶硅大规模稳定供应的唯一国产供应商。

在国际市场上，电子级多晶硅及其下游 12 英寸硅片市场均呈现寡头垄断格局，电子级多晶硅供应完全被德国瓦克、美国 Hemlock、日本德山等少数国际厂商垄断，下游 12 英寸硅片市场基本被前五大硅片厂商所占据（产能占比超过 70%）。国际硅片厂商对电子级多晶硅的技术指标和稳定性要求更为严苛，供应链进入壁垒极高。经多年技术积累和反复验证，公司已成功进入国际一线硅片厂商供应链，在全球高纯电子级多晶硅供应体系中打开了更为广阔的市场空间。

在技术难度更高、质量指标更为严苛的超高纯电子级多晶硅领域，全球技术成熟、能够稳定供应的厂商数量更少，该领域已成为全球半导体关键材料的尖端领域。在该领域能否取得技术突破与自主供应，关系到能否支撑国产集成电路制造领域向先进制程和高端化发展，能否满足各类高端功率半导体战略领域及相关高端装备国产化的需求，公司目前已经在超高纯电子级多晶硅的技术研发和生产

方面取得突破性进展，相关产品已通过国内外部分主流客户验证并实现小批量出货，具备了向技术成熟应用、大规模生产出货推进的关键基础。

4、竞争优势与劣势

（1）发行人竞争优势

1）领先的技术水平

半导体硅材料行业属于技术密集型行业。公司组建了专业扎实、经验丰富的研发团队，建立了高效灵活的研发机制，并持续引进高层次技术人才，为公司实现持续创新和保持技术领先提供了坚实的人才保障。经过多年的技术积累和生产实践，公司成功突破并优化了多项关键工艺，构建了较高的技术壁垒，形成了深厚的技术储备和工艺积淀。目前，公司已掌握电子级多晶硅长周期稳定量产产业化技术、ppt 级氯硅烷痕量杂质纯化技术、高效 CVD 可控晶体沉积技术等核心技术，电子级多晶硅材料技术水平达到国际先进。

电子级多晶硅的生产是一个融合化工过程与高纯物质制造的特殊工艺流程。公司全面掌握了该复杂制造过程中的各项关键技术，并通过科学合理的工艺集成，形成了完整的产业化成套技术体系。任何环节的技术缺失或薄弱，均可能影响最终产品的质量，难以满足高端半导体制造的需求。公司已掌握高纯硅基材料生产的基础性核心技术，相关技术不仅支撑现有电子级多晶硅产品的稳定生产，还可向外延展，具备向其他高纯硅基材料产品拓展的能力，为构建多元化的高纯硅基材料技术体系奠定了坚实基础。

2）优质的产品质量

目前，发行人主要产品涵盖各类品质等级的直拉用电子级多晶硅，并已成功开发区熔用电子级多晶硅棒。公司产品已全面覆盖 12 英寸、8 英寸、4-6 英寸硅片以及半导体用硅部件等各等级应用领域，在轻掺、重掺等多种工艺条件下均表现出优异性能，尤其在主流的 12 英寸硅片制造中实现稳定应用，标志着公司产品质量已达到市场最前沿水平，与国际先进标准保持一致，具备了参与全球市场竞争的基础能力。同时，公司在超高纯电子级多晶硅领域也已经完成技术突破，并实现在国内外主流客户的验证和小批量出货。

依托国内丰富的产业与人力资源支撑，结合产线建设过程中大量采用的新工

艺、新材料，公司相较传统老牌多晶硅企业，在产线整体现代化水平上实现显著提升。这使得公司产品在质量稳定性方面表现突出，为未来参与全球化竞争奠定了坚实基础，具备较强的综合市场竞争力。

3) 广泛的客户基础

公司下游半导体硅片企业对各类原材料的质量要求极为严苛，对供应商的遴选极为审慎，进入芯片制造企业的合格供应商名录面临较高的准入壁垒。通常，硅片制造企业会要求硅料供应商先提供样品用于试生产；在通过内部工艺验证后，再将使用该材料制成的硅片送至其终端客户进行应用评估；只有获得下游客户认可，才会对供应商启动正式认证流程，认证通过后方可进入批量供货阶段。该过程认证程序严格，周期较长，部分验证周期可达 2 至 3 年。

凭借产品高良品率、优异的参数稳定性以及持续稳定的产品供应能力，公司已成功通过多家国内领先客户的严格认证，长期稳定供货于西安奕材、沪硅产业、TCL 中环、立昂微、Ferrotec 等几乎所有国内规模化的 12 英寸半导体硅片制造商，有效实现进口替代，打破了国外厂商的长期垄断。同时，国际战略客户的导入也在稳步推进，公司产品已进入国际一线硅片厂商，实现批量供应。公司与核心客户建立了长期、稳定的合作关系，在客户资源方面形成了显著的壁垒优势。

4) 高品质规模化生产能力

对于下游半导体硅片厂商而言，核心原材料的稳定供应是维持正常生产运营的生命线。公司凭借高品质、规模化的生产能力，确保电子级多晶硅这一关键原材料能够持续、稳定地输送至下游客户，有效规避了因原材料短缺导致的生产中断风险，保障客户实现连续高效的生产运行，进一步巩固了产业链上下游协同合作的信任基础。

电子级多晶硅的高品质规模化生产是一项技术难度极高的系统工程，面临多重严苛挑战：在超纯工艺控制方面，需将硼、磷等关键杂质含量精确控制在 ppb（十亿分之一）甚至 ppt（万亿分之一）量级，任何微小偏差均可能导致产品不达标；在复杂化学合成环节，必须精准调控反应条件，确保中间产物的高纯度与稳定性，对工艺精细度和过程控制能力要求极高；在大规模连续化生产中，还需实现整套系统的长期稳定运行，涉及洁净环境控制、温湿度恒定、设备高可靠性

及自动化管控等多维度技术集成，对生产管理与工程技术提出极为严苛的要求。

凭借深厚的技术积累和持续的自主创新，公司成功攻克了上述关键技术难题，实现了电子级多晶硅从实验室研发到大规模工业化生产的跨越，具备稳定产出满足 12 英寸硅片制造需求的高品质产品的能力。目前，公司是国内少数实现电子级多晶硅高品质、规模化量产的领军企业，在技术实力和供应保障能力方面处于行业领先地位。

5) 销售服务优势

目前，公司主要竞争对手为来自德国、美国、日本等地的国际领先企业。依托中国大陆的地理优势，公司深耕本土市场，为国内半导体硅片制造厂商提供贴近客户的本地化服务。相较于国外竞争对手，公司能够更及时响应客户需求，通过定期与不定期的客户拜访，快速、精准地把握客户的个性化需求，提供高效的技术支持与定制化服务方案。在客户响应速度、产品交付周期以及持续服务保障能力等方面，公司均展现出显著优势，逐步形成了以快速响应和高效服务为核心的销售服务竞争力。

（2）发行人竞争劣势

1) 国内产业起步较晚

此前，国内电子级多晶硅行业长期面临高纯度硅料供应短缺的局面，核心技术与市场被外资企业高度垄断，导致国产半导体硅片成本居高不下。全球市场主要由德国瓦克、美国 Hemlock、日本德山等少数几家企业主导，长期形成寡头格局，国内产业发展整体滞后于国际先进水平。公司成立于 2015 年，而国际龙头企业如德国瓦克（1914 年）、日本德山（1918 年）、美国 Hemlock（1961 年）均拥有数十年甚至上百年的技术积累和产业化经验，在规模、产能、技术成熟度等方面具备显著优势。

尽管公司正积极推进产能扩张，但电子级多晶硅行业属于资金密集、技术密集和人才密集型产业，新建产线不仅需要巨额资金投入，还需经历复杂的设备调试、工艺优化及严格的产品质量验证过程，周期长、门槛高。因此，公司在发展过程中仍受到国内产业起步较晚、基础薄弱等客观条件的制约，追赶国际领先水平仍需持续的技术积累和资源投入。

2) 产品单一

公司通过持续的技术改进，不断提升产能利用率，业务规模稳步扩大。尽管已具备一定的技术实力和行业地位，但在总体产能与产量方面，相较于国际龙头企业仍存在一定差距。目前，公司产品以直拉用电子级多晶硅为主，产品结构相对单一，区熔用电子级多晶硅的销售规模尚小，处于客户导入和市场拓展阶段。公司已在超高阻电子级多晶硅、硅基电子特气、高纯石英砂等围绕高纯硅基材料的多元化产品领域完成技术储备，具备进一步拓展的基础。为加快新产品产业化进程，丰富产品体系，提升综合竞争力，公司亟需通过新建或扩建项目，提升研发中试和规模化生产能力，实现产品结构的优化升级。

3) 融资渠道单一

半导体多晶硅行业属于资本密集型行业，且正处于快速发展阶段，企业在持续研发、技术升级和产能扩张等方面需大量资金投入。近年来，公司业务稳步发展，新项目陆续推进，对资金的需求日益迫切。然而，目前公司自有资金实力有限，融资渠道相对单一，主要依赖自有积累和银行贷款，难以完全满足大规模投资和快速扩张的需求，一定程度上制约了公司产能提升和新产品产业化进程，对公司整体规模扩张和竞争力提升形成制约。

5、发行人与同行业可比公司的比较情况

(1) 同行业可比公司选择依据

公司主要从事半导体产业用电子级多晶硅的研发、生产与销售。作为半导体制造的关键基础材料，电子级多晶硅直接用于制备半导体硅片及硅部件，是集成电路产业链的起点。公司产品已广泛应用于国内外主流半导体制造企业的生产流程，实现了科技成果与半导体产业的深度融合。

全球电子级多晶硅市场长期由少数国际厂商主导，主要竞争者包括德国瓦克、美国 Hemlock、日本德山等。上述企业进入行业时间早，技术积淀深厚，具备全球化的生产与供应体系。鉴于其在业务范围、产品应用及客户结构等方面与公司存在一定程度的可比性，本招股说明书将其作为业务层面的主要对标对象，用于分析行业地位与技术实力。

从财务可比性角度，由于境外竞争对手多为多元化集团，电子级多晶硅业务

在其整体收入中占比较小，相关细分数据难以获取；而国内目前尚无产品应用领域与公司完全重合的上市企业。综合考虑产业链位置、产品发展阶段及国产替代背景，本招股说明书选取沪硅产业和西安奕材作为财务可比公司，二者与发行人同属半导体产业的硅基主材领域，核心产品均处于国产化加速阶段，与公司具有较高的业务关联性和可比基础。

（2）发行人与同行业可比公司的经营情况比较

公司与主要竞争对手的经营情况对比如下：

名称	主营业务	业务范围	业务规模
德国瓦克	为全球所有关键工业领域提供产品并积极活跃于有机硅、聚合物、生物科技和多晶硅市场。	产品种类包括有机硅、黏合剂、聚合物添加剂、采用生物技术生产的药物活性成分以及半导体和光伏产业用高纯硅等。	2025 年营业收入为 54.85 亿欧元，净利润为-8.21 亿欧元。
美国 Hemlock	主营业务为生产高纯度多晶硅和其他硅基产品。	主要产品为高纯度多晶硅。	暂未对外披露
日本德山	公司主要业务领域包括 ICT 领域，其主要产品为半导体级多晶硅；医疗保健领域，包括眼镜镜片材料、牙科材料和设备等；环境领域，包括回收和环保业务。	产品包括各种氯衍生物、电子级多晶硅、水泥产品以及仿制药、中间体等。	2025 年营业收入为 3,494.76 亿日元，净利润为 222.05 亿日元。
发行人	半导体用电子级多晶硅	电子级多晶硅	2025 年营业收入为 17.91 亿元，净利润为 13,973.03 万元。

注：日本德山披露的 2025 年年度报告报告期为 2025 年 2 季度至 2026 年 1 季度

相较于国际竞争对手，公司虽在整体规模和历史积淀方面存在差距，但业务聚焦度更高，专注于电子级多晶硅这一细分赛道。新建产线采用先进的工艺路线与高度自动化的控制系统，装备现代化水平较高。同时，依托本土化优势，公司在客户需求响应、供货保障、定制化开发及技术服务等方面具备更强的灵活性与效率，能够更有效地支撑国内半导体产业链对关键基础材料的自主可控需求。

（3）发行人与同行业可比公司的技术指标比较

1）与同行业可比公司比较

公司作为国内系统掌握高纯电子级多晶硅提纯技术的多晶硅企业，突破了半导体硅材料制造领域的关键核心技术，产品技术指标全面达到国际先进水平，主

要参数指标对比如下：

厂商项目	德国瓦克	三菱材料	日本德山	鑫华半导体
施主杂质含量（P+As），ppt	7.0-12.1	18-27	25	3-10
受主杂质含量（B+Al），ppt	1.7-3.0	5-6	2	1-5
碳含量，ppb	6.0-6.6	<26	15	<10
Na, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn 基体金属杂质浓度，ppbw	-	-	-	0.009-0.027
Na, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Al, K 表面金属含量，ppbw	0.008-0.051	<0.200	<0.050	0.010-0.047

注 1：根据《国家标准〈电子级多晶硅〉编制说明（送审稿）》，国际主流厂商数据来源于其各自的产品 COA 证书，发行人数据亦来自经客户认可的产品 COA 证书；

注 2：国际主流厂商产品 COA 证书未体现基体金属杂质含量指标，故未列示；

注 3：ppb、ppt 指以原子数计的浓度单位，ppb 为十亿分之一原子比，ppt 为万亿分之一原子比；ppbw 指以质量计的浓度单位，ppbw 为十亿分之一质量比，下同；

注 4：2022 年 10 月，三菱材料电子级多晶硅子公司被全球五大硅片厂商之一 SUMCO 收购。

2）与国家标准比较

根据 2023 年 7 月正式实施的《电子级多晶硅》国家标准，我国将电子级多晶硅的技术指标由原有的三级标准扩展为四级，新增“特级”等级。其中，“特级”产品对标美国、日本、德国等国际先进厂商，可满足 12 英寸集成电路的制造需求；“1 级”对应国内当前技术水平，适用于 8 英寸及以下集成电路；“2 级”和“3 级”则主要用于分立器件领域。目前，公司产品已达到“特级”水平，主要参数指标均符合该等级要求，主要参数指标对比如下：

项目	电子级多晶硅国家标准技术指标要求				鑫华半导体
	特级品	电子 1 级	电子 2 级	电子 3 级	
施主杂质含量（P、As、Sb 总含量），ppt	≤30	≤50	≤100	≤300	3-10
受主杂质含量（B、Al 总含量），ppt	≤10	≤30	≤50	≤100	1-5
碳含量，ppb	≤20	≤50	≤50	≤100	<10
基体金属杂质含量（Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na 总含量）ng/g，ppbw	≤0.1	≤0.3	≤0.5	≤2.0	0.009-0.027
表面金属杂质含量（Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Al、K、Na、Ti、Mo、W、Co 总含量）ng/g，ppbw	≤0.1	≤0.5	≤1.0	≤5.0	0.010-0.047

注：国家标准中杂质含量及碳含量指标单位原为 atoms/cm³，为便于理解，单位已统一换算为 ppt 及 ppb。

（六）引用第三方数据情况

发行人引用的第三方数据已注明资料来源，符合权威、客观、独立及时效性要求，相关数据并非专门为本次发行准备，发行人未为此支付费用或提供帮助。

三、发行人销售和主要客户情况

（一）发行人主要产品的产能、产量、销量、产销率情况

报告期内，随着公司持续提升生产效能，产能稳步增长。徐州产线完成扩产后，2024 年新增产能 3,000 吨/年；内蒙产线正式投产后，2025 年新增产能 10,000 吨/年。发行人主要产品的产能、产量、销量及产销率情况如下：

单位：吨

产品	指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
多晶硅	产能	18,000.00	8,000.00	5,000.00
	产量	13,998.38	9,613.78	6,548.91
	销量	12,921.75	7,057.58	5,477.49
	产销率	92.31%	73.41%	83.64%

注 1：上述产能指直拉用电子级多晶硅产能。发行人目前产能中，还存在少部分由区熔用电子级多晶硅研发试制所占用，由于区熔用电子级多晶硅工艺特点，未来规模化生产时其单位产量会耗用更多产能；

注 2：内蒙产线于 2024 年下半年开始试生产，2024 年末完成转固，相关产能未纳入发行人 2024 年产能统计范围；2025 年公司产能为 18,000 吨/年。

报告期内，发行人产销率整体维持在较高水平，表明公司产能释放节奏与下游客户需求基本匹配，产品具备良好的市场接受度和稳定的消化能力；发行人产销率 2024 年相对较低，主要由于 2024 年下半年内蒙产线开始试生产，副产品产出率较高，而当年副产品市场价格处于历史低位，发行人减少对外销售。

（二）发行人主要产品销售情况

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	174,138.73	97.23%	106,701.69	96.16%	86,498.92	91.41%
其他业务收入	4,968.70	2.77%	4,262.46	3.84%	8,128.00	8.59%
合计	179,107.43	100.00%	110,964.15	100.00%	94,626.92	100.00%

1、根据产品类别分类

报告期内，公司主营业务收入根据产品类别分类如下：

单位：万元

产品类别		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
区熔用多晶硅		1,858.43	1.07%	1,325.57	1.24%	84.74	0.10%
直拉用多晶硅	P 级	144,986.52	83.26%	81,918.37	76.77%	67,256.26	77.75%
	S 级	26,430.39	15.18%	22,250.02	20.85%	18,488.90	21.37%
其他主营业务		863.40	0.50%	1,207.74	1.13%	669.02	0.77%
合计		174,138.73	100.00%	106,701.69	100.00%	86,498.92	100.00%

注 1：公司其他主营业务产品包括碳化硅硅粉、电子特气、高纯石英砂等新产品，下同；

注 2：公司超高阻电子级多晶硅（J 级）目前实现小批量出货，金额较小，故与 P 级合并列示，下同。

根据产品形态和产品质量等级，发行人主营业务收入分为区熔用多晶硅、直拉用多晶硅和其他主营业务。直拉用电子级多晶硅又分为 J 级、P 级和 S 级产品。其中，J 级产品主要用于生产先进制程用 12 英寸硅片、高阻硅片等产品，杂质含量较 P 级更低，为目前全球前沿产品；P 级产品主要用于生产大尺寸硅片、高等级硅部件，杂质含量极低，指标波动极小，客户验证周期相对较长；S 级产品主要用于生产中小尺寸硅片、硅部件等，杂质含量低，指标波动小。报告期内，公司销售产品以 P 级为主，占比逐年提升。

2、根据销售模式分类

报告期内，公司主营业务收入以直销模式为主，各期直销收入占比均超过 95%，具体情况如下：

单位：万元

销售模式	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销模式	167,288.01	96.07%	102,456.59	96.02%	85,241.19	98.55%
贸易商模式	6,850.72	3.93%	4,245.10	3.98%	1,257.73	1.45%
合计	174,138.73	100.00%	106,701.69	100.00%	86,498.92	100.00%

（三）发行人主要产品销售价格的变动情况

报告期内，公司主要产品为电子级多晶硅产品，其销售价格变动情况详见本

招股说明书之“第六节、八、（三）、2、毛利率情况分析”。

（四）发行人向前五名客户的销售情况

公司销售产品包括电子级多晶硅以及副产品。报告期内，向前五名客户销售情况如下表所示：

单位：万元

2025 年度				
排名	客户名称	主要销售内容	收入金额	比例
1	TCL 中环及其下属公司	电子级多晶硅	41,053.89	22.92%
2	西安奕材	电子级多晶硅	30,034.40	16.77%
3	沪硅产业	电子级多晶硅	25,780.75	14.39%
4	立昂微	电子级多晶硅	21,599.47	12.06%
5	有研硅及其关联方	电子级多晶硅	9,570.71	5.34%
前五大合计			128,039.23	71.49%
2024 年度				
排名	客户名称	主要销售内容	收入金额	比例
1	TCL 中环及其下属公司	电子级多晶硅	24,334.09	21.93%
2	西安奕材	电子级多晶硅	18,707.88	16.86%
3	沪硅产业	电子级多晶硅	16,164.90	14.57%
4	立昂微	电子级多晶硅	8,756.69	7.89%
5	中晶科技	电子级多晶硅	5,916.41	5.33%
前五大合计			73,879.97	66.58%
2023 年度				
排名	客户名称	主要销售内容	收入金额	比例
1	TCL 中环及其下属公司	电子级多晶硅	21,170.12	22.37%
2	Ferrotec	电子级多晶硅	16,846.74	17.80%
3	沪硅产业	电子级多晶硅	12,441.42	13.15%
4	西安奕材	电子级多晶硅	6,740.74	7.12%
5	有研硅及其关联方	电子级多晶硅	5,421.20	5.73%
前五大合计			62,620.22	66.18%

注 1：Ferrotec 包括 Ferrotec Holdings Corporation 下属的中和新材料、宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司、宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司、杭州盾源聚芯半导体科技有限公司和浙江丽水中欣晶圆半导体材料有限公司；

注 2：TCL 中环及其下属公司包括 TCL 中环及其下属的内蒙古中环领先、中环领先徐州（于 2023 年 2 月被 TCL 中环收购，成为 TCL 中环的下属公司）、天津中环领先、天津环睿；

注 3：沪硅产业包括上海硅产业集团股份有限公司下属的上海新昇、上海新昇晶睿和晋科硅

材料；

注 4：西安奕材包括其下属的西安奕斯伟硅片技术有限公司和西安欣芯材料科技有限公司；

注 5：有研硅及其关联方包括有研硅及其下属的山东有研半导体材料有限公司，及其关联方山东有研艾斯半导体材料有限公司和有研国晶辉新材料有限公司；

注 6：济南科盛及其关联方包括济南科盛电子有限公司及其下属的内蒙古科晟科技有限公司，及其关联方山东科芯电子有限公司；

注 7：中晶科技包括其下属的宁夏中晶半导体材料有限公司和浙江中晶新材料研究有限公司；

注 8：立昂微包括其下属的杭州立昂半导体技术有限公司、金瑞泓科技（衢州）有限公司、金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司、金瑞泓微电子（衢州）有限公司和浙江金瑞泓科技股份有限公司。

报告期内，公司向前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为 66.18%、66.58%和 71.49%，各期第一大客户销售占比均不超过 30%，公司不存在向单个客户的销售比例超过 50%或严重依赖于少数客户的情况。公司向前五大客户销售收入占比相对较高，是由于下游国产硅片厂商尤其是 12 英寸硅片厂商较为集中，根据公开信息，在 12 英寸硅片领域国内前五大厂商占比 90%左右。公司主要客户均为下游行业主流厂商，与下游市场分布匹配。

报告期内，公司前五大客户中，除沪硅产业与发行人存在关联关系外，因 TCL 科技全资子公司天津硅石增资持有内蒙古鑫华 40%股权，自内蒙古鑫华增资完成前 12 个月内及之后，天津硅石视为发行人关联方，出于谨慎性原则，TCL 科技控制的 TCL 中环及其下属公司与发行人之间的交易往来自 2021 年 1 月 1 日起比照关联交易披露，其他主要客户与发行人不存在关联关系。发行人向沪硅产业、TCL 中环及其下属公司销售的产品由其自身生产经营使用。

四、发行人采购和主要供应商情况

（一）主要原材料、能源采购情况

公司原材料主要包括三氯氢硅、硅粉等。报告期期初，三氯氢硅主要委托中能硅业加工，2023 年开始公司由委托加工逐步转为自产。公司主要能源采购为电力与蒸汽。此外，公司还采购氮气等公用介质、硝酸等辅料以及备品备件用于生产。报告期内，发行人原材料、能源等采购情况如下：

单位：万元

类别	项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		采购额	占比	采购额	占比	采购额	占比
原材料	硅粉	15,638.43	16.53%	15,860.95	20.25%	10,724.52	16.91%
	三氯氢硅	5,123.57	5.41%	2,712.12	3.46%	3,485.90	5.50%

类别	项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		采购额	占比	采购额	占比	采购额	占比
	其他	2,387.10	2.52%	2,468.74	3.15%	2,407.18	3.80%
	小计	23,149.11	24.46%	21,041.82	26.86%	16,617.60	26.20%
能源	电力	44,610.81	47.14%	33,445.61	42.70%	29,268.04	46.15%
	蒸汽	9,089.86	9.61%	11,544.98	14.74%	7,040.34	11.10%
	小计	53,700.67	56.75%	44,990.59	57.43%	36,308.38	57.25%
公用介质		3,241.01	3.42%	3,150.69	4.02%	2,482.38	3.91%
辅料及备品备件		14,541.34	15.37%	9,152.08	11.68%	8,011.70	12.63%
合计		94,632.13	100.00%	78,335.19	100.00%	63,420.06	100.00%

2024 年下半年内蒙产线开始试生产，在配套三氯氢硅产能爬坡过程中，还存在部分委托加工三氯氢硅情形。此外，2025 年徐州三氯氢硅产线停产检修时，临时对外委托加工少量三氯氢硅。除委托加工外，公司在三氯氢硅产线达产爬坡及日常运行过程中，还需直接外购部分三氯氢硅、四氯化硅等原材料，用于工艺调试及补充系统物料损耗。

报告期内，公司采购蒸汽主要用于精馏、尾气回收、氢化及制冷机组等环节。在上述工序满产开工情况下，总体蒸汽消耗量稳定。2024 年下半年内蒙产线开始试生产，导致蒸汽采购进一步增加。2025 年蒸汽采购减少，主要系公司生产工艺优化导致氢化和精馏环节蒸汽耗用降低。

报告期内，公司采购的公用介质主要包括氮气等，用于物料系统保护等环节，采购金额占比整体较低。公用介质用量较为刚性，与产量不具备显著线性关系。

（二）主要原材料、服务价格变动趋势

1、主要原材料价格变动趋势

报告期内，公司采购的原材料主要为硅粉和三氯氢硅。报告期各期，公司主要原材料的价格变动情况如下：

单位：元/吨

采购项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
硅粉	67.87	83.37	100.00
三氯氢硅委托加工	49.07	105.20	100.00

三氯氢硅委托加工中，公司提供部分原材料，委托第三方根据原材料类别分

别采用冷氢化工艺或反歧化工艺加工三氯氢硅。2025 年，公司在原有基础上进一步向加工方提供部分硅粉作为委托加工的原料，因此三氯氢硅委托加工单价较以前年度大幅下降。

报告期内，公司硅粉平均采购价格持续下降，主要系受工业硅市场价格整体下行影响。

2、主要能源价格变动趋势

报告期内，公司采购的主要能源为电力与蒸汽，相关采购价格变化情况如下：

单位：元/度、元/吨

主要能源	平均采购价格		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度
电力	65.52	65.52	100.00
蒸汽	88.35	92.83	100.00

报告期内，电力与蒸汽平均采购价格整体呈下降趋势。电力采购价格下降原因请参见本招股说明书之“第六节、八、（二）、2、主营业务成本按料工费构成分析”。蒸汽采购价格略有下降，波动较小。

（三）报告期内向前五名原材料、能源供应商采购情况

报告期内，公司向前五名原材料、能源供应商采购情况如下表所示：

单位：万元

2025 年度				
排名	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占采购总额的比例
1	中能硅业及其关联方	电力、公用介质、三氯氢硅等	21,764.07	23.00%
2	内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电分公司	电力	19,384.27	20.48%
3	山东银丰纳米新材料有限公司	硅粉	15,318.69	16.19%
4	国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司	电力	10,280.01	10.86%
5	徐州金山桥热电有限公司	蒸汽	5,548.92	5.86%
前五大合计			72,295.96	76.40%
2024 年度				
排名	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占采购总额的比例

1	中能硅业及其关联方	电力、公用介质等	16,689.00	21.30%
2	山东银丰纳米新材料有限公司	硅粉	15,114.80	19.30%
3	国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司	电力	10,577.39	13.50%
4	内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电分公司	电力	10,234.41	13.06%
5	徐州金山桥热电有限公司	蒸汽	8,948.35	11.42%
前五大合计			61,563.95	78.59%
2023 年度				
排名	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占采购总额的比例
1	中能硅业及其关联方	电力、公用介质、三氯氢硅等	21,052.97	33.20%
2	国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司	电力	15,003.09	23.66%
3	徐州金山桥热电有限公司	蒸汽	7,040.34	11.10%
4	山东银丰纳米新材料有限公司	硅粉	4,072.73	6.42%
5	厦门建发股份有限公司	硅粉	3,287.16	5.18%
前五大合计			50,456.30	79.56%

注 1：对同一控制下的供应商合并计算；

注 2：中能硅业及其关联方包括中能硅业、河南协鑫光伏科技有限公司、协鑫特材、协鑫高科纳米、内蒙古鑫环和内蒙古鑫元硅材料科技有限公司；

注 3：厦门建发股份有限公司包括其下属的厦门建发高科有限公司和建发（北京）有限公司。

报告期内，公司向前五大供应商合计采购金额占各期采购总额的比例分别为 79.56%、78.59%和 **76.40%**，整体呈下降趋势。其中，公司向中能硅业及其关联方采购总额的占比分别为 33.20%、21.30%和 **23.00%**，亦呈逐年显著下降趋势，不存在对中能硅业或其关联方的重大依赖。公司与中能硅业及其关联方交易的具体情况请参见本招股说明书之“第八节、七、（二）关联交易”。

公司报告期各期新增前五大供应商中，厦门建发高科有限公司、山东银丰纳米新材料有限公司为硅粉供应商，新增原因为发行人 2022 年 12 月冷氢化生产装置建成之后，自产三氯氢硅，需对外采购硅粉；内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电分公司为内蒙古鑫华电力供应单位，随着内蒙古鑫华半导体电子级多晶硅生产基地产能逐渐爬坡，电力采购金额大幅增加。

报告期内，除中能硅业及其关联方、金山桥外，公司其他主要供应商与发行人不存在关联关系。

五、发行人主要固定资产、无形资产及其他资源要素

（一）主要固定资产情况

1、固定资产概况

发行人固定资产主要包括房屋及建筑物、专用设备、运输工具、办公设备及其他设备等。截至 2025 年 12 月 31 日，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元

项目	折旧年限	原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	10-20 年	84,268.95	8,137.63	76,131.32	90.34%
专用设备	5-15 年	353,283.37	113,989.68	239,293.70	67.73%
运输工具	4-5 年	1,123.98	622.72	501.26	44.60%
办公设备及其他设备	3-10 年	5,732.06	2,077.80	3,654.26	63.75%
合计		444,408.36	124,827.83	319,580.54	71.91%

截至 2025 年 12 月 31 日，公司固定资产总体成新率为 71.91%，主要机器设备的使用性能良好。报告期内，公司固定资产未出现因市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情形，故公司未计提固定资产减值准备。

发行人与建信金融租赁有限公司分别于 2022 年 7 月 11 日、2022 年 7 月 29 日签署售后回租融资租赁协议，将部分设备转让给建信金融租赁有限公司，并以融资租赁方式回租该部分设备，转让价款合计 4.5 亿元，租赁期限自起租日起算，共计 5 年，发行人于租赁期限届满后取回该部分设备的所有权。上述售后回租交易实质为抵押借款，本公司将收到的转让价款作为长期应付款列示。

2、房屋及建筑物

（1）自有房产

截至本招股说明书签署日，发行人自有房产情况具体如下：

序号	权利主体	权属证书编号	坐落	用途	房屋建筑面积 (m ²)	使用期限至	他项权利
1	鑫华半导体	苏（2022）徐州市不动产权第0106285号	徐州市金山桥区徐州经济技术开发区杨山路66号	工业	19,215.20	2056/08/19	抵押

序号	权利主体	权属证书编号	坐落	用途	房屋建筑面积 (m ²)	使用期限至	他项权利
2	鑫华半导体	苏（2023）徐州市不动产权第0069563号	徐州市金山桥区徐州经济技术开发区杨山路66号	工业	6,486.23	2056/08/19	无
3	鑫华半导体	苏（2023）徐州市不动产权第0069558号	徐州市金山桥区徐州经济技术开发区杨山路66号	工业	6,505.81	2056/08/19	无
4	鑫华半导体	苏（2026）徐州市不动产权第0039897号	徐州市金山桥区徐州经济技术开发区杨山路66号	工业	6,992.39	2056/08/19	无

（2）租赁房产

截至本招股说明书签署日，发行人租赁的主要房产情况具体如下：

序号	承租方	出租方	坐落	租赁面积(m ²)	租金	租赁期限	用途
1	鑫华半导体	中能硅业	徐州市金山桥区徐州经济技术开发区杨山路66号	25,232.23	6.5 元/m ² /月	2022/10/01 至 2036/12/31	生产用房
2	鑫华半导体	中能硅业	徐州市金山桥区徐州经济技术开发区杨山路66号	1,310.75	13 元/m ² /月	2025/05/01 至 2035/04/30	配电室
3	徐州泛半导体	徐州城投园区管理有限公司	徐州经济技术开发区徐海路南侧凤凰湾集成电路产业园	4,800	16 元/m ² /月	2024/01/19 至 2029/01/18	生产用房
4	徐州泛半导体	徐州城投园区管理有限公司	徐州经济技术开发区徐海路南侧凤凰湾集成电路产业园	3 号甲类仓库面积 275.4m ² ；氢气站 352m ²	3 号甲类仓库 17 元/m ² /月；氢气站 17 元/m ² /月	2024/03/07 至 2029/03/06	甲类仓库
5	湖北鑫阳	十堰聚鑫产业园区运营管理有限公司	十堰市云阳经济开发区大运路8号	厂房面积 8,389.30m ² ；办公楼及宿舍面积 2,318.21m ²	办公及宿舍楼：12 元/m ² /月；B、C 车间：12 元/m ² /月；D、E 车间：9 元/m ² /月；	2025/08/21 至 2026/08/20	车间、宿舍、办公楼

（二）主要无形资产情况

1、无形资产概况

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人无形资产具体情况如下：

单位：万元

类别	账面原值	累计摊销	账面价值
土地使用权	18,241.80	1,688.84	16,552.96
非专利技术	2,220.39	1,529.68	690.70
软件及其他	2,653.23	801.12	1,852.11
合计	23,115.41	4,019.64	19,095.77

2、土地使用权

（1）自有土地使用权

截至本招股说明书签署日，发行人所拥有的土地使用权情况具体如下：

序号	权利主体	不动产权证书编号	坐落	面积（m ² ）	用途	使用期限至	他项权利
1	鑫华半导体	苏（2022）徐州市不动产权第0106285号	徐州市金山桥区徐州经济技术开发区杨山路66号	35,021.63	工业	2056/08/19	抵押
2	鑫华半导体	苏（2023）徐州市不动产权第0069563号	徐州市金山桥区徐州经济技术开发区杨山路66号	29,853.05	工业	2056/08/19	无
3	鑫华半导体	苏（2023）徐州市不动产权第0069558号	徐州市金山桥区徐州经济技术开发区杨山路66号	17,339.56	工业	2056/08/19	无
4	鑫华半导体	苏（2026）徐州市不动产权第0039897号	徐州市金山桥区徐州经济技术开发区杨山路66号	29,853.05	工业	2056/8/19	无
5	内蒙古鑫华	蒙（2022）呼和浩特市不动产权第0048792号	呼和浩特市金桥开发区世纪十七路南	150,561.93	工业	2058/08/26	无
6	内蒙古鑫华	蒙（2022）呼和浩特市不动产权第0074479号	呼和浩特市赛罕区金桥开发区金电路以东、阿木尔南街以北	65,959.78	工业	2072/08/08	无

（2）租赁土地使用权

截至本招股说明书签署日，发行人租赁土地使用权情况具体如下：

序号	承租方	出租方	坐落	租赁面积	租金	租赁期限	用途
1	鑫华半导体	中能硅业	徐州市金山桥区徐州经济技	3,390.00m ²	2 元/m ² /月	2022/10/01 至 2036/12/31	生产、仓储、办公、

序号	承租方	出租方	坐落	租赁面积	租金	租赁期限	用途
			术开发区杨山路66号				污水处理
2	湖北鑫阳	十堰聚鑫产业园区运营管理有限公司	十堰市云阳经济开发区大运路8号	13.35 亩	500 元/亩/月	2025/08/21 至 2026/08/20	存放矿石、机器设备

3、商标

（1）发行人自有商标权

截至本招股说明书签署日，发行人所拥有的商标情况如下：

序号	权利人	注册号	商标	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
1	发行人	38449513		1	2020/06/07-2030/06/06	继受取得	无
2	发行人	38449514		7	2020/06/07-2030/06/06	继受取得	无
3	发行人	63419691A		9	2022/10/28-2032/10/27	原始取得	无
4	发行人	63421424A		40	2022/10/28-2032/10/27	原始取得	无
5	发行人	62405450		1	2022/07/28-2032/07/27	原始取得	无
6	发行人	62400235		35	2022/07/28-2032/07/27	原始取得	无
7	发行人	62404161A		40	2022/08/14-2032/08/13	原始取得	无
8	发行人	62397456A		9	2022/08/14-2032/08/13	原始取得	无
9	发行人	77799217		35	2024/09/28-2034/09/27	原始取得	无
10	发行人	77792280		1	2024/09/28-2034/09/27	原始取得	无
11	发行人	77791428		9	2024/12/14-2034/12/13	原始取得	无
12	发行人	77791425		40	2024/10/07-2034/10/06	原始取得	无
13	发行人	77778338		1	2024/09/28-2034/09/27	原始取得	无
14	发行人	77791419		9	2024/11/28-2034/11/27	原始取得	无
15	发行人	77778285		40	2024/09/28-2034/09/27	原始取得	无

序号	权利人	注册号	商标	核定使用商品类别	有效期	取得方式	他项权利
16	发行人	77795935		35	2025/10/28-2035/10/27	原始取得	无
17	发行人	02528795		中国台湾地区第 009 类	2026/5/1-2036/4/30	原始取得	无

（2）发行人及子公司获授权使用的商标权

发行人与协鑫控股和中能硅业于 2022 年 4 月 6 日签署了《商标使用许可协议》，发行人获授权免费使用 11 项注册商标，许可使用方式为普通许可，许可使用的期限追溯确认至 2019 年 1 月 1 日，即许可使用的期限为 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日止，许可期限届满 30 天前双方无异议则自动按年续期，许可使用的地域为许可商标被许可使用的国家和地区范围。内蒙古鑫华与协鑫控股和中能硅业于 2022 年 6 月 20 日签署了《商标使用许可协议》，内蒙古鑫华获授权免费使用 11 项注册商标，许可使用方式为普通许可，许可使用的期限为 2022 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 30 日止，许可期限届满 30 天前双方无异议则自动按年续期。

2025 年 2 月 21 日，发行人、内蒙古鑫华与协鑫控股、中能硅业经友好协商，一致同意解除《商标使用许可协议》。截至本招股说明书签署之日，发行人及子公司不存在获授权使用的商标权。

4、域名

截至本招股说明书签署日，发行人拥有的域名如下：

序号	所有权人	域名	到期时间	ICP 网站备案号
1	发行人	sinvar.com	2031/02/07	苏 ICP 备 2022003635 号-1
2	发行人	sinvar.com	2032/02/07	苏 ICP 备 2022003635 号-3

5、专利

截至本招股说明书签署日，发行人在中国境内共拥有 144 项已获授权专利，包括发明专利 59 项，实用新型专利 85 项，具体情况如下：

(1) 发明专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	授权日	取得方式	他项权利
1	发行人、徐州泛半导体	硅碳负极材料及其制备方法、负极极片、电化学装置	ZL202511513796.5	2026/02/06	原始取得	无
2	内蒙古鑫华	电子级多晶硅还原炉的底盘清洁方法	ZL202410458060.1	2026/01/30	原始取得	无
3	发行人	一种硅料清洗装置及使用方法	ZL202410140526.3	2026/01/27	原始取得	无
4	发行人	一种电子级硅料清洗装置及方法	ZL202410202301.6	2025/11/25	原始取得	无
5	内蒙古鑫华	一种电子级硅棒外观自动检测与标识设备及其检测工艺	ZL202410010651.2	2025/11/18	原始取得	无
6	发行人	纳米硅及其制备方法和锂离子电池负极材料	ZL202310166361.2	2025/11/07	原始取得	无
7	发行人、江苏师范大学	三维电极及其制备方法和应用	ZL202211529837.6	2025/11/07	原始取得	无
8	发行人	碳化硅外延片及其制备方法和半导体器件	ZL202510915846.6	2025/09/30	原始取得	无
9	发行人	一种基于交直流综合调控的多晶硅沉积方法	ZL202510942821.5	2025/09/19	原始取得	有
10	发行人	一种多晶硅棒破碎装置及其破碎方法	ZL202311072814.1	2025/09/19	原始取得	无
11	内蒙古鑫华	一种区熔用多晶硅原料联合母料生产工艺	ZL202311653785.8	2025/09/09	原始取得	无
12	发行人	基于硅芯棒生长特征的多晶硅沉积进气装置及控制方法	ZL202510884885.4	2025/09/02	原始取得	有
13	发行人	多晶硅破碎方法	ZL202310495908.3	2025/08/29	原始取得	无
14	发行人	一种电子级多晶硅棒破碎方法及系统	ZL202310803300.2	2025/08/05	原始取得	无
15	发行人	超高纯电子级多晶硅的提纯方法及其用途	ZL202310114726.7	2025/06/03	原始取得	无
16	发行人	切割 U 形硅棒的方法	ZL202211475782.5	2025/05/30	原始取得	有
17	发行人	电子级多晶硅的尾气处理方法	ZL202310349188.X	2025/04/08	原始取得	无
18	发行人	电子级多晶硅筛分装置	ZL202211468898.6	2025/03/11	原始取得	无
19	发行人	多晶硅还原炉和多晶硅化学气相沉积方法	ZL202110226249.4	2024/12/31	原始取得	无
20	发行人	三氯氢硅净化系统和方法	ZL202010344097.3	2024/08/06	原始取得	无
21	发行人	电子级多晶硅清洗系统和方法	ZL202011255660.6	2024/08/06	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	授权日	取得方式	他项权利
22	发行人	用于电子级多晶硅生产系统的在线监测痕量杂质的方法	ZL202111661288.3	2024/08/06	原始取得	无
23	发行人	检测块状多晶硅杂质的装置及其用途、检测方法	ZL202210553776.0	2024/06/14	原始取得	无
24	发行人	衬底及其制备方法	ZL202410320975.6	2024/06/14	原始取得	无
25	发行人	从含有氯硅烷的渣浆中分离硅粉的方法、系统及其用途	ZL202211370069.4	2024/04/12	原始取得	无
26	发行人	一种硅棒 U 形弯的切割分离装置及切割方法	ZL201810916026.9	2024/02/09	原始取得	无
27	发行人	电子级多晶硅 CVD 炉内破碎方法和装置	ZL202210134709.5	2024/01/30	原始取得	无
28	发行人	复合导电粘结剂及其制备方法与应用	ZL202210187311.8	2024/01/26	原始取得	无
29	发行人	电子级六氯乙硅烷及其制备方法和应用	ZL202211313645.1	2023/10/24	原始取得	无
30	发行人	制备低内应力区熔用电子级多晶硅的系统和方法	ZL202010120753.1	2023/09/22	原始取得	无
31	发行人、广陵学院	清洁机器人及清洁方法	ZL202310845640.1	2023/09/19	原始取得	无
32	发行人	制备区熔用电子级多晶硅的方法和系统	ZL202010120752.7	2023/08/01	原始取得	无
33	发行人	电子级多晶硅用硅芯清洗设备	ZL202210632512.4	2023/08/01	原始取得	无
34	发行人	多晶硅样芯清洗分析方法以及系统	ZL202210405419.X	2023/07/14	原始取得	无
35	发行人	评估袋装多晶硅干燥效果的方法	ZL202111197335.3	2023/06/20	原始取得	有
36	发行人	对电子级多晶硅进行清洗的方法	ZL202210376804.6	2023/06/20	原始取得	无
37	发行人	提纯三氯氢硅的方法及系统	ZL202010120663.2	2023/04/07	原始取得	无
38	发行人	对电子级多晶硅块进行干燥的方法和系统	ZL202211611821.X	2023/03/31	原始取得	无
39	发行人	多晶硅块的包装方法	ZL202211529171.4	2023/03/14	原始取得	有
40	发行人	生产电子级多晶硅的方法	ZL202110405133.7	2023/02/24	原始取得	无
41	发行人	用于区熔的多晶硅棒的预处理方法	ZL202210781422.1	2022/09/23	原始取得	无
42	发行人	一种红外测温仪的校正装置及校正方法	ZL201810145650.3	2022/07/15	原始取得	无
43	发行人	电子级多晶硅还原炉及多晶硅的生产方法	ZL201710904159.X	2022/04/01	原始取得	无
44	发行人	一种三氯硅烷的检测前处理方法及检测方法	ZL202110905705.8	2022/02/22	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	授权日	取得方式	他项权利
45	发行人	一种超临界二氧化碳硅块清洗装置、硅块处理系统及方法	ZL202110749231.2	2022/02/18	原始取得	无
46	发行人、广陵学院	一种多晶硅清洗液的评估方法	ZL202111058646.1	2022/02/15	原始取得	无
47	发行人	一种电子级多晶硅生产用氢气提纯的方法	ZL202110748209.6	2022/02/01	原始取得	无
48	发行人	电子级多晶硅清洗方法	ZL202011290207.9	2022/01/28	原始取得	无
49	发行人	一种硅块破碎装置及使用方法、硅块破碎方法及应用方法	ZL202110769884.7	2021/10/08	原始取得	无
50	发行人	电子级多晶硅生产系统和方法	ZL202011301481.1	2021/09/21	原始取得	无
51	发行人	一种三氯氢硅质量检测方法、提纯控制方法及装置	ZL202110774793.2	2021/09/17	原始取得	无
52	协鑫特材、发行人	一种化学气相沉积反应器	ZL201610805996.2	2019/01/01	原始取得	无
53	发行人	一种用于生产硅烷的隔壁塔	ZL201710072132.9	2018/09/11	原始取得	无
54	发行人	一种耦合的多晶硅生产系统	ZL201710053559.4	2018/08/31	原始取得	无
55	发行人	采用表面微结构硅芯沉积多晶硅的方法	ZL201010604262.0	2012/05/16	继受取得	无
56	发行人	一种多晶硅的生产工艺	ZL200910263230.6	2011/12/21	继受取得	无
57	发行人	硅碳负极材料及其制备方法、负极极片和电化学装置	ZL202511487851.8	2026/02/17	原始取得	无
58	发行人	一种用于石英矿的高效冷却方法及冷却系统	ZL202311056395.2	2026/04/14	原始取得	无
59	内蒙古鑫华	电子级多晶硅还原炉生长设备及沉积颗粒检测方法	ZL202410384188.8	2026/04/14	原始取得	无

注：2025 年 12 月 19 日，发行人与南京银行股份有限公司徐州分行（以下简称“质权人”）签订《权利质押合同》，将上述第 9、12、16、35、39 项专利质押给质权人，用于担保发行人对质权人 1,000 万元的借款，质权自 2025 年 12 月 25 日起设立，专利权质押登记号为 Y2025980065455。

（2）实用新型专利

序号	专利权人	专利名称	专利号	授权日	取得方式	他项权利
1	发行人	一种新型气流吹扫流化床	ZL202423030060.6	2025/12/12	原始取得	无
2	发行人	一种电子级多晶硅装袋装置	ZL202520032100.6	2025/12/02	原始取得	无
3	内蒙古鑫华	电子级混酸回收系统	ZL202521302828.2	2025/07/29	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	授权日	取得方式	他项权利
4	发行人	一种超重力精馏装置	ZL202421944986.3	2025/07/01	原始取得	无
5	发行人	一种 EP 洁净管道检查工装	ZL202421870162.6	2025/06/17	原始取得	无
6	内蒙古鑫华	变电站及供电系统	ZL202421840286.X	2025/05/23	原始取得	无
7	发行人	一种多晶硅的酸洗废气处理系统	ZL202421498905.1	2025/04/11	原始取得	无
8	内蒙古鑫华	多晶硅干燥系统	ZL202520178695.6	2025/04/08	原始取得	无
9	内蒙古鑫华	一种电子级多晶硅输送系统	ZL202423231350.7	2025/03/11	原始取得	无
10	发行人	上半月石墨件及外延炉	ZL202420354196.3	2025/03/11	原始取得	无
11	发行人	一种用于电子级多晶硅干燥的系统	ZL202420679088.3	2025/03/07	原始取得	无
12	发行人	一种用于电子级多晶硅等静压石墨的纯化装置	ZL202420561145.8	2025/03/07	原始取得	无
13	发行人	一种用于高纯电子特气的在线取样系统	ZL202420489917.1	2025/02/25	原始取得	无
14	发行人	一种用于废气、废液处理的可移动溶解装置	ZL202420412831.9	2025/02/14	原始取得	无
15	发行人	一种李比希管洁净焊接装置	ZL202420278762.7	2025/01/28	原始取得	无
16	发行人	多晶硅沉积层形貌保持用基板酸洗装置	ZL202420213905.6	2025/01/28	原始取得	无
17	发行人	一种用于电子级多晶硅废酸回收系统	ZL202421244363.5	2025/01/24	原始取得	无
18	发行人	一种新型电子级区熔多晶硅 CVD 反应系统	ZL202420320886.7	2025/01/24	原始取得	无
19	发行人、徐州泛半导体	一种高纯石英砂连续浮选装置	ZL202420166839.1	2025/01/03	原始取得	无
20	内蒙古鑫华	十字头销安装工具	ZL202421122629.9	2025/01/03	原始取得	无
21	内蒙古鑫华	转运装置及物料工线	ZL202422725474.4	2025/01/03	原始取得	无
22	内蒙古鑫华	多晶硅生产系统	ZL202422720350.7	2025/01/03	原始取得	无
23	发行人、徐州泛半导体	一种高纯石英砂氯化提纯尾气收集装置	ZL202420289844.1	2024/12/20	原始取得	无
24	发行人	一种用于硅料热破的保护结构	ZL202420286152.1	2024/11/29	原始取得	无
25	发行人	一种多晶硅材料加工用抑尘式磨面机	ZL202420042861.5	2024/11/15	原始取得	无
26	发行人	一种三氯氢硅杂质去除装置	ZL202420208120.X	2024/11/01	原始取得	无
27	内蒙古鑫华	一种硅料的酸洗设备	ZL202422324313.4	2024/11/01	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	授权日	取得方式	他项权利
28	内蒙古鑫华	预热装置和具有其的硅芯炉	ZL202323425945.1	2024/10/01	原始取得	无
29	内蒙古鑫华	用于硅芯炉的预热装置和具有其的硅芯炉	ZL202323360743.3	2024/08/23	原始取得	无
30	内蒙古鑫华	破碎设备	ZL202420037277.0	2024/08/23	原始取得	无
31	内蒙古鑫华	多晶硅破碎除尘装置	ZL202421243194.3	2024/07/29	原始取得	无
32	内蒙古鑫华	安装工具	ZL202421112877.5	2024/06/18	原始取得	无
33	内蒙古鑫华	一种无尘清洁服清洗设备	ZL202323076433.9	2024/06/11	原始取得	无
34	发行人	一种氯硅烷与氢气气液分离系统	ZL202322579708.4	2024/04/26	原始取得	无
35	发行人	多晶硅还原炉喷嘴组件和多晶硅还原炉	ZL202322652999.5	2024/04/19	原始取得	无
36	发行人	一种籽晶夹头	ZL202322611311.9	2024/04/16	原始取得	无
37	发行人	氯硅烷提纯装置	ZL202322181430.5	2024/04/05	原始取得	无
38	发行人	一种多晶硅还原炉喷嘴及还原炉	ZL202322492396.3	2024/04/05	原始取得	无
39	发行人	一种碳化硅外延片生长加热器	ZL202322394212.X	2024/04/02	原始取得	无
40	发行人	一种高纯多晶硅包装袋	ZL202322256311.1	2024/03/29	原始取得	无
41	发行人	一种多晶硅生产还原系统	ZL202322284605.5	2024/03/19	原始取得	无
42	发行人	一种多晶硅破碎锤	ZL202321834122.1	2024/02/09	原始取得	无
43	发行人	一种石墨夹头组件及多晶硅反应炉	ZL202321896586.5	2024/01/02	原始取得	无
44	发行人	一种多晶硅反应炉	ZL202321902989.6	2024/01/02	原始取得	无
45	发行人	硅料清洗装置	ZL202320972247.4	2023/11/24	原始取得	无
46	发行人	粉体分级系统	ZL202321072428.8	2023/11/24	原始取得	无
47	发行人	用于区熔检测的多晶硅棒抛光垫	ZL202321102142.X	2023/10/03	原始取得	无
48	发行人	托盘	ZL202320208949.5	2023/08/08	原始取得	无
49	发行人	去除石墨件碳化硅沉积层的设备	ZL202320293299.9	2023/07/18	原始取得	无
50	发行人	清洗料篮	ZL202320015758.7	2023/05/09	原始取得	无
51	发行人	提高碳化硅外延生产洁净度的装置	ZL202320145938.7	2023/04/11	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	授权日	取得方式	他项权利
52	发行人	定量测试多晶硅含水量的系统	ZL202222970939.3	2023/03/21	原始取得	无
53	发行人	电子级多晶硅清洗装置	ZL202222971518.2	2023/03/07	原始取得	无
54	发行人	多晶硅棒翘曲度的测试装置	ZL20222269821.8	2022/12/13	原始取得	无
55	发行人	多晶硅还原炉	ZL20221950013.1	2022/10/11	原始取得	无
56	发行人	废酸回收装置	ZL20221437943.7	2022/09/20	原始取得	无
57	发行人	用于多槽连续清洗设备的弹性抓取装置	ZL20220773451.9	2022/07/26	原始取得	无
58	发行人	用于压缩机的密封组件、密封装置和压缩机	ZL202122737503.5	2022/07/12	原始取得	无
59	发行人	一种用于风淋室悬挂物资的工装	ZL20220591175.4	2022/07/12	原始取得	无
60	发行人	取样充装一体化装置	ZL202122469921.0	2022/06/21	原始取得	无
61	发行人	往复式活塞压缩机	ZL202122599781.9	2022/06/14	原始取得	无
62	发行人	多晶硅还原炉的底盘和多晶硅还原炉	ZL202123450637.5	2022/06/14	原始取得	无
63	发行人	颚式破碎机动臂的连杆机构和具有其的颚式破碎机	ZL202122494464.0	2022/04/05	原始取得	无
64	发行人	物料分选系统	ZL202122615702.9	2022/04/05	原始取得	无
65	发行人	电子级多晶硅清洗系统	ZL202022606894.2	2021/09/17	原始取得	无
66	发行人	多晶硅还原炉	ZL202120443526.2	2021/04/05	原始取得	无
67	发行人	提纯三氯氢硅的系统	ZL202020217179.7	2021/03/19	原始取得	无
68	发行人	对多晶硅生产中循环氢进行纯化的系统	ZL202020217215.X	2021/03/19	原始取得	无
69	发行人	硅块破碎装置	ZL202020358560.5	2021/03/19	原始取得	无
70	发行人	制热-冷冻-声波联用硅块破碎装置	ZL202020357309.7	2021/01/29	原始取得	无
71	发行人	三氯氢硅净化系统	ZL202020671519.3	2021/01/29	原始取得	无
72	发行人	预处理-声波联用硅块破碎装置	ZL202020357625.4	2021/01/12	原始取得	无
73	发行人	制备低内应力区熔用电子级多晶硅的系统	ZL202020217188.6	2020/12/18	原始取得	无
74	发行人	制备区熔用电子级多晶硅的系统	ZL202020217207.5	2020/12/18	原始取得	无

序号	专利权人	专利名称	专利号	授权日	取得方式	他项权利
75	发行人	电子级多晶硅筛分装置	ZL202020217214.5	2020/12/18	原始取得	无
76	发行人	一种硅棒 U 形弯的切割分离装置	ZL201821297684.6	2019/08/16	原始取得	无
77	发行人	一种区熔硅生产用的用于夹持硅芯的石墨电极夹头	ZL201820468090.0	2018/11/09	原始取得	无
78	发行人	一种用于红外测温仪温度校正的视镜和一种红外测温仪的校正装置	ZL201820251385.2	2018/09/25	原始取得	无
79	发行人	一种电子级多晶硅的生产系统	ZL201720111678.6	2017/12/12	原始取得	无
80	发行人	一种用于生产硅烷的隔壁塔	ZL201720115594.X	2017/09/12	原始取得	无
81	发行人	一种电子级多晶硅尾气吸收的控制系统	ZL201720109977.6	2017/08/29	原始取得	无
82	发行人	用于电子级多晶硅尾气纯化的多层吸附塔	ZL201621453271.3	2017/08/15	原始取得	无
83	协鑫特材、发行人	一种化学气相沉积反应器	ZL201621037771.9	2017/03/15	原始取得	无
84	协鑫特材、发行人	一种石墨隔热装置及具有石墨隔热装置的 CVD 反应器	ZL201621037871.1	2017/03/15	原始取得	无
85	内蒙古鑫华	用于固定电缆盘的固定装置	ZL202521001469.7	2026/04/28	原始取得	无

6、软件著作权

截至本招股说明书签署日，发行人拥有软件著作权 5 项，具体情况如下：

序号	软件名称	登记号	登记日期	取得方式	著作权人	他项权利
1	石英砂提纯过程智能监控平台软件 V1.0	2025SR2056544	2025/10/23	原始取得	湖北鑫阳	无
2	高纯石英砂选矿全流程生产指标优化分析软件 V1.0	2025SR2275341	2025/11/25	原始取得	湖北鑫阳	无
3	矿石破碎生产线智能控制系统软件 V1.0	2025SR2235824	2025/11/20	原始取得	湖北鑫阳	无
4	高纯石英砂智能上料系统物料流量	2025SR2235826	2025/11/20	原始取得	湖北鑫阳	无

序号	软件名称	登记号	登记日期	取得方式	著作权人	他项权利
	精准控制软件 V1.0					
5	高性能磁选机参数自适应调控软件 V1.0	2025SR2275332	2025/11/25	原始取得	湖北鑫阳	无

（三）其他资源要素

1、业务经营资质情况

截至本招股说明书签署日，发行人取得的对生产经营重要的业务资质、许可证书等资源要素列示如下：

序号	公司名称	资质名称	发证机关	证书编号	有效期至
1	鑫华半导体	高新技术企业证书	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	GR202532016017	2028/12/18
2	鑫华半导体	安全生产许可证	江苏省应急管理厅	（苏）WH 安许证字（C00193）	2028/07/17
3	内蒙古鑫华	安全生产许可证	内蒙古自治区应急管理厅	（蒙）WH 安许证字[2024]001275 号	2027/12/18
4	鑫华半导体	危险化学品登记证	江苏省化学品登记中心和应急管理部化学品登记中心	32032500041	2028/11/12
5	内蒙古鑫华	危险化学品登记证	内蒙古自治区危险化学品登记办公室和应急管理部化学品登记中心	15012400019	2027/03/26
6	鑫华半导体	排污许可证	徐州市生态环境局	91320301MA1MCPL L8F001R	2028/03/13
7	鑫华半导体	排污许可证	徐州市生态环境局	91320301MA1MCPL L8F001R	2028/06/05
8	鑫华半导体	排污许可证	徐州市生态环境局	91320301MA1MCPL L8F001R	2028/12/27
9	内蒙古鑫华	排污许可证	呼和浩特市生态环境局	91150105MABMQK DB6L001V	2029/12/04
10	鑫华半导体	城镇污水排入排水管网许可证	徐州经济技术开发区行政审批局	苏（徐开）水排字（2022）第（008）号	2027/04/26
11	内蒙古鑫华	城镇污水排入排水管网许可证	呼和浩特市赛罕区住房和城乡建设局	蒙 A 赛字第 0001 号	2029/11/05
12	鑫华半导体	对外贸易经营者备案登记表	徐州市商务局	04195373	长期有效

2、特许经营权

截至本招股说明书签署日，发行人无特许经营权。

六、发行人核心技术与研发情况

（一）核心技术情况

1、主要核心技术及技术来源

公司是国内领先的电子级多晶硅材料供应商。公司自成立以来长期专注于电子级多晶硅材料的研发、生产和销售，持续积累并优化核心技术。

公司的核心技术是公司的主要竞争力之一。经过多年的技术实践与积累，公司突破并优化了多项关键技术，自主研发了电子级多晶硅长周期稳定量产产业化技术、ppt 级氯硅烷痕量杂质纯化技术、高效 CVD 可控晶体沉积技术、硅棒洁净破碎、硅块洁净刻蚀等 11 项主要核心技术，构建了较高的技术壁垒，公司拥有的改良西门子法电子级多晶硅生产工艺技术已处于国际先进水平。

公司掌握的核心技术情况如下：

序号	核心技术名称	技术来源	核心技术应用的具体生产环节	相关专利情况	技术所处阶段
1	电子级多晶硅长周期稳定量产产业化技术	自主研发	电子级多晶硅生产系统	已授权发明专利 11 项	大批量生产
2	ppt 级氯硅烷痕量杂质纯化技术		精馏工序	已授权发明专利 4 项	大批量生产
3	高效 CVD 可控晶体沉积技术		还原工序	已授权发明专利 4 项	大批量生产
4	还原炉及配套辅助设备开发技术			已授权发明专利 10 项	大批量生产
5	还原尾气分离及氢气提纯技术		尾气回收工序	已授权发明专利 2 项	大批量生产
6	硅棒洁净破碎技术		后处理工序	已授权发明专利 4 项	大批量生产
7	硅块筛分技术			已授权发明专利 1 项	大批量生产
8	硅块洁净刻蚀技术			已授权发明专利 7 项	大批量生产
9	痕量杂质检测技术		检测工序	已授权发明专利 3 项	大批量生产
10	区熔用多晶硅棒生产技术		-	已授权发明专利 3 项	试生产
11	硅基特气生产技术		气体提纯及充装工序	已授权发明专利 1 项	试生产

2、技术先进性及具体表征

依托公司的研发实力和工艺技术积累，公司已承担和具体实施多项国家及省

级核心技术攻关项目，公司是国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》（02 专项）子课题《电子级多晶硅材料研发》的具体实施单位，公司承担了“国家工业强基工程”“江苏省工业和信息产业转型升级项目”“江苏省关键核心技术攻关项目”以及“江苏省重点研发计划项目”。基于在电子级多晶硅领域的技术能力与行业地位，公司已被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，并作为牵头单位完成了国家标准《电子级多晶硅》的修订工作。

（1）电子级多晶硅长周期稳定量产产业化技术

电子级多晶硅的主流工艺是改良西门子法，生产过程较为复杂，洁净度控制难度极高，杂质去除难度大。对于产业化规模量产技术而言，需要规划高效合理的物料处理流程，匹配满足要求的设备及公辅条件，将多晶硅中的施主、受主、碳、表面金属等关键杂质含量控制在极低水平，并能长期维持产品质量的稳定表现，这是一个系统性的工艺设计难题，长期困扰我国多晶硅行业。

公司通过对 CVD、痕量精馏提纯、硅块表面洁净处理等瓶颈环节进行技术攻关，对物料走向、冷热源供给等进行了优化布局，结合对各质量影响环节的控制逻辑优化提升，改善了各生产环节间的质量匹配性，大幅提高系统整体生产效率和水平，形成了具有自主知识产权的闭路循环全流程生产工艺，解决了万吨级电子级多晶硅大规模量产工艺技术难题。

（2）ppt 级氯硅烷痕量杂质纯化技术

改良西门子法的主要原料为 SiHCl_3 ，其纯度决定了电子级多晶硅产品的纯度水平。因为 SiHCl_3 含有硼、磷及其他金属杂质，浓度在 10^{-11} - 10^{-12} 量级，除杂困难，所以杂质分离提纯技术成为制约多晶硅产品质量的瓶颈问题。同时限于现有检测技术发展水平，对液体 SiHCl_3 中各类杂质的检测极限仅能达到 10^{-9} - 10^{-10} 量级，导致杂质含量难以精确测量。

公司创新研发了痕量杂质“精馏-吸附-络合”联用定向除杂技术，并配套研制了专用的隔壁塔和反应精馏塔，开发了新型催化体系和特种精馏填料，大幅度提升对原料的除杂能力，使 SiHCl_3 的最终纯度达到 10^{-11} 以上。同时公司还设计了“提纯+稳定”双向原则的多塔精馏流程，开发了延时调整技术，以小试放行的方式检测精馏效果，使得原料纯度的稳定性能够得到保证，满足了集成电路产

业对质量波动的要求。

（3）高效 CVD 可控晶体沉积技术

改良西门子的核心在于 CVD 环节，即在还原炉中通过 SiHCl_3 和 H_2 在一定温度、压力条件下的化学气相沉积产出多晶硅棒，该环节为全过程化学变化的最后一步，直接影响电子级多晶硅产品的体杂质水平，同时其作为核心生产环节和主要能耗环节，也直接影响全过程的生产效率和最终成本。

公司建立了 CVD 反应模型并根据实际数据实现了对数值仿真模型的修正，形成了对该环节的数值理论模拟能力。依据多年的研发积累，通过调整温度、进料量、 SiHCl_3 的比例，优化了 CVD 工艺配方，实现了对晶体生长形态、沉积速度的有效控制，同时利用对气体组分的分段控制，调控不同气体组分的沉积选择性，避免杂质参与晶体的沉积并在多晶硅产品中的富集，实现了 N 型电阻率大于 $10,000\Omega\cdot\text{cm}$ 多晶硅棒的大规模制备，施主杂质 P 含量小于 10ppt，受主杂质 B 含量小于 5ppt。

（4）还原炉及配套辅助设备开发技术

还原炉作为改良西门子法的特种核心反应器，在该工艺中占据了极为重要的位置。其提供的多晶硅棒反应生长环境，直接影响多晶硅棒产品的体杂质含量、晶体形态、表观状态、沉积速度等，其整体结构设计水平对产品质量具有不可忽视的作用。

公司通过不断地研发和技术积累，具备了对还原炉整体结构和配套设备的开发和持续优化能力，通过对电极布局、进出气口布局 and 结构、还原炉整体结构和材质进行优化，实现了反应器内气场、温场的均匀分布，为高效 CVD 沉积工艺的运行提供了稳定的设备基础，能够产出表面质量优异的多晶硅棒，同时经过特殊处理的反应器材质也杜绝了高温条件下痕量金属杂质挥发对多晶硅产品的污染，保证了外部洁净环境的水平。

（5）还原尾气分离提纯技术

CVD 过程是一个复杂的化学变化过程，三氯氢硅和氢气在其中只有部分反应生成多晶硅，还原炉排出的尾气中含有四氯化硅、三氯氢硅、二氯二氢硅、氢气等，需要对其进行分离，分类进行后续处理，这是整个工艺过程能够形成闭路

循环的关键环节。

公司在常规尾气回收技术的基础上，在部分环节进行了优化改进，通过在尾气淋洗控制技术等方面的改善，提高了氯硅烷对氢气中 HCl 的清洗效果，配合特种反应吸附技术，将氢气中的各类杂质除去，大幅度提高了循环使用氢气的纯度，经过纯化的氢气各类杂质均小于 1ppb，由此生产的多晶硅 N 型电阻率大于 $10000\Omega\cdot\text{cm}$ 。

（6）硅棒洁净破碎技术

CVD 过程产出的硅棒需要破碎成不同规格尺寸的硅块，才能用于后续半导体单晶拉制，公司掌握了无接触式高压脉冲硅棒破碎技术，通过高压脉冲放电将硅棒破碎成块。因为此过程中硅棒仅与高纯水接触，避免了传统人工或机械破碎过程中人、破碎锤或破碎机械对硅块表面的污染，极大幅度提高了硅块表面洁净程度，表面金属含量达到 30pptw 以下，表征质量稳定性的关键参数 CPK 达到 1.67 以上。因为高压脉冲破碎并不是机械性破碎，其硅块的棱角较为圆润，在单晶拉制过程中不易划坏坩埚，避免了因此导致的杂质污染。

（7）硅块筛分技术

公司掌握了高效的洁净筛分技术，通过对多层筛分机的特殊订制，能够保证硅块的粒径分布合理，避免了硅块破碎中必然会存在的长条状等特殊形状硅块的遗漏，这些会对单晶拉制中复投造成堵塞。公司的筛分机选用特种耐磨材质，不会对硅块表面造成额外的金属或其他污染。

（8）硅块洁净刻蚀技术

硅块刻蚀是硅块后处理最重要的环节，通过对硅块表面的刻蚀将所有表面杂质去除，避免其在拉晶过程中进入后续单晶产品，影响其纯度。公司开发了以硝酸、氢氟酸为基础的多池混酸刻蚀技术，通过对配方、补酸量、清洗节拍等参数的优化，形成了较为合理的梯度清洗，保证了对硅块表面的刻蚀效果。同时还设计了具有良好接触的清洗篮结构和清洗运动模式，保证了硅块能够与清洗液均匀接触，清洗刻蚀效果一致。产品表观形态良好，无色斑，表面金属含量达到 20pptw 以下。

（9）痕量杂质检测技术

电子级多晶硅的产品及生产过程中超痕量杂质的检测系行业公认的技术难点。公司通过系统优化取样与分析方法，显著降低了检测过程中的背景污染；同时深度挖掘仪器性能潜力，使电子级多晶硅的关键参数施/受主杂质的检测限达到 1ppta，已逼近低温傅里叶红外光谱仪（LT-FTIR）的理论检测极限；表面金属杂质的检测限亦达到 1pptw，处于电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）的仪器检测能力上限。此外，公司还开发了氯硅烷中有机物、氢气中金属杂质、硅料少子寿命高精度检测等方法，能够及时有效地指导生产工艺调节、产品质量标定、客户需求等各类使用目的。

（10）区熔用多晶硅棒生产技术

区熔用多晶硅棒是专为区熔单晶生长而开发的核心材料，其生产工艺与传统的直拉单晶技术差异显著，对硅棒纯度、内应力控制、表面光滑度等性能要求极为苛刻。生产过程中，因硅棒内部应力过大且结构过于致密，常出现棒体开裂甚至倾倒现象，导致产品良率低、试制成本居高不下。公司通过精准调整原料配比，优化化学气相沉积工艺参数，并引入高精度温控系统和动态时间管理技术，对硅棒生长的温度曲线及反应时长进行严格调控。这一系列改进显著降低了硅棒内应力，提升了结晶均匀性，最终成功制备出结构稳定、符合单晶硅棒生产需求的高质量多晶硅棒，大幅提高了良率并降低了试制成本。

在后续生产环节中，硅棒晶粒尺寸的精准控制及沉积均匀性是另一大技术难点，若处理不当易在区熔拉晶时引发断棱缺陷，严重影响产品质量稳定性。由于硅棒沉积过程受还原炉内气流速度、温度分布及原料杂质等多因素干扰，团队针对性优化了还原炉结构：改进炉筒内壁的反射涂层以增强热场均匀性，重新设计底盘电极与气体喷嘴布局以稳定气流分布，并结合智能控制系统实时调整原料配比与气体流量。这些措施实现了硅晶粒尺寸的精细调控，确保沉积层致密且晶粒分布高度均匀。改进后，多晶硅棒的缺陷率显著降低，为下游区熔拉晶提供了高可靠性原料，有效保障了单晶硅产品的性能与良率。

（11）硅基特气生产技术

硅基电子特气主要用于外延等半导体制程，因其多采用瓶装的方式进行充装

使用，对产品纯度、充装过程均有较高要求。公司通过高效提纯技术对电子级多晶硅生产系统内的三氯氢硅、二氯二氢硅等进行再次纯化，将 B/P\金属等杂质进一步去除，并保证了氮、氯硅烷组分等指标合格，同时利用成熟的钢瓶清洗、洁净管道、洁净充装等技术，保证了充装过程不再产生额外污染。因为电子级多晶硅生产系统相对于硅基特气的生产体量巨大，大系统的抗波动能力强，能够保证特气产品波动极小。

（二）核心技术在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况

报告期内，发行人源于核心技术相关产品的销售收入情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
源于核心技术相关产品的销售收入	177,855.24	107,312.88	93,448.13
营业收入	179,107.43	110,964.15	94,626.92
收入占比	99.30%	96.71%	98.75%

注：源于核心技术相关产品的销售收入包括电子级多晶硅及副产品、碳化硅硅粉和电子特气销售收入。

报告期内，发行人源于核心技术相关产品的销售收入占营业收入比例均超过 95%。发行人已经形成了稳定的销售、采购、生产、研发等经营模式，获得了下游客户的广泛认可。

（三）核心技术的科研实力和成果情况

1、专利情况

公司根据核心技术的不同类型，除申请知识产权之外，将大量配方及工艺类技术诀窍（Know-How）加以严格保密，避免因专利的公开而泄露技术秘密。公司已申请获得多项发明专利，专利情况请参见本招股说明书之“第五节、五、（二）主要无形资产情况”。

2、公司获得的重要奖项及荣誉资质

序号	年份	奖项荣誉名称	颁发机构
1	2025 年	国家级高新技术企业	江苏省科学技术厅
2	2025 年	江苏省先进级智能工厂	江苏省工业和信息化厅
3	2025 年	国家专利产业化样板培育库入库企业	江苏省知识产权局

序号	年份	奖项荣誉名称	颁发机构
4	2025 年	博士后科研工作站	江苏省人力资源和社会保障厅办公室
5	2024 年	江苏独角兽企业	江苏省生产力促进中心
6	2024 年	江苏精品	江苏省市场监督管理局
7	2023 年	中国专利优秀奖	国家知识产权局
8	2023 年	半导体材料专业前十企业	中国电子材料行业协会
9	2023 年	专精特新“小巨人”企业	工业和信息化部
10	2023 年	省工业互联网示范工程项目	江苏省工业和信息化厅
11	2023 年	江苏省绿色工厂	江苏省工业和信息化厅
12	2022 年	智能制造优秀场景	工业和信息化部装备工业一司
13	2022 年	省级企业技术中心	江苏省工业和信息化厅
14	2021 年	江苏省科学技术奖三等奖	江苏省人民政府
15	2021 年	省工业互联网发展示范企业	江苏省工业和信息化厅
16	2021 年	省级工程技术研究中心	江苏省科学技术厅
17	2021 年	江苏省博士后实践创新基地	江苏省人力资源和社会保障厅
18	2021 年	协会工作突出贡献奖	中国电子材料行业协会

3、发行人承接的重大科研项目

公司核心团队长期从事电子级多晶硅的研发，拥有雄厚的科研实力，承担了多项重大科研任务，不断提高自身的研发能力和技术水平，已完成的主要项目情况如下：

序号	项目名称	项目来源	公司参与情况	完成情况
1	半导体级高纯多晶硅实施方案（国家强基工程）	工业和信息化部	承担单位	已完成
2	大规模集成电路用硅料生产工艺研发（江苏省重点研发计划项目）	江苏省科学技术厅	承担单位	已完成
3	大规模集成电路用 12 英寸单晶制造的电子级多晶硅材料（江苏省关键核心技术攻关项目）	江苏省工业和信息化厅	承担单位	已完成
4	鑫华半导体智能工厂项目（江苏省工业和信息产业转型升级项目）	江苏省工业和信息化厅	承担单位	已完成
5	大规模集成电路用电子级多晶硅材料关键技术研发及产业化（徐州市科技成	徐州市科学技术局	承担单位	已完成

序号	项目名称	项目来源	公司参与情况	完成情况
	果转化项目）			
6	徐州市鑫华集成电路用高纯硅工程技术研究能力提升（徐州市科技局技术中心项目）	徐州市科学技术局/徐州市财政局	承担单位	已完成

4、主持或参与制定国家标准、行业标准情况

截至本招股说明书签署日，公司参与制定的主要国家标准和行业标准情况列示如下：

序号	标准名称	标准类型	标准编号	公司参与情况	当前状态
1	电子级多晶硅	国家标准	GB/T 12963-2022	主持	实施
2	石英玻璃光谱透射比试验方法	国家标准	GB/T 43892-2024	参与	实施
3	多晶硅表面金属杂质含量测定 酸浸取-电感耦合等离子体质谱法	国家标准	GB/T 24582-2023	参与	实施
4	用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程	国家标准	GB/T 29057-2023	参与	实施
5	硅和锗体内少数载流子寿命的测定 光电导衰减法	国家标准	GB/T 1553-2023	参与	实施
6	硅单晶中 III、V 族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法	国家标准	GB/T 24581-2022	参与	实施
7	节水型企业多晶硅行业	国家标准	GB/T 38907-2020	参与	实施
8	银-钢复合板	行业标准	YS/T 1556-2022	参与	实施
9	氯硅烷组分含量的测定 气相色谱法	行业标准	YS/T 1392-2020	参与	实施

（四）研究开发情况

1、发行人正在从事的研发项目

公司目前在电子级多晶硅领域具备国际市场竞争力，核心技术与行业技术水平相比具有先进性。公司研发项目主要是持续对核心技术进行研发、演进和拓展。在保持现有产品竞争优势的同时，公司正向电子级多晶硅衍生产品方向布局，力争成为全球一流硅基材料供应商。

截至报告期末，公司尚未结项的研发项目及进展情况具体如下：

序号	在研项目名称	进展情况	拟达到的目标
1	超高纯电子级多晶硅工艺及设备的开发	正在研发	针对超高阻硅片及先进制程用硅片的需求，通过对全流程ppt级痕量杂质的在线管控，优化提升三氯氢硅中难除杂质定向吸附提纯技术，优化硅料表面精制过程对表面金属及有机物等杂质去除和防护能力，优化晶体沉积过程中对晶体形态及杂质选择性沉积过程，大幅度提升现有电子级多晶硅长周期杂质控制稳定性及内在晶体生长形态
2	电子级多晶硅衍生产品的开发与应用	正在研发	开发电子级三氯氢硅充装核心工艺及电子级二氯氢硅提纯及充装核心工艺；开发碳化硅外延片关键技术开发，满足下游客户验证的需求；开发纳米硅表面修饰处理技术包括开发材料改性、电学性能提升技术，并建立电学性能测试线；突破高纯合成石英砂技术关键难题，使产品纯度达到7N以上级别；通过固化、碳化、活化等方式，打通树脂合成硅碳用多孔碳工艺流程，实现硅碳用多孔炭的可控低成本自主合成；开发各方面电化学性能均优于现在市场销售的硅碳材料
3	区熔用电子级多晶硅工艺及设备的开发	正在研发	通过对还原炉及其附属电气设备开发、改造，满足超大尺寸区熔硅棒的生产要求；通过对沉积工艺和应力控制程序的开发，形成并固化具备良好成晶性能和机械性能的大尺寸区熔硅棒生产方法；通过开发区熔棒的机加工、酸洗、转运和包装设备，具备生产区熔硅棒成品的能力
4	还原关键工艺及设备的研究开发	正在研发	针对新型还原炉进行制造研发，并对其应用于电子级多晶硅生产的工艺技术进行探索研究；开发升级还原炉复层材料、炉筒基材材料、底盘材质及冷却介质等；对还原炉电极头提纯方式、锻造形式、无损检测技术进行优化提升；对一炉多产联合生产工艺进行开发，降低还原炉单耗、提高生产效率；开发微波预热系统，实现微波预热系统对红外预热系统的完全替代
5	高效纯度提升及副产循环优化工艺的研究与开发	正在研发	提高渣浆装置处理能力，降低去除渣料中杂质的时间，并解决脱高沸系统中杂质高及设备管线堵塞问题；对现有的氢化粗品输送工艺流程进行优化，提高输送的稳定性
6	电子级多晶硅相关检测技术的研究与应用	正在研发	通过导入新分析模块，丰富异物检测手段，提升检测效率；通过氢气中杂质气体的测试方法开发，监控高纯氢气中的烃类、硼烷和磷烷杂质，控制气中的碳（烃类）和硼元素、磷元素杂质含量，减少多晶硅在还原炉生产过程中的杂质的引入，进而确保电子级多晶硅的质量稳定
7	后处理关键工艺及设备的研究开发	正在研发	对硅芯拉制籽晶夹头及母料底座的材质及结构进行研发，以减少硅芯拉制过程中杂质的引入，同时通过对硅芯清洗配方、工艺流程和相关结构的优化，提升硅芯清洗质量

2、研发投入构成情况

公司历来重视技术创新以及新产品的研发，积极开展研发活动。报告期内，公司研发费用口径的研发投入情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发投入	10,702.11	7,173.67	5,287.76

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	179,107.43	110,964.15	94,626.92
研发投入占比	5.98%	6.46%	5.59%

除上述研发费用外，公司在生产线上进行工艺试验或技术性验证时投入的原材料在试验结束后形成可供出售的产品，实现销售后确认至“营业成本”科目，并未计入研发费用，但该部分也属于公司为产品或技术研发而投入的相关资源。

3、合作研发情况

报告期初至今，发行人合作研发情况如下：

序号	合作方	合作协议主要内容	主要权利义务划分约定及采取的保密措施	合作进度
1	中国矿业大学化工学院	中国矿业大学化工学院针对公司在工业生产、技术改造、技术引进中急需解决的技术难题和攻关项目，积极向公司推荐合适的新技术、新工艺、新产品等科技成果（可优惠转让或联合开发）；公司积极组织、努力推进对方的技术成果，使其成为中国矿业大学化工学院的中试基地之一	由双方共同合作研发的科研成果、工艺及产品包括专利论文等，为双方共有，不得泄漏，不得单独转让第三方	已完成
2	扬州大学广陵学院	扬州大学广陵学院针对公司提出的高新技术项目需求和企业技术难题，积极组织力量进行研究开发、成果转化和技术攻关；公司提供生产试验条件和校外实训基地，为扬州大学广陵学院进行科学研究提供良好的生产试验条件，合作完成科研任务	合作期间双方共同保守合作项目及企业的技术和商业秘密，属于产学研合作	进行中
3	东南大学	双方通过委托开发、合作共研，开展智能制造技术及系统领域的科技创新活动，同时通过成果转化、项目联合申报等方式，共同争取承担国家级及省部级智能制造领域重大项目，承担相关重点行业的委托项目，实现相关科技成果的示范应用及产业化推进	合作期间双方所获悉对方的资料和信息、知识产权、技术秘密应承担严格的保密义务，未经同意，不得向第三方泄露，属于战略合作框架	已完成
4	江苏师范大学	面向新能源汽车、3C 电子产品等锂离子电池应用场景，通过产、学、研结合，发挥各自优势，开拓创新，合作开发出超细、低氧和稳定的纳米硅产品，为开发高首效、高容量和高稳定性的新型硅碳复合负极材料奠定坚实的基础	双方同意有关本项目内容之设计及研发所产生之专利、著作权、商业秘密及其他相关知识产权，如为纳米硅相关的知识产权归属公司，如为新型的粘结剂和导电添加剂相关的知识产权归属江苏师范大学；双方约定对本合同的签订、本合同的内容、研究项目资料、研究开发的材料改性方法等技术细节；	已完成

序号	合作方	合作协议主要内容	主要权利义务划分约定及采取的保密措施	合作进度
			甲方提供一切相关资料和乙方在甲方工厂内部知悉的宣传、指示等信息在整个项目运行期内以及项目结束后 3 年保密	
5	清华大学	共建专业学位研究生专业实践基地，共同推进高层次应用型专门人才培养	专业实践期间，清华大学研究生为完成专业实践任务/项目，或者主要利用发行人提供的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等物质技术条件做出的发明创造，其知识产权（包括专利权、著作权、商标权、技术秘密等）归双方共有；清华大学研究生将其专业实践任务/项目相关信息作为写作素材的（包括但不限于论文、评论等），双方享有共同署名权；未经对方许可，甲乙双方及其各自人员均不得将基于本协议知晓、获得的对方相关任何技术信息、材料、数据等透露给第三方，双方严格执行产品、技术等科研成果的保密措施，对专业实践过程中知晓或者获得的涉及对方产品和科研成果的技术、文档、数据进行保密，确保有关信息不作为任何商业目的转让	已完成
6	中国矿业大学	在发行人优化后纳米硅样品的基础上，进行不同碳源与纳米硅的兼容性匹配和包覆方法的研究，针对性开发出纳米硅碳包覆技术，获得高稳定性可商品化的硅碳样品	以本合同规定有关本项目内容之设计及研发所产生的专利、著作权、商业秘密及其他相关知识产权，归发行人所有；双方约定对本合同的签订、本合同的内容、研究项目资料、研究开发的材料改性方法等技术细节；甲方提供一切相关资料和乙方在甲方工厂内部知悉的宣传、指示等信息在整个项目运行期内以及项目结束后 3 年保密	已完成
7	合作研发方 A	共同开发一种新型小尺寸硅料刻蚀工艺设备，技术目标为所开发研究的设备能够满足发行人半导体级硅料清洗后的质量要求	双方共同开发部分形成的研究开发成果由发行人持有知识产权；自协议生效之日起 5 年内，合作研发方 A 不得直接或间接向除公司外的任何第三方销售、转让、特许或授权使用该研发有关的多晶硅清洗系统的广义知识产权和实物	已完成
8	扬州大学	扬州大学针对公司提出的企业智能化数字化、大数据分析及系统优化、人工智能、AI 智能、视觉检测和自动控制等领域推进过程中存在的问题和需求，积极组织	未明确合作成果具体归属及保密措施，属于产学研合作	已完成

序号	合作方	合作协议主要内容	主要权利义务划分约定及采取的保密措施	合作进度
		科研力量提供技术解决方案，以支持双方在此领域相关核心技术的联合攻关，形成关键技术的突破；双方共同争取承担参与国家级及省部级科技项目，依托产学研合作关系实现联合攻关形成的科研成果产业化		
9	广东中晟芯科半导体有限公司	发行人对现有水平腔外延生长炉功能升级，中晟芯科协助发行人调试开发新型碳化硅外延，并在发行人生产外延片流片数据符合中晟芯科需求标准的基础上，开展长期业务合作及联合开发新产品	由发行人单独研发的技术与知识产权归发行人所有，中晟芯科单独研发的技术与知识产权归中晟芯科所有，双方联合研发新产品知识产权归双方共有；双方合作框架协议相关内容需要保密，未经双方许可不得对外宣传；双方技术、资料、产品等利益相关信息相互有保密责任，未经授权不可对第三方透露	已完成
10	南京理工大学微电子学院	双方约定构建双方在研究生培养、关键技术研究、科技成果转化等方面的资源共享机制，基于联合实验平台，共同推进高层次应用型专门人才培养，以发行人产业化需求为导向，联合实验室协助发行人解决产业化过程中的技术制约	有关本项目内容之设计及研发所产生的专利、著作权、商业秘密及其他相关知识产权，归发行人所有，南京理工大学具有署名权；对于在合作过程中涉及到的商业秘密、专利技术等信息，以及合作中产生的先进技术和方案，双方均负有保密义务，未经双方一致同意，不得对外泄露并许可他人使用	进行中
11	江苏省新能源/半导体高端装备创新联合体（含中圣装备、南工大、南理工等8家单位）	聚焦新能源/半导体产业的多晶硅、单晶硅生产关键核心技术与装备，为世界科技前沿，国家重大战略和江苏省战略性新兴产业集群发展需求，组织上下游产学研用联合攻关，协同创新，实现产业关键核心技术突破、重点领域和关键环节自主可控，打造具有全球影响力的优势产业；发行人负责创新成果工程应用，促进成果更新迭代	任何一方在本项目中的科研成果，若由该方完全独立完成，则其所有知识产权归该方所有，共同研发成果由参与方共同享有相关知识产权；各方承诺对合作研究内容保密，除非获得其余各方事先书面同意，否则项目任一方不得透露合作研究信息	已完成

（五）核心技术人员、研发人员情况

公司拥有稳定的研发队伍，拥有化学、材料等各方面的人才，近两年核心技术人员没有发生重大变动。截至 2025 年末，公司核心技术人员共 5 名，占员工总数的 0.53%，对公司核心技术、业务发展作出突出贡献；公司共有研发人员 136 名，研发人员占员工总数的 14.51%。

1、核心技术人员情况

核心技术人员简历详见本招股说明书之“第四节、九、（一）、4、核心技术人员”。

核心技术人员对公司主要技术贡献情况如下：

人员姓名	职务	对公司技术贡献
蒋文武	副董事长	致力于多晶硅生产模式研究，以及全过程质量波动控制技术、多晶硅超痕量杂质检测技术的开发，主持了 5,000 吨/年电子级多晶硅产线建设，综合规划了电子级多晶硅产品实现路线，制定了全流程的关键质量监控点，确保了生产过程中的风险可控，为公司的整体技术路线的确定和生产流程的搭建做出了卓越贡献
田新	总经理	致力于提升公司多晶硅关键指标及生产规模控制水平，主持了大规模电子级多晶硅产业化流程系统搭建、高纯度三氯氢硅提纯技术开发和高纯度多晶硅洁净破碎技术开发，在电子级多晶硅生产研发、硅基特气开发等领域有丰富经验，带领团队突破了国外长期技术垄断，在电子级多晶硅大规模产业化领域做出突出贡献
李明峰	内蒙古鑫华常务副总经理兼总工程师	致力于生产成本控制、智能化产线设计、循环氢吸附等技术的研究开发，主持了全流程智能化产线设计、基于活性炭的吸附塔提纯技术开发、有效降低杂质含量的选择性 CVD 技术开发，在产线设计、自动化、还原沉积领域有丰富经验，对公司生产精益管理和产品工艺改善有着突出贡献
吴锋	技术研发部经理兼 FAE 副总监	致力于氯硅烷中超痕量杂质高效提纯技术、多晶硅块高洁净蚀刻清洗技术、高效 CVD 可控晶体沉积技术的研究开发，主持吸附-络合-精馏联合提纯技术开发、电子级多晶硅块高洁净蚀刻清洗技术开发、区熔用多晶硅生产技术开发，在氯硅烷精馏纯化、硅块精制技术领域有丰富经验
江宏富	研究院执行院长	致力于公司创新产品及技术开发，围绕公司现有生产工艺流程，积极推动公司产业链项目开展，为公司的发展奠定基础。主持了碳化硅和纳米硅两项重大研发项目的实施和推进工作，在硅基半导体材料应用技术领域有丰富经验

2、研发人员情况

（1）研发人员的认定口径

发行人以员工实际从事研发活动的工时占比情况作为研发人员的划分依据，将当期研发工时占其当期在公司总工时比例不低于 50% 的人员界定为研发人员。研发人员进一步分为两类：当期研发工时占其当期在公司总工时比例达到 100% 的研发人员为全时研发人员；当期研发工时占其当期在公司总工时比例不足 100% 的研发人员为非全时研发人员。

（2）报告期各期末研发人员数量及占比情况

单位：人

项目	2025 年末	2024 年末	2023 年末
研发人员数量	136	114	87
研发人员占员工总数比例	14.51%	12.74%	10.96%

报告期内，公司重视研发工作，并将持续加大研发投入，进行研发体系、研发团队的建设和完善，研发人员数量不断增加。截至 **2025 年末**，公司研发人员 **136 名**，占比 **14.51%**。

（3）研发人员学历分布情况

单位：人

项目	2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	数量	占比	数量	占比	数量	占比
硕士及以上	29	21.32%	25	21.93%	22	25.29%
本科	82	60.29%	69	60.53%	50	57.47%
专科及以下	25	18.38%	20	17.54%	15	17.24%
合计	136	100.00%	114	100.00%	87	100.00%

半导体材料行业属于技术密集型行业，公司是国内领先的电子级多晶硅材料供应商，需要构建具有高素质的研发队伍。报告期各期末，公司本科及以上学历的研发人员占比分别达到 82.76%、82.46%和 **81.62%**，公司研发团队整体学历层次较高。

3、发行人对核心技术人员实施的约束激励措施

发行人制定了良好的激励制度，向核心技术人员提供具有市场竞争力的薪酬及福利，与核心技术人员签订了竞业限制协议、保密协议，并对核心技术人员实施了股权激励。

4、报告期内核心技术人员的变动情况及对发行人的影响

报告期内，除张天雨因个人原因离职外，公司其他核心技术人员未发生变动，核心技术团队人员稳定，不存在重大不利变化。

（六）研发创新机制

凭借优秀的自主创新和研发能力，公司吸引了诸多领军人才加盟，为公司的

技术研发形成了保障。在此基础上，公司通过制定完善的培训计划，不定期组织员工进行培训，与行业内的专家、客户进行交流探讨，及时了解行业的技术与发展趋势。

公司形成了完善的绩效考核制度，为员工提供发展空间与创新的平台，实施股权激励，充分调动员工积极性。公司建立了研发项目管理规定，有效规范了研发项目的开发程序。公司研发工作主要是基于对行业和世界前沿技术的充分调研分析，结合公司持续发展和战略性需要，组织团队进行科技攻关、技术开发和试验研究，通过对现有工艺、设备、产品的不足进行改良，以提高生产效率、产品质量和安全性，降低生产成本，开发新工艺、新设备和新产品，从而提升企业的创新能力和核心竞争力。

公司在不断提升自主研发水平的同时，与清华大学、东南大学、中国矿业大学等院校广泛开展合作研发，形成了自主研发、合作研发相结合的研发模式。公司外部研发通过和高等院校进行合作，为公司新技术项目的开发解决了部分技术难点，降低了研发风险，为公司持续的技术创新和人力资源提供支持和保障。

七、发行人生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

（一）生产经营中涉及的主要污染物及处理情况

1、公司生产经营中主要排放的污染物情况

公司生产经营过程中涉及的污染物主要包括固体废物、废气、废水及噪声等。报告期内，发行人严格执行各项环境保护措施，遵守环境保护相关法律法规。

（1）固体废物

公司生产过程中产生的固体废物主要为废酸、废油等。公司按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）要求在厂区内暂存危险废物，部分废物回收利用，其他废物由公司支付费用委托第三方运出公司进行处理。

（2）废气

公司废气污染物主要包括生产过程中的精馏提纯不凝气、还原炉吹扫废气、尾气回收系统排放废气等，废气经处理设施处理后，达到《大气污染物综合排放

标准》（GB16297）中规定的标准限值达标排放。

（3）废水

公司生产过程中产生的废水主要有尾气处理装置废水、酸洗废气洗涤塔废水、还原炉清洗废水等，通过中和、混凝、沉淀工艺处理达到接管标准后，经独立污水管网排入开发区污水处理厂集中处理。

（4）噪声

公司生产经营过程中的噪声源主要为压缩机、冷却水泵等。公司采取了选用低噪声设备、车间隔离、设备减振、加装隔音罩等方式降低噪声污染，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。

2、环保设施的处理能力及实际运行情况

公司根据实际需要置备了必要的环保设施，环保设施运行状况良好，处理能力均满足排放量的要求，使得生产经营过程中产生的废气、废水、固体废物及噪声得到了合理、有效的控制。发行人持续对产线的工艺进行优化，报告期前期，为保证产品质量，废气排放较多，随着工艺改进，废气排放量逐步下降。

报告期内，公司主要污染物的主要处理设施、处理能力及运行情况如下：

污染物类型	具体污染物	处理设施	最大污染处理能力	运行情况
大气污染物	氟化物、氯化氢、氮氧化物	尾气处理系统、酸洗废气洗涤塔	1,400m ³ /h、60,000m ³ /h	运行良好
废水	含悬浮物、全盐量、化学需氧量、氨氮、总磷、氯化物、氟化物	生产废水处理站	50m ³ /h	运行良好
噪声	工业企业厂界环境噪声	采用低噪音设备，厂房采用隔音措施	-	运行良好
固体废物	硅粉	委外处理	委外处理	-
固体废物	废油	委外处理	委外处理	-
固体废物	吸附剂	委外处理	委外处理	-
固体废物	污泥	委外处理	委外处理	-
固体废物	硝酸和氢氟酸	委外处理	委外处理	-

（二）发行人环保投入及环保相关成本费用情况

报告期内，公司及子公司环保相关费用成本支出情况如下：

单位：万元

环保相关费用成本科目	2025 年	2024 年度	2023 年度
聘请第三方处理费用	1,279.01	711.41	520.19
环保设备折旧	1,190.66	250.44	233.88
合计	2,469.67	961.85	754.07

（三）发行人安全生产、环境保护方面受处罚情况

报告期内，发行人不存在因安全生产或环境保护而受到相关主管机关行政处罚的情形。

（四）法律法规强制披露的环境信息

根据生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》，被列入实施强制性清洁生产审核的企业和重点排污单位应披露相关环境信息。报告期内，公司与子公司内蒙古鑫华属于强制性清洁生产审核企业或重点排污单位，相关主体已依法披露法律法规强制披露的环境信息。

八、公司境外经营情况

截至本招股说明书签署日，公司不拥有境外子公司、参股公司，也不存在持有境外资产的情形。

报告期内，公司境外销售的主要地区为中国台湾、韩国等，报告期各期，公司来自境外的销售收入占主营业务收入的比例分别为 1.26%、6.19%和 5.04%，收入占比相对较低。

第六节 财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经毕马威审计的财务报表。毕马威对财务报表出具无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第 2621643 号）。

本节财务会计数据及有关分析说明反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量。本节对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量，公司提醒投资者关注本招股说明书所附财务报告及审计报告全文，以获取全部的财务资料。

除特别说明外，本节所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

一、财务报表

（一）合并资产负债表、利润表和现金流量表

1、合并资产负债表

单位：万元			
科目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	82,384.94	94,532.67	134,806.34
交易性金融资产	20,959.17	-	-
应收票据	16,470.80	6,424.96	4,615.30
应收账款	44,040.76	33,101.46	18,079.19
应收款项融资	15,138.21	17,077.22	6,821.41
预付款项	599.33	1,257.78	1,196.76
其他应收款	2,683.19	5,415.27	7,425.54
存货	40,352.64	26,066.05	18,200.63
其他流动资产	3,007.39	3,120.09	4,225.48
流动资产合计	225,636.42	186,995.50	195,370.66
非流动资产：			
长期股权投资	764.58	772.76	797.14
其他权益工具投资	17,346.74	5,268.12	281.40
固定资产	319,580.54	342,359.64	116,282.09

科目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
在建工程	9,333.47	18,266.70	208,039.03
使用权资产	1,551.46	1,657.33	1,411.22
无形资产	19,095.77	19,516.04	19,711.00
长期待摊费用	4,783.22	1,521.21	1,077.50
其他非流动资产	2,114.60	1,514.04	18,344.59
非流动资产合计	374,570.38	390,875.83	365,943.98
资产总计	600,206.80	577,871.33	561,314.64
流动负债：			
短期借款	32,692.57	33,450.64	33,582.51
应付票据	830.77	6,900.89	21,866.81
应付账款	25,018.97	14,354.76	7,987.34
合同负债	46.50	29.61	27.35
应付职工薪酬	7,104.45	6,062.31	3,589.39
应交税费	239.22	619.09	161.96
其他应付款	52,802.53	66,878.20	80,482.72
预计负债	120.99	35.17	30.60
一年内到期的非流动负债	16,695.95	13,356.15	8,965.22
其他流动负债	2.64	3.16	3.09
流动负债合计	135,554.60	141,689.97	156,696.98
非流动负债：			
长期借款	86,504.81	85,231.22	57,389.29
长期应付款	4,764.89	15,546.43	24,160.60
租赁负债	1,629.71	1,644.08	1,297.89
递延收益	5,925.78	6,122.40	6,711.23
非流动负债合计	98,825.19	108,544.13	89,559.02
负债合计	234,379.78	250,234.11	246,256.00
股东权益：			
股本	148,571.43	148,571.43	148,571.43
资本公积	96,112.05	94,333.23	92,383.52
其他综合收益	10,186.61	-94.38	-81.10
专项储备	-	-	-
盈余公积	5,518.62	2,984.07	2,167.73

科目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
未分配利润	39,326.70	23,276.33	17,230.35
归属于母公司股东权益合计	299,715.40	269,070.68	260,271.93
少数股东权益	66,111.62	58,566.54	54,786.71
股东权益合计	365,827.02	327,637.23	315,058.64
负债和股东权益总计	600,206.80	577,871.33	561,314.64

2、合并利润表

单位：万元、元/股

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	179,107.43	110,964.15	94,626.92
减：营业成本	134,484.00	86,058.52	79,835.31
税金及附加	909.75	433.72	430.78
销售费用	1,249.30	1,011.26	888.28
管理费用	8,356.21	7,478.05	6,730.19
研发费用	10,702.11	7,173.67	5,287.76
财务费用	4,374.76	7.65	1,159.94
其中：利息费用	4,316.48	2,208.25	2,859.78
利息收入	720.99	2,097.93	1,773.41
加：其他收益	3,310.26	2,507.10	3,282.77
投资收益	-8.19	-24.38	-2.86
其中：对联营企业的投资损失	-8.19	-24.38	-2.86
公允价值变动收益	1,173.98	-	-
信用减值损失	-160.37	-286.49	-87.09
资产减值损失	-12,255.17	-4,793.44	-256.05
资产处置收益	-	20.10	246.89
二、营业利润	11,091.82	6,224.18	3,478.31
加：营业外收入	1,111.44	10.51	288.92
减：营业外支出	27.86	6.58	134.16
三、利润总额	12,175.40	6,228.10	3,633.08
减：所得税费用	-1,797.64	-	-
四、净利润	13,973.03	6,228.10	3,633.08
1.归属于母公司股东的净利润	18,584.92	6,862.32	4,554.03
2.少数股东损益	-4,611.88	-634.21	-920.95

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
五、其他综合收益的税后金额	10,280.99	-13.28	-81.10
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额/（亏损）	10,280.99	-13.28	-81.10
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	24,254.02	6,214.82	3,551.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,865.90	6,849.04	4,472.93
归属于少数股东的综合收益总额	-4,611.88	-634.21	-920.95
七、每股收益：			
基本及稀释每股收益	0.13	0.05	0.03

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	115,480.56	73,340.96	74,706.14
收到的税费返还	198.19	21,642.55	0.02
收到其他与经营活动有关的现金	3,722.86	3,181.73	4,363.51
经营活动现金流入小计	119,401.60	98,165.24	79,069.67
购买商品、接受劳务支付的现金	61,524.46	63,572.49	52,533.50
支付给职工以及为职工支付的现金	23,654.24	14,196.49	15,031.04
支付的各项税费	7,595.84	2,375.59	2,625.61
支付其他与经营活动有关的现金	2,233.90	2,716.39	3,130.54
经营活动现金流出小计	95,008.44	82,860.96	73,320.69
经营活动产生的现金流量净额	24,393.16	15,304.28	5,748.98
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	688.85	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	198.00	1,272.77
收到其他与投资活动有关的现金	3,188.76	21,398.50	6,917.27
投资活动现金流入小计	3,877.61	21,596.50	8,190.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,318.76	77,313.93	126,049.31
投资支付的现金	21,800.00	6,000.00	-
取得联营公司支付的现金净额	-	-	800.00
支付的其他与投资活动有关的现金	100.00	520.17	31,001.27

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
投资活动现金流出小计	37,218.76	83,834.10	157,850.57
投资活动使用的现金流量净额	-33,341.14	-62,237.60	-149,660.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	12,000.00	4,300.00	144,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000.00	4,300.00	44,150.00
取得借款收到的现金	41,162.82	67,190.64	92,792.51
筹资活动现金流入小计	53,162.82	71,490.64	236,942.51
偿付借款支付的现金	46,757.60	43,629.15	32,238.21
偿付利息支付的现金	4,051.01	4,735.09	3,489.99
支付其他与筹资活动有关的现金	711.73	294.54	1,430.64
筹资活动现金流出小计	51,520.34	48,658.78	37,158.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,642.47	22,831.86	199,783.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-305.11	67.75	-53.31
五、现金及现金等价物净增加额	-7,610.62	-24,033.71	55,818.81
加：期/年初现金及现金等价物余额	88,870.00	112,903.70	57,084.89
六、期/年末现金及现金等价物余额	81,259.37	88,870.00	112,903.70

（二）母公司资产负债表、利润表和现金流量表

1、母公司资产负债表

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	66,435.04	66,989.22	84,599.22
交易性金融资产	20,959.17	-	-
应收票据	10,394.05	6,041.23	4,615.30
应收账款	37,955.80	32,898.48	18,574.72
应收款项融资	9,348.90	16,743.13	6,821.41
预付款项	401.47	213.31	798.34
其他应收款	6,012.46	6,945.13	7,399.37
存货	21,878.48	20,003.20	18,090.39
其他流动资产	776.13	819.73	1,685.11
流动资产合计	174,161.50	150,653.42	142,583.86
非流动资产：			

科目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
其他权益工具投资	111,075.67	91,822.76	85,147.14
长期股权投资	17,346.74	5,268.12	281.40
固定资产	92,395.91	103,331.30	116,043.58
在建工程	7,246.85	11,565.21	10,467.56
使用权资产	1,247.94	1,256.13	1,411.22
无形资产	4,787.25	5,083.23	4,932.26
长期待摊费用	4,392.26	1,521.21	1,077.50
其他非流动资产	2,114.60	1,463.67	256.23
非流动资产合计	240,607.21	221,311.62	219,616.89
资产总计	414,768.71	371,965.05	362,200.75
流动负债：			
短期借款	31,692.57	33,450.64	33,582.51
应付票据	666.69	2,616.40	3,075.97
应付账款	32,015.50	16,554.40	7,986.87
合同负债	20.31	26.32	27.35
应付职工薪酬	4,590.88	4,064.09	2,612.64
应交税费	183.16	574.32	105.90
其他应付款	11,269.91	11,610.32	12,212.76
预计负债	53.26	35.17	30.60
一年内到期的非流动负债	10,624.49	9,283.96	8,933.53
其他流动负债	2.64	3.16	3.09
流动负债合计	91,119.41	78,218.77	68,571.22
非流动负债：			
长期借款	2,124.09	-	-
长期应付款	4,764.89	14,195.58	23,254.83
租赁负债	1,139.43	1,138.66	1,297.89
递延收益	5,925.78	6,122.40	6,711.23
非流动负债合计	13,954.19	21,456.64	31,263.96
负债合计	105,073.59	99,675.41	99,835.18
股东权益：			
股本	148,571.43	148,571.43	148,571.43
资本公积	95,750.91	93,971.87	92,197.97

科目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
其他综合收益	10,186.61	-94.38	-81.10
盈余公积	5,518.62	2,984.07	2,167.73
未分配利润	49,667.55	26,856.65	19,509.55
股东权益合计	309,695.12	272,289.64	262,365.57
负债和股东权益总计	414,768.71	371,965.05	362,200.75

2、母公司利润表

单位：万元、元/股

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	162,494.34	111,137.57	95,622.43
减：营业成本	118,935.29	89,013.64	80,814.39
税金及附加	244.81	235.23	214.21
销售费用	971.31	949.64	888.28
管理费用	6,198.84	5,760.19	4,541.33
研发费用	6,791.80	5,671.95	4,355.87
财务费用	1,392.13	651.39	1,353.88
其中：利息费用	1,627.62	2,190.03	2,859.78
利息收入	889.23	1,472.64	1,554.01
加：其他收益	2,008.71	2,289.75	2,450.07
投资收益	-8.19	-24.38	-2.86
其中：对联营企业的投资损失	-8.19	-24.38	-2.86
公允价值变动收益	959.13	-	-
信用减值损失	-553.66	-315.49	-80.88
资产减值损失	-6,820.90	-2,685.91	-256.05
资产处置收益	-	47.02	246.89
二、营业利润	23,545.27	8,166.52	5,811.62
加：营业外收入	28.78	3.51	286.97
减：营业外支出	26.24	6.58	134.16
三、利润总额	23,547.81	8,163.45	5,964.44
减：所得税费用	-1,797.64	-	-
四、净利润	25,345.45	8,163.45	5,964.44
五、其他综合收益的税后金额	10,280.99	-13.28	-81.10
六、综合收益总额	35,626.43	8,150.17	5,883.34

3、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	103,835.31	74,374.48	75,964.60
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,219.75	2,208.71	3,491.28
经营活动现金流入小计	106,055.06	76,583.19	79,455.88
购买商品、接受劳务支付的现金	29,118.93	53,247.72	52,533.45
支付给职工以及为职工支付的现金	13,563.46	12,004.27	13,393.52
支付的各项税费	6,874.51	2,156.23	2,256.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,276.31	1,270.35	2,434.86
经营活动现金流出小计	50,833.21	68,678.57	70,618.82
经营活动产生的现金流量净额	55,221.85	7,904.61	8,837.06
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	474.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	754.38	1,277.36
收到其他与投资活动有关的现金	3,331.14	1,827.36	2,706.84
投资活动现金流入小计	3,805.14	2,581.73	3,984.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,808.91	1,729.93	9,261.73
投资支付的现金	41,061.09	12,700.00	66,350.00
取得联营公司支付的现金净额	-	-	800.00
支付的其他与投资活动有关的现金	2,460.00	2,140.00	7,200.00
投资活动现金流出小计	49,330.00	16,569.93	83,611.73
投资活动使用的现金流量净额	-45,524.85	-13,988.19	-79,627.53
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	100,000.00
取得借款收到的现金	35,162.82	35,490.64	34,492.51
筹资活动现金流入小计	35,162.82	35,490.64	134,492.51
偿付借款支付的现金	42,757.60	43,629.15	32,238.21
偿付利息支付的现金	1,520.23	2,207.29	2,925.72
支付其他与筹资活动有关的现金	434.62	294.54	437.14
筹资活动现金流出小计	44,712.45	46,130.98	35,601.08

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
筹资活动产生/（使用）的现金流量净额	-9,549.63	-10,640.34	98,891.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-304.81	67.75	-53.31
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	-157.45	-16,656.17	28,047.66
加：期/年初现金及现金等价物余额	65,631.24	82,287.41	54,239.75
六、期/年末现金及现金等价物余额	65,473.79	65,631.24	82,287.41

二、审计意见、关键审计事项、重要性水平及财务报表的编制基础

（一）审计意见

毕马威作为公司本次发行的审计机构，对公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度及 2025 年度的合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表及财务报表附注进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第 2621643 号），审计意见如下：

“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了鑫华半导体 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

（二）关键审计事项

关键审计事项是毕马威根据职业判断，认为对 2023 年度、2024 年度及 2025 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，毕马威不对这些事项单独发表意见。

毕马威在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
鑫华半导体的收入主要来源于中国国内及海外市场销售电子级多晶硅、副产品光伏正料以及副产品杂料等。2023 年度、2024 年度及 2025 年度营业收入分别为 94,626.92 万元、110,964.15 万元及 179,107.43 万元。报告期内，鑫华半导体销售商品属于在某一时刻履行的履约义务，以客户取得相关商品的控制权时点作为收	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： - 了解和评价与收入确认相关的关键财务报告内部控制的设计和运行的有效性； - 选取鑫华半导体与客户签订的销售合同或订单，识别与控制权转移相关的主要条款，评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求； - 选取特定客户进行实地走访或视频访谈，并与客户的相关工作人员进行访谈，询问其与鑫华半导体的业务往来情况及其是否与鑫华半导体存在关联方关

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
入确认的判断标准。 根据销售合同的约定，不同商品销售收入的确认时点分为以下两种情况： - 对于内销，鑫华半导体区熔用多晶硅产品由购买方验证并获取结算单时确认收入，其他电子级多晶硅产品按照合同约定将产品交付给购买方，并由购买方签收并获得签收单时确认收入。 - 对于外销，根据不同贸易条款分为以下三种情况：1）将产品运至出发港口装船并获得提单时确认收入；2）将产品运至目的地港口，鑫华半导体集团在购买方提货并获得签收单时确认收入；3）将产品在指定的地点交给买方指定的承运人，并获得提单时确认收入。 由于收入是鑫华半导体的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险或收入被确认于不正确的会计期间的错报风险，因此毕马威将销售商品收入确认识别为关键审计事项。	系，关注是否存在与所了解到的业务及交易信息有重大不一致等异常的情况； - 选取报告期内主要客户，根据工商登记等资料或其他可获得的公开信息，了解客户的行业地位、财务状况等以检查客户的真实性并识别是否存在异常情况；将客户的股东、董事和监事信息与鑫华半导体提供的关联方清单进行比对，检查是否存在关联方关系； - 选取报告期内的收入交易，核对至销售合同或销售订单、出库单、签收单或结算单、报关单、提单、销售发票等相关支持性文件，以评价相关收入是否按照鑫华半导体的会计政策予以确认； - 选取特定客户，对相关客户于各报告期期末的应收账款余额及报告期内的销售交易金额执行函证程序； - 选取临近资产负债表日前后记录的销售交易记录，核对至相关的销售合同或销售订单、出库单、签收单或结算单、报关单、提单、销售发票等相关支持性文件，评价相关收入是否已记录在恰当的会计期间； - 检查资产负债表日后是否存在销售退回，如存在重大销售退回，则与相关支持性文件进行核对，评价收入是否记录于恰当期间； - 选取符合特定风险标准的营业收入会计分录，检查相关支持性文件。

（三）重要性水平

公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性。从性质来看，主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素。从金额来看，公司确定与财务会计信息相关的重大事项和重要性水平标准如下：

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	金额≥净资产的 0.15%
重要的在建工程	金额≥净资产的 0.15%
重要的非全资子公司	金额≥净资产的 0.15%

（四）财务报表的编制基础

发行人以持续经营为基础编制财务报表。

三、合并财务报表范围、变化情况及分部信息

（一）合并财务报表范围、变化情况

1、合并财务报表范围

报告期内，纳入发行人合并财务报表范围的子公司共 6 家，具体情况如下：

公司名称	是否纳入合并范围			持股比例	
	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	直接	间接
扬州鑫华	/	2024 年 12 月注销	/	100.00%	-
徐州鑫华销售	是	/	/	100.00%	-
鑫华特种气体	是	/	/	100.00%	-
内蒙古鑫华	是	是	是	60.00%	-
湖北鑫阳	是	是	是	70.00%	-
徐州泛半导体	是	是	是	70.00%	-

注：2025 年 11 月 4 日，十堰聚鑫产业园区运营管理有限公司将其所持有湖北鑫阳 30.00% 的股权转让给发行人。截至本招股说明书签署日，发行人持有湖北鑫阳 100.00% 股权。徐州泛半导体于 2025 年 10 月 22 日通过股东会决议，徐州臻心创业投资有限公司通过产权交易所挂牌转让其持有的 30% 股份，发行人决议受让该部分股份。截至本招股说明书签署日，发行人持有徐州泛半导体 100.00% 股权。

2、报告期内合并财务报表范围变化情况

发行人于 2023 年 6 月与十堰聚鑫产业园区运营管理有限公司共同出资设立湖北鑫阳，拟作为发行人高纯石英砂等项目的孵化和研发中心，注册资本为 500 万元，公司占其注册资本的 70%，2023 年 6 月起公司将其纳入合并范围。

发行人于 2023 年 10 月与徐州臻心创业投资有限公司共同出资设立徐州泛半导体，拟围绕泛半导体产业进行技术研发、项目孵化、成果转化，并建设相应的检测中心，为发行人未来发展提供技术储备，注册资本 1,000 万元，公司占其注册资本的 70%，2023 年 10 月起公司将其纳入合并范围。

发行人于 2024 年 1 月投资设立扬州鑫华，拟作为发行人新型硅基半导体材料项目的实施主体，后续由于计划改变，于 2024 年 12 月完成对扬州鑫华的注销，注销后公司不再将其纳入合并范围。

发行人于 2025 年 1 月投资设立徐州鑫华销售管理有限公司，注册资本 600 万元，公司占其注册资本的 100%，作为发行人销售统一集中管理平台，2025 年

1 月起公司将其纳入合并范围。

发行人于 2025 年 7 月投资设立徐州鑫华特种气体有限公司，注册资本 3,000 万元，公司占其注册资本的 100%，作为发行人特种气体等项目的孵化和研发中心，2025 年 7 月起公司将其纳入合并范围。

（二）分部信息

根据公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度，公司的经营业务只涉及一个经营分部，故无需披露分部信息。

四、重要会计政策和会计估计

本部分内容仅披露报告期内对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计。关于公司采用的会计政策和会计估计的详细说明，请参见公司经审计的财务报表附注。

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 **2025 年 12 月 31 日** 的合并财务状况和财务状况，2023 年度、2024 年度和 **2025 年度** 的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本财务报表仅为本公司申请首次公开发行 A 股股票之目的使用。本财务报表同时符合中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。公司主要业务的营业周期通常小于 12 个月。

（四）记账本位币

公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。公司的境外子公司采用母公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表根据本招股说明书之“第六节、四、（七）外币业务及外币报表折算”进行了折算。

（五）合并财务报表的编制方法

1、总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括公司及公司控制的子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

2、处置子公司

公司丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务及外币报表折算

公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

（八）金融工具

公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的其他权益投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司按照根据本招股说明书之“第六节、四、（二十）收入”的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

（1）公司金融资产的分类

公司通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产。

除非公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：1）公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：1）公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金

额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

（2）公司金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

以摊余成本计量的金融资产：初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资：初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资：初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债：初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

4、抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5、金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，公司终止确认该金融资产：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，公司将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

6、减值

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产、合同资产。

（1）预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产外，公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：1）该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 2）该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

应收款项的坏账准备

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据：

应收账款	根据公司的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此公司将全部应收账款作为一个组合，在计算应收账款的坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。
其他应收款	公司其他应收款主要包括应收建信租赁保证金、应收关联方和比照关联方拆借款及利息、应收其他租赁保证金、备用金、应收银行存款利息等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，公司将其他应收款划分为 3 个组合，具体为：应收建信租赁保证金、应收关联方和比照关联方拆借款及利息及应收其他租赁保证金、备用金、应收银行存款利息、合并范围内关联方款项。

（2）具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风

险。

（3）信用风险显著增加

公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括：1）债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；2）已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；3）已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；4）现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

（4）已发生信用减值的金融资产

公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：1）发行方或债务人发生重大财务困难；2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约（或逾期）等；3）公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

（5）预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（6）核销

如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到公司催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7、权益工具

公司发行权益工具，按实际发行价格计入股东权益，相关的交易费用从股东权益（资本公积）中扣减，如资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。回购公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

（九）存货

1、存货的分类和成本

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品以及低值易耗品。低值易耗品指不符合固定资产定义包装物和其他辅助材料。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

2、发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

低值易耗品采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发

生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

4、存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

（十）长期股权投资

1、长期股权投资投资成本确定

对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，公司按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，公司按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2、长期股权投资后续计量及损益确认方法

（1）对子公司的投资

在公司个别财务报表中，公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法请参见本招股说明书之“第六节、四、（十六）除存货及金融资产外的其他资产减值”。

在公司合并财务报表中，对子公司按本招股说明书之“第六节、四、（五）合并财务报表的编制方法”进行处理。

（2）对联营企业的投资

联营企业指公司能够对其施加重大影响（请参见本招股说明书之“第六节、四、（十）、3、确定对被投资单位具有重大影响的判断标准”）的企业。

后续计量时，对联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。

公司在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

取得对联营企业投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，公司以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照公司的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

公司对联营企业发生的净亏损，除公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对联营企业净投资的长期权益减记至零为限。联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

公司对联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法请参见本招股说明书之“第六节、四、（十六）除存货及金融资产外的其他资产减值”。

3、确定对被投资单位具有重大影响的判断标准

重大影响指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（十一）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指公司为生产商品或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按本节之“（十二）在建工程”确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，公司分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入公司时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

2、固定资产的折旧方法

公司将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

类别	使用寿命	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-20 年	5%	4.75%-9.50%
专用设备	5-15 年	5%	6.33%-19.00%
办公设备及其他设备	3-10 年	5%	9.50%-31.67%
运输工具	4-5 年	5%	19.00%-23.75%

公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行

行复核。

（十二）在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

公司各类别工程结转为固定资产的标准和时点：

类别	结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	工程完工并达到预定可使用状态后转固。
机器设备-非生产线相关	相关设备及其他配套设施已安装完毕并经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行。
生产线	产能利用率达到预设指标，相关产品良率达到公司设定的指标值。

（十三）借款费用

公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，公司按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

1、对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，公司以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

2、对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

公司确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计

入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

（十四）无形资产

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（请参见本招股说明书之“第六节、四、（十六）除存货及金融资产外的其他资产减值”）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，公司将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	33-50
非专利技术	10
软件及其他	5-10

公司至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

公司将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至报告期各资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

报告期内公司将研发支出均在其产生的期间内确认为费用。

（十五）长期待摊费用

公司将已发生且受益期在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用。

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销年限（年）
租赁资产改良支出	3-5
蒸汽接入费用	8 年

（十六）除存货及金融资产外的其他资产减值

公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的

迹象，包括：（1）固定资产；（2）在建工程；（3）使用权资产；（4）无形资产；（5）长期股权投资；（6）长期待摊费用等。

公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

（十七）公允价值的计量

除特别声明外，公司按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

公司估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（十八）预计负债

如果与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出公司，以及有关金额能够可靠地计量，则公司会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，公司综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 1、或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；
- 2、或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十九）股份支付

1、股份支付的种类

公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

2、实施股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付

公司以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，公司在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量做出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

当公司接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是公司股东或其控制的除

公司外的子公司的权益工具时，公司将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

（二十）收入

收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（“新收入准则”）。

报告期内，公司执行新收入准则。

1、收入确认的一般原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指公司向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

附有质量保证条款的合同，公司对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，公司将其作为单项履约义务。否则，公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2）客户能够控制公司履约过程中在建的商品；3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：1）公司就该商品或服务享有现时收款权利；2）公司已将该商品的实物转移给客户；3）公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；4）客户已接受该商品或服务。

公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，如有变化，作为会计估计变更进行会计处理。

公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提

减值（请参见本招股说明书之“第六节、四、（八）、2、金融资产的分类和后续计量”）。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

2、收入确认的具体方法

公司的收入主要为销售电子级多晶硅产品的收入，属于某一时点履行的履约义务。

对于内销，公司区熔用多晶硅产品由购买方验证并获取结算单时确认收入，其他电子级多晶硅产品按照合同约定将产品交付给购买方，并由购买方签收并获得签收单时确认收入。

对于外销，根据不同贸易条款分为以下三种情况：1）将产品运至出发港口装船并获得提单时确认收入；2）将产品运至目的地港口，在购买方提货并获得签收单时确认收入；3）将产品在指定的地点交给买方指定的承运人，并获得提单时确认收入。

（二十一）合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2、该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3、该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成

本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

（二十二）职工薪酬

1、短期薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利-设定提存计划

公司所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，公司职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。公司在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

（2）公司有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对公司将实施重组的合理预期时。

（二十三）政府补助

政府补助是公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向公司投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，公司将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

（二十四）所得税

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果公司拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果单项交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债并未导致产生等额应纳税暂

时性差异和可抵扣暂时性差异，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，公司根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 1、纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 2、递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

（二十五）租赁

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司进行如下评估：（1）合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；（2）承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；（3）承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按本招股说明书之“第六节、四、（二十）收入”所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

（1）公司作为承租人

在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按本招股说明书之“第六节、四、（十六）除存货及金融资产外的其他资产减值”所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 1) 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 2) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

3) 公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

（2）公司作为出租人

在租赁开始日，公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，公司将该转租赁分类为经营租赁。经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（二十六）重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策的变更

财政部在 2023 年至 2025 年期间发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），除下述事项外，新发布的规定没有对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。

根据《企业会计准则解释第 18 号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，公司将计提的保证类质保费用计入“主营业务成本”，不再计入“销售费用”。

公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

上述会计政策变更对报告期合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总如下：

单位：万元

采用变更后会计政策增加/（减少）报表项目金额	2025 年	2024 年	2023 年
营业成本	-	4.57	28.38
销售费用	-	-4.57	-28.38

2、会计估计变更

报告期内，发行人不存在重要会计估计变更。

五、主要税种税率和享受的主要税收优惠政策

（一）主要税种及税率

公司所适用的主要税种及对应税率如下表所示：

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	加工服务及销售商品 13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

根据《财政部 税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号）的相关规定，本公司作为集成电路企业，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。

子公司内蒙古鑫华作为集成电路企业，自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。

合并报表范围内各公司企业所得税税率如下表所示：

纳税主体名称	所得税税率		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度
鑫华半导体	15%	15%	15%
内蒙古鑫华	15%	15%	15%
湖北鑫阳	20%	20%	20%
徐州泛半导体	20%	20%	20%
扬州鑫华	不适用	2024 年 1 月成立至 2024 年 12 月注销期间适用 25%	不适用

徐州鑫华销售	20%	不适用	不适用
鑫华特种气体	20%	不适用	不适用

（二）税收优惠政策

1、企业所得税优惠税率

发行人分别于2022年12月12日和2025年12月19日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR202232010735和GR202532016017的高新技术企业证书，有效期三年。
子公司内蒙古鑫华于2025年11月19日被内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局联合认定为高新技术企业，并取得编号为GR202515000017的高新技术企业证书，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，发行人在2023年、2024年及2025年适用15%的高新技术企业优惠税率，**子公司内蒙古鑫华在2025年适用15%的高新技术企业优惠税率。**

根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。发行人子公司内蒙古鑫华属于设在西部地区从事鼓励类产业的企业，于2023年、2024年减按15%的税率征收企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）规定，本公司的子公司湖北鑫阳、徐州泛半导体、徐州鑫华销售、鑫华特种气体在2023年、2024年及自2025年适用小微企业优惠税率，即对年应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2、研发费用加计扣除

财政部、国家税务总局于2021年3月31日制定下发了《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第13号），根

据此公告，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

财政部、国家税务总局于 2023 年 3 月 26 日，制定下发了《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号），根据此公告，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

财政部、国家税务总局、国家发改委、工业和信息化部于 2023 年 9 月 12 日，制定下发了《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部公告 2023 年第 44 号），根据此公告，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 220%在税前摊销。

内蒙古鑫华、湖北鑫阳、徐州泛半导体于报告期内按照研发费用实际发生额的 100%在税前加计扣除。

母公司鑫华半导体于 2023 年度按照研发费用实际发生额的 100%在税前加计扣除。2024 年度及 2025 年度按照研发费用实际发生额的 120%在税前加计扣除。

3、固定资产采购加计扣除

财政部、国家税务总局于 2022 年 9 月 22 日制定下发了《科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（科技部公告 2022 年第 28 号），根据此通知，高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。公司于 2022 年第四季度新购置的设备、器具，按照一次性全额扣除

的 100%在税前加计扣除。

（三）税收优惠的影响及可持续性

报告期内，发行人享受的税收优惠主要为企业所得税税率优惠，即鑫华半导体作为高新技术企业，可减按 15%的税率缴纳企业所得税。截至本招股说明书签署日，该等税收优惠政策未发生重大变化，未来税收优惠的可持续性较高。

六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

（一）非经常性损益的具体内容及金额

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的相关规定，发行人编制了报告期内合并非经常性损益明细表，经毕马威会计师审核并出具《关于江苏鑫华半导体科技股份有限公司非经常性损益明细表的专项报告》（毕马威华振专字第 2603167 号），发行人报告期内非经常性损益的具体内容、金额如下：

单位：万元

项目		2025 年度	2024 年度	2023 年度
(1)	非流动资产处置收益	-	20.10	246.89
(2)	计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	355.30	372.97	1,131.85
(3)	股份支付费用	-9.57	-	-
(4)	计入当期损益的对非金融企业收取的资金拆借利息费用	52.47	131.02	114.59
(5)	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,173.98	-	-
(6)	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,083.58	3.92	154.76
(7)	其他	1,797.64	-	-
非经常性损益总额		4,453.38	528.01	1,648.09
(8)	所得税影响额	-	-	-
(9)	少数股东权益影响额（税后）	525.46	66.48	333.86

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于母公司股东的非经常性损益	3,927.92	461.54	1,314.23

注：1、2025 年计入非经常性损益的股份支付费用为部分员工已授予权益工具被取消而导致的加速行权费用；
2、公司于 2023 年度、2024 年度和 2025 年度与非金融企业存在资金拆借的情况并收取拆借利息费用，不含税利息金额分别为 114.59 万元、131.02 万元和 52.47 万元；
3、公司持有的其他权益工具投资产生的公允价值变动收益对应的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，并计入其他综合收益。公司以递延所得税负债为限确认递延所得税资产，该金额计入所得税费用。
4、上述（1）-（7）项非经常性损益项目按税前金额列示。

报告期内，公司非经常性损益项目主要为政府补助，各期计入非经常性损益的政府补助金额分别为 1,131.85 万元、372.97 万元和 355.30 万元，公司获得的政府补助主要情况请参见本招股说明书之“第六节、八、（五）其他收益”相关内容。

（二）非经常性损益对当期经营成果的影响

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于母公司股东的非经常性损益净额	3,927.92	461.54	1,314.23
归属于母公司股东的净利润	18,584.92	6,862.32	4,554.03
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例	21.13%	6.73%	28.86%
扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润	14,657.00	6,400.78	3,239.80

报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 1,314.23 万元、461.54 万元和 3,927.92 万元，占各期归属于母公司股东的净利润的比例分别为 28.86%、6.73%和 21.13%。

七、主要财务指标

（一）基本财务指标

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.66	1.32	1.25
速动比率（倍）	1.37	1.14	1.13
资产负债率（合并）	39.05%	43.30%	43.87%
资产负债率（母公司）	25.33%	26.80%	27.56%

归属于发行人股东的每股净资产（元）	2.02	1.81	1.75
项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次）	4.57	4.26	6.03
存货周转率（次）	3.25	3.44	5.91
利息保障倍数	13.19	6.16	7.13
息税折旧摊销前利润（万元）	57,419.33	28,466.71	25,034.01
归属于发行人股东的净利润（万元）	18,584.92	6,862.32	4,554.03
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	14,657.00	6,400.78	3,239.80
研发投入占营业收入的比例	5.98%	6.46%	5.59%
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.16	0.10	0.04
每股净现金流量（元）	-0.05	-0.16	0.38

注：除特别注明，上述财务指标均以合并财务报表数据计算，其计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额×100%

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/（费用化利息支出+资本化利息支出）

存货周转率=营业成本/存货平均余额

息税折旧摊销前利润=利润总额+（利息费用-利息收入）+固定资产及使用权资产计提的折旧+无形资产以及长期待摊费用的摊销

研发投入占营业收入的比例=（研发费用/营业收入）×100%

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东的净资产/期末股本总额

（二）净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求，公司加权平均净资产收益率及每股收益如下：

净利润		加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
2025 年度	归属于公司普通股股东的净利润	6.68	0.13	0.13
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.27	0.10	0.10
2024 年度	归属于公司普通股股东的净利润	2.60	0.05	0.05
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.43	0.04	0.04
2023 年度	归属于公司普通股股东的净利润	2.68	0.03	0.03

净利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元/股）	
		基本	稀释
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.91	0.02	0.02

注：上述财务指标的计算方法如下：

1、加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

八、经营成果分析

报告期内，公司主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	179,107.43	110,964.15	94,626.92
营业毛利	44,623.43	24,905.63	14,791.61
营业利润	11,091.82	6,224.18	3,478.31
利润总额	12,175.40	6,228.10	3,633.08
净利润	13,973.03	6,228.10	3,633.08
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润	14,657.00	6,400.78	3,239.80

（一）营业收入构成及变动分析

1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入构成情况如下表：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	174,138.73	97.23%	106,701.69	96.16%	86,498.92	91.41%
其他业务收入	4,968.70	2.77%	4,262.46	3.84%	8,128.00	8.59%
合计	179,107.43	100.00%	110,964.15	100.00%	94,626.92	100.00%

报告期内，公司主营业务收入来自销售电子级多晶硅产品，各期占营业收入的比例分别为 91.41%、96.16%和 **97.23%**，主营业务收入占比逐期上升。此外，在电子级多晶硅生产过程中，因部分炉次产品未达到电子级标准、硅棒头尾料处理以及破碎过程产生硅粉料等原因，会产出部分电子级多晶硅副产品。电子级多晶硅副产品收入作为其他业务收入核算。除该部分收入外，**2023 年及 2024 年的其他业务收入还包含自制三氯氢硅的销售收入，2025 年包含少量检测费收入。**

（1）2024 年主营业务收入增长的原因

2024 年公司主营业务收入较 2023 年同比增长 20,202.77 万元，涨幅为 23.36%。中国半导体行业自 2023 年下半年开始进入复苏增长阶段，根据 Wind 数据，2024 年中国半导体行业销售规模同比增长 19.32%。公司电子级多晶硅是半导体制造行业的关键主材，受行业回暖影响，下游客户需求上升，向公司采购量增加，带动公司当年主营业务收入增长 23.36%，业绩表现优于行业平均水平。

（2）2025 年主营业务收入增长的原因

1) 下游市场需求结构性分化，应用于大尺寸硅片的 P 级产品需求强劲

根据 Wind 数据，2025 年中国半导体行业销售规模同比增长 18.10%。在此行业增长背景下，公司业绩表现显著优于行业平均水平，2025 年主营业务收入增长率为 63.20%。其中，2025 年 P 级产品增长尤为显著，销售收入增长率为 76.99%。这一增长主要得益于下游需求的结构性分化。自 2025 年以来，受 AI、数据中心、先进逻辑和存储芯片等领域的强劲拉动，大尺寸硅片尤其是 12 英寸硅片需求持续提升，直接带动了公司 P 级产品的销售。2025 年，公司 P 级产品的产销率接近 100%，已处于供不应求状态。

相比之下，S 级产品主要用于生产中小尺寸硅片、硅部件等，其收入保持平稳增长。

2) 产品竞争力增强，国产化率进一步提高

公司在国内市场地位突出，生产工艺不断取得突破，产品质量持续优化。同时，相比国外竞争对手，公司产品具备服务优势、价格优势，下游主要客户不断增加向公司的采购比例，推动电子级多晶硅国产化率进一步提高，进而带动公司主营业务收入增长。

3) 新增产能释放，供应能力显著提升

2024 年底，公司内蒙产线投产，随着产能逐步爬坡，公司获得新增产能。在行业高景气度背景下，公司紧抓市场机遇，快速扩大下游客户订单，驱动公司主营业务收入进一步增长。随着内蒙产线产能逐步释放和良率提升，公司对电子级多晶硅的整体供应能力显著增强。

(3) 其他业务收入变化的原因

报告期内，公司其他业务收入占比呈下降趋势，主要是随着太阳能级多晶硅市场自 2023 年初开始持续下行，电子级多晶硅副产品价格下降幅度较大，公司副产品销售收入大幅下降。

2、主营业务收入按产品类别构成分析

报告期内，公司主营业务收入按不同产品类别的构成情况如下表：

单位：万元

产品类别		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
区熔用多晶硅		1,858.43	1.07%	1,325.57	1.24%	84.74	0.10%
直拉用多晶硅	P 级	144,986.52	83.26%	81,918.37	76.77%	67,256.26	77.75%
	S 级	26,430.39	15.18%	22,250.02	20.85%	18,488.90	21.37%
其他主营业务		863.40	0.50%	1,207.74	1.13%	669.02	0.77%
合计		174,138.73	100.00%	106,701.69	100.00%	86,498.92	100.00%

注 1：公司其他主营业务产品包括碳化硅硅粉、电子特气、高纯石英砂等新产品，下同；
注 2：公司超高阻电子级多晶硅（J 级）目前实现小批量出货，金额较小，故与 P 级合并列示，下同。

从业务结构看，公司高端产品 P 级电子级多晶硅销售收入占比逐渐提高，主要是由于：（1）P 级产品主要应用于大尺寸硅片，自 2025 年以来，受 AI、数据中心、先进逻辑和存储芯片等领域的强劲拉动，大尺寸硅片尤其是 12 英寸硅片

需求持续提升，公司市场地位较强，已与几乎所有国内成规模 12 英寸半导体硅片厂商签订长期供应订单；（2）公司工艺研发不断取得突破，P 级产品产出率稳定提升；（3）P 级产品质量要求更高，多以长单形式锁定价格，成交价格更加稳定；而 S 级产品主要用于生产中小尺寸硅片、硅部件等，下游市场竞争相对更激烈，多采用短单形式交易，价格容易产生波动。

3、主营业务收入按区域构成分析

报告期内，公司主营业务收入按地区构成情况如下表：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内销售	165,365.77	94.96%	100,094.66	93.81%	85,406.80	98.74%
境外销售	8,772.96	5.04%	6,607.03	6.19%	1,092.12	1.26%
合计	174,138.73	100.00%	106,701.69	100.00%	86,498.92	100.00%

公司抓住国内集成电路行业快速发展的机遇，大力开拓境内外客户。报告期内，公司销售收入以境内为主，各期占比分别为 98.74%、93.81%和 **94.96%**；公司已进入国际一线硅片厂商，但境外销售收入占比仍相对较低，公司境外销售的主要地区为中国台湾、韩国等。

4、主营业务收入按销售模式分析

报告期内，公司主营业务收入按销售模式构成情况如下表：

单位：万元

销售模式	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销模式	167,288.02	96.07%	102,456.59	96.02%	85,241.19	98.55%
贸易商模式	6,850.72	3.93%	4,245.10	3.98%	1,257.73	1.45%
合计	174,138.73	100.00%	106,701.69	100.00%	86,498.92	100.00%

报告期内，公司电子级多晶硅销售业务存在直销与贸易商模式。对于境内客户，公司主要采取直销模式向客户提供产品，对于部分境外客户及少部分境内客户，公司采取贸易商模式向客户提供产品。2023 年，境外销售收入及占比减少，导致公司贸易商模式下的销售收入及占比有所下降。

5、主营业务收入的季节性分析

报告期内，公司各季度销售占比情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	40,664.32	23.35%	21,514.09	20.16%	23,607.39	27.29%
第二季度	43,781.15	25.14%	23,504.32	22.03%	20,141.43	23.29%
第三季度	44,933.61	25.80%	26,437.36	24.78%	21,234.28	24.55%
第四季度	44,759.66	25.70%	35,245.93	33.03%	21,515.82	24.87%
合计	174,138.73	100.00%	106,701.69	100.00%	86,498.92	100.00%

报告期内，公司的下游客户主要为半导体硅片制造企业，行业需求不存在规律性季节性变化，故公司产品销售收入无显著的季节性特征，各季度占比随下游行业波动有所变化。2024 年半导体行业回暖明显，收入逐季提升。**2023 年和 2025 年各季度占比相对稳定。**

（二）营业成本分析

1、营业成本构成

公司营业成本构成如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	130,475.66	97.02%	82,051.46	95.34%	71,935.00	90.10%
其他业务成本	4,008.34	2.98%	4,007.06	4.66%	7,900.31	9.90%
合计	134,484.00	100.00%	86,058.52	100.00%	79,835.31	100.00%

报告期各期，公司主营业务成本与主营业务收入占比逐年上升趋势一致。

2、主营业务成本按料工费构成分析

报告期内，公司主营业务成本按料工费构成列示如下表：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	24,781.43	18.99%	18,223.65	22.21%	17,363.01	24.14%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接人工	13,858.67	10.62%	6,755.42	8.23%	5,045.90	7.01%
能耗动力	44,500.61	34.11%	30,144.21	36.74%	28,336.77	39.39%
制造费用	45,976.97	35.24%	26,086.41	31.79%	20,669.22	28.73%
运费	1,357.98	1.04%	841.77	1.03%	520.11	0.72%
合计	130,475.66	100.00%	82,051.46	100.00%	71,935.00	100.00%

公司主营业务成本包括直接材料、直接人工、能耗动力、制造费用及运费，其中以直接材料、能耗动力和制造费用为主。报告期内，公司直接材料主要为硅粉、三氯氢硅等。2024 年及 2025 年公司直接材料占比下降，主要系生产所需主要原材料硅粉的市场价格持续下降所致。

2023 年至 2025 年，公司制造费用占比逐期上升。2023 年公司开始从直接采购三氯氢硅转变为外采硅粉自行生产三氯氢硅，导致制造费用占比上升。同时，公司持续优化产线，增加产线建设、技改投资以及内蒙产线于 2024 年底转固导致折旧与摊销金额有所上升。

报告期内，公司能耗动力进一步细化分类如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电力	36,075.97	81.07%	21,725.12	72.07%	22,764.27	80.33%
蒸汽	8,424.64	18.93%	8,419.10	27.93%	5,572.50	19.67%
合计	44,500.61	100.00%	30,144.21	100.00%	28,336.77	100.00%

2024 年公司能耗动力中电力成本占比相对较低，原因如下：（1）2023 年至 2024 年，徐州产线平均采购电价有所下降，徐州产线生产用电分为向国家电网直接采购和通过中能硅业采购两部分，其中向国家电网直接采购电价相对稳定，通过中能硅业采购电价系参照其向国家电网采购的电度用电价格（加成一定金额容/需量费）确定，受其自身光伏行业波动及工艺调整影响，中能硅业产能利用率和用电负荷下降，向国家电网采购低谷时段电量占比增加，导致与发行人的结算电价下降；（2）2024 年下半年公司内蒙产线开始试生产，并于 2024 年底正式投产，内蒙产线平均采购电价较低。

2025 年公司能耗动力中电力成本金额及占比相对较高，原因如下：一方面，内蒙产线 2024 年仅为下半年试生产，而 2025 年实现了全年生产且产能逐渐爬坡，用电规模随之增加；另一方面，相较于徐州产线，内蒙产线因新增电解制氢和脱盐水工序，且冷氢化、精馏等环节配套设备的功率更大，导致整体耗电量更高。

2023 年至 2024 年，公司能耗动力中蒸汽金额及占比上升，除电费占比下降导致蒸汽占比被动上升外，主要还由于公司自建三氯氢硅冷氢化产线于 2022 年底投入使用，2023 年逐步成熟达产，且 2024 年下半年内蒙产线开始试生产，均导致蒸汽耗用量相应增加。

2025 年，蒸汽耗用有所降低。一方面，徐州产线受冷氢化装置停产检修影响，基础蒸汽耗用量有所降低；同时，得益于工艺优化与设备升级改造，徐州产线节能降耗成效显著：氢化工序通过设备更新与参数优化降低了蒸汽消耗，7 度水制冷机组由溴化锂蒸汽机组更改为电制冷机组，直接减少了蒸汽用量；精馏系统也在保质的前提下优化了生产参数，降低了使用强度。

另一方面，随着 2025 年内蒙产线投产及产量释放，还原环节副产蒸汽有效补充了生产需求，从而减少了外购蒸汽总量。同时，内蒙产线在工艺设计上采用了精馏耦合设计，进一步降低了整体蒸汽消耗量。

（三）毛利及毛利率分析

1、毛利构成及变动分析

报告期内，公司毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务毛利	43,663.08	97.85%	24,650.23	98.97%	14,563.92	98.46%
其他业务毛利	960.36	2.15%	255.40	1.03%	227.69	1.54%
合计	44,623.43	100.00%	24,905.63	100.00%	14,791.61	100.00%

（1）主营业务毛利

报告期内，公司主营业务毛利分别为 14,563.92 万元、24,650.23 万元和

43,663.08 万元。2023 年受半导体行业下行周期影响，公司部分下游客户需求减少，电子级多晶硅尤其是 S 级产品收入和毛利率有所下降，且 2023 年 7 月产线升级改造而停工导致产品单位成本上升，共同导致主营业务毛利有所降低。2024 年及 2025 年受下游客户需求回暖、公司高端 P 级产品占比提升、产品单位成本下降等因素影响，主营业务毛利大幅上升。

(2) 其他业务毛利

报告期内，公司其他业务毛利主要来源于电子级多晶硅副产品销售，其销售价格参考太阳能级多晶硅市场公开价格。2023 年以后，随着太阳能级多晶硅市场价格持续快速下跌，公司其他业务毛利较低。

2、毛利率情况分析

(1) 主营业务毛利率

报告期内，主营业务毛利率情况如下表：

产品类别	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
电子级多晶硅产品	25.10%	99.50%	23.29%	98.87%	16.98%	99.23%
其他主营业务	10.25%	0.50%	6.29%	1.13%	-1.50%	0.77%
合计	25.07%	100.00%	23.10%	100.00%	16.84%	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利率呈现一定波动，主要受电子级多晶硅产品影响，其他主营业务影响较小。其中电子级多晶硅产品具体情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	金额	变动	金额	变动	金额
电子级多晶硅产品毛利率	25.10%	增加 1.81 个百分点	23.29%	增加 6.31 个百分点	16.98%
单位售价	15.50	-5.05%	16.32	-8.57%	17.85
单位成本	11.61	-7.30%	12.52	-15.53%	14.82

报告期内公司电子级多晶硅产品单位售价每年略有下降，综合变动幅度分别为-8.57%、-5.05%，主要是随着公司突破关键技术，成为国内主要的电子级多晶硅供应厂商，在生产及销售规模快速扩大、单位成本有所下降的情况下，对下游客户售价合理下降，能够促进公司所在产业链整体健康发展。

2024 年和 2025 年电子级多晶硅产品毛利率持续上升，主要受单位成本下降所致。2024 年单位成本变化幅度为-15.53%，主要由于电力采购单位成本下降、产量上升导致折旧和人工等刚性成本有所摊薄。2025 年单位成本变化幅度为-7.30%，进一步降低，主要由于生产所需原材料硅粉、能源蒸汽的价格有所下降所致。

（2）其他业务毛利率

报告期内，公司其他业务毛利率分别为 2.80%、5.99%和 19.33%,公司其他业务主要为电子级多晶硅副产品销售，其销售价格参考太阳能级多晶硅市场公开价格。2023 年和 2024 年，太阳能级多晶硅市场价格的持续走低，导致其他业务毛利率较低。2025 年，尽管电子级多晶硅副产品销售的毛利率仍处于较低水平，但受益于高毛利率的检测费业务规模扩大，公司其他业务整体毛利率有所回升。

3、同行业可比公司毛利率比较分析

（1）同行业可比公司的选择

从财务可比性角度，由于电子级多晶硅领域全球厂商较少，国内主要为发行人，国际厂商主要为德国瓦克、美国 Hemlock、日本德山等，其多为多元化集团，电子级多晶硅业务在其整体收入中占比较小，相关细分数据难以获取。因此，本招股说明书选取沪硅产业和西安奕材作为财务可比公司，沪硅产业、西安奕材与发行人同属半导体产业的硅基主材领域，核心产品均处于国产化加速阶段，与发行人具有较高的业务关联性和可比基础。鉴于发行人在产品具体类型、技术路径及下游应用细分领域等方面与上述可比公司仍存在一定差异，且半导体硅片制造环节的市场竞争格局、客户结构及定价机制亦有所不同，导致包括综合毛利率在内的部分财务指标存在一定程度的差异。沪硅产业和西安奕材具体情况如下表所示：

可比公司简称	证监会行业	主营业务
沪硅产业	计算机、通信和其他电子设备制造业	从事半导体硅片的研发、生产和销售，提供的产品类型涵盖 12 英寸抛光片及外延片、8 英寸及以下抛光片、外延片及 SOI 硅片
西安奕材	计算机、通信和其他电子设备制造业	12 英寸硅片的研发、生产和销售

（2）同行业可比公司毛利率比较分析

发行人收入主要来自于电子级多晶硅销售业务。报告期内，发行人与同行业可比公司主营业务毛利率对比情况如下：

可比公司	业务类型	2025 年度	2024 年度	2023 年度
沪硅产业	半导体硅片业务	-17.64%	-11.23%	13.93%
西安奕材	半导体硅片业务	3.44%	5.49%	0.66%
可比公司平均		-7.10%	-2.87%	7.30%
发行人（主营业务）		25.07%	23.10%	16.84%

与西安奕材相比，2024 年受半导体行业回暖影响，发行人与西安奕材毛利率均呈现上升趋势。2025 年二者毛利率变动有所差异，主要系当期西安奕材除受市场价格下降影响外，其第二工厂于 2024 年转固，2025 年度尚处于产能爬坡阶段，折旧摊销等固定成本增加且规模效应尚未充分体现；而发行人受益于产品结构优化及成本控制能力，毛利率持续提升。

与沪硅产业相比，双方毛利率变动趋势有所差异，主要原因系沪硅产业产能扩张带来的成本压力与产品结构差异。一方面，沪硅产业在 2024 年处于上海、山西等地 12 英寸硅片产能扩张的爬坡期间，固定成本快速提升以及产销量尚未充分释放，导致单位成本大幅上升；另一方面，沪硅产业产品除 12 英寸外还包括 8 英寸及以下成熟产品。相比之下，发行人作为所在细分行业的主要市场参与者，受益于行业周期回暖，毛利率实现修复。

（四）期间费用分析

报告期各期，公司各类期间费用金额及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	费用率	金额	费用率	金额	费用率
销售费用	1,249.30	0.70%	1,011.26	0.91%	888.28	0.94%
管理费用	8,356.21	4.67%	7,478.05	6.74%	6,730.19	7.11%
研发费用	10,702.11	5.98%	7,173.67	6.46%	5,287.76	5.59%
财务费用	4,374.76	2.44%	7.65	0.01%	1,159.94	1.23%
合计	24,682.38	13.78%	15,670.63	14.12%	14,066.17	14.86%

报告期内，公司期间费用占各期营业收入的比例整体较为稳定。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	701.54	56.15%	416.41	41.18%	399.47	44.97%
股份支付费用	74.87	5.99%	70.77	7.00%	69.58	7.83%
样品费	173.99	13.93%	178.30	17.63%	117.30	13.21%
业务招待费	214.71	17.19%	237.30	23.47%	159.14	17.92%
其他	84.20	6.74%	108.49	10.73%	142.78	16.07%
合计	1,249.30	100.00%	1,011.26	100.00%	888.28	100.00%

报告期内，公司销售费用分别为 888.28 万元、1,011.26 万元和 1,249.30 万元。公司销售费用主要由职工薪酬、业务招待费及样品费等构成。

报告期内，公司销售费用率与同行业可比公司的对比情况如下：

可比公司名称	销售费用率		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度
沪硅产业	2.08%	2.07%	2.50%
西安奕材	2.50%	3.12%	3.58%
可比公司平均	2.29%	2.60%	3.04%
发行人	0.70%	0.91%	0.94%

与沪硅产业、西安奕材相比，公司销售费用率相对较低，主要系公司产品工艺及良率已相对稳定，市场占有率已相对较高，下游客户较为集中且多为长期客户，经过前期客户开拓及验证后，后期所需销售费用相对较少。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用主要构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	5,102.22	61.06%	4,561.49	61.00%	3,950.90	58.70%
股份支付费用	1,285.13	15.38%	1,229.66	16.44%	1,174.47	17.45%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁费	125.63	1.50%	60.74	0.81%	73.43	1.09%
业务招待费	305.37	3.65%	271.09	3.63%	350.64	5.21%
车辆使用费	29.71	0.36%	26.69	0.36%	28.48	0.42%
咨询服务费	433.61	5.19%	199.06	2.66%	606.73	9.02%
物业管理费	113.00	1.35%	131.79	1.76%	78.89	1.17%
折旧与摊销	434.68	5.20%	227.25	3.04%	92.23	1.37%
其他费用	526.86	6.30%	770.30	10.30%	374.43	5.56%
合计	8,356.21	100.00%	7,478.05	100.00%	6,730.19	100.00%

报告期各期，公司管理费用分别为 6,730.19 万元、7,478.05 万元和 **8,356.21** 万元。2024 年度及 **2025 年度** 公司管理费用有所上升，主要原因系内蒙产线于 2024 年开始筹备试生产，公司增加人员招聘规模，管理人员数量增加导致职工薪酬相应增加，差旅费等其他费用相应增加。

公司管理费用率与同行业可比公司的对比情况如下：

可比公司名称	管理费用率		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度
沪硅产业	8.33%	8.97%	8.74%
西安奕材	8.14%	9.82%	15.22%
可比公司平均	8.24%	9.39%	11.98%
发行人	4.67%	6.74%	7.11%

报告期内，公司管理费用率分别为 7.11%、6.74%和 **4.67%**，低于同行业可比公司平均水平，主要原因系公司目前产品结构以电子级多晶硅为主，下游客户集中度较高，业务管理复杂度相对较低，对行政管理人员及相关办公场所、办公设备的需求较小，因此管理费用占营业收入比例较低。

3、研发费用

（1）研发费用的构成及变动情况分析

报告期内，公司研发费用的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
----	---------	---------	---------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	4,445.94	41.54%	3,348.63	46.68%	2,675.39	50.60%
股份支付费用	269.55	2.52%	233.08	3.25%	269.61	5.10%
试验装置费	840.85	7.86%	293.31	4.09%	263.15	4.98%
耗材费	1,664.82	15.56%	877.20	12.23%	697.74	13.20%
专业服务费	144.11	1.35%	300.79	4.19%	65.37	1.24%
折旧与摊销	1,848.67	17.27%	1,188.71	16.57%	741.98	14.03%
水电燃料费	1,285.68	12.01%	846.01	11.79%	470.70	8.90%
其他费用	202.49	1.89%	85.94	1.20%	103.83	1.96%
合计	10,702.11	100.00%	7,173.67	100.00%	5,287.76	100.00%

报告期内，公司研发项目集中于生产工艺的提升改造和新产品的开发，不存在研发投入资本化的情形。公司研发投入的计算口径与研发费用口径一致，主要包括职工薪酬、耗材费、折旧与摊销、水电燃料费等。公司最近三年累计研发投入金额为 **23,163.54** 万元，占最近三年累计营业收入的比例为 **6.02%**，最近三年研发投入的复合增长率为 **42.27%**。其中 2024 年及 2025 年公司研发费用增长较快，主要原因系公司加大区熔用多晶硅产品的研发，研发试制过程中产生较大研发损耗，对应耗材费、水电燃料费及折旧与摊销相应增加，同时公司研发人员数量及平均薪酬水平有所增加。

(2) 报告期内公司主要研发项目

报告期内，公司主要研发项目如下：

单位：万元

项目类型	2025 年度	2024 年度	2023 年度
超高纯电子级多晶硅（含区熔用电子级多晶硅）工艺及设备的开发	5,092.63	2,178.09	937.28
电子级多晶硅衍生产品的开发与应用	3,061.88	1,766.05	1,473.37
还原关键工艺及设备的研究开发	1,660.39	823.84	544.78
高效纯度提升及副产循环优化工艺的研究与开发	276.97	887.94	563.70
电子级多晶硅相关检测技术的研究与应用	284.48	630.83	738.10
后处理关键工艺及设备的研究开发	118.42	671.06	830.77
其他	207.34	215.85	199.77
合计	10,702.11	7,173.67	5,287.76

注：本表系根据公司各项研发项目的研发方向归类整理后列示。

公司主要研发方向均围绕公司的核心技术和主要产品开展，目前上述研发项目处于正常研发中。

（3）与可比公司研发费用率的对比

报告期各期，公司研发费用率与同行业可比公司的对比情况如下：

可比公司名称	研发费用率		
	2025 年度	2024 年度	2023 年度
沪硅产业	9.52%	7.88%	6.96%
西安奕材	10.76%	12.20%	11.63%
可比公司平均	10.14%	10.04%	9.30%
发行人	5.98%	6.46%	5.59%

报告期内公司研发费用率分别为 5.59%、6.46%和 **5.98%**，低于可比公司平均水平，主要原因系公司研发模式与可比公司半导体硅片业务研发模式存在差异。例如，公司更高等级的产品研发，是在已经具备极高纯度的基础上，进行更高纯度的上探；公司部分产品研发项目，产出的产品虽因研发活动的介入（如工艺或配方的试验性调整）在质量等级上可能存在差异，但通常也可实现对外销售。因此，公司将标准成本对应的料工费结转至存货成本，剩余未结转至存货成本部分的研发投入为研发探索活动产生的损耗，为结余的研发费用。因此，同等情况下公司研发费用率较可比公司相对较低。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用的具体构成如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
贷款及应付款项的利息支出	4,276.44	4,534.96	3,444.86
租赁负债的利息支出	76.53	86.07	68.04
减：资本化的净利息支出	-36.48	-2,412.78	-653.12
存款及应收款项的利息收入	-720.99	-2,097.93	-1,773.41
净汇兑（收益）/亏损	664.63	-122.19	39.89
其他财务费用	114.63	19.52	33.68
合计	4,374.76	7.65	1,159.94

报告期各期，公司财务费用分别为 1,159.94 万元、7.65 万元和 **4,374.76** 万元，主要为银行贷款利息支出。

2024 年，公司财务费用大幅降低，主要原因系：（1）内蒙产线建设期间申请项目贷款，相应利息支出进行资本化；（2）公司于 2023 年收到 B 轮投资款，存款利息收入有较大幅度的增加。2025 年，公司财务费用大幅增加，主要原因系公司内蒙产线于 2024 年底完成转固，相应利息支出不再进行资本化。

（五）其他收益

报告期内，发行人其他收益均为政府补助，各期金额分别为 3,282.77 万元、2,507.10 万元和 **3,310.26** 万元，主要系增值税加计抵减。报告期内公司主营业务开展良好，对政府补助不存在重大依赖。报告期内，发行人政府补助的具体情况如下：

2025 年度			
种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	9,491.65	递延收益/其他收益	826.61
与收益相关	2,483.65	其他收益	2,483.65
合计	11,975.30	/	3,310.26
2024 年度			
种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	8,861.65	递延收益/其他收益	723.49
与收益相关	1,783.61	其他收益	1,783.61
合计	10,645.26	/	2,507.10
2023 年度			
种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	8,727.00	递延收益/其他收益	587.63
与收益相关	2,695.15	其他收益	2,695.15
合计	11,422.15	/	3,282.77

（六）投资收益

报告期内，公司投资收益分项目情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
----	---------	---------	---------

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-8.19	-24.38	-2.86
合计	-8.19	-24.38	-2.86

报告期内，公司投资损失系持有对武汉立膜、硅研新材的股权按权益法核算产生。公司对武汉立膜的投资情况请参见本招股说明书之“第六节、九、（三）、5、长期股权投资”相关内容；公司已于 2022 年 7 月将持有的硅研新材全部股权置换为深云智合的股权并按照其他权益工具投资核算，具体请参见本招股说明书之“第六节、九、（三）、7、其他权益工具投资”相关内容。

（七）信用减值损失、资产减值损失分析

1、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款	151.32	262.31	101.38
其他应收款	9.04	24.18	-14.29
合计	160.37	286.49	87.09

注：转回以“-”表示。

报告期各期末，公司应收账款账龄基本位于 6 个月以内，账龄相对较短，信用减值损失金额整体较小；公司其他应收款主要系支付的融资租赁保证金，该保证金可用于到期抵付公司应支付的融资租赁款，不存在回收风险，因此未计提减值准备。剩余其他应收款金额较小，信用减值损失金额整体较小。

2、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货	11,127.26	4,793.44	256.05
固定资产	976.27	-	-
工程物资	151.64	-	-
合计	12,255.17	4,793.44	256.05

2024 年度及 2025 年度，公司资产减值损失金额有所增加，主要原因系：（1）

受电子级多晶硅副产品影响。电子级多晶硅副产品价格自 2023 年开始下行，至 2024 年已经跌至低位，公司相应对存货中副产品计提跌价准备；同时，2024 年下半年内蒙产线开始试生产，2024 年底正式投产，在产能及良率爬坡阶段，副产品产出率相对较高，因此 **2025 年度** 资产减值损失进一步增加；（2）受部分电子级多晶硅合同价格较低影响。公司为打入境外市场，与部分境外客户签订的多晶硅长单合同价格较低，导致部分电子级多晶硅存货跌价准备金额较高。

2025 年度，为改进产线，公司对部分机械设备进行了拆除改造，对拆除资产计提固定资产减值准备 **976.27** 万元。

（八）营业外收入与营业外支出

报告期内，公司营业外收入与营业外支出的具体情况如下：

单位：万元			
项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
赔偿收入	1,069.50	-	285.93
专精特新企业奖励政府补助	-	-	-
其他	41.93	10.51	2.99
营业外收入合计	1,111.44	10.51	288.92
非流动资产报废支出	-	-	110.20
其他	27.86	6.58	23.96
营业外支出合计	27.86	6.58	134.16

报告期内，公司营业外收入主要为保险理赔收入；营业外支出主要系对部分无维修价值的老化设备进行报废处置产生的报废支出。其中，**2025 年**营业外收入金额相对较高，主要系生产过程中发生纳入保险范围的生产故障，获得保险公司理赔收入。

（九）非经常性损益项目

报告期内，公司非经常性损益项目主要为政府补助及其它营业外收入和支出。非经常性损益项目及其对当期经营成果的影响请参见本招股说明书之“第六节、六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表”相关内容。

（十）纳税情况

发行人编制了报告期内的《主要税种纳税情况说明》，并经毕马威鉴证并出

具了《关于主要税种纳税情况说明的专项报告》（毕马威华振专字第 2603166 号），发行人报告期内主要税种为企业所得税、增值税，具体缴纳情况如下：

1、增值税

单位：万元

期间	期初未交数	本期应交	本期已交	期末未交数
2025 年度	475.19	6,271.66	6,678.26	68.59
2024 年度	-	2,303.58	1,828.39	475.19
2023 年度	148.99	1,843.06	1,992.05	-

2、企业所得税

报告期内，发行人不存在重大税收政策变化的情况。公司于 2019 年被评为高新技术企业，2022 年 12 月通过高新技术企业复审，适用 15% 所得税优惠税率。由于公司累计可抵扣亏损较多，因此报告期内相关税收优惠对发行人影响较小。

（十一）未弥补亏损情况

报告期各期末，公司合并报表未分配利润分别为 17,230.35 万元、23,276.33 万元和 39,458.48 万元，母公司报表未分配利润分别为 19,509.55 万元、26,856.65 万元和 49,797.56 万元，公司不存在未弥补亏损。

九、资产质量分析

（一）资产构成及变化分析

报告期各期末，公司资产总体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	225,636.42	37.59%	186,995.50	32.36%	195,370.66	34.81%
非流动资产	374,570.38	62.41%	390,875.83	67.64%	365,943.98	65.19%
资产合计	600,206.80	100.00%	577,871.33	100.00%	561,314.64	100.00%

报告期各期末，公司总资产分别为 561,314.64 万元、577,871.33 万元和 600,206.80 万元。报告期各期末，公司非流动资产占比分别为 65.19%、67.64% 和 62.41%，非流动资产占比较高，符合电子级多晶硅产业重资产模式的特点。

（二）流动资产分析

报告期内，公司流动资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	82,384.94	36.51%	94,532.67	50.55%	134,806.34	69.00%
交易性金融资产	20,959.17	9.29%	-	-	-	-
应收票据	16,470.80	7.30%	6,424.96	3.44%	4,615.30	2.36%
应收账款	44,040.76	19.52%	33,101.46	17.70%	18,079.19	9.25%
应收款项融资	15,138.21	6.71%	17,077.22	9.13%	6,821.41	3.49%
预付款项	599.33	0.27%	1,257.78	0.67%	1,196.76	0.61%
其他应收款	2,683.19	1.19%	5,415.27	2.90%	7,425.54	3.80%
存货	40,352.64	17.88%	26,066.05	13.94%	18,200.63	9.32%
其他流动资产	3,007.39	1.33%	3,120.09	1.67%	4,225.48	2.16%
流动资产合计	225,636.42	100.00%	186,995.50	100.00%	195,370.66	100.00%

报告期各期末，公司流动资产金额分别为 195,370.66 万元、186,995.50 万元和 225,636.42 万元，主要包括货币资金、应收账款、应收款项融资、存货等。随着公司业务规模持续扩大，公司流动资产规模整体呈现增长趋势。

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行存款	81,259.37	88,870.00	112,903.70
其他货币资金	1,125.57	5,662.67	21,902.64
合计	82,384.94	94,532.67	134,806.34
其中：信用证保证金	270.89	359.98	1,637.67
银行承兑汇票保证金	854.68	5,302.69	20,264.97

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 134,806.34 万元、94,532.67 万元和 82,384.94 万元。2023 年末，公司货币资金规模增长幅度较大，主要系 B 轮融资完成，收到股东出资款 100,000.00 万元所致。

2、交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产的构成情况如下：

单位：万元

银行承兑汇票	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
理财产品-结构性存款	20,809.72	-	-
外汇掉期合同	149.45	-	-
合计	20,959.17	-	-

报告期各期末，公司交易性金融资产分别为 0.00 万元、0.00 万元和 20,959.17 万元，主要系公司为提高资金使用效率购买的理财产品。公司投资的产品期限较短或可随时赎回或转让，流动性较高，风险较低。因此，该交易性金融资产系公司在保证资金安全性和流动性的前提下进行的日常资金管理，不会对公司资金使用安排产生重大影响。

3、应收票据及应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资的情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收票据			
银行承兑汇票	15,864.53	6,192.85	4,615.30
商业承兑汇票	606.28	232.11	-
小计	16,470.80	6,424.96	4,615.30
应收款项融资			
银行承兑汇票	15,138.21	17,077.22	6,821.41
合计	31,609.02	23,502.18	11,436.71

注：报告期末应收款项融资为期末结存的信用等级较高的国有大型商业银行和股份制商业银行开具的银行承兑汇票。

报告期内，公司与部分客户以承兑汇票方式结算货款。报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资余额合计分别为 11,436.71 万元、23,502.18 万元和 31,609.02 万元，公司应收票据及应收款项融资规模逐年上升，与公司报告期内营业收入波动趋势相匹配。

报告期各期末，公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据和

应收款项融资情况如下：

单位：万元

银行承兑汇票	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
期/年末未终止确认金额	13,765.99	2,293.74	1,252.77
期/年末终止确认金额	45,498.17	8,472.07	8,796.02

公司已背书或已贴现但尚未到期的应收票据，在报告期末是否终止确认的依据为出票行是否为信用等级较高的国有大型商业银行和股份制商业银行，如是，公司进行终止确认；否则，公司不进行终止确认。

4、应收账款

（1）应收账款总体情况

报告期各期末，公司应收账款的情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
账面余额	44,750.75	33,660.14	18,375.56
坏账准备	710.00	558.68	296.37
账面价值	44,040.76	33,101.46	18,079.19

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 18,375.56 万元、33,660.14 万元和 44,750.75 万元，公司应收账款余额呈现增长趋势。

（2）应收账款变动分析

报告期内，公司应收账款余额变动及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
应收账款余额	44,750.75	33,660.14	18,375.56
应收账款增长率	32.95%	83.18%	41.36%
营业收入	179,107.43	110,964.15	94,626.92
营业收入增长率	61.41%	17.26%	-25.75%
应收账款余额/ 当期营业收入	24.99%	30.33%	19.42%

报告期各期末，公司应收账款余额/当期营业收入分别为 19.42%、30.33%和

24.99%，呈现先升后降的趋势，具体原因如下：

公司主营业务产品电子级多晶硅在经历 2023 年半导体产业下行周期后，市场在 2024 年开始迎来回暖，电子级多晶硅收入规模快速增长，下游半导体硅片客户普遍存在账期，导致应收账款规模增长，但报告期内公司严格控制应收账款回款进度，应收账款周转天数始终未超过三个月。2025 年公司收入增长较快，同时加强应收账款回收，应收账款余额占当期营业收入的比例降低。

(3) 应收账款坏账准备的计提情况

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	44,750.75	100.00%	710.00	1.59%	45,460.75
合计	44,750.75	100.00%	710.00	1.59%	45,460.75
项目	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	33,660.14	100.00%	558.68	1.66%	33,101.46
合计	33,660.14	100.00%	558.68	1.66%	33,101.46
项目	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	18,375.56	100.00%	296.37	1.61%	18,079.19
合计	18,375.56	100.00%	296.37	1.61%	18,079.19

公司按组合以整个存续期预期信用损失计量应收账款坏账准备，并以账龄与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失，具体情况如下表：

单位：万元

账龄	2025 年 12 月 31 日
----	------------------

	账面余额	比例	坏账准备	预期信用损失率	账面价值
6个月以内	43,707.70	97.67%	655.62	1.50%	43,052.09
6-12个月	1,034.13	2.31%	51.71	5.00%	982.42
1-2年	8.93	0.02%	2.68	30.00%	6.25
2-3年	-	-	-	60.00%	-
3年以上	-	-	-	100.00%	-
合计	44,750.75	100.00%	710.00	/	44,040.76
账龄	2024年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	预期信用损失率	账面价值
6个月以内	33,523.29	99.59%	502.85	1.50%	33,020.44
6-12个月	7.13	0.02%	0.36	5.00%	6.78
1-2年	74.52	0.22%	22.36	30.00%	52.16
2-3年	55.19	0.16%	33.12	60.00%	22.08
3年以上	-	-	-	100.00%	-
合计	33,660.14	100.00%	558.68	/	33,101.46
账龄	2023年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	预期信用损失率	账面价值
6个月以内	18,248.81	99.31%	273.73	1.50%	17,975.07
6-12个月	61.56	0.34%	3.08	5.00%	58.48
1-2年	65.19	0.35%	19.56	30.00%	45.64
2-3年	-	-	-	60.00%	-
3年以上	-	-	-	100.00%	-
合计	18,375.56	100.00%	296.37	/	18,079.19

注：预期信用损失率基于应收账款过去期间的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与公司认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

报告期内，公司制定了较为稳健的坏账计提政策，并已经按照会计政策要求及时足额计提坏账准备。报告期各期末，公司应收账款账龄基本在6个月以内，账龄相对较短，应收账款管理情况良好，发生坏账损失的风险较小。

（4）主要应收账款客户情况

报告期各期末，公司应收账款金额前五名情况如下：

单位：万元

2025 年 12 月 31 日				
单位名称	金额	账龄	占应收账款 总额比例	坏账准备
TCL 中环及其下属公司	13,079.89	6 个月以内	29.23%	196.20
西安奕材	6,892.78	6 个月以内	15.40%	103.39
沪硅产业	6,843.34	6 个月以内	15.29%	102.65
Ferrotec	4,182.26	6 个月以内	9.35%	62.73
立昂微	3,085.99	6 个月以内	6.90%	46.29
合计	34,084.26	/	76.17%	511.26
2024 年 12 月 31 日				
单位名称	金额	账龄	占应收账款 总额比例	坏账准备
沪硅产业	8,405.15	6 个月以内	24.97%	126.08
TCL 中环及其下属公司	8,165.43	6 个月以内	24.26%	122.48
西安奕材	6,790.75	6 个月以内	20.17%	101.86
中晶科技	1,745.46	6 个月以内	5.19%	26.18
立昂微	1,426.03	6 个月以内	4.24%	21.39
合计	26,532.83	/	78.83%	397.99
2023 年 12 月 31 日				
单位名称	金额	账龄	占应收账款 总额比例	坏账准备
沪硅产业	6,735.47	6 个月以内	36.65%	101.03
西安奕材	2,591.24	6 个月以内	14.10%	38.87
中晶科技	2,255.13	6 个月以内	12.27%	33.83
Ferrotec	1,204.42	6 个月以内	6.55%	18.07
中能硅业及其关联方	918.80	6 个月以内	5.00%	13.78
合计	13,705.06	/	74.58%	205.58

注 1：对中能硅业及其关联方的应收账款余额包括对中能硅业、其控股子公司、其联营公司以及与中能硅业受同一控制方控制企业的应收账款的金额；

注 2：对其他的应收账款前五名客户的应收账款余额将同一控制下的企业合并计算。

报告期各期末，公司前五名应收账款余额合计占比分别为 74.58%、78.83% 和 76.17%，应收账款的集中度较高，与公司下游集中度较高的特点匹配。

（5）主要客户信用政策

公司根据客户的综合实力、销售规模、合作时长、历史回款情况等综合评定，

一般会给予 1-3 个月左右的信用期。报告期内，公司主要客户应收账款回款情况良好，不存在大额应收账款无法收回的情况。

（6）同行业可比公司坏账计提情况

报告期各期，与同行业可比公司的坏账计提政策对比如下：

可比公司	计提比例				
	6 个月以内	6-12 个月	1-2 年	2-3 年	3 年以上
沪硅产业	0.57%-1.85%	3.93%-64.34%	100%		
西安奕材	0.5%-1%	5%	100%		
发行人	1.5%	5%	30%	60%	100%

注：数据来源于可比公司定期报告或招股说明书等公开披露文件，下同。

报告期内，公司 99%以上应收账款的账龄集中在 6 个月内，对于 6 个月以内的应收账款坏账计提政策较为谨慎，与同行业公司不存在重大差异。

报告期各期末，公司与可比公司坏账准备计提比例对比如下：

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
沪硅产业	1.74%	1.01%	1.89%
西安奕材	0.55%	0.52%	0.57%
平均值	1.15%	0.77%	1.23%
发行人	1.58%	1.66%	1.61%

报告期内，公司应收账款坏账准备计提比例高于可比公司均值，主要系公司 99%以上应收账款的账龄集中在 6 个月内，公司对 6 个月内坏账计提比例较高所致。

（7）应收账款期后回款情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司报告期各期末应收账款的期后回款率分别为 100.00%、99.97%和 85.50%，期后回款情况良好，不存在较大坏账风险。

5、预付款项

报告期各期末，公司预付款项的情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预付材料款	306.74	963.12	754.16

其他	292.59	294.66	442.60
合计	599.33	1,257.78	1,196.76

报告期各期末，公司预付款项金额分别为 1,196.76 万元、1,257.78 万元和 599.33 万元，主要为预付原材料采购款，其账龄主要在一年以内。

6、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款按款项性质分类情况如下：

单位：万元

款项性质	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
拆迁补偿款	-	-	-
租赁保证金	2,279.58	2,280.08	2,266.00
股权购买保证金	100.00	-	-
关联方及比照关联方拆借款及利息	-	3,011.09	4,921.37
备用金	2.25	-	0.48
应收银行存款利息	216.71	109.87	195.92
其他	131.31	51.85	56.00
小计	2,729.84	5,452.88	7,439.77
减：坏账准备	46.65	37.61	14.23
合计	2,683.19	5,415.27	7,425.54

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 7,425.54 万元、5,415.27 万元和 2,683.19 万元。公司其他应收款项余额主要为租赁保证金和资金拆借款及利息，其中租赁保证金主要系公司与建信金融租赁有限公司于 2022 年 7 月签署融资租赁协议，依合同规定支付保证金 2,250 万元。

报告期各期末，公司其他应收款账龄情况如下：

单位：万元

账龄	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
6 个月以内	391.53	274.98	2,570.37
6-12 个月	4.25	4.16	2,600.91
1-2 年	45.95	2,905.25	2,252.50
2-3 年	19.61	2,252.50	16.00
3 年以上	2,268.50	16.00	-

账龄	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
小计	2,729.84	5,452.88	7,439.77
减：坏账准备	46.65	37.61	14.23
合计	2,683.19	5,415.27	7,425.54

7、存货

（1）存货结构及变动分析

报告期各期末，公司存货具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面价值	比例	账面价值	比例	账面价值	比例
原材料	645.91	1.60%	434.20	1.67%	536.18	2.95%
在产品	14,272.15	35.37%	7,755.90	29.75%	4,192.06	23.03%
半成品	416.35	1.03%	407.56	1.56%	349.68	1.92%
产成品	19,438.38	48.17%	14,354.88	55.07%	10,583.14	58.15%
低值易耗品	5,579.85	13.83%	3,113.50	11.94%	2,539.56	13.95%
合计	40,352.64	100.00%	26,066.05	100.00%	18,200.63	100.00%

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 18,200.63 万元、26,066.05 万元和 40,352.64 万元，主要包括在产品、产成品、低值易耗品等，呈现持续增长趋势。公司作为国内电子级多晶硅龙头，为支撑下游国产半导体硅片产业的快速扩产，通过产线技改和新建产能等方式不断增强供应能力，提升电子级多晶硅产业国产化率，自身产销规模和业绩规模随之上升。公司提升产能和加大备货与下游硅片产业的迅速增长态势相匹配。

此外，公司内蒙产线自 2024 年下半年试生产以来，产能及良率爬坡阶段产出较多电子级多晶硅副产品，公司视市场情况择机出售。

（2）存货跌价准备计提情况

报告期各期末，公司存货跌价准备的计提情况如下：

单位：万元

存货种类	2025 年 1 月 1 日 余额	本年增加金额	本年减少金额	2025 年 12 月 31 日余额
		计提	转销	

原材料	345.54	52.77	-318.31	80.00
在产品	343.87	606.13	-64.37	885.64
低值易耗品	-	124.25	-21.42	102.83
产成品	4,625.97	10,344.11	-4,988.97	9,981.12
合计	5,315.38	11,127.26	-5,393.06	11,049.58
存货种类	2024 年 1 月 1 日 余额	本年增加金额	本年减少金额	2024 年 12 月 31 日余额
		计提	转销	
原材料	309.48	36.06	-	345.54
在产品	-	343.87	-	343.87
产成品	212.47	4,413.50	-	4,625.97
合计	521.95	4,793.44	-	5,315.38
存货种类	2023 年 1 月 1 日 余额	本年增加金额	本年减少金额	2023 年 12 月 31 日余额
		计提	转销	
原材料	300.08	43.58	-34.19	309.48
产成品	-	212.47	-	212.47
合计	300.08	256.05	-34.19	521.95

报告期各期末，公司计提的存货跌价准备余额分别为 521.95 万元、5,315.38 万元和 11,049.58 万元，主要为按成本高于其可变现净值的差额对产成品计提的跌价准备。2024 年末及 2025 年末，公司产成品计提的存货跌价准备金额较高，主要系对副产品计提的跌价准备金额较大。一方面，受副产品太阳能级多晶硅的市场行情低迷影响，徐州产线当期生产的副产品在期末尚未实现销售，同时内蒙产线自试生产后一段期间内的副产品产出率相对较高，导致公司副产品的整体期末余额较大；另一方面，副产品太阳能级多晶硅市场价格仍处于低位，副产品的可变现净值较低。

发行人存货库龄基本在 1 年以内，不存在库龄较长的大额存货。在资产负债表日，公司对存在减值迹象的存货采用成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备。公司存货跌价准备情况已合理反映了存货减值风险。

8、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	2023 年
----	--------	--------	--------

	12月31日	12月31日	12月31日
待抵扣及待认证进项税额	2,205.46	2,583.51	3,770.85
上市服务费	694.34	477.23	368.55
其他	107.59	59.35	86.07
合计	3,007.39	3,120.09	4,225.48

报告期各期末，公司其他流动资产金额分别为 4,225.48 万元、3,120.09 万元和 3,007.39 万元，主要为待抵扣及待认证进项税额和上市服务费。2023 年末，公司其他流动资产余额增长较大，主要系当期内蒙产线建设投入较大，待抵扣及待认证进项税额上升。

（三）非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期股权投资	764.58	0.20%	772.76	0.20%	797.14	0.22%
其他权益工具投资	17,346.74	4.63%	5,268.12	1.35%	281.40	0.08%
固定资产	319,580.54	85.32%	342,359.64	87.59%	116,282.09	31.78%
在建工程	9,333.47	2.49%	18,266.70	4.67%	208,039.03	56.85%
使用权资产	1,551.46	0.41%	1,657.33	0.42%	1,411.22	0.39%
无形资产	19,095.77	5.10%	19,516.04	4.99%	19,711.00	5.39%
长期待摊费用	4,783.22	1.28%	1,521.21	0.39%	1,077.50	0.29%
其他非流动资产	2,114.60	0.56%	1,514.04	0.39%	18,344.59	5.01%
非流动资产合计	374,570.38	100.00%	390,875.83	100.00%	365,943.98	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产以固定资产、在建工程为主，前述两项资产占非流动资产合计比例分别为 88.63%、92.26%和 87.81%，符合重资产业务模式特点。

1、固定资产

（1）固定资产构成及变动情况分析

报告期各期末，公司固定资产构成情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日				
	原值	比例	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	84,268.95	18.96%	8,137.63	-	76,131.32
专用设备	353,283.37	79.50%	113,989.68	-	239,293.70
运输工具	1,123.98	0.25%	622.72	-	501.26
办公设备及其他设备	5,732.06	1.29%	2,077.80	-	3,654.26
合计	444,408.36	100.00%	124,827.83	-	319,580.54
项目	2024 年 12 月 31 日				
	原值	比例	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	83,710.82	19.52%	3,357.84	-	80,352.98
专用设备	339,216.94	79.10%	81,494.42	-	257,722.52
运输工具	960.47	0.22%	480.77	-	479.70
办公设备及其他设备	4,978.55	1.16%	1,174.12	-	3,804.43
合计	428,866.78	100.00%	86,507.14	-	342,359.64
项目	2023 年 12 月 31 日				
	原值	比例	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	14,926.11	8.19%	2,440.66	-	12,485.45
专用设备	164,953.64	90.50%	62,421.77	-	102,531.87
运输工具	732.37	0.40%	378.26	-	354.11
办公设备及其他设备	1,661.42	0.91%	750.76	-	910.66
合计	182,273.54	100.00%	65,991.45	-	116,282.09

报告期内，公司固定资产主要为与经营活动密切相关的专用设备，各期末专用设备的账面价值分别为 102,531.87 万元、257,722.52 万元和 **239,293.70** 万元，占固定资产账面价值总额的比例在 70%以上。2024 年末，固定资产增长较大，主要系内蒙产线转固所致，内蒙产线于 2024 年下半年开始试生产，达到预定可使用状态后于 2024 年底完成转固。2024 年和 2025 年，公司产能及经营规模快速提升，与固定资产的增长趋势相符。

截至 **2025 年 12 月 31 日**，公司涉及抵押的房屋及建筑物账面价值为 **5,783.97** 万元；涉及抵押的机器设备账面价值为 **35,842.13** 万元；公司未办妥产权证书的房屋及建筑物账面价值为 **64,723.79** 万元，主要系内蒙产线完成转固后，部分相关房屋建筑物的产权证书仍在办理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司固定资产成新率情况如下：

单位：万元

项目	折旧年限	原值	累计折旧	净值	成新率
房屋及建筑物	10-20 年	84,268.95	8,137.63	76,131.32	90.34%
专用设备	5-15 年	353,283.37	113,989.68	239,293.70	67.73%
运输工具	3-10 年	1,123.98	622.72	501.26	44.60%
办公设备及其他设备	4-5 年	5,732.06	2,077.80	3,654.26	63.75%
合计		444,408.36	124,827.83	319,580.54	71.91%

截至 2025 年 12 月 31 日，公司固定资产总体成新率为 71.91%，主要机器设备的使用性能良好，公司业务稳健发展，不存在重大减值迹象。

（2）与同行业可比公司的比较

公司主要固定资产的折旧年限与同行业可比公司对比情况如下：

项目	折旧年限		
	沪硅产业	西安奕材	发行人
房屋及建筑物	10-67.5 年	10-50 年	10-20 年
专用设备	3-15 年	5-10 年	5-15 年
运输工具	3-5 年	4 年	4-5 年
办公设备及其他设备	3-10 年	2-5 年	3-10 年

公司固定资产折旧年限与同行业可比公司相比不存在重大差异。

2、在建工程

报告期各期末，公司在建工程及工程物资构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
在建工程	8,268.10	15,098.97	206,071.30
工程物资	1,065.38	3,167.72	1,967.73
合计	9,333.47	18,266.70	208,039.03

报告期内，公司在建工程主要为正在施工但尚未满足固定资产确认条件的生产线建设及改造项目，工程物资主要为购进但尚未安装调试的工程专用设备。报告期各期末，公司在建工程及工程物资的账面价值合计分别为 208,039.03 万元、18,266.70 万元和 9,333.47 万元。

报告期各期末，公司重大在建工程项目余额情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
内蒙电子级多晶硅扩能项目	-	310.22	194,876.15
湖北鑫阳石英砂项目	-	3,127.77	931.85
电子级多晶硅衍生产品的开发与 应用项目	-	2,126.35	1,013.78
电子级多晶硅新型还原炉工艺 项目	-	2,249.94	4,448.06
鑫华半导体供电系统提升项目	1,561.02	2,340.37	-
鑫华半导体供能系统节能改造 升级项目	3,599.77	340.62	-
超高纯净化提纯及回收系统技 改项目	893.55	-	-
其他	2,213.75	4,603.70	4,801.46
合计	8,268.10	15,098.97	206,071.30

2023 年末，公司在建工程余额增长幅度较大，主要系内蒙产线建设投入持续增加所致。2024 年随着内蒙产线完成试生产并转固，2024 年末在建工程金额大幅下降。

报告期内，公司在建工程转入固定资产的情况主要包括内蒙电子级多晶硅扩能项目、15 万吨冷氢化技改提升项目等，主要系公司为扩大产能、提升产线功能、改进工艺等，而建设或购买安装的相关房屋建筑物及机器设备。

报告期内，公司向建设银行呼和浩特赛罕区支行取得专用借款用于内蒙产线建设，上述专用借款产生的利息费用及利息收入的差额在工程建设期间予以资本化。报告期内，资本化金额分别为 653.12 万元、2,412.78 万元和 36.48 万元，资本化率分别为 3.75%、3.67%和 2.88%。

公司在建工程状况良好，不存在长期停工的情形，不存在重大减值迹象。

3、无形资产

报告期各期末，公司无形资产的构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日				
	原值	比例	累计摊销	减值准备	账面价值

土地使用权	18,241.80	78.92%	1,688.84	-	16,552.96
非专利技术	2,220.39	9.61%	1,529.68	-	690.70
软件及其他	2,653.23	11.48%	801.12	-	1,852.11
合计	23,115.41	100.00%	4,019.64	-	19,095.77
项目	2024 年 12 月 31 日				
	原值	比例	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	18,241.80	80.74%	1,224.23	-	17,017.57
非专利技术	2,220.39	9.83%	1,306.52	-	913.86
软件及其他	2,131.28	9.43%	546.68	-	1,584.60
合计	22,593.47	100%	3,077.43	-	19,516.04
项目	2023 年 12 月 31 日				
	原值	比例	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	18,241.80	83.30%	758.58	-	17,483.22
非专利技术	2,220.39	10.14%	1,083.36	-	1,137.02
软件及其他	1,437.68	6.56%	346.92	-	1,090.76
合计	21,899.86	100%	2,188.86	-	19,711.00

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 19,711.00 万元、19,516.04 万元和 19,095.77 万元，公司无形资产主要为土地使用权、非专利技术，其中土地使用权主要系 2023 年公司向中能硅业购买土地。

截至 2025 年 12 月末，公司涉及抵押的土地使用权账面价值为 1,111.75 万元。

4、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 1,411.22 万元、1,657.33 万元和 1,551.46 万元，主要为公司向关联方中能硅业租用房屋及建筑物，作为办公场所、生产场所以及员工公寓等。

5、长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资账面价值分别为 797.14 万元、772.76 万元和 764.58 万元，系对联营企业武汉立膜的投资。

公司于 2023 年 12 月 12 日向武汉立膜科技有限公司新增投资 800 万元，持有其 22.22% 的股权，公司有权提名武汉立膜董事会的一名成员，对武汉立膜的

财务和经营政策有参与决策的权力，因此公司对武汉立膜具有重大影响，采用权益法核算。

6、长期待摊费用

报告期各期末，公司的长期待摊费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
租赁资产改良支出	2,729.37	1,521.21	1,077.50
蒸汽接入费用	2,053.85	-	-
减：减值准备	-	-	-
合计	4,783.22	1,521.21	1,077.50

报告期各期末，公司长期待摊费用金额分别为 1,077.50 万元、1,521.21 万元和 4,783.22 万元，主要为公司租赁资产改良支出与蒸汽接入费用，其中蒸汽接入费用具体情况参见本招股说明书之“第八节、七、（二）、6、（2）、2）与金山桥之间的采购交易”相关内容。

7、其他权益工具投资

报告期各期末，公司其他权益工具投资情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益			
北京深云智合科技有限公司	67.03	268.12	281.40
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	17,279.71	5,000.00	-
合计	17,346.74	5,268.12	281.40

报告期各期末，公司其他权益工具投资余额分别为 281.40 万元、5,268.12 万元和 17,346.74 万元，系公司持有的西安奕斯伟材料科技股份有限公司、北京深云智合科技有限公司股权。

公司于 2024 年 6 月，向西安奕材新增投资 5,000 万元，持有其 0.2074%的股权。公司对西安奕材的投资不具有控制、共同控制或重大影响，将该投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

公司于 2022 年 7 月与硅研新材及北京深云智合科技有限公司签署股权置换协议，将本公司持有的硅研新材全部股权置换为深云智合的股权，2022 年末持有深云智合 1.45% 的股权。股权置换后，公司对深云智合不具有重大影响，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资核算。

西安奕材主营业务系硅片的研发、生产和销售，深云智合主营业务为化学反应计算及技术开发，与公司主营业务存在产业协同性，系公司为长期战略目标持有的非交易性股权投资，计入“其他权益工具投资”核算，以公允价值计量且变动计入其他综合收益，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

8、其他非流动资产

报告期各期末，公司的其他非流动资产的具体构成情况如下：

单位：万元			
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
预付工程及设备款	67.80	514.04	2,810.27
待抵扣进项税	-	-	15,534.32
定期存单	2,046.80	1,000.00	-
减：减值准备	-	-	-
合计	2,114.60	1,514.04	18,344.59

报告期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 18,344.59 万元、1514.04 万元和 2,114.60 万元，主要为预付工程及设备款、待抵扣进项税及购买的大额存单存款。2023 年末，公司其他非流动资产余额增长较大，主要系随着内蒙产线建设持续进行，工程及设备预付款及待抵扣进项税增加所致。2024 年末，随着内蒙产线转固，预付工程及设备预付款及待抵扣进项税同比大幅下降。

（四）主要资产减值准备分析

公司制定了稳健的资产减值准备计提政策，各项减值准备的计提符合目前公司资产的状况。报告期内，公司信用减值损失和资产减值损失发生额合计分别为 343.14 万元、5,079.93 万元和 12,415.53 万元，主要为存货减值损失、固定资产减值损失及应收账款坏账损失。具体请参见本招股说明书之“第六节、八、（七）信用减值损失、资产减值损失分析”相关内容。

十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债分析

1、负债结构及变化情况分析

报告期各期末，公司负债的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	135,554.60	57.84%	141,689.97	56.62%	156,696.98	63.63%
非流动负债	98,825.19	42.16%	108,544.13	43.38%	89,559.02	36.37%
合计	234,379.78	100.00%	250,234.11	100.00%	246,256.00	100.00%

报告期各期末，公司负债合计分别为 246,256.00 万元、250,234.11 万元和 234,379.78 万元。2023 年末，公司负债金额大幅增加，主要原因系随着内蒙产线建设投入持续增加，公司长期借款、其他应付款中的应付工程及设备款等相应增加。

2、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	32,692.57	24.12%	33,450.64	23.61%	33,582.51	21.43%
应付票据	830.77	0.61%	6,900.89	4.87%	21,866.81	13.95%
应付账款	25,018.97	18.46%	14,354.76	10.13%	7,987.34	5.10%
合同负债	46.50	0.03%	29.61	0.02%	27.35	0.02%
应付职工薪酬	7,104.45	5.24%	6,062.31	4.28%	3,589.39	2.29%
应交税费	239.22	0.18%	619.09	0.44%	161.96	0.10%
其他应付款	52,802.53	38.95%	66,878.20	47.20%	80,482.72	51.36%
预计负债	120.99	0.09%	35.17	0.02%	30.60	0.02%
一年内到期的非流动负债	16,695.95	12.32%	13,356.15	9.43%	8,965.22	5.72%
其他流动负债	2.64	0.00%	3.16	0.00%	3.09	0.00%
流动负债合计	135,554.60	100.00%	141,689.97	100.00%	156,696.98	100.00%

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
信用借款	29,797.24	33,253.28	32,890.00
票据贴现借款	2,895.33	197.36	692.51
合计	32,692.57	33,450.64	33,582.51

公司短期借款主要为信用借款，不存在逾期未偿还的短期借款，上述短期借款均用于公司正常经营周转，报告期内随着业务规模增长，资金需求有所增加。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	830.77	6,900.89	21,866.81
合计	830.77	6,900.89	21,866.81

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 21,866.81 万元、6,900.89 万元和 830.77 万元，均为一年内到期的银行承兑汇票。2023 年末，公司应付票据余额增幅较大，主要系本期内蒙产线建设投入持续增加，发行人以票据支付相关款项的金额相应增加。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 7,987.34 万元、14,354.76 万元和 25,018.97 万元，无单项金额重大、账龄超过一年的应付账款。公司应付账款主要为货款，应付账款余额与业务规模变动趋势一致。

（4）合同负债

报告期各期末，公司合同负债余额分别为 27.35 万元、29.61 万元和 46.50 万元，占流动负债的比例较小，主要系公司在履行履约义务前向客户收取的预收货款，该合同的相关收入将在公司履行相应履约义务后进行确认。

（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
短期薪酬	7,082.40	6,062.31	3,589.39
离职后福利—设定提存计划	22.05	-	-
辞退福利	-	-	-
合计	7,104.45	6,062.31	3,589.39

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 3,589.39 万元、6,062.31 万元和 7,104.45 万元，主要为已计提尚未发放的工资、奖金等，与公司业绩变动趋势一致。

（6）应交税费

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 161.96 万元、619.09 万元和 239.22 万元，主要为应交增值税。公司主要税种及税率情况请参见本招股说明书之“第六节、五、主要税种税率和享受的主要税收优惠政策”相关内容。

（7）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付工程及设备款	51,570.03	66,514.59	79,946.63
政府补助	780.00	-	-
其他	452.50	363.61	536.09
合计	52,802.53	66,878.20	80,482.72

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 80,482.72 万元、66,878.20 万元和 52,802.53 万元，主要为应付工程及设备款，随着内蒙产线建设进展波动。

（8）预计负债

报告期各期末，公司其他应付款的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
产品质量保证	112.74	35.17	30.60
亏损合同	8.25	-	-
合计	120.99	35.17	30.60

报告期各期末，公司预计负债的余额分别为 30.60 万元、35.17 万元和 120.99 万元，占流动负债比例较小，主要为针对产品质量保证及亏损合同计提的预计负债。

（9）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	7,071.46	4,072.19	31.68
一年内到期的长期应付款	9,473.83	9,146.72	8,802.49
一年内到期的租赁负债	150.66	137.24	131.05
合计	16,695.95	13,356.15	8,965.22

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为 8,965.22 万元、13,356.15 万元和 16,695.95 万元，主要为一年内到期的长期借款及长期应付款，公司现金储备能够充分覆盖。

（10）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为 3.09 万元、3.16 万元和 2.64 万元，占流动负债比例较小。

3、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	86,504.81	85.00%	85,231.22	78.52%	57,389.29	64.08%
长期应付款	4,764.89	8.09%	15,546.43	14.32%	24,160.60	26.98%
租赁负债	1,629.71	1.61%	1,644.08	1.51%	1,297.89	1.45%

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
递延收益	5,925.78	5.29%	6,122.40	5.64%	6,711.23	7.49%
非流动负债合计	98,825.19	100.00%	108,544.13	100.00%	89,559.02	100.00%

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
保证借款	90,452.18	89,303.41	57,420.97
信用借款	3,124.09	-	-
减：一年内到期的长期借款	7,071.46	4,072.19	31.68
合计	86,504.81	85,231.22	57,389.29

2023 年，公司子公司内蒙古鑫华与中国建设银行呼和浩特分行签订了为期 7 年的固定资产贷款协议，贷款额度为 10 亿元，借款利率为浮动利率。此借款为保证借款，保证人为本公司和天津硅石。

2025 年，公司与中国银行徐州分行签订为期 3 年的固定资产借款合同，借款总金额为 4,000.00 万元，分期提款，借款利率为浮动利率。此借款为信用借款。

（2）长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付融资租赁款	14,238.71	24,693.15	32,963.09
减：一年内到期的长期应付款	9,473.83	9,146.72	8,802.49
合计	4,764.89	15,546.43	24,160.60

2022 年 7 月，公司与建信金融租赁有限公司签订售后回租融资租赁协议，约定本公司将部分设备（以下简称“租赁物”）转让给建信金融租赁有限公司，转让价款为 4.50 亿元，并将租赁物租回，租赁期 5 年，借款利率为浮动利率，报告期各期实际利率分别为 4.73%、4.55%、3.75%和 3.00%；同时公司以部分土地使用权、房屋和设备（以下简称“抵押资产”）作为抵押，公司于租赁期限届

满后取回租赁物的所有权，并同时解除抵押资产的抵押权。上述售后回租交易实质为抵押借款，公司将收到的转让价款作为长期应付款列示。2026 年 1 月，公司与建信金融租赁有限公司签订补充协议，提前终止融资租赁协议，剩余应付款项已于 2026 年 1 月 27 日支付。

（3）租赁负债

报告期各期末，公司因租赁办公场所、生产场所以及员工公寓等产生的一年以上到期的租赁负债金额分别为 1,297.89 万元、1,644.08 万元和 **1,629.71 万元**。

（4）递延收益

报告期各期末，公司递延收益为尚未计入损益的政府补助。与资产相关的政府补助，公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益。报告期各期末，公司递延收益余额分别为 6,711.23 万元、6,122.40 万元和 **5,925.78 万元**，均为与资产相关的政府补助。

（二）报告期内股利分配情况

报告期内，公司不存在股利分配的情形。

（三）报告期内现金流量情况

报告期内，公司现金流量的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动现金流入小计	119,401.60	98,165.24	79,069.67
经营活动现金流出小计	95,008.44	82,860.96	73,320.69
经营活动产生的现金流量净额	24,393.16	15,304.28	5,748.98
投资活动现金流入小计	3,877.61	21,596.50	8,190.05
投资活动现金流出小计	37,218.76	83,834.10	157,850.57
投资活动使用的现金流量净额	-33,341.14	-62,237.60	-149,660.53
筹资活动现金流入小计	53,162.82	71,490.64	236,942.51
筹资活动现金流出小计	51,520.34	48,658.78	37,158.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,642.47	22,831.86	199,783.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-305.11	67.75	-53.31

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-7,610.62	-24,033.71	55,818.81

1、经营活动现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 5,748.98 万元、15,304.28 万元和 **24,393.16 万元**，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	115,480.56	73,340.96	74,706.14
收到的税费返还	198.19	21,642.55	0.02
收到其他与经营活动有关的现金	3,722.86	3,181.73	4,363.51
经营活动现金流入小计	119,401.60	98,165.24	79,069.67
购买商品、接受劳务支付的现金	61,524.46	63,572.49	52,533.50
支付给职工以及为职工支付的现金	23,654.24	14,196.49	15,031.04
支付的各项税费	7,595.84	2,375.59	2,625.61
支付其他与经营活动有关的现金	2,233.90	2,716.39	3,130.54
经营活动现金流出小计	95,008.44	82,860.96	73,320.69
经营活动产生的现金流量净额	24,393.16	15,304.28	5,748.98

报告期内，公司经营活动整体情况良好。其中，2023 年公司经营活动现金流量净额较上年有所下降，主要原因系公司 2023 年销售规模下降导致现金流入减少、备货增加、收到的税费返还减少，且 2022 年光伏市场行情较好，公司电子级副产品收入规模较大导致 2022 年经营活动现金流入较高；2024 年公司经营活动现金流量净额较上年有所上升，主要系公司本期收到较大金额的增值税留抵退税款所致；**2025 年公司经营活动现金流量净额较上年有所上升，主要系公司 2025 年销售规模上升导致现金流入增加所致。**

报告期内，公司经营活动现金流量净额与净利润之间的差异情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	13,973.03	6,228.10	3,633.08
加：资产减值损失	12,255.17	4,793.44	256.05
资产处置损失	-	-20.10	-246.89

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
固定资产报废损失	-	-	110.20
信用减值损失	160.37	286.49	87.09
固定资产折旧	39,635.52	20,696.33	19,203.75
无形资产摊销	942.21	516.91	381.72
长期待摊费用摊销	795.62	672.78	562.60
使用权资产折旧	275.09	242.27	166.49
财务费用	4,573.44	1,568.88	2,048.35
投资损失	8.19	24.38	2.86
公允价值变动收益	-848.02	-	-
股份支付费用	2,093.49	1,853.10	1,859.57
递延所得税资产的增加	-1,797.64	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-25,413.85	-12,786.46	-10,296.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-33,239.16	-34,502.56	-7,420.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,979.69	25,730.73	-4,599.06
经营活动产生的现金流量净额	24,393.16	15,304.28	5,748.98

报告期内，公司净利润与经营活动现金流量净额之间的差异主要系受固定资产折旧、存货跌价准备计提、财务费用、经营性应收及经营性应付等项目的影响。

2023年至2025年公司经营活动产生的现金流量净额均高于净利润，主要原因为：

（1）报告期内公司固定资产投入较大，固定资产折旧较高；（2）报告期内随着业务规模扩张，经营性应收、应付项目金额较大。

2、投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
取得投资收益收到的现金	688.85	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	198.00	1,272.77
收到其他与投资活动有关的现金	3,188.76	21,398.50	6,917.27
投资活动现金流入小计	3,877.61	21,596.50	8,190.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,318.76	77,313.93	126,049.31

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
投资支付的现金	21,800.00	6,000.00	-
取得联营公司支付的现金净额	-	-	800.00
支付的其他与投资活动有关的现金	100.00	520.17	31,001.27
投资活动现金流出小计	37,218.76	83,834.10	157,850.57
投资活动使用的现金流量净额	-33,341.14	-62,237.60	-149,660.53

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-149,660.53 万元、-62,237.60 万元和**-33,341.14 万元**。投资活动产生的现金流出主要为报告期内购建固定资产和其他长期资产支付的现金。

3、筹资活动现金流量

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	12,000.00	4,300.00	144,150.00
取得借款收到的现金	41,162.82	67,190.64	92,792.51
筹资活动现金流入小计	53,162.82	71,490.64	236,942.51
偿付借款支付的现金	46,757.60	43,629.15	32,238.21
偿付利息支付的现金	4,051.01	4,735.09	3,489.99
支付其他与筹资活动有关的现金	711.73	294.54	1,430.64
筹资活动现金流出小计	51,520.34	48,658.78	37,158.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,642.47	22,831.86	199,783.67

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 199,783.67 万元、22,831.86 万元和 **1,642.47 万元**。报告期内，公司筹资活动现金流入包括股权融资、取得借款等，筹资活动现金流出主要为偿还债务、支付利息等。

（四）资本性支出

1、报告期内资本性支出情况

报告期内，随着公司业务规模的发展，固定资产、无形资产和在建工程等项目增加，构成公司资本性支出的主要组成部分。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 126,049.31 万元、77,313.93 万元和 **15,318.76 万元**，主要为经营发展需要而购建的固定资产等，与公司主营业务密切相关。

2、未来其他可预见的重大资本性支出计划

除前述项目外，公司未来可预见的重大资本性支出计划主要为本次公开发行股票募集资金投资项目。本次募集资金投资项目属于公司主营业务范畴，公司不存在跨行业投资的情况。

本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次发行募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项。本次募集资金投资项目详见本招股说明书之“第七节、一、募集资金运用概况”和“第十二节、七、募集资金具体运用情况”。

（五）流动性及偿债能力

1、流动性及偿债能力指标分析

报告期内，公司主要流动性及偿债能力指标如下：

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
流动比率（倍）	1.66	1.32	1.25
速动比率（倍）	1.37	1.14	1.13
资产负债率（合并）	39.05%	43.30%	43.87%
资产负债率（母公司）	25.33%	26.80%	27.56%
息税折旧摊销前利润（万元）	57,419.33	28,466.71	25,034.01
利息保障倍数（倍）	13.19	6.16	7.13

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.25、1.32 和 1.66，速动比率分别为 1.13、1.14 和 1.37，公司流动比率及速动比率均大于 1，短期偿债能力较强。2023 年末流动比率、速动比率较低，主要原因系本期内蒙产线建设投入持续增加，导致公司其他应付款及应付票据增加。

报告期各期末，公司资产负债率(母公司)分别为 27.56%、26.80%和 25.33%。公司资产负债率（母公司）持续下降，主要系公司增资收到股东出资款以及陆续偿还长期银行借款所致。

公司与可比公司偿债能力指标对比情况如下：

指标	公司	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
流动比率(倍)	沪硅产业	1.53	2.38	3.63
	西安奕材	2.24	1.89	1.65
	可比公司平均	1.88	2.14	2.64
	发行人	1.66	1.32	1.25
速动比率(倍)	沪硅产业	1.24	1.98	3.13
	西安奕材	1.82	1.50	1.25
	可比公司平均	1.53	1.74	2.19
	发行人	1.37	1.14	1.13
资产负债率 (母公司)	沪硅产业	13.42%	15.83%	15.70%
	西安奕材	14.86%	27.62%	16.08%
	可比公司平均	14.14%	21.72%	15.89%
	发行人	25.33%	26.80%	27.56%

2023-2025 年，公司流动比率、速动比率低于同行业可比公司平均水平，资产负债率高于同行业可比公司平均水平，主要因为：一方面由于可比公司通过上市取得大额的募集资金，如沪硅产业 2020 年上市，西安奕材 2025 年上市后由于取得大额募集资金，流动比率、速动比率高于发行人；另一方面公司处于快速发展期，生产经营投入较大，公司主要债项为银行借款和与原材料采购、厂房、产线工程建设相关的应付款项。

2、公司不存在流动性已经或可能发生重大变化的情形

截至报告期末，公司货币资金充足，流动比率、速动比率和资产负债率均处于合理水平。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为正，经营活动情况良好。考虑到公司经营规模快速扩大、盈利能力增强，预计未来公司现金流入具有可持续性，公司不存在流动性风险。

3、对持续经营能力产生重大不利影响的因素及管理层的自我评判

（1）对持续经营能力产生重大不利影响的因素

对公司持续经营能力产生重大不利影响的的风险因素主要有市场竞争风险、业绩波动的风险、毛利率波动的风险、原材料价格波动的风险、产品单一风险、技术迭代风险等，具体情况详见本招股说明书之“第三节、风险因素”相关内容。

（2）管理层对持续经营能力的自我评判

公司管理层认为，公司电子级多晶硅产品在国内已经取得了较高市场地位，被国内几乎全部领先的半导体硅片企业验证和采用。公司目前在手订单充足，随着技术水平不断提高和产品性能持续升级，公司产品的市场占有率稳健发展，主要产品具有广阔的市场前景，未来发展计划具有可实现性，不存在对公司持续经营能力产生重大影响的不利因素。

十一、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并

报告期内，公司资本性支出具体情况请参见本招股说明书之“第六节、十、（四）资本性支出”相关内容，公司对外股权投资具体情况请参见本招股说明书之“第四节、四、（二）参股公司”。

除上述事项外，报告期内公司不存在其他重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并。

十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项

（一）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在或有事项。

（三）其他重要事项

有关公司其他重要事项请参见本招股说明书之“第十节 其他重要事项”。

（四）重大担保、诉讼等事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在尚未了结的或可预见的对财务状况、盈利能力及持续经营产生重大影响的重大担保、诉讼等事项。

十三、盈利预测

公司未编制盈利预测报告。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

（一）募集资金运用计划

公司本次拟公开发行不低于 16,507.9366 万股 A 股普通股股票（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），本次公开发行的实际募集资金扣除发行费用后全部用于公司主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运资金。

根据公司发行及上市方案以及公司的实际情况，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	项目备案情况	项目环评情况
1	10,000 吨/年高纯电子级多晶硅产业集群项目	282,832.22	18,000.00	2205-150105-07-05-722098	呼环政批字〔2022〕175 号、内环表〔2023〕202 号
2	1,500 吨/年超高纯多晶硅项目	40,025.46	24,000.00	2502-150105-07-02-815129（注 1）	呼环政批字〔2025〕30 号
3	1,500 吨/年区熔用多晶硅项目	50,870.33	50,000.00	2502-320371-89-02-481283	徐开行环〔2025〕2 号
4	高纯硅材料研发基地项目	20,388.05	20,000.00	2512-320371-89-01-455234、2602-320371-89-03-745251	徐开行环〔2026〕2 号；子项目之二办理中（注 2）
5	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	/	/
合计		414,116.06	132,000.00	/	/

注 1：根据项目建设实际情况对项目具体设备等内容进行了调整，内蒙古鑫华向呼和浩特市赛罕区工业和信息化局进行了变更备案，并于 2026 年 4 月 17 日取得呼和浩特市赛罕区工业和信息化局下发的《变更项目备案告知书》。

注 2：高纯硅材料研发基地项目中子项目之二“半导体级高纯硅材料研发基地项目”预计于 2026 年 5 月取得环评批复。

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行上市实际募集资金（扣除发行费用后）低于募集资金项目投资额，不足部分公司将通过自筹资金解决；若本次募集资金（扣除发行费用后）超过募集资金项目投资额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。

（二）募集资金运用对公司同业竞争和公司独立性的影响

本次募集资金投资项目“10,000 吨/年高纯电子级多晶硅产业集群项目”及“1,500 吨/年超高纯多晶硅项目”由发行人子公司内蒙古鑫华实施，“1,500 吨/年区熔用多晶硅项目”“高纯硅材料研发基地项目”及“补充流动资金”由发行人实施。本次募集资金投资项目的实施不会新增同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

（三）募集资金使用管理制度

公司已制定《募集资金使用管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度。公司将严格按照《募集资金使用管理制度》和证券监督管理部门的相关要求，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司在募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（四）募集资金重点投向科技创新领域的具体安排，与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，聚焦科技创新领域，系基于公司核心技术积累和产业发展趋势，面向国家重大战略需求所规划的重点建设项目。项目内容主要包括现有产线的技术升级、工艺优化及产能扩建，旨在进一步提升公司研发能力、产品质量稳定性、生产效率及规模化供应能力。项目实施后，将有效支撑公司开展系统化、工程化的技术研发，拓展产品在高端半导体制造等领域的应用，强化技术壁垒，巩固并提升公司在电子级多晶硅领域的市场地位。补充流动资金项目则主要用于满足公司业务规模持续扩张带来的营运资金需求，保障原材料采购、研发投入及日常经营的高效运转。

综上，本次募集资金投向与公司主营业务高度相关，与核心技术发展路径一致，符合募集资金应重点投向科技创新领域的要求。

（五）募集资金投资项目实施的必要性和可行性

1、项目实施的必要性

（1）强化关键材料自主可控，保障半导体产业链安全

当前，我国半导体产业持续快速发展，但上游关键基础材料的国产化水平仍有待提升，部分高端硅基材料尚未实现稳定、规模化本土供应，制约了产业链的整体安全与韧性。用于极大规模集成电路制造的 11N 级以上电子级多晶硅，因纯度及杂质控制要求极为严苛，全球仅少数企业具备量产能力，尤其是 13N 级超高纯电子级多晶硅作为国内先进制程半导体制造所需原料，仍严重依赖境外采购；区熔用多晶硅作为高端功率半导体的核心原材料，其晶体完整性与纯度直接影响器件性能与可靠性，亦主要由海外厂商供应。此外，高端电子特气作为晶圆制造过程中不可或缺的工艺气体，国产化率较低；随着集成电路制程不断向更先进节点演进，天然石英材料在金属杂质含量、结构均匀性等方面已难以满足光刻、扩散等关键工艺的洁净度要求，高纯合成石英砂成为支撑前沿制程技术的重要配套材料，国内尚处于产业化初期。

为系统提升我国在上述领域的材料保障能力，公司依托在“硅+高纯”领域的技术积累，正全面推进高纯硅材料、电子特气及高纯石英材料的能力建设：一方面提升超高阻与区熔用多晶硅的工程化水平，支撑先进逻辑芯片与高端功率器件的本土化制造；另一方面基于电子级多晶硅副产氯硅烷资源，开展深度提纯，加速高端电子特气的国产替代进程；同步布局高纯合成石英砂技术开发与产业化。募投项目的实施将显著增强我国半导体上游关键材料的自主可控能力，有效服务国家产业链供应链安全战略。

（2）拓展高端产品矩阵，支撑企业可持续高质量发展

在全球半导体产业格局深刻调整、区域供应链加速重构的背景下，企业需通过技术升级、产品多元化与生态协同构建长期竞争优势。公司立足自身在高纯材料领域的核心能力，实施“巩固基础、突破高端、横向延伸”的发展战略：在持续扩大高纯电子级多晶硅供应规模的同时，重点推进适用于先进制程的超高纯多晶硅及高端功率半导体所需的区熔用多晶硅产业化，精准对接国内晶圆制造产能扩张与技术迭代需求；依托现有硅材料体系的技术协同优势，积极向产业链横向

拓展，利用副产氯硅烷资源开发高端电子特气，并布局高纯合成石英砂等先进制程关键耗材，初步形成覆盖硅基主体材料、工艺气体与石英制品的多元化产品体系。该布局不仅有效拓宽了公司在人工智能、新能源汽车、5G 通信、数据中心等高成长性领域的应用边界，也显著提升了对下游客户的综合配套服务能力。

通过同步加强材料研发、工艺验证与质量管控体系建设，公司可有效缩短新产品在客户产线的导入周期，提升产品一致性、稳定性及交付保障水平，深化与产业链上下游企业的战略合作。募投项目的实施既契合国家关于加快关键基础材料自主化、构建安全高效产业链的政策导向，也为公司打造可持续增长引擎、实现从单一材料供应商向全球领先的半导体材料综合服务商转型升级提供坚实支撑。

2、项目实施的可行性

（1）政策可行性

近年来，国家高度重视半导体产业链安全与关键基础材料自主可控，持续出台一系列支持集成电路及其上游材料产业发展的政策措施，明确将高纯电子级多晶硅、高端电子特气、高纯石英材料等列为战略性新材料，鼓励企业突破核心技术、扩大国产化产能。相关支持涵盖研发引导、产业化扶持、首用验证等多个维度，为本次募集资金投资项目提供了良好的政策环境和可靠的制度保障。

（2）技术可行性

公司自成立以来深耕高纯硅材料领域，已掌握电子级多晶硅大规模生产、超高纯度控制、区熔级晶体生长等核心工艺，具备完整的工程化能力和稳定的质量管控体系。依托长期积累形成的“硅+高纯”技术平台及专业化技术团队，公司在高纯材料制备与过程控制方面具备扎实基础，能够为电子特气、高纯合成石英砂等关联方向的技术开发与产业化提供有效支撑。公司持续的研发投入机制和成熟的项目实施能力，为募投项目的顺利落地提供了可靠保障。

（3）市场可行性

电子级多晶硅是制造集成电路、功率器件等半导体产品的基础原材料，而高端电子特气与高纯石英砂则是晶圆制造过程中不可或缺的关键配套材料。目前，上述高端材料市场集中度高，主要由境外厂商主导，国产供应能力有限。随着国内晶圆厂产能快速释放，以及人工智能、新能源汽车、数据中心等新兴领域对先

进制程和高性能器件的需求持续增长，对全品类高纯硅材料、特种气体及先进石英制品的国产化需求日益迫切。公司募投项目覆盖从主体材料到工艺气体、核心耗材的多元化产品体系，能够有效满足下游客户对供应链安全与本地化配套的诉求，具备明确的市场空间 and 商业化前景。

（六）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响

本次募集资金将围绕高纯硅基材料及其关键配套材料，系统推进产能建设、高端产品突破与核心技术研发，全面支撑公司主营业务的高质量发展。通过 10,000 吨/年电子级多晶硅产线建设，公司总产能将突破 18,000 吨/年，显著缓解国内电子级多晶硅供应紧张的局面；同步实施的 1,500 吨/年超高纯和区熔用多晶硅项目，聚焦超高阻硅料与区熔硅料的国产化，填补 AI 芯片、先进功率器件等前沿应用领域的材料空白。项目投产后，公司将具备全品类电子级多晶硅的量产能力，成为全球少数可覆盖先进制程与高端功率器件全场景需求的企业，持续提升国产替代水平。

与此同时，公司同步建设高纯硅材料研发基地，重点围绕电子特气提纯工艺与高纯合成石英砂制备技术开展系统性研发，构建从原料分析、工艺开发到产品验证的全链条创新能力，为半导体气体材料及先进石英制品的产业化提供关键技术支撑。依托上述布局，公司业务将由高纯硅材料向电子特气、高纯石英等关键配套材料延伸，形成覆盖硅基主体材料、工艺气体与核心耗材的多元化产品体系。

募投项目是公司实现“技术引领—产能驱动—全球竞争”战略升级的核心抓手。通过产能与技术双轮驱动，公司将进一步强化与产业链上下游的协同效应，带动国产设备、耗材供应商集群化发展；在国际化方面，项目将有力支撑公司进入全球主流硅片厂商的供应链体系，推动中国电子级多晶硅及相关高端材料从“国产替代”迈向“全球竞合”，全面提升在全球半导体材料市场的竞争力与影响力。

（七）募集资金运用涉及与他人合作的情况

本次募集资金项目中，10,000 吨/年高纯电子级多晶硅产业集群项目和 1,500 吨/年超高纯多晶硅项目实施主体为内蒙古鑫华，涉及与他人合作的情况，其余项目不涉及与他人合作的情况。

2022年4月，公司召开第二次临时股东大会，决定与TCL科技合资建厂，设立内蒙古鑫华，启动10,000吨/年高纯电子级多晶硅产业集群项目建设。内蒙古鑫华注册资本180,000万元，其中鑫华半导体认缴出资额108,000万元，TCL科技子公司天津硅石认缴出资额72,000万元，双方已按照各自认缴出资比例等比例实缴出资。对于1,500吨/年超高纯多晶硅项目建设，天津硅石承诺：在鑫华半导体根据各阶段投资方案的资金需求对内蒙古鑫华进行增资时，天津硅石将按照与鑫华半导体对内蒙古鑫华增资的同等价格，并依据届时其持有的内蒙古鑫华股权比例，以现金方式同比例投入相应资金，履行同步增资义务。

二、公司战略规划

（一）发展战略规划

公司的发展目标是依靠“硅+高纯”的技术特征，形成互补多元化产品体系，成为全球一流硅基材料供应商。

为实现公司发展目标，公司制定了清晰的发展战略：（一）采取跟随与超越战略，固优补短，成为国内硅基半导体材料技术引领者，为半导体行业提供卓越的研发、产品与服务的系统化解解决方案；（二）立足于公司现有业务，聚焦于硅相关的半导体材料，同时在制造材料和封装材料领域发展，依靠硅+高纯的技术特征，形成互补的多元化产品体系；（三）在科技战略引导下，通过实施水平一体化战略，搭建硅基材料产业链，形成多元化经营模式，最终实现公司业绩增长的目标，回报社会与股东。

（二）为实现战略目标已采取的措施及实施效果

报告期内，公司引入战略、产业及财务投资人，初步完成产业链资源的整合。在各方力量推动下，公司专注于电子级多晶硅的研发和生产，产品关键指标达到国际先进水平。

公司经历了多年的技术研发和工艺探索，掌握了电子级直拉用及区熔用多晶硅的生产技术。公司电子级多晶硅产品已陆续获得了国内主流半导体硅片客户的认证。公司将通过本次募集资金实施电子级多晶硅扩产、高端电子级多晶硅产品的量产，以实现公司收入与业绩的持续增长。

（三）未来规划采取的措施

未来，公司将采取以下措施进一步促进公司发展：

1、积极谋划业务布局，实现多元业务战略组合

聚焦公司核心业务，继续完善电子级多晶硅生产技术，实现在成本和质量上对国际领军企业的超越。在新产品研发、工艺改进等方面持续加大投入，加快关键技术突破，提升超高阻电子级多晶硅和区熔用多晶硅技术水平，攻克硅基电子特气的技术瓶颈，成功完成产品验证，实现规模化生产及销售。积极布局发展新型硅基半导体材料项目，形成多元化的产品系列。

2、整合产业资源，打造产业生态圈

公司将充分利用各方资源，继续专注于直拉用及区熔用电子级多晶硅的生产，实现全球领先、国内标杆的核心产品战略目标。公司将适时成立鑫华产业投资平台及产学研支持平台，整合产业链、地方政府及技术资源，共同实施未来发展项目的孵化，并以资本为纽带，链接上下游产业链资源，培育战略供应商，发展战略客户，共同打造产业生态圈。

3、集成数智平台，支持数智化变革

（1）全面实现工厂数字化

公司将建设全方位智能信息系统管理，实现以 ERP 为核心的运营管理信息平台，通过 BI 系统对各项运营数据分析呈现，辅助决策，持续升级改造 MES、EAM、WMS、NC、APS 等智能管理系统建设，全面打造数字化工厂，实现灵活、全方位的信息互联、实时数据监测，推动公司管理效率的提高。

（2）全面实现工厂自动化和信息化

为贯彻“降本增效”的目标，公司将继续推动生产自动化的建设，实现生产全流程自动化、智能物流应用导入。通过建设完善的数据采集系统，消除信息孤岛，实现信息互联，掌握精准生产信息，推动公司生产效率的提高。

（3）全面实现工厂智能化

公司将在智能生产的基础上，基于大数据分析技术，推动实现经营管理和决策的智能化。通过三维数字化工厂应用拓展，实现生产全流程的可视化，为智能

生产提供交互平台，从而实现智能感知、智能预警、远程调度以及提质降本。

第八节 公司治理与独立性

一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

股份公司设立前，鑫华有限依据《公司法》等法律法规，按照当时有效之《公司章程》等规定规范运作。

公司整体变更设立股份有限公司以来，按照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了由股东会、董事会、高级管理人员等组成的公司治理结构，根据自身和行业特点制订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理制度》等规章制度，构建了相对完善的内控体系，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并能够有效落实、执行上述制度。

股份公司成立以来，公司股东会、董事会、监事会/审计委员会以及经理层均严格按照相关法律、法规和《公司章程》赋予的职权依法独立规范运作，切实履行各自的权利和义务，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制，不存在公司治理缺陷。2025 年 11 月，公司召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其他制度文件的议案》，不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

二、公司内部控制情况

（一）公司管理层对内部控制制度的自我评估意见

公司董事会认为：公司现有内部控制已基本建立健全，能够适应本公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供基础，能够对公司各项业务活动的正常运作及国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行提供有效的监督。公司内部控制制定以来，各项制度得到了有效的实施。于本招股说明书签署日，公司完成了对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制的自我评估，已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制具有固有局限性，故仅能为实现相关目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不适当，或对控制政策和程序遵循

的程度降低，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，以合理保证财务报表的真实准确完整，经营管理的合法合规及资产安全，以及提高公司的经营效率效果，最终促进公司实现发展战略。

（二）注册会计师对发行人内部控制的审计意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具《江苏鑫华半导体科技股份有限公司内部控制审计报告》（毕马威华振审字第 2621642 号），发表如下意见：公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（三）报告期内公司存在的内部控制不规范情形及整改情况

报告期内，发行人存在与原间接股东协鑫集团及其相关方拆借资金的情形，金额合计 7,700 万元。其中 7,300 万元最终使用方为协鑫集团，用于其偿还债务，因此属于关联资金拆借；400 万元使用方为金山桥，用于其生产经营，比照关联资金拆借披露。截至报告期末，该等资金拆借的本金及利息均已结清，利息金额合计 315.95 万元。利息参考同期 LPR 确定，定价公允。发行人已专项整改，建立严格的内控制度，确保不再发生。审计基准日后，发行人未再发生类似情形。

根据《贷款通则》（中国人民银行令〔1996 年 2 号〕）第六十一条规定，企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》（2020 第二次修正）（以下简称“《若干问题》”）第十条规定，法人之间、非法人组织之间以及它们相互之间为生产、经营需要订立的民间借贷合同，除存在民法典第一百四十六条、第一百五十三条、第一百五十四条规定的民事法律行为无效以及《若干问题》第十三条规定的民间借贷合同无效的情形外，当事人主张民间借贷合同有效的，人民法院应予支持。

前述资金拆借行为虽然不符合《贷款通则》的要求，但经清理规范，截至报告期末，上述拆借资金及相应利息均已结清，并未发生损害发行人及其股东利益的情况，且迄今未再发生类似情况。因此，上述发行人资金拆借行为不构成重大违法违规，不存在被处罚情形，均已清理整改完毕，不构成本次公开发行及上市的实质性障碍。

三、报告期内存在的违法违规行及处罚情形

报告期内，发行人子公司内蒙古鑫华存在“未批先建”情形，但未受到行政处罚。由于内蒙古鑫华 2023 年存在建设项目未完成相关审批即开工建设的情形，2023 年 8 月和 2023 年 10 月，呼和浩特市生态环境局和呼和浩特市应急管理局分别出具《不予行政处罚决定书》（呼环罚（赛）〔2023〕5 号）和《不予行政处罚决定书》（（呼）应急不罚〔2023〕WH0002 号）。因上述事项属于初次违法，未造成危害后果且已及时改正，主管机关不予行政处罚。

报告期内，由于生产工艺改进及生产效率提高，发行人徐州产线实际产量曾超过项目备案和环评批复产能。根据徐州市经济技术开发区应急管理局出具的说明，发行人生产装置负荷较改进前未增加，安全性并未降低，上述情形不属于重大违法违规行为。根据第三方检测机构出具的检测报告，发行人主要污染物的排放情况均为达标；另据徐州市生态环境局出具的情况说明及《江苏省企业上市合法合规信息核查报告》，报告期内发行人不存在因违反环保领域法律、法规规章及规范性文件而受到行政处罚的情形。发行人已于 2023 年 3 月完成投资项目备案，对原有项目进行扩建，并于 2023 年 6 月取得环评批复，于 2024 年办理了竣工验收，后续发行人未再出现超产能生产情形。

报告期内公司不存在重大违法违规行为，不存在受到相关主管机关重大处罚，不存在受到监督管理措施、纪律处分及自律监管措施等情况。

四、报告期内资金占用和对外担保的情况

发行人无控股股东或实际控制人。报告期内，发行人存在资金拆借的情况，具体情况请参见本招股说明书之“第八节、二、（三）报告期内公司存在的内部控制不规范情形及整改情况”。

报告期内，公司不存在为合并报表外主体提供担保的情况。

五、直接面向市场独立持续经营情况

公司自整体变更股份有限公司以来，按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，逐步建立健全了规范的公司治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于主要股东及其控制的其他企业，具有独立完整的研发、采

购、生产、销售与服务体系及独立面向市场自主经营的能力。

（一）资产完整情况

发行人系由鑫华有限整体变更设立而来，依法继承了鑫华有限的全部资产，发起人投入的资产已足额到位。截至本招股说明书签署日，发行人具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术等资产的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，不存在持股 5%以上主要股东及其控制的其他企业违规占用发行人资产的情况。

（二）人员独立情况

发行人拥有独立的人事管理制度，公司董事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生和任职。截至本招股说明书签署日，发行人的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在持股 5%以上主要股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，发行人的财务人员未在持股 5%以上主要股东及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立情况

发行人已依据《企业会计准则》等相关法律法规的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。发行人设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，设立了独立的财务账户。截至本招股说明书签署日，发行人不存在与持股 5%以上主要股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（四）机构独立情况

发行人依照《公司法》和《公司章程》的规定设置了股东会、董事会、审计委员会等决策及监督机构，建立了完善的法人治理结构，并根据自身经营特点建立健全了独立完整的组织结构，各机构独立行使经营管理职权。发行人与持股 5%以上主要股东及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

（五）业务独立情况

发行人独立从事业务，具有完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力。发行人的业务独立于持股 5%以上主要股东及其控制的其他企业，与持股 5%以上主要股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

（六）发行人主营业务、控制权、管理团队及核心技术人员稳定情况

发行人的主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近两年内发行人主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均未发生重大不利变化；最近两年，发行人一直处于无实际控制人状况，发行人股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（七）对持续经营有重大影响的事项

发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

六、同业竞争

（一）同业竞争情况说明

公司无控股股东、实际控制人。截至本招股说明书签署日，公司第一大股东合肥国材叁号及其一致行动人中建材新材料基金持股比例合计为 25.55%，第二大股东集成电路基金持有公司 20.62%的股份。

合肥国材叁号为专项投资发行人股权的企业主体，除股权投资外无其他实质业务，与发行人业务无关；其一致行动人中建材新材料基金为已备案登记的私募股权投资基金；集成电路基金系为促进国家集成电路产业发展而设立，主营业务为运用多种形式投资集成电路产业链上下游的企业。合肥国材叁号、中建材新材料基金、集成电路基金主营业务与发行人主营业务不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争承诺函

为防范利益输送、利益冲突，保持鑫华半导体的业务独立性，避免同业竞争未来对鑫华半导体业务造成重大不利影响，维护鑫华半导体利益并保证其长期稳

定发展，合肥国材叁号及中建材新材料基金、集成电路基金、国投创业基金和厦门鼎峰出具了《避免同业竞争的承诺函》。

合肥国材叁号和中建材新材料基金承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业（如有）并未在中国境内或境外直接或间接从事任何与发行人或其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务。

2、自本承诺函出具日起，在本企业直接或间接持有发行人的股份（权益）的期间，本企业（含本企业直接或间接控制的下属企业）将不会通过设立或收购等方式直接或间接取得从事与发行人主营业务构成重大不利影响的同业竞争的企业的企业（以下简称‘竞争企业’）的控制权，或以其他方式拥有竞争企业的控制性股份、控制性股权或控制性权益。

3、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本企业不再是发行人股东；（2）发行人的股票终止在任何证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。”

集成电路基金承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外直接或间接从事任何与发行人或其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务。

2、自本承诺函签署日起，在本企业直接或间接持有发行人的股份（权益）的期间，本企业（含本企业直接或间接控制的下属企业）将不会通过设立或收购等方式直接或间接取得从事与发行人主营业务构成重大不利影响的同业竞争的企业的企业（以下简称‘竞争企业’）的控制权，或以其他方式拥有竞争企业的控制性股份、控制性股权或控制性权益。

3、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本企业不再是发行人股东；（2）发行人的股票终止在任何证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。”

国投创业基金和厦门鼎峰承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外直接或间接从事任何与发行人或其下属企业存在重大不利影响的同业竞争或潜在同业竞争的业务。

2、自本承诺函签署日起，在本企业直接或间接持有发行人的股份（权益）的期间，本企业（含本企业直接或间接控制的下属企业）将不会通过设立或收购等方式直接或间接取得从事与发行人主营业务构成重大不利影响的同业竞争的业务的业务的企业（以下简称‘竞争企业’）的控制权。

3、本承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本企业不再持有发行人 5%以上股份；（2）发行人的股票终止在任何证券交易所上市（但发行人的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。”

七、关联方、关联关系和关联交易**（一）关联方及关联关系**

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，发行人的关联方及关联关系情况如下：

1、直接持有发行人 5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人及其控制的其他法人或组织，间接持有发行人 5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人，直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人及其控制的或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

截至本招股说明书签署日，发行人不存在直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人，直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人及其他组织情况如下：

序号	关联方	关联关系
1	合肥国材叁号	直接持有发行人 24.55%股份
2	集成电路基金	直接持有发行人 20.62%股份
3	国投创业基金	直接持有发行人 5.65%股份
4	厦门鼎峰	直接持有发行人 5.65%股份
5	中建材新材料基金	直接持有发行人 1.00%股份，同时间

序号	关联方	关联关系
		接持有发行人 5%以上股份
6	中建材联合投资有限公司	间接持有发行人 5%以上股份
7	中国建材集团有限公司	间接持有发行人 5%以上股份
8	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	间接持有发行人 5%以上股份
9	杭州毅鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	间接持有发行人 5%以上股份
10	国风投创新投资基金股份有限公司	间接持有发行人 5%以上股份
11	建信信托有限责任公司	间接持有发行人 5%以上股份

截至本招股说明书签署日，直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人、其他组织的一致行动人，直接持有发行人 5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人所直接或间接控制的其他法人或组织，均为发行人关联方。其中报告期内与发行人发生关联交易的企业如下：

序号	关联方	关联关系
1	凯圣氟化学	直接持有发行人 5%以上股份的股东集成电路基金作为并列第一大股东并且持股 26.40%的中巨芯科技股份有限公司之全资子公司
2	浙江博瑞电子科技有限公司	直接持有发行人 5%以上股份的股东集成电路基金作为并列第一大股东并且持股 26.40%的中巨芯科技股份有限公司之全资子公司
3	中国国检测试控股集团股份有限公司	间接持有发行人 5%以上股份的股东中国建材集团有限公司之全资子公司中国建筑材料科学研究总院有限公司持股 64.27%的企业
4	咸阳陶瓷研究设计院有限公司	间接持有发行人 5%以上股份的股东中国建材集团有限公司之全资子公司中国建筑材料科学研究总院有限公司的全资子公司
5	中材高新氮化物陶瓷有限公司	间接持有发行人 5%以上股份的股东中国建材集团有限公司通过中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国建材股份有限公司（3323.HK）等主体控制的企业中材高新材料股份有限公司持股 84.39%的企业
6	连云港中复连众复合材料集团有限公司	间接持有发行人 5%以上股份的股东中国建材集团有限公司控制的企业中材科技股份有限公司（002080.SZ）持股 57.97%的中材科技风电叶片股份有限公司之全资子公司
7	北京中材人工晶体研究院有限公司	间接持有发行人 5%以上股份的股东中国建材集团有限公司通过中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国建材股份有限公司（3323.HK）等主体控制的企业中材高新材料股份有限公司之二级全资子公司

此外，报告期内，曾经直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人、其他组织、自然人也属于发行人关联方，其中主要包括：

序号	关联方	关联关系
1	中能硅业	报告期内曾经直接持有发行人 5%以上股份
2	协鑫科技控股有限公司	报告期内曾经间接持有发行人 5%以上股份
3	协鑫集团	报告期内曾经间接持有发行人 5%以上股份
4	朱共山	报告期内曾经间接控制发行人 5%以上股份

报告期内，曾经直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人、其他组织的一致行动人，曾经直接持有发行人 5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人所直接或间接控制的其他法人或组织，直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人所直接或间接控制的其他法人或组织，均为发行人关联方。其中报告期内与发行人发生关联交易的企业如下：

序号	关联方	关联关系
1	河南协鑫光伏科技有限公司	曾经直接持有发行人 5%以上股份的股东中能硅业之全资子公司
2	协鑫特材	曾经直接持有发行人 5%以上股份的股东中能硅业之全资子公司
3	上海协鑫元工业设计有限公司	曾经直接持有发行人 5%以上股份的股东中能硅业之全资子公司
4	徐州云龙汇商务管理有限公司	曾经直接持有发行人 5%以上股份的股东中能硅业之全资子公司
5	协鑫高科纳米	曾经直接持有发行人 5%以上股份的股东中能硅业之二级全资子公司
6	内蒙古鑫环	曾经直接持有发行人 5%以上股份的股东中能硅业持股 60.00%的企业
7	内蒙古鑫元硅材料科技有限公司	曾经直接持有发行人 5%以上股份的股东中能硅业持股 54.99%的企业
8	协鑫控股	曾经间接控制发行人 5%以上股份的自然人朱共山控制的企业
9	苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	曾经间接控制发行人 5%以上股份的自然人朱共山控制的企业
10	江苏协鑫硅材料	曾经间接控制发行人 5%以上股份的自然人朱共山控制的企业
11	徐州协鑫太阳能材料有限公司	曾经间接控制发行人 5%以上股份的自然人朱共山控制的企业
12	江苏鑫财云信息科技有限公司	曾经间接控制发行人 5%以上股份的自然人朱共山控制的企业
13	新疆协鑫智慧能源服务有限公司	曾经间接控制发行人 5%以上股份的自然人朱共山控制的企业
14	内蒙古协鑫智慧技术服务有限公司	曾经间接控制发行人 5%以上股份的自然人朱共山控制的企业

2、子公司、合营企业及联营企业

报告期内相关企业情况如下：

序号	关联方	关联关系
1	内蒙古鑫华	发行人持有 60.00%股权
2	湖北鑫阳	发行人持有 100.00%股权
3	徐州泛半导体	发行人持有 70.00%股权
4	徐州鑫华销售	发行人持有 100.00%股权
5	鑫华特种气体	发行人持有 100.00%股权
6	扬州鑫华	报告期内，发行人曾持有 100.00%股权， 该公司已于 2024 年 12 月注销
7	武汉立膜	发行人持有 22.22%股权并委派董事

注：徐州泛半导体已于 2025 年 10 月 22 日通过股东会决议，徐州臻心创业投资有限公司通过产权交易所挂牌转让其持有的 30%股份，发行人决议受让该部分股份。**截至 2026 年 3 月 13 日，公司已取得交易所产权交易凭证，并已完成工商变更，变更后发行人持有徐州泛半导体 100%股权。**

上述企业的具体情况详见本招股说明书之“第四节、四、发行人的控股子公司、参股公司及分公司的基本情况”。

3、发行人董事、监事和高级管理人员

发行人董事、报告期内监事和高级管理人员为发行人的关联方。

发行人现任董事和高级管理人员的具体情况详见本招股说明书之“第四节、九、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的情况”。

除发行人现任董事和高级管理人员外，报告期内曾担任过发行人董事、监事、高级管理人员的自然人也为发行人关联方。

4、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人和发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员

报告期初至今直接或间接持有/曾持有发行人 5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员，以及报告期初至今担任/曾担任发行人董事、监事、高级管理人员的自然人关系密切的家庭成员，均为发行人的关联方。关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

5、上述关联自然人直接或者间接控制的或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

发行人现任董事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的法人或其他组织的具体情况请参见本招股说明书之“第四节、九、（二）董事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况”。

发行人现任董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织属于发行人关联方。其中报告期内与发行人发生关联交易的企业如下：

序号	关联方	关联关系
1	江苏华中气体有限公司	副董事长蒋文武关系密切的家庭成员持股 81.52%
2	徐州赫博包装有限公司	副董事长蒋文武关系密切的家庭成员持股 76.41%

报告期初以来曾经直接或间接持有发行人 5%以上股份或任发行人董事、监事、高级管理人员的自然人及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织亦属于发行人关联方。

6、其他关联方

（1）重要子公司的少数股东

2022 年 7 月，发行人与 TCL 科技全资子公司天津硅石签订《增资协议》，同意对内蒙古鑫华进行增资，增资后鑫华半导体持有内蒙古鑫华 60%股权，天津硅石持有内蒙古鑫华 40%股权。内蒙古鑫华为发行人本次募集资金投资项目的实施主体。天津硅石作为发行人重要子公司的少数股东，为发行人关联方。

天津硅石系 TCL 科技控制的企业。发行人将 TCL 科技及其控制的其他企业（包括但不限于 TCL 中环、内蒙古中环领先、天津环睿、天津中环领先、宁夏中环光伏材料有限公司、内蒙古中环光伏材料有限公司等）比照关联方披露，报告期内 TCL 科技控制的 TCL 中环及其下属公司与发行人之间的交易往来比照关联交易披露。

其中，中环领先徐州于报告期初至 2023 年 2 月系曾经间接控制发行人 5%以上股份的股东朱共山之一致行动人有重大影响的企业，于 2023 年 2 月被 TCL

中环收购，成为 TCL 中环的下属公司。报告期内，发行人与中环领先徐州的交易为关联交易。

（2）其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织

发行人的其他关联方还包括根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织等，其中报告期内与发行人发生关联交易的关联方如下：

序号	关联方	关联关系
1	全椒亚格泰电子新材料科技有限公司	张昊玳担任董事的安徽亚格盛电子新材料股份有限公司的全资子公司
2	中环领先徐州	曾为曾经间接控制发行人 5%以上股份的股东朱共山之一致行动人有重大影响的企业
3	金山桥	历史上曾隶属协鑫集团，且报告期内曾向协鑫集团拆出资金，基于谨慎性原则，将其比照发行人关联方
4	科峰电器	历史上曾隶属协鑫集团，且报告期内曾向协鑫集团拆出资金，基于谨慎性原则，将其比照发行人关联方
5	源宝莱	其历史股东、主要人员与发行人原间接股东协鑫集团关系密切，且报告期内曾向协鑫集团拆出资金，基于谨慎性原则，将其比照发行人关联方

除上述关联方外，发行人其他关联方还包括其他根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定认定的关联方。

（二）关联交易

1、关联交易总体情况

根据公司《关联交易管理制度》，公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的交易及与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产千分之一以上（截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计总资产千分之一为 600.21 万元）且超过 300 万元的交易，应当经董事会审议。按照上述标准，将与关联法人发生的成交金额在 500 万元以上的交易，以及与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的交易认定为重大关联交易，或金额虽未达到上述标准但公司认定较为重要的相关事项，从而区分重大关联交易与一般关联交易。

报告期内，公司关联交易总体情况如下表：

单位：万元

关联交易类型	关联交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
重大经常性关联交易	采购商品/接受劳务	23,485.41	18,701.71	22,669.10
	出售商品/提供劳务	25,780.75	16,164.90	12,441.42
	关键管理人员薪酬	2,202.69	2,009.90	1,329.31
重大偶发性关联交易	担保	公司和子公司少数股东天津硅石为发行人子公司内蒙古鑫华长期借款提供担保		
	厂房及土地转让	公司向关联方中能硅业购买厂房及土地		
	资产转让	公司向关联方中能硅业购买电站及配套资产		
	资金拆借	公司与原间接股东协鑫集团及其相关方（包括中能硅业、金山桥、科峰电器、源宝莱）之间的资金拆借，最终使用方为协鑫集团		
	销售商品	-	3,346.90	864.42
一般关联交易	采购商品/接受劳务	827.28	900.51	779.92
	出售商品/提供劳务	279.74	298.64	1.87
	关联租赁-承租	293.47	244.02	238.19
	关联租赁-出租	19.65	8.19	-
	商标许可	协鑫控股和中能硅业授权发行人及内蒙古鑫华免费使用许可商标		
比照关联交易披露的交易	出售商品/提供劳务	41,053.89	24,334.09	21,170.12
	采购商品/接受劳务	5,548.92	8,948.35	8,879.28
	资金拆借	公司与金山桥之间的资金拆借		

2、重大经常性关联交易

（1）向关联方购买商品或接受劳务

报告期各期，公司重大经常性关联采购金额分别为 22,669.10 万元、18,701.71 万元和 23,485.41 万元，占各期营业成本的比重分别为 28.39%、21.73%和 17.46%，具体情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
中能硅业	采购商品/接受劳务	19,586.54	16,019.91	20,891.72
凯圣氟化学	采购商品	1,694.81	2,018.42	1,763.43

关联方	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
内蒙古鑫环	采购商品/ 接受劳务	2, 204. 07	663.38	13.94
合计		23, 485. 41	18,701.71	22,669.10
占营业成本比例		17. 46%	21.73%	28.39%

1) 向中能硅业采购

报告期内，公司向中能硅业采购内容主要为生产所需的原材料、能源及部分公用介质等，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
采购商品	电力	14, 946. 53	12,633.81	14,264.94
	三氯氢硅	1, 452. 99	-	3,384.69
	公用介质及氢气	2, 785. 74	2,755.50	2,468.44
	其他	1. 11	99.12	385.02
接受劳务	检测费、保养费、加工费、住宿费等	400. 17	531.49	388.63
合计		19, 586. 54	16,019.91	20,891.72
占当期营业成本的比例		14. 56%	18.62%	26.17%

①采购电力能源

鑫华有限设立时，主要经营产线为徐州产线，中能硅业以产线设备等固定资产完成对鑫华有限出资，中能硅业注资产线的原始电力设计方案已固定。鑫华有限以中能硅业出资资产为基础，进行技术改造升级后建设而成现有产线。该等产线资产在出资前属于中能硅业自有产线，已建成相应电力配套设施。同时，根据集成电路基金与中能硅业于 2015 年 12 月签署的《江苏中能硅业科技发展有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司关于设立江苏鑫华半导体材料科技有限公司之合资经营合同》（以下简称“《合资经营合同》”）约定：“就合资公司所需用水、用电、蒸汽以及各类工程资源，由中能硅业按照公平合理价格供应，但该等价格不应高于适用于中能硅业的同等价格。”

因此，鉴于原电力设计方案及园区电力平衡要求，整体供电体系无法轻易更改的现实情况以及《合资经营合同》的相关约定，发行人部分生产用电通过中能硅业进行采购，具有合理性及必要性。中能硅业与发行人供电线路设有专用用电

计量装置，每月进行抄表核算，电量分摊机制和分摊比例合理，发行人徐州产线向中能硅业采购电力价格参照中能硅业向国家电网采购的电度用电价格（加成一固定金额容/需量费）确定，采购价格具备公允性。报告期内公司向中能硅业采购电力能源金额占同类采购（能源类采购，包括电力及蒸汽，下同）比例分别为 39.29%、28.08%和 **27.83%**，占比持续下降。

基于供电体系的稳定性、可靠性等考虑，在可预见的未来内，公司仍将持续形成一定规模的上述类型关联采购。

②采购三氯氢硅

综合考虑地理位置较近、购置方便、运输成本和管理成本较低等原因，发行人向中能硅业采购生产所需的原材料三氯氢硅，报告期内采购金额分别为 3,384.69 万元、0 万元和 **1,452.99** 万元。发行人主要通过委托加工方式向中能硅业采购三氯氢硅，2023 年委托加工金额为 3,018.30 万元；2023 年初因发行人三氯氢硅生产线投产初期系统尚不稳定，需要外补少量三氯氢硅，该部分三氯氢硅由发行人向中能硅业直接采购，而非委托加工，采购金额为 366.40 万元。发行人向中能硅业委托加工三氯氢硅根据其加工成本加成合理利润的方式进行结算，向中能硅业直接采购三氯氢硅定价根据市场情况协商确定，定价方式合理、公允。

随着发行人三氯氢硅生产线逐渐达到稳定满产状态，发行人于 2023 年 5 月后已不再委托中能硅业加工三氯氢硅。2025 年 9 月至 11 月，因公司三氯氢硅生产线停产检修，公司临时向中能硅业委托加工少量三氯氢硅，采购金额为 **1,452.99** 万元。报告期内，公司向中能硅业采购三氯氢硅金额占同类采购（材料类采购，包括原材料、公用介质、辅料及备品备件等，下同）金额比例分别为 12.48%、0%和 **3.55%**。

③采购公用介质及氢气

报告期内，公司向中能硅业采购的公用介质主要为氮气等，用于物料系统保护等环节；采购的氢气主要用于还原工序，与已提纯过的三氯氢硅在高效还原炉中经过化学气相沉积生成多晶硅棒。报告期内，公司向中能硅业采购公用介质及氢气占同类采购（材料类采购）比例分别为 9.10%、8.26%和 **6.81%**。

公司向中能硅业采购氢气及公用介质的定价主要参考中能硅业生产成本或

外购价协商确定，不存在输送利益的情形，双方定价具备合理性及公允性。基于采购的便捷性、质量的稳定性等考虑，在可预见的未来，公司仍将持续形成一定规模的上述类型关联采购。

④其他关联采购

公司三氯氢硅生产线在运行过程中，会产生氯元素的耗损，因此公司需要采购一定含氯原材料（主要为四氯化硅）以补充生产系统耗损，未来预计仍可能发生采购。此外，报告期内公司向中能硅业采购少量生产所需的树脂、仪表、压缩机等物资，采购金额整体较小。上述公司向中能硅业采购系考虑地理位置较近、购置运输方便、原材料质量稳定性等原因，定价系根据市场情况协商确定，不存在输送利益的情形，具备合理性及公允性。

2) 向凯圣氟化学采购

凯圣氟化学主要从事电子湿化学品业务。报告期内，公司向凯圣氟化学主要采购氢氟酸、硝酸及盐酸等，用于后处理阶段的酸洗工序，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
采购商品	氢氟酸、硝酸、盐酸等	1,694.81	2,018.42	1,763.43
占当期营业成本的比例		1.26%	2.35%	2.21%

报告期内，公司向凯圣氟化学采购氢氟酸、硝酸、盐酸等产品的价格由双方基于市场公平交易原则协商确定，定价公允，不存在交易价格显失公允的情形。报告期内该等关联采购规模较为稳定，占同类采购比例（材料类采购）分别为6.50%、6.05%和**4.14%**，基于采购的稳定性、可靠性等考虑，在可预见的未来内，公司仍将持续形成一定规模的上述类型关联采购。

3) 向内蒙古鑫环采购

内蒙古鑫环主要从事颗粒硅、气相二氧化硅等产品的生产和销售。报告期内，发行人子公司内蒙古鑫华基于地理位置较近、购置运输方便等原因，主要向内蒙古鑫环采购生产所需的原材料三氯氢硅及部分公用介质，各期采购金额分别为13.94万元、663.38万元和**2,204.07**万元，占各期营业成本的比例分别为0.02%、0.77%和**1.64%**，占同类采购（材料类采购）比例分别为0.05%、1.99%和**5.38%**，

占比整体较低。公司根据内蒙古鑫环三氯氢硅及公用介质的加工成本或外购价进行结算，定价方式合理、具备公允性。在可预见的未来内，公司仍将持续形成一定规模的上述类型关联采购。

（2）向关联方销售商品或提供劳务

报告期各期，公司重大关联销售金额分别为 12,441.42 万元、16,164.90 万元和 **25,780.75** 万元，占公司同期营业收入的比重分别为 13.15%、14.57%和 **14.39%**。报告期内，公司重大经常性关联销售情况如下：

单位：万元

关联方名称	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
上海新昇	出售商品	7,160.84	8,294.66	8,082.05
上海新昇晶睿	出售商品	9,528.29	7,870.24	4,359.37
晋科硅材料	出售商品	9,091.62	-	-
合计		25,780.75	16,164.90	12,441.42
占营业收入比重		14.39%	14.57%	13.15%

1) 向上海新昇、上海新昇晶睿、晋科硅材料销售

上海新昇、上海新昇晶睿及晋科硅材料同属沪硅产业，沪硅产业作为国内半导体硅片头部企业之一，具有稳定的电子级多晶硅材料采购需求，同时公司是目前已经实现电子级多晶硅大规模稳定供应的主要国产供应商，因此公司向上海新昇、上海新昇晶睿及晋科硅材料销售电子级多晶硅产品具备合理性及必要性。报告期内，公司向上海新昇、上海新昇晶睿、晋科硅材料销售电子级多晶硅占同类销售比例（电子级多晶硅产品）分别为 14.50%、15.32%和 **14.88%**，销售价格根据市场价格经双方商业谈判后确定，与非关联第三方交易价格不存在明显差异，关联销售价格具备公允性。受客户需求影响，公司对沪硅产业销售收入逐年增加，预计该关联交易将持续发生。

（3）关键管理人员薪酬

报告期内，发行人关键管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

关联方	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	2,202.69	2,009.90	1,329.31

3、重大偶发性关联交易

（1）关联担保

1）本公司作为担保方

报告期内，公司不存在为其他企业担保的情况。

2）本公司作为被担保方

报告期内，不存在其他企业为公司提供担保的情况。

3）本公司及子公司少数股东作为担保方，子公司作为被担保方

报告期内，公司和子公司少数股东为发行人子公司内蒙古鑫华的长期借款提供担保，具体情况如下：

单位：万元

接受担保方	担保方	担保形式	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已履行完毕
内蒙古鑫华	鑫华半导体	保证担保	100,000.00	2023/5/17	2033/5/17	否
	天津硅石	保证担保				否

注：鑫华半导体与天津硅石于 2023 年 8 月签署保证合同补充协议，双方对主合同项下的债务，以双方在内蒙古鑫华的持股比例（协议签署时双方持股比例为 3:2，持股比例发生变化时，双方可另行签署补充协议重新约定）为准承担按份连带责任保证担保。

2023 年，内蒙古鑫华与建设银行呼和浩特分行签订了为期 7 年的固定资产贷款协议，贷款额度为 10 亿元。此借款为保证借款，保证人为内蒙古鑫华股东鑫华半导体和天津硅石。内蒙古鑫华按照 0.30% 的担保费率向公司及天津硅石计提并支付担保费，2023 年、2024 年和 2025 年计提对天津硅石的担保费金额分别为 21.90 万元、93.13 万元和 106.63 万元。截至报告期末，此借款已放款 9.5 亿元，上述担保尚未履行完毕。

（2）关联方厂房及土地转让

2022 年 8 月，公司与中能硅业签署了《不动产转让协议》，约定发行人受让中能硅业所持坐落于徐州市经济技术开发区杨山路 66 号的部分不动产，其中：房屋建筑面积为 12,992.04 平方米，土地使用权面积为 47,192.61 平方米，转让价格为 3,901.47 万元，转让价格基于第三方评估机构于 2022 年 7 月 1 日出具的《房地产咨询估价报告》。公司已于 2023 年 5 月取得了相应不动产权证书，并于 2023 年 7 月份向中能硅业支付完毕全部转让价款。上述转让主要为进一步增强公司资

产完整性，定价参考第三方评估机构估价结论，具有必要性和公允性。

（3）关联方资产转让

为解决公司供电系统稳定性及降低用电成本，公司与中能硅业于 2024 年 7 月签署资产转让协议，公司向中能硅业购买 110kV 变电站及相关配套资产，公司与中能硅业共同委托江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司对上述交易资产进行评估，评估价值为 4,404.69 万元（不含各项税费），含税转让价款合计 4,977.30 万元。合同转让价款根据评估值确定，具有公允性。上述资产主要用于用电系统升级改造，提升用电系统稳定性，同时通过将用电电压等级从 10kV 提升至 110kV，降低公司用电单位成本，具有必要性。国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司已于 2026 年 1 月 20 日对该升级改造相关设计报告完成评审并出具评审意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已向中能硅业支付 90% 价款。

（4）关联资金拆借

请参见本招股说明书本节之“二、（三）报告期内公司存在的内部控制不规范情形及整改情况”。

（5）向关联方销售商品

报告期内，发行人主要向中能硅业销售三氯氢硅，各期销售金额分别为 864.42 万元、3,346.90 万元和 0 万元。2023 年 12 月，发行人新增对中能硅业的三氯氢硅销售，主要原因系：一方面，随着中能硅业逐步转向颗粒硅的生产，部分棒状硅产线逐步停产，原配套的三氯氢硅产线停产导致其三氯氢硅产能暂时出现部分缺口；另一方面，随着发行人三氯氢硅生产线达到稳定满产状态，存在加工三氯氢硅富余产能，对外销售部分三氯氢硅过剩产能可以帮助发行人降低单位产品的分摊成本。考虑到地理位置较近、购置方便、运输成本和管理成本较低等原因，中能硅业选择从发行人直接采购，因此发行人向中能硅业销售三氯氢硅具备必要性及合理性。报告期内，发行人向中能硅业销售三氯氢硅的定价原则与期初向中能硅业采购三氯氢硅的定价原则均为参考成本确定，具备公允性。

4、一般关联交易

报告期内，发行人发生的一般关联交易情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类型		关联方	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一般经常性关联交易	采购商品与接受劳务	江苏华中气体有限公司	氮气等系统保护性气体	22.94	108.55	54.75
		徐州赫博包装有限公司	包装材料	136.57	221.42	51.70
		徐州云龙汇商务管理有限公司	员工餐厅服务和保洁服务	240.69	229.60	165.36
		江苏鑫财云信息科技有限公司	咨询服务	-	-	9.43
		苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	员工培训服务	29.79	44.22	45.58
		上海协鑫元工业设计有限公司	工业设计服务	104.82	3.77	7.24
		协鑫高科纳米	氯化氢材料	-	68.76	162.56
		江苏协鑫硅材料	材料加工服务	3.04	6.25	2.85
		河南协鑫光伏科技有限公司	方硅芯	-	60.94	-
		宁夏中环光伏材料有限公司	单晶圆棒	-	1.68	-
		新疆协鑫智慧能源服务有限公司	电气技术服务	-	132.17	74.76
		内蒙古协鑫智慧技术服务有限公司	运维服务	106.07	15.94	-
		内蒙古中环光伏材料有限公司	能耗费用	-	-	6.54
		内蒙古鑫元硅材料科技有限公司	硅粉、培训费	129.48	-	10.00
		北京中材人工晶体研究院有限公司	隔热环、绝缘套	34.61	-	-
		中国国检测试控股集团股份有限公司	技术服务	5.66	-	4.72
		咸阳陶瓷研究设计院有限公司	气氛保护炉	-	-	23.89
		中材高新氮化物陶瓷有限公司	氮化硅管、隔热环等	12.09	7.18	-
		协鑫特材	托盘	1.54	-	-
		连云港中复连众复合材料集团有限公司	废气液封槽等	-	-	160.53
		小计		827.28	900.51	779.92
	出售商品与提供劳务	中环领先徐州	检测费	-	-	1.87（注）
		协鑫特材	维保费	10.80	14.81	-
		协鑫高科纳米	维保费	8.88	12.18	-
		浙江博瑞电子科技有限公司	电子特气产品	-	23.58	-

关联交易类型		关联方	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
		徐州协鑫太阳能材料有限公司	涂覆砂	13.42	71.99	-
		徐州立膜科技有限公司	租赁厂房分摊的电费	19.65	-	-
		全椒亚格泰电子新材料科技有限公司	电子特气产品	208.93	176.08	-
		内蒙古鑫环硅能科技有限公司	氢气	18.06	-	-
		小计		279.74	298.64	1.87
	关联租赁-承租	中能硅业	厂房、土地、设备、公寓	293.47	244.02	238.19
	关联租赁-出租	徐州立膜科技有限公司	厂房	19.65	8.19	-
	商标许可	协鑫控股和中能硅业授权发行人及内蒙古鑫华免费使用许可商标				

注：中环领先徐州于 2023 年 2 月被 TCL 中环收购，成为 TCL 中环的下属公司。报告期初至 2023 年 1 月发行人与中环领先徐州的交易为关联交易，2023 年 2 月及之后的交易比照关联交易披露，比照关联交易的详情请参见本招股说明书之“第八节、七、（二）、6、比照关联交易披露的交易”。

（1）采购商品与接受劳务

报告期内，公司一般关联采购内容主要为向江苏华中气体有限公司、徐州赫博包装有限公司、徐州云龙汇商务管理有限公司、苏州鑫之海企业管理咨询有限公司、上海协鑫元工业设计有限公司、协鑫高科纳米、新疆协鑫智慧能源服务有限公司、内蒙古协鑫智慧技术服务有限公司、内蒙古鑫元硅材料科技有限公司、连云港中复连众复合材料集团有限公司等关联方采购日常业务中需要使用的保护气体、包装材料、餐厅服务、员工培训服务、工业设计服务、氯化氢气体、电气技术服务、运维服务、硅粉及培训费、废气液封槽等，系公司与关联方根据业务需要进行，该类关联采购金额较小，主要为公司日常经营所需，交易价格由双方基于市场公平交易原则协商确定，价格公允。

（2）销售商品与提供劳务

报告期内，公司一般关联销售内容主要为向徐州协鑫太阳能材料有限公司、全椒亚格泰电子新材料科技有限公司等关联方销售涂覆砂、电子特气产品等，系公司与关联方根据业务需要进行，该等关联销售合计金额较小，销售价格根据具体产品需求独立谈判、参考市场价格确定，交易具有公允性及合理性。

（3）关联租赁

1）公司作为承租方

报告期内，公司作为承租人，向关联方租赁部分厂房、土地及设备，具体情况如下：

单位：万元

出租方名称	租赁内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
中能硅业	厂房、土地、设备、公寓	293.47	244.02	238.19
合计		293.47	244.02	238.19

报告期内，公司向中能硅业租赁的主要内容为部分厂房、土地、设备和公寓，各期租赁金额较为稳定。中能硅业以生产线出资设立公司时，由于公司后处理生产场地等场所仅涉及部分厂房，无法直接过户给公司，因此采用租赁的形式使用。除厂房租赁外，公司还向中能硅业租赁少量氢气压缩机设备以及员工宿舍，租赁金额较小。综上，公司向中能硅业租赁厂房及土地具有合理性。公司向中能硅业租赁场地价格参考周边同类厂房市场价格协商合理确定，具有公允性。

2）公司作为出租方

报告期内，公司作为出租人，向关联方徐州立膜科技有限公司租赁部分厂房，各期租赁金额分别为 0 万元、8.19 万元和 19.65 万元。武汉立膜于 2024 年 2 月与徐州经济技术开发区管理委员会签订了《阴离子交换膜项目投资协议书》（以下简称“投资协议”），该项目由发行人引进作为徐州泛半导体创新中心项目并参与投资，武汉立膜成立子公司徐州立膜作为项目建设运营主体。投资协议约定由发行人将承租自徐州城投园区管理服务有限公司的部分厂房向其进行转租，租赁价格参照发行人承租价格确认，具备公允性。

（4）商标许可

发行人与协鑫控股和中能硅业于 2022 年 4 月 6 日签署了《商标使用许可协议》，发行人有权在制造和销售许可商标相关产品以及提供许可商标相关服务时使用许可商标，许可商标使用为免费使用，许可期限为 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日，许可期限届满 30 天前双方无异议则自动按年续期，许可方式为普通许可，许可使用的地域为许可商标被许可使用的国家和地区范围。2023 年 5

月 11 日，发行人与协鑫控股和中能硅业签署了《商标使用许可协议》，约定前述 11 项注册商标的许可使用期限为 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日。

内蒙古鑫华与协鑫控股和中能硅业于 2022 年 6 月 20 日签署了《商标使用许可协议》，内蒙古鑫华获授权使用 11 项注册商标，许可商标使用为免费使用，许可使用的期限为 2022 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 30 日止，许可期限届满 30 天前双方无异议则自动按年续期，许可方式为普通许可，许可使用的地域为许可商标被许可使用的国家和地区范围。

上述《商标使用许可协议》到期后未再续签，相关方已确认终止上述商标的法律授权。截至本招股书出具之日，发行人和内蒙古鑫华已不再使用上述注册商标。

5、关联方往来余额

（1）应收关联方款项余额

单位：万元

科目名称	关联方	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	中能硅业	-	-	915.14
	协鑫特材	-	-	3.67
	上海新昇晶睿	2,339.41	4,142.88	2,799.36
	上海新昇	2,916.01	4,262.27	3,936.12
	徐州协鑫太阳能材料有限公司	13.00	14.90	-
	徐州立膜科技有限公司	31.34	8.93	-
	晋科硅材料	1,587.92	-	-
应收账款小计		6,887.67	8,428.98	7,654.28
预付账款	中能硅业	-	-	745.83
预付账款小计		-	-	745.83
其他应收款	中能硅业	-	28.87	28.87
	科峰电器	-	636.57	1,538.79
	金山桥	-	1,929.46	2,951.17
其他应收款小计		-	2,594.90	4,518.84
合计		6,887.67	11,023.88	12,918.95

(2) 应付关联方款项余额

单位：万元

科目名称	关联方	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
应付账款	中能硅业	5,938.68	1,541.61	-
	徐州云龙汇商务管理有限公司	48.37	58.99	25.02
	浙江凯圣氟化学有限公司	974.94	1,533.54	800.59
	徐州赫博包装有限公司	166.94	206.32	16.20
	江苏华中气体有限公司	9.29	95.58	65.54
	上海协鑫元工业设计有限公司	20.00	-	-
	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	-	4.00	-
	协鑫高科纳米新材料（徐州）有限公司	-	-	124.09
	内蒙古鑫环硅能科技有限公司	403.24	36.42	-
	中材高新氮化物陶瓷有限公司	7.15	0.66	0.66
	连云港中复连众复合材料集团有限公司	69.25	-	-
	北京中材人工晶体研究院有限公司	-	6.83	6.83
	内蒙古协鑫智慧技术服务有限公司	33.90	-	-
	应付账款小计	7,671.75	3,483.94	1,038.94
其他应付款	中能硅业	497.73	497.73	-
	徐州云龙汇商务管理有限公司	-	2.99	0.16
	江苏鑫财云信息科技有限公司	9.43	9.43	5.85
	浙江凯圣氟化学有限公司	1.76	1.76	1.50
	徐州赫博包装有限公司	-	1.62	1.62
	江苏华中气体有限公司	0.45	28.76	9.60
	苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	1.70	1.70	5.40
	新疆协鑫智慧能源服务有限公司	-	7.39	62.01
	内蒙古鑫环硅能科技有限公司	-	47.49	14.68
	内蒙古协鑫智慧技术服务有限公司	5.26	16.90	-
	咸阳陶瓷研究设计院有限公司	-	2.70	2.70
	中材高新氮化物陶瓷有限公司	-	7.18	-
	连云港中复连众复合材料集团有限公司	6.58	70.80	75.20
	天津硅石	53.36	56.19	21.90
	北京中材人工晶体研究院有限公司	21.98	31.42	31.42

科目名称	关联方	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	上海协鑫元工业设计有限公司	16.80	-	-
	其他应付款小计	615.06	784.06	232.04
	合计	8,286.81	4,268.00	1,270.98

报告期内，公司应付账款余额主要系对中能硅业的应付三氯氢硅委托加工费和电费以及浙江凯圣氟化学有限公司的后处理酸洗阶段所需的氢氟酸、硝酸及盐酸采购款项等。2025 年末公司对中能硅业的应付账款余额有所增加，主要系对背书转让至中能硅业的票据中截至期末尚未终止确认的部分进行了还原，涉及金额 3,949.32 万元，剔除该影响后，应付账款余额无显著变化。

6、比照关联交易披露的交易

（1）销售商品

报告期各期，公司比照关联交易披露的销售金额分别为 21,170.12 万元、24,334.09 万元和 41,053.89 万元，占公司同期营业收入的比重分别为 22.37%、21.93%和 22.92%。报告期内，公司比照关联交易披露的销售情况如下：

单位：万元

比照关联销售披露的客户名称	交易内容	2025 年度	2024 年度	2023 年度
TCL 中环及其下属公司	出售商品/提供劳务	41,053.89	24,334.09	21,170.12
合计		41,053.89	24,334.09	21,170.12
占营业收入的比例		22.92%	21.93%	22.37%

注：TCL 中环及其下属公司包括中环领先徐州、天津中环领先、内蒙古中环领先、TCL 中环及天津环睿

报告期各期，发行人来自 TCL 中环及其下属公司的销售收入合计分别为 21,170.12 万元、24,334.09 万元和 41,053.89 万元，占发行人营业收入比例分别为 22.37%、21.93%和 22.92%。公司与 TCL 中环及其下属公司之间的交易在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格公允。

（2）购买商品

1) 与科峰电器之间的采购交易

科峰电器系发行人供应商，主要业务为生产、加工电器仪表箱柜等输配电控制设备。报告期内，发行人与科峰电器的采购交易情况如下：

单位：万元

交易主体	交易日期	交易内容	交易金额	交易情况
内蒙古鑫华	2023/3/9	高压开关柜	1,060.18	用于内蒙产线建设，已执行完毕
内蒙古鑫华	2023/5/9	还原炉开关柜	778.76	用于内蒙产线建设，已执行完毕

2) 与金山桥之间的采购交易

金山桥系发行人供应商，主要业务为蒸汽供应。发行人与金山桥的采购交易主要是徐州产线生产用蒸汽，报告期内金额分别为 7,040.34 万元、8,948.35 万元和 5,548.92 万元。报告期内，除采购蒸汽外，发行人与金山桥之间金额较大的采购还包括 2025 年 12 月向其采购长期供热及技术服务，金额为 2,200 万元。

金山桥是发行人所在地区唯一生产用蒸汽供应商，发行人与金山桥之间生产用蒸汽采购交易参照同地区政府指导价格定价，定价公允。

(3) 资金拆借

2023 年 10 月，发行人曾向金山桥拆出资金 400 万元，用于其生产经营。截至报告期末，资金本息均已收回。利息参考同期 LPR 确定，定价公允。

(4) 往来余额

1) 应收款项余额

单位：万元

科目名称	公司名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	TCL 中环及其下属公司	13,079.89	8,165.44	754.13
其他应收款	金山桥	-	416.18	402.53
合计		13,079.89	8,581.61	1,156.66

注：TCL 中环及其下属公司包括中环领先徐州、天津中环领先、内蒙古中环领先、TCL 中环及天津环睿

2) 应付款项余额

单位：万元

科目名称	公司名称	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付账款	金山桥	892.92	724.47	749.61
其他应付款	科峰电器	207.80	207.80	743.20
合计		1,100.72	932.27	1,492.81

（三）报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司发生的关联交易价格按照市场化原则确定，不存在交易价格显失公允的情形。报告期内，关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

（四）关联交易相关决策与治理程序

1、关于关联交易决策程序和权力的规定

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求规范了法人治理结构，并在《公司章程（草案）》中对关联交易的决策权限与程序作出了安排，同时还制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限和审批程序进一步予以明确并严格遵照执行，以保护公司及公司股东利益不因关联交易而受到损害。

2、报告期内关联交易决策情况

公司已建立了完善的公司治理制度，在《公司章程》中，规定了关联股东在股东会审议关联交易时的回避表决制度，并明确了股东会和董事会在关联交易方面的决策权限，以保证公司关联交易的公允性。

除《公司章程》以外，公司制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》等相关制度对关联交易决策权限与程序作了更加详尽的规定，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

根据发行人董事会、股东会决议以及会议记录，发行人的董事会、股东会将对关联交易进行表决时关联董事、关联股东均回避表决。

3、独立董事关于公司报告期内关联交易执行情况的意见

针对发行人报告期内发生的关联交易，发行人独立董事发表独立意见，认为其遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意相关议案内容。

（五）规范关联交易的承诺函

为减少并规范发行人与关联方之间未来可能发生的关联交易，确保公司中小股东利益不受损害，发行人股东合肥国材叁号及中建材新材料基金、集成电路基

金、国投创业基金和厦门鼎峰就规范和减少关联交易作出承诺。

合肥国材叁号及中建材新材料基金、集成电路基金、国投创业基金和厦门鼎峰承诺如下：

“1.在不对发行人及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本企业将采取措施规范并尽量减少与发行人发生关联交易；

2.对于正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本企业将与发行人依法签订规范的交易协议，并配合发行人按照有关法律、法规、规范性文件和届时有效的《江苏鑫华半导体科技股份有限公司章程》的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将基于公允定价的原则实施；

3.本企业将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务；

4.本企业保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润或从事其他损害发行人及股东利益的行为，不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益。”

发行人就规范和减少关联交易作出承诺如下：

“1、对于存在可选择的外部销售和采购交易事项，通过公开招标、竞争性谈判、询价等方式拓展和引进外部客户和供应商，进一步降低关联交易的占比；

2、对于因双方日常经营活动开展而产生且无法避免的关联交易，公司遵循公平、公正原则，参考无关联第三方的交易价格、市场公允价格等进行定价；

3、未来公司将继续严格执行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》等内控制度对关联交易进行管理，严格执行关联交易决策程序、回避制度和信息披露制度，加强独立董事对关联交易的监督，进一步健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益。”

（六）发行人报告期内关联方的变化情况

发行人报告期内的关联方情况请参见本招股说明书之“第八节、七、（一）关联方及关联关系”。

第九节 投资者保护

一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序

根据公司 2025 年第二次临时股东会决议审议通过的《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》，为使公司股东和潜在投资者共享公司发展成果，公司本次发行上市前滚存的未分配利润，由本次发行上市后公司新老股东按其持股比例共享。

二、发行人的股利分配政策

（一）现行股利分配政策

根据《公司章程》，公司的股利分配政策如下：

- 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
- 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
- 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
- 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
- 5、公司违反前款规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
- 6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司第二届董事会第八次会议、2025 年第六次临时股东会审议通过

过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对股东的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

（三）发行后的股利分配政策和决策程序

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》等相关文件要求，公司董事会制定了《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》并经公司董事会、股东会审议通过，《江苏鑫华半导体科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》规定：

1、利润分配的形式

公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。

现金分红方式优先于股票股利方式。

2、利润分配的期限间隔

在符合现金分红条件下，公司原则上每年进行一次现金分红，董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议进行中期现金分红。中期分红的上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

3、现金分红的条件和比例

公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 3,000 万元；公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。

公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营、研究开发所需流动资金等投入。

公司具备现金分红条件，董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因。

4、现金股利和股票股利相结合的分配方式

公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，基本原则如下：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

（4）公司发展阶段属成长期但无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例不得低于 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在当次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

5、利润分配政策的决策程序

公司每年利润分配预案由董事会结合章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。

利润分配政策应提交审计委员会审议,经过半数以上审计委员会委员表决通过方可提交董事会审议。

董事会审议制订利润分配相关政策时,须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议。

股东会对现金分红具体方案进行审议前,董事会应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

股东会审议调整或变更利润分配政策相关议案时,须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

6、公司利润分配政策的调整

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。公司每三年将重新审议一次股东分红回报规划。

公司根据生产经营情况、投资规则和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,应当根据股东（特别是公众投资者）的意见作出适当且必要的修改。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定,不得违反坚持现金分红为主,且在无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下,每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十的基本原则。

利润分配政策的调整需要履行前述“5、利润分配政策的决策程序”及届时公司章程规定的决策程序。

（四）本次发行前后股利分配政策的差异情况

与发行前股利分配政策相比，本次发行后的公司股利分配政策主要根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定制定，更加合理和完善。公司发行上市后的股利分配方式将优先采用现金分红的方式，符合相关要求，更有利于保护投资者的合法利益。同时，公司对股利分配的实施条件，尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了更为详细的规定，并进一步完善了利润分配方案的决策程序和机制，增强了股利分配政策的可操作性。

三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业关于投资者保护的措施

截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的情形，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

公司结合自身业务特点，参考重要性水平，综合考虑总资产、营业收入、净利润等财务指标，确定了不同类别重大合同的标准和依据。截至 2025 年 12 月 31 日，对公司的生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

（一）重大销售合同

重大销售合同的披露标准系参照发行人最近一个会计年度营业收入的 5%确定，即单个合同/订单金额在 8,900 万元以上，或者合同/订单金额虽未超过 8,900 万元，但对公司报告期内经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的主营业务销售合同。

报告期内，发行人与客户签订的已履行或正在履行的重大销售合同的具体情况如下：

序号	客户名称	合同内容	合同类型或金额 (万元，不含税)	签订时间	履行情况
1	申和新材料	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	履行完毕
2	申和新材料	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	履行完毕
3	宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	履行完毕
4	宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	履行完毕
5	宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2025 年	正在履行
6	内蒙古中环领先、中环领先徐州	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	正在履行
7	中环领先徐州	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	履行完毕
8	天津中环领先	电子级多晶硅	框架协议	2024 年	正在履行
9	山东有研半导体材料有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	履行完毕
10	济南科盛	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	履行完毕
11	内蒙古科晟科技有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	履行完毕
12	宁夏中晶半导体材料有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	履行完毕
13	浙江中晶新材料研究有限公司、宁夏中晶半导体材料有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2023 年	履行完毕

序号	客户名称	合同内容	合同类型或金额 (万元, 不含税)	签订时间	履行情况
14	浙江中晶新材料研究有限公司、宁夏中晶半导体材料有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2024 年	履行完毕
15	浙江中晶新材料研究有限公司、宁夏中晶半导体材料有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2025 年	正在履行
16	上海合晶硅材料股份有限公司、郑州合晶硅材料有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	正在履行
17	合晶科技股份有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	正在履行
18	上海新昇	电子级多晶硅	框架协议	2021 年	履行完毕
19	上海新昇、上海新昇晶睿	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	正在履行
20	上海新昇、上海新昇晶睿、晋科硅材料	电子级多晶硅	框架协议	2025 年	正在履行
21	西安奕斯伟硅片技术有限公司、西安欣芯材料科技有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	正在履行
22	西安欣芯材料科技有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2023 年	正在履行
23	西安奕材	电子级多晶硅	框架协议	2025 年	正在履行
24	西安奕材	电子级多晶硅	框架协议	2025 年	正在履行
25	西安欣芯材料科技有限公司	电子级多晶硅	11,860.73	2025 年	正在履行
26	杭州立昂半导体技术有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	履行完毕
27	杭州立昂半导体技术有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2024 年	履行完毕
28	金瑞泓科技（衢州）有限公司、金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司、浙江金瑞泓科技股份有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2025 年	正在履行
29	新美光（苏州）半导体科技有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	履行完毕
30	衢州晶哲电子材料有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2022 年	履行完毕
31	浙江海纳半导体股份有限公司、海纳半导体（山西）有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2023 年	正在履行
32	浙江海纳半导体股份有限公司、海纳半导体（山西）有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2023 年	正在履行
33	JM	电子级多晶硅	框架协议	2023 年	履行完毕
34	四川雅吉芯电子科技有限公司	电子级多晶硅	框架协议	2025 年	正在履行

（二）重大采购合同

重大采购合同的披露标准系参照发行人最近一个会计年度营业成本的 5% 确定，即为单个合同/订单金额在 **6,700** 万元以上，或者合同/订单金额虽未超过 **6,700** 万元，但对公司报告期内经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的采购合同。

报告期内，发行人与供应商签订的已履行或正在履行的重大采购合同的具体情况如下：

序号	供应商名称	合同内容	合同类型或金额 (万元，不含税)	签订时间	履行情况
1	中能硅业	三氯氢硅委托加工	框架协议	2016 年	履行完毕
2	中能硅业	三氯氢硅委托加工	框架协议	2025 年	正在履行
3	中能硅业	公用介质供应	框架协议	2016 年	履行完毕
4	中能硅业	公用介质供应	框架协议	2024 年	正在履行
5	中能硅业	动力能源供应	框架协议	2015 年	履行完毕
6	中能硅业	动力能源供应	框架协议	2024 年	正在履行
7	国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司	采购电力	框架协议	2022 年	正在履行
8	徐州金山桥热电有限公司	采购蒸汽	框架协议	2022 年	履行完毕
9	徐州金山桥热电有限公司	采购蒸汽	框架协议	2024 年	履行完毕
10	徐州金山桥热电有限公司	采购蒸汽	框架协议	2025 年	正在履行
11	凯圣氟化学	UPS 酸	框架协议	2022 年	履行完毕
12	供应商 A	电子级包装袋	框架协议	2022 年	履行完毕
13	山东银丰纳米新材料有限公司	工业硅粉	框架协议	2022 年	履行完毕
14	山东银丰纳米新材料有限公司	工业硅粉	框架协议	2023 年	履行完毕
15	山东银丰纳米新材料有限公司	工业硅粉	8,858.41	2024 年	履行完毕
16	山东银丰纳米新材料有限公司	工业硅粉	框架协议	2024 年	正在履行
17	厦门建发高科有限公司	工业硅粉	框架协议	2023 年	履行完毕
18	北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂	采购蒸汽	框架协议	2023 年	正在履行

序号	供应商名称	合同内容	合同类型或金额 (万元, 不含税)	签订时间	履行情况
19	内蒙古电力（集团） 有限责任公司呼和浩特 供电分公司	采购电力	框架协议	2024 年	正在履行
20	国网江苏综合能源服 务有限公司	采购电力	框架协议	2025 年	正在履行
21	山东银丰纳米新材料 有限公司	工业硅粉	框架协议	2025 年	正在履行

（三）重大借款/授信合同

报告期内，发行人签订的已履行或正在履行的金额在 3,000 万元以上的重大借款/授信合同情况如下：

序号	合同名称	借款方	贷款方/授信方	借款用途	金额 (万元)	借款期限 /授信期限	担保情况	履行 情况
1	人民币流 动资金贷 款合同	鑫华半 导体	中国建设银行股份 有限公司徐州开发 区支行	日常经营周转	3,000.00	2022/05/25- 2023/05/24	无担保	履行 完毕
2	流动资金 借款合同	鑫华半 导体	交通银行股份有限 公司徐州分行	日常经营周转	3,000.00	2022/07/18- 2023/05/27	无担保	履行 完毕
3	流动资金 借款合同	鑫华半 导体	交通银行股份有限 公司徐州分行	日常经营周转	3,000.00	2022/08/19- 2023/05/27	无担保	履行 完毕
4	人民币流 动资金贷 款合同	鑫华半 导体	中国建设银行股份 有限公司徐州开发 区支行	日常经营周转	3,000.00	2022/10/31- 2023/10/30	无担保	履行 完毕
5	综合授信 合同	鑫华半 导体	中国民生银行股份 有限公司徐州分行	日常经营周转	10,000.00	2022/12/30- 2023/12/29	无担保	履行 完毕
6	授信额度 协议	鑫华半 导体	中国银行股份有限 公司徐州分行	日常经营周转	10,000.00	2023/02/14- 2023/11/09	信用担保	履行 完毕
7	授信协议	鑫华半 导体	招商银行股份有限 公司徐州分行	日常经营周转	10,000.00	2023/02/21- 2024/02/20	无担保	履行 完毕
8	流动资金 借款合同	鑫华半 导体	中国银行股份有限 公司徐州分行	采购 原材料	3,500.00	2023/02/17- 2024/02/01	无担保	履行 完毕
9	流动资金 借款合同	鑫华半 导体	中国工商银行股份 有限公司徐州经济 开发区支行	支付货款	3,000.00	2023/03/17- 2024/03/17	无担保	履行 完毕
10	流动资金 借款合同	鑫华半 导体	中国工商银行股份 有限公司徐州经济 开发区支行	支付货款、电费	3,000.00	2023/05/24- 2024/05/23	无担保	履行 完毕
11	人民币流 动资金贷 款合同	鑫华半 导体	中国建设银行股份 有限公司徐州开发 区支行	日常经营周转	3,000.00	2023/10/27- 2024/10/26	无担保	履行 完毕
12	固定资产 贷款合同	内蒙古 鑫华	中国建设银行股份 有限公司呼和浩特 分行	电子级多晶硅 产业集群项目	100,000.00	2023/05/17- 2030/05/17	保证担保	正在 履行
13	综合授信 协议	鑫华半 导体	中国光大银行股份 有限公司徐州分行	日常经营周转	10,000.00	2024/04/15- 2026/04/14	无担保	履行 完毕
14	授信协议	鑫华半 导体	招商银行股份有限 公司徐州分行	日常经营周转	10,000.00	2024/05/07- 2025/05/06	无担保	履行 完毕
15	流动资金 借款合同	鑫华半 导体	中国工商银行徐州 经济开发区支行	支付货款、电费	4,000.00	2024/06/19- 2025/06/18	无担保	履行 完毕
16	流动资金 借款合同	鑫华半 导体	交通银行股份有限 公司徐州分行	日常经营周转	4,000.00	2024/08/27- 2025/06/29	无担保	履行 完毕

序号	合同名称	借款方	贷款方/授信方	借款用途	金额 (万元)	借款期限 /授信期限	担保情况	履行 情况
17	授信额度 协议	鑫华半 导体	中国银行股份有限公司徐州分行	日常经营周转	10,000.00	2024/02/02- 2024/11/12	信用担保	履行 完毕
18	流动资金 借款合同	鑫华半 导体	中国银行股份有限公司徐州分行	支付货款、电费	5,000.00	2024/09/29- 2025/09/30	信用担保	履行 完毕
19	授信业务 总协议	鑫华半 导体	中国银行股份有限公司徐州分行	日常经营周转	8,000.00	2025/02/08- 2026/01/23	无担保	履行 完毕
20	固定资产 借款合同	鑫华半 导体	中国银行股份有限公司徐州分行	供能系统节能 改造升级项目 设备采购	4,000.00	2025/04/29- 2028/04/22	无担保	正在 履行

注：金额系指合同约定的最高可贷款金额。

（四）重大担保合同

报告期内，发行人签订的已履行或正在履行的金额在 2,000 万元以上担保合同情况如下：

单位：万元

序号	债务人	债权人	担保方	担保形式	担保标的	担保金额	担保期限	履行 情况
1	内蒙古 鑫华	中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行	鑫华半导体	保证担保	/	100,000.00	2023/5/17- 2033/5/17	正在 履行
			天津硅石	保证担保	/		2023/5/17- 2033/5/17	正在 履行

2023 年，内蒙古鑫华与建设银行呼和浩特分行签订了为期 7 年的固定资产贷款协议，贷款额度为 10 亿元。此借款为保证借款，保证人为内蒙古鑫华股东鑫华半导体和天津硅石。

（五）融资租赁相关合同

发行人与建信金融租赁有限公司分别于 2022 年 7 月 11 日、2022 年 7 月 29 日签署融资租赁协议，将部分设备转让给建信金融租赁有限公司，并以融资租赁方式回租该部分设备，转让价款合计 4.5 亿元，发行人于租赁期限届满后取回该部分设备的所有权。相关合同具体情况如下：

1、转让合同

序号	转让方	受让方	合同形式	合同标的	转让价款	签署日期	履行 情况
1	鑫华半 导体	建信金融 租赁有限 公司	转让合同	电子级多 晶硅生产 设备	35,000.00 万元	2022/7/29	履行 完毕
2	鑫华半 导体	建信金融 租赁有限 公司	转让合同	电子级多 晶硅生产 设备	10,000.00 万元	2022/7/11	履行 完毕

2、租赁合同

序号	出租人	承租人	合同名称及编号	租金（含税，万元/期）	起租日期	租赁期限	履行情况
1	建信金融租赁有限公司	鑫华半导体	租赁协议 202217310010001810	559.99	2022/7/11	自起租日起算，共计5年（60个月）	履行完毕
2	建信金融租赁有限公司	鑫华半导体	租赁协议 202217310010001839	1,969.87	2022/7/29	自起租日起至编号为202217310010001810的租赁协议项下租赁到期日止	履行完毕

注 1：起租日期为出租人向承租人支付首笔租赁物转让价款之日；

注 2：租金支付期间共计 20 期，每 3 个月为一期。

3、抵押合同

序号	合同名称	担保物	担保期限	主合同	履行情况
1	动产抵押合同	电子级多晶硅生产设备	2022/7/29 至主合同项下承租人的所有债务履行期限届满之日后 3 年止	编号为 202217310010001810 的租赁协议、转让合同及相关协议、文件	履行完毕
2	不动产抵押合同及补充协议	鑫华半导体合法拥有的不动产权证（苏（2022）徐州市不动产权第 0106285 号）上的土地使用权和地上建筑及附着物	2022/7/29-2027/5/20		履行完毕
3	动产抵押合同	电子级多晶硅生产设备	2022/7/29 至主合同项下承租人的所有债务履行期限届满之日后 3 年止	编号为 202217310010001839 的租赁协议、转让合同及相关协议、文件	履行完毕
4	不动产抵押合同及补充协议	鑫华半导体合法拥有的不动产权证（苏（2022）徐州市不动产权第 0106285 号）上的土地使用权和地上建筑及附着物	2022/7/29-2027/5/20		履行完毕

二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保的情况。

三、重大诉讼和仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在尚未了结的对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，发行人无控股股东、无实际控制人，发行人主要股东、控股子公司、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近 3 年不存在涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。

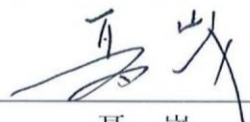
发行人第一大股东报告期内不存在重大违法行为。

第十一节 声明

一、发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：



聂 巍

蒋文武

安 帅

张昊玳

舒 恺

邓志红

李 炜

林爱梅

蒋阳波

石 瑛

许 军

审计委员会委员签字：

林爱梅

石 瑛

许 军

安 帅

舒 恺

全体高级管理人员签字：

田 新

许继海

方世琼

朱 蓬

江苏鑫华半导体科技股份有限公司



第十一节 声明

一、发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

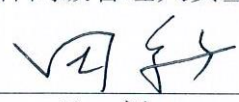
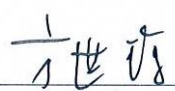
全体董事签字：

_____ 聂 巍	 _____ 蒋文武	_____ 安 帅
_____ 张昊玳	_____ 舒 恺	_____ 邓志红
_____ 李 炜	_____ 林爱梅	_____ 蒋阳波
_____ 石 瑛	_____ 许 军	

审计委员会委员签字：

_____ 林爱梅	_____ 石 瑛	_____ 许 军
_____ 安 帅	_____ 舒 恺	

全体高级管理人员签字：

 _____ 田 新	 _____ 许继海	 _____ 方世琼
 _____ 朱 蓬		

江苏鑫华半导体科技股份有限公司



第十一节 声明

一、发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

_____ 聂 巍	_____ 蒋文武	_____  安 帅
_____ 张昊玳	_____ 舒 恺	_____ 邓志红
_____ 李 炜	_____ 林爱梅	_____ 蒋阳波
_____ 石 瑛	_____ 许 军	

审计委员会委员签字：

_____ 林爱梅	_____ 石 瑛	_____ 许 军
_____  安 帅	_____ 舒 恺	

全体高级管理人员签字：

_____ 田 新	_____ 许继海	_____ 方世琼
_____ 朱 蓬		

江苏鑫华半导体科技股份有限公司



第十一节 声明

一、发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

_____ 聂 崑	_____ 蒋文武	_____ 安 帅
_____ 张昊玳	_____ 舒 恺	_____ 邓志红
_____ 李 炜	_____ 林爱梅	_____ 蒋阳波
_____ 石 瑛	_____ 许 军	

审计委员会委员签字：

_____ 林爱梅	_____ 石 瑛	_____ 许 军
_____ 安 帅	_____ 舒 恺	

全体高级管理人员签字：

_____ 田 新	_____ 许继海	_____ 方世琼
_____ 朱 蓬		

江苏鑫华半导体科技股份有限公司



第十一节 声明

一、发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

_____ 聂 崑	_____ 蒋文武	_____ 安 帅
_____ 张昊玳	_____ 舒 恺	_____ 邓志红
_____ 李 炜	_____ 林爱梅	_____ 蒋阳波
_____ 石 瑛	_____ 许 军	

审计委员会委员签字：

_____ 林爱梅	_____ 石 瑛	_____ 许 军
_____ 安 帅	_____ 舒 恺	

全体高级管理人员签字：

_____ 田 新	_____ 许继海	_____ 方世琼
_____ 朱 蓬		

江苏鑫华半导体科技股份有限公司



第十一节 声明

一、发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

_____ 聂 崑	_____ 蒋文武	_____ 安 帅
_____ 张昊玳	_____ 舒 恺	_____ 邓志红
_____  李 炜	_____ 林爱梅	_____ 蒋阳波
_____ 石 瑛	_____ 许 军	

审计委员会委员签字：

_____ 林爱梅	_____ 石 瑛	_____ 许 军
_____ 安 帅	_____ 舒 恺	

全体高级管理人员签字：

_____ 田 新	_____ 许继海	_____ 方世琼
_____ 朱 蓬		

江苏鑫华半导体科技股份有限公司

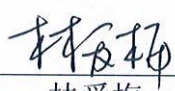


第十一节 声明

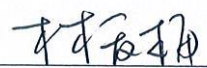
一、发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

_____ 聂 巍	_____ 蒋文武	_____ 安 帅
_____ 张昊玳	_____ 舒 恺	_____ 邓志红
_____ 李 炜	 林爱梅	_____ 蒋阳波
_____ 石 瑛	_____ 许 军	

审计委员会委员签字：

 林爱梅	_____ 石 瑛	_____ 许 军
_____ 安 帅	_____ 舒 恺	

全体高级管理人员签字：

_____ 田 新	_____ 许继海	_____ 方世琼
_____ 朱 蓬		

江苏鑫华半导体科技股份有限公司



第十一节 声明

一、发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

_____ 聂 崑	_____ 蒋文武	_____ 安 帅
_____ 张昊玳	_____ 舒 恺	_____ 邓志红
_____ 李 炜	_____ 林爱梅	_____  蒋阳波
_____ 石 瑛	_____ 许 军	

审计委员会委员签字：

_____ 林爱梅	_____ 石 瑛	_____ 许 军
_____ 安 帅	_____ 舒 恺	

全体高级管理人员签字：

_____ 田 新	_____ 许继海	_____ 方世琼
_____ 朱 蓬		

江苏鑫华半导体科技股份有限公司

2026年5月11日



第十一节 声明

一、发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

_____ 聂 崑	_____ 蒋文武	_____ 安 帅
_____ 张昊玳	_____ 舒 恺	_____ 邓志红
_____ 李 炜	_____ 林爱梅	_____ 蒋阳波
_____  石 瑛	_____ 许 军	

审计委员会委员签字：

_____ 林爱梅	_____  石 瑛	_____ 许 军
_____ 安 帅	_____ 舒 恺	

全体高级管理人员签字：

_____ 田 新	_____ 许继海	_____ 方世琼
_____ 朱 蓬		

江苏鑫华半导体科技股份有限公司



第十一节 声明

一、发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

_____ 聂 巍	_____ 蒋文武	_____ 安 帅
_____ 张昊玳	_____ 舒 恺	_____ 邓志红
_____ 李 炜	_____ 林爱梅	_____ 蒋阳波
_____ 石 瑛	_____  许 军	

审计委员会委员签字：

_____ 林爱梅	_____ 石 瑛	_____  许 军
_____ 安 帅	_____ 舒 恺	

全体高级管理人员签字：

_____ 田 新	_____ 许继海	_____ 方世琼
_____ 朱 蓬		

江苏鑫华半导体科技股份有限公司



二、发行人第一大股东声明

本企业承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

执行事务合伙人（委派代表）：



安 帅

合肥国材叁号企业管理合伙企业（有限合伙）

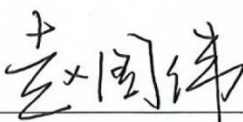


2026 年 5 月 11 日

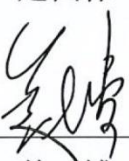
三、保荐人（主承销商）声明

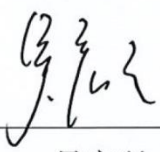
本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：


赵国伟

保荐代表人：


姜 博


吴宏兴

法定代表人（代）：


朱江涛



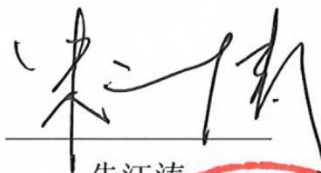
招商证券股份有限公司

2026年5月11日

保荐人（主承销商）法定代表人、总经理声明

本人已认真阅读江苏鑫华半导体科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理、法定代表人（代）、董事长（代）：



朱江涛



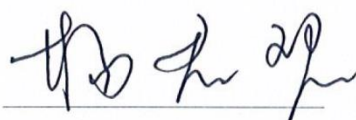
招商证券股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

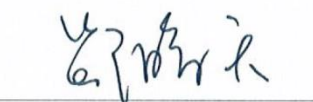
四、律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师：



杨君珺

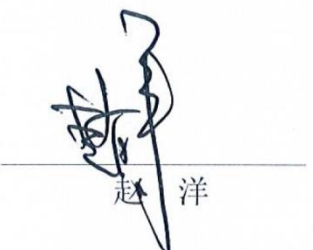


郑晴天



张 燊

律师事务所负责人：



赵 洋



北京市竞天公诚律师事务所

2026年5月11日



毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码：100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读《江苏鑫华半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（“招股说明书”），确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：付强

付强



高林

高林



会计师事务所负责人签名：黄文辉



毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)

2026年 5 月 11 日

六、评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资产评估师（签名）：_____（已离职）
张中华



资产评估机构负责人（签名）：_____
徐峰

A handwritten signature in black ink, appearing to be "徐峰".

上海东洲资产评估有限公司



承担评估业务的资产评估机构关于经办资产评估事项

的签字资产评估师离职的说明

张中华原为本机构员工，现已因个人原因从本机构离职。

张中华在本机构任职期间，曾作为签字资产评估师，为江苏鑫华半导体科技股份有限公司 2022 年发起设立股份公司时截止 2022 年 01 月 31 日的净资产资产进行了评估，并出具了“东洲评报字【2022】第 0389 号”《资产评估报告书》。

特此说明。

资产评估机构负责人：


徐峰


上海东洲资产评估有限公司
2026 年 5 月 11 日



毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码：100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

承担验资业务的机构的声明

本所及签字注册会计师已阅读《江苏鑫华半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（“招股说明书”），确认招股说明书与本所出具的验资报告（报告号为毕马威华振验字第 2200706 号）无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：付强

付强



高林

高林



会计师事务所负责人签名：黄文辉



毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)

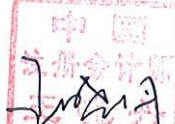
2026年 5 月 11 日

七、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读鑫华半导体招股说明书，确认招股说明书与本所出具的《验资报告》（天衡验字[2022]00069号、天衡验字[2022]00070号）无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的上述验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签名）：


宋福荣
320300010007


王曉丹
3203000100075


董昌秀
3203000100321


顾为勇
320300050021

会计师事务所负责人（签名）：


郭 澳

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2016年5月11日





毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码：100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

承担验资复核业务的机构的声明

本所及签字注册会计师已阅读《江苏鑫华半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（“招股说明书”），确认招股说明书与本所出具的验资复核报告（报告号为毕马威华振验字第 2201107 号）无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：付强



高林



会计师事务所负责人签名：黄文辉



毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)

2026 年 5 月 11 日

第十二节 附件

一、本招股说明书附件

- （一）发行保荐书；
- （二）上市保荐书；
- （三）法律意见书；
- （四）财务报告及审计报告；
- （五）公司章程（草案）；
- （六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；
- （七）与投资者保护相关的承诺；
- （八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；
- （九）内部控制审计报告；
- （十）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （十一）股东会、董事会、监事会/审计委员会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；
- （十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；
- （十三）募集资金具体运用情况；
- （十四）子公司、参股公司简要情况；
- （十五）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间及地点

查阅时间：工作日的上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00

查阅地点：公司及保荐机构（主承销商）的住所

除以上查阅地点外，投资者可以登录证监会和证券交易所指定网站，查阅《招

股说明书》正文及相关附录。

三、与投资者保护相关的承诺

（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

1、合肥国材叁号和中建材新材料基金关于股份锁定及减持意向的承诺

“一、本企业持有的发行人的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本企业所持发行人的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

二、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份（包括该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积转增等，以下简称‘首发前股份’），也不提议由发行人回购该部分股份。

三、发行人上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行人本次发行上市时的股票发行价（以下简称‘发行人股票发行价’），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人股票发行价（若发行人在本次发行上市后 6 个月内发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权、除息事项的，收盘价格按照监管规则的规定作相应调整），本企业直接或间接持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。

四、发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本企业届时所持股份锁定期限 **12 个月**；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 **12 个月**；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本企业届时所持股份锁定期限 **12 个月**。（‘届时所持股份’是指本企业上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份）

五、如发行人发生《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市并摘牌前，本企业将不会减持发行人股

份。

六、本企业将严格遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定。

七、本企业将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本企业直接或间接持有的首发前股份。本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将综合考虑稳定发行人股价、资本运作、长远发展等因素并根据自身需要审慎制定股票减持计划，通过证券交易所以协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式进行。

八、本企业所持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行人股票发行价（若发行人在本次发行上市后至本企业减持期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格按照监管规则的规定作相应调整）。

九、本企业将依据相关监管规则的要求及时报告本企业持有的发行人股份及其变动情况，以及拟变动计划。

十、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。

十一、如果本企业未履行上述承诺减持发行人股份的，则本企业承诺依据法律法规及相关监管规则的要求承担责任。”

2、集成电路基金关于股份锁定及减持意向的承诺

“一、本企业持有的发行人的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本企业所持发行人的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

二、自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份（包括该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积转增等，以下简称‘首发前股份’），也不提议由发

行人回购该部分股份。

三、本企业将严格遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定。

四、本企业将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本企业直接或间接持有的首发前股份。本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将综合考虑稳定发行人股价、资本运作、长远发展等因素并根据自身需要审慎制定股票减持计划，通过证券交易所以协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式进行。

五、本企业将及时向发行人报告本企业持有的发行人股份及其变动情况，以及拟变动计划。

六、如果相关监管规则不再对上述某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。

七、如果本企业未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业自行承担。

八、截至本承诺函出具之日，本企业无在发行人上市后取得发行人控制权的计划，且自发行人股票上市之日起36个月内不主动谋求对发行人的控制权。”

3、国投创业基金和厦门鼎峰关于股份锁定及减持意向的承诺

“一、本企业持有的发行人的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本企业所持发行人的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

二、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份（包括该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积转增等，以下简称‘首发前股份’），也不提议由发行人回购该部分股份。

三、本企业将严格遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定。

四、本企业将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本企业直接或间接持有的首发前股份。本企业在锁定期届满后减持首发前股份的，将综合考虑稳定发行人股价、资本运作、长远发展等因素并根据自身需要审慎制定股票减持计划，通过证券交易所协议转让、大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式进行。

五、本企业所持有的发行人股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于法律法规等相关规定允许的最低价。

六、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。

七、截至本承诺函出具之日，本企业无在发行人上市后取得发行人控制权的计划，且自发行人股票上市之日起36个月内不主动谋求对发行人的控制权。

八、如以上承诺被证明不真实或未被遵守，本企业将依法承担相应责任。”

4、鑫之志、鑫之同、鑫之道、鑫之源、鑫之合关于股份锁定及减持意向的承诺

“一、本企业持有的发行人的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本企业所持发行人的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

二、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份（包括该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积转增等），也不提议由发行人回购该部分股份。

三、本企业将严格遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定。

四、如果本企业未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业自行承担。”

5、科创新兴、华舆转型、青岛融源关于股份锁定及减持意向的承诺

“一、本企业持有的发行人的股份不存在权属不清晰或存在潜在纠纷的情形，不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

二、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份（包括该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积转增等），也不提议由发行人回购该部分股份。

三、本企业将严格遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定。

四、如果本企业未履行上述承诺减持发行人股份的，由此导致的全部损失及法律后果由本企业自行承担。”

6、其他股东关于股份锁定及减持意向的承诺

“一、本企业持有的发行人的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本企业所持发行人的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

二、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份（包括该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积转增等），也不提议由发行人回购该部分股份。

三、本企业将严格遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定。

四、如果本企业未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业自行承担。”

7、持有发行人股份的公司董事、高级管理人员（蒋文武、田新、许继海、方世琼）关于股份锁定及减持意向的承诺

“一、本人持有的发行人的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所持发行人的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

二、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人本次发行上市前已发行的股份（包括该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积转增等，以下简称‘首发前股份’），也不提议由发行人回购该部分股份。

三、上述股份锁定期届满后，本人在发行人任职期间，每年转让股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；本人若自发行人离职，则离职 6 个月内将不得以任何方式转让本人持有的发行人股份；本人若在任期届满前自发行人离职，则在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。

四、发行人上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行人本次发行上市时的股票发行价（以下简称‘发行人股票发行价’），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人股票发行价（若发行人在本次发行上市后 6 个月内发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权、除息事项的，收盘价格按照监管规则的规定作相应调整），本人持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。

五、本人将严格遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定。

六、本人通过员工持股平台间接持有的发行人股份将同时遵守员工持股平台的股份锁定及减持承诺。

七、本人持有的首发前股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行人股票发行价（若发行人在本次发行上市后至本人减持期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权、除息事项的，减持价格按照监管规则的

规定作相应调整）。

八、上述第三、四、五、六、七项承诺不因本人在发行人职务变更、离职等原因而放弃履行。

九、本人将及时向发行人申报本人持有的发行人股份数量及变动情况；本人持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守法律法规和规范性文件及发行人相关管理制度的规定。

十、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。

十一、如果本人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。”

8、持有发行人股份的公司核心技术人员（蒋文武、田新、李明峰、江宏富、吴锋）关于股份锁定及减持意向的承诺

“一、本人持有的发行人的股份不存在委托持股、信托持股或其他可能导致本人所持发行人的股份权属不清晰或存在潜在纠纷的情形；不存在任何质押、冻结、查封等权利受到限制的情形。

二、自发行人股票上市之日起 12 个月内，或本人自发行人离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行上市前已发行的股份（包括该部分股份派生的股份，如送红股、资本公积转增等，以下简称‘首发前股份’），也不提议由发行人回购该部分股份。

三、作为发行人的核心技术人员，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过本人所持首发前股份总数的 25%，减持比例可累积使用。

四、本人将严格遵守中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定。

五、本人通过员工持股平台间接持有的发行人股份将同时遵守员工持股平台的股份锁定及减持承诺。

六、本人将及时向发行人申报本人直接或间接持有的发行人股份数量及变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守法律法规和规范性文件及发行人相关管理制度的规定。

七、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。

八、同时兼任发行人董事和/或高级管理人员的核心技术人员须同时遵守其作为发行人董事和/或高级管理人员应履行的股份锁定和减持承诺。

九、如果本人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本人自行承担。”

（二）稳定股价的措施和承诺

1、发行人关于稳定股价的预案及相应约束措施

发行人制订了《关于江苏鑫华半导体科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施》，并由公司 2025 年第六次临时股东会审议通过。

“一、启动和停止股价稳定措施的条件

（一）启动条件：如果公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上交所科创板上市（以下简称“本次发行上市”）后三年内股价出现连续 20 个交易日收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，如果公司股票发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息事项或者因其他原因导致公司净资产或股份总数发生变化的，则相关的计算对比方法按照上交所的有关规定或者其他适用的规定做调整处理，下同）的情况时，公司将启动以下稳定股价预案，其中公司回购股票为第一顺位，在公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员增持股票为第二顺位。

（二）停止条件：在以下稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 5 个交易日收盘价均高于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，或者相关增持或者回购资金使用完毕，或继续增持/回购/买入公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件，将停止实施股价稳定措施。

二、稳定股价的措施

（一）公司稳定股价的措施

当触发上述股价稳定措施的启动条件时，在确保公司股权分布符合上市条件以及不影响公司正常生产经营的前提下，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后，向社会公众股东回购股份。

公司应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内召开董事会审议公司回购股份的议案，该等董事会决议须经公司董事会全体董事二分之一以上表决通过，并在董事会做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、有关议案及召开股东会的通知。回购股份的议案应包括回购股份的价格或价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例，回购股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息。公司股东会对回购股份的议案做出决议，须经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过，公司主要股东（持股 5%以上股东）承诺就该等回购事宜在股东会中投赞成票。公司应在股东会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

公司为稳定股价之目的通过回购股份议案的，回购公司股份的数量或金额应当符合以下条件：

1、单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于公司股东净利润的 10%，但不高于上一个会计年度经审计的归属于公司股东净利润的 20%；

2、同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于公司股东净利润的 50%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价

预案。

（二）负有增持义务的董事、高级管理人员稳定股价的措施

当公司启动股价稳定措施后，公司股票连续 20 个交易日的收盘均价仍低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，在公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外，下同，下称‘负有增持义务的董事’）、高级管理人员应启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：

1、负有增持义务的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持，并承诺就公司稳定股价方案以其董事身份（如有）在董事会上投赞成票，并在股东会上以所拥有的全部表决票数（如有）投赞成票。

2、上述负有增持义务的董事、高级管理人员应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，就其是否有增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司公告。如有具体计划，应包括增持股份的价格或价格区间、定价原则，拟增持股份的种类、数量及占总股本的比例，增持股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息。该等董事、高级管理人员应在稳定股价方案公告后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。

3、上述负有增持义务的董事、高级管理人员为稳定股价之目的增持公司股份的，增持公司股份的数量或金额应当符合以下条件：

自上述股价稳定措施启动条件成就之日起一个会计年度内，上述负有增持义务的董事、高级管理人员增持公司股票的金额不低于其上年度从发行人处领取的现金分红（如有）、薪酬和津贴合计金额的 30%，增持股份数量不超过发行人股份总数的 1%。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

4、在本预案有效期内，新聘任的符合上述条件的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定。公司及公司主要

股东、现有董事、高级管理人员应当促成新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案，并在其获得书面提名前签署相关承诺。

（三）主要股东稳定股价的措施

1、公司第一大股东合肥国材叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称‘合肥国材叁号’）及其一致行动人的承诺

若公司股价多次触发《上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施》需采取股价稳定措施条件的，公司、在公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员将继续按照《上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施》执行，在稳定公司股价的具体措施被提交公司股东会审议时，合肥国材叁号及其一致行动人应在符合相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要求的前提下，在股东会中投赞成票，并尽力促使股东会审议通过该等稳定股价的措施。

2、公司其他持股 5%以上股东（包括集成电路基金、国投创业基金和厦门鼎峰）的承诺

若公司股价多次触发《上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施》需采取股价稳定措施条件的，公司、负有增持义务的董事和高级管理人员将继续按照《上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施》执行，在稳定公司股价的具体措施被提交公司股东会审议时，公司其他持股 5%以上股东应在符合相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要求的前提下，在股东会中投赞成票，并尽力促使股东会审议通过该等稳定股价的措施。

（四）其他稳定股价的措施

根据届时有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，在履行相关法定程序后，公司及有关方可以采用法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他稳定股价的措施。

（五）稳定股价措施的其他相关事项

1、除因继承、被强制执行或公司重组等情形必须转股或触发上述股价稳定措施的启动条件外，在股东会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，上述有增持义务的人员不转让其持有的公司股份；除经股东会非关联股东同意外，不由公

司回购其持有的股份。

2、触发上述股价稳定措施的启动条件时，上述负有增持义务的董事、高级管理人员，不因在稳定股价具体方案实施期间内职务变更、离职等情形（因任期届满未连选连任或被调职等非主观原因除外）而拒绝实施上述稳定股价的措施。

三、约束措施

（一）公司未履行稳定股价承诺的约束措施

如公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

（二）负有增持义务的董事、高级管理人员未履行稳定股价承诺的约束措施

如上述负有增持义务的董事、高级管理人员未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，应调减或停发薪酬或津贴，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。”

2、合肥国材叁号及中建材新材料基金关于稳定股价的措施和承诺

“若公司股价多次触发《上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施》需采取股价稳定措施条件的，公司、在公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员将继续按照《上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施》执行，在稳定公司股价的具体措施被提交公司股东会审议时，本企业应在符合相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要求的前提下，在股东会中投赞成票，并尽力促使股东会审议通过该等稳定股价的措施。”

3、集成电路基金、国投创业基金、厦门鼎峰关于稳定股价的措施和承诺

“若公司股价多次触发《上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施》需采

取股价稳定措施条件的，公司、在公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员将继续按照《上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施》执行，在稳定公司股价的具体措施被提交公司股东会审议时，本企业应在符合相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要求的前提下，在股东会中投赞成票，并尽力促使股东会审议通过该等稳定股价的措施。”

（三）股份回购和股份买回的措施和承诺

具体承诺内容请参见本附件之“（四）对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺”相关内容。

（四）对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺

1、发行人关于欺诈发行上市的股份购回承诺

“本公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司首发上市公开发行的全部新股。”

2、发行人股东合肥国材叁号和中建材新材料基金关于欺诈发行上市的股份购回承诺

“公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内督促公司启动股份购回程序，促使公司购回公司首发上市公开发行的全部新股，本企业将购回本企业已转让的原限售股份（如有）。 ”

3、发行人股东集成电路基金关于欺诈发行上市的股份购回承诺

“公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内督促公司启动股份购回程序，极力促使公司购回公司首发上市公开发行的全部新股，本企业将购回本企业已转让的原限售股份（如有）。 ”

4、发行人股东国投创业基金关于欺诈发行上市的股份购回承诺

“公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内督促公司启动股份购回程序，极力促使公司购回公司首发上市公开发行的全部新股。”

（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

“一、公司将采取的填补措施和承诺

本公司承诺将通过如下方式努力提升经营水平，增加未来收益，以填补被摊薄的即期回报：

1、迅速提升公司整体实力，扩大公司业务规模

本公司首发上市完成后，本公司的总资产将得到进一步提升，抗风险能力和综合实力明显增强，市场价值明显提升。本公司将借助资本市场和良好的发展机遇，不断拓展主营业务规模，充分发挥本公司在电子级多晶硅产业的优势地位，推动本公司持续、健康、稳定发展。

2、加快募投项目实施进度，加强募集资金管理

本次募投项目均围绕本公司主营业务展开，有利于提升本公司的综合竞争力和盈利能力。本次发行募集资金到位后，本公司将加快推进募投项目实施进度，尽快实现预期收益。同时，本公司将根据《公司章程（草案）》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途实现收益。

3、完善利润分配政策，强化投资者回报

本公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定要求，结合本公司实际情况，为明确对本公司股东权益分红的回报，进一步细化了《公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，并制定了《江苏鑫华半导体科技股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》。本公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投资回报机制。

二、公司全体董事和高级管理人员的承诺

公司全体董事和高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

（4）由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）若公司后续推出股权激励政策，则行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）本人承诺，若中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期回报相关规定，则本人承诺将按照新规要求出具补充承诺，并积极推进公司制定新的填补措施。

（7）若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将接受中国证监会和上海证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；违反承诺给公司或股东造成损失的，将按照有权机关的生效裁判依法承担补偿责任。”

（六）利润分配政策的承诺

“一、公司制定本规划考虑的因素

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，根据公司利润和现金流量状况、生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

二、本规划的制定原则

公司股东回报规划制定的原则是结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考

虑和听取股东（特别是中小股东）的意见，实行持续、稳定的利润分配政策。

三、公司未来三年的分红回报规划具体情况

1、利润分配的形式

公司股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。

现金分红方式优先于股票股利方式。

2、利润分配的期限间隔

在符合现金分红条件下，公司原则上每年进行一次现金分红，董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议进行中期现金分红。中期分红的上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

3、现金分红的条件和比例

公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）。

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过

3,000 万元；公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。

公司具备现金分红条件的，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在实施分红后，公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营、研究开发所需流动资金等投入。

公司具备现金分红条件，董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因。

4、现金股利和股票股利相结合的分配方式

公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，基本原则如下：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

（4）公司发展阶段属成长期但无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例不得低于 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在当次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

四、公司承诺

本公司承诺上市后将严格执行本规划确定的利润分配政策。”

（七）依法承担赔偿责任的承诺

1、发行人未能履行承诺时的约束措施

“1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺的出具需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在本公司股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉；

（2）若因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法承担赔偿责任；

（3）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定可以采取的其他措施。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗力原因导致本公司未能履行公开承诺事项的，本公司需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序），并在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。”

2、发行人股东合肥国材叁号和中建材新材料基金未能履行承诺时的约束措施

“1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）本企业将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）本企业将及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；

（3）本企业将不得转让公司股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；

（4）本企业将向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的

权益；

（5）如违反相关承诺给投资者造成损失的，本企业将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本企业将继续履行该等承诺。

2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。”

3、发行人股东集成电路基金关于未能履行承诺时的约束措施

“1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）本企业将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）本企业将及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；

（3）本企业将不得转让公司股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；

（4）本企业将向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并同意将前述补充承诺或替代承诺提交股东会审议；

（5）如违反相关承诺给投资者造成损失的，本企业将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本企业将继续履行该等承诺。

2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。”

4、国投创业基金和厦门鼎峰关于未能履行承诺时的约束措施的承诺

“1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）本企业将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）本企业将及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；

（3）本企业将向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，并同意将前述补充承诺或替代承诺提交股东会审议；

2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、《公司章程》的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。”

5、发行人董事、审计委员会委员、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施

“1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）本人将在公司股东会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；

（2）如未履行相关承诺事项，本人同意公司根据情节轻重调减或停止向本人发放薪酬或津贴（如有），直至本人履行完成相关承诺事项；

（3）如未履行相关承诺事项，本人将不得作为公司股权激励方案的激励对象，不得参与公司的股权激励计划；

（4）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定可以采取的其他措施。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗力原因导致本人未能履行公开承诺事项的，本人将提出新的承诺，并在股东会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因。”

（八）股东避免新增同业竞争的承诺

发行人股东合肥国材叁号及中建材新材料基金、集成电路基金、国投创业基金及厦门鼎峰出具了《避免同业竞争的承诺函》，详见本招股说明书之“第八节、六、（二）避免同业竞争承诺函”。

（九）其他承诺事项

1、依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

（1）发行人关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

“1、本公司《招股说明书》及其他信息披露资料的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

2、如因本公司《招股说明书》及其他信息披露资料的内容有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。

3、若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后但股票尚未上市交易前触发上述回购义务的，对于首次公开发行的全部新股，本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

4、若在本公司首次公开发行的股票上市交易后触发上述回购义务的，本公

公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格不低于回购公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值（期间本公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施；如本公司启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。

自上述义务触发之日起，至本公司完全履行相关承诺之前，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券等；且本公司将停止制定或实施现金分红计划、停止发放董事和高级管理人员的薪酬、津贴。

5、如因本公司《招股说明书》及其他信息披露资料的内容有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券发行与交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”

（2）发行人股东合肥国材叁号和中建材新材料基金关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

“公司《招股说明书》及其他信息披露资料的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

如因公司《招股说明书》及其他信息披露资料的内容有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。”

（3）发行人股东集成电路基金关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

“公司《招股说明书》及其他信息披露资料的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。”

（4）发行人股东国投创业基金关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

“公司《招股说明书》及其他信息披露资料的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。”

（5）发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

“公司《招股说明书》及其他信息披露资料的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。”

如因公司《招股说明书》及其他信息披露资料的内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”

2、减少与规范关联交易的承诺

发行人及发行人股东合肥国材叁号及中建材新材料基金、集成电路基金、国投创业基金和厦门鼎峰出具了《减少和规范关联交易的承诺》，具体内容详见本招股说明书之“第八节、七、（五）规范关联交易的承诺函”。

3、关于股东信息披露的承诺

根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》，发行人就股东持股情况作出如下承诺：

“1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。

2、本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形。

3、截至本承诺函签署之日，本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形。

4、除招股说明书披露情况外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形。

5、本公司不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

6、本公司不存在证监会系统离职人员不当入股的情况。

7、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地履行了信息披露义务。

8、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

4、中介机构关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

（1）保荐机构承诺

“本公司为江苏鑫华半导体科技股份有限公司（以下简称‘发行人’）首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司过错致使为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者在证券交易中造成损失的，本公司将承担相应的法律责任。”

（2）律师承诺

“如本所律师在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致本所法律文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，且导致发行人不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的，在该等事实和损失被有管辖权的司法机关终审裁定、判决后，本所将在相关裁决、判决生效之日起，启动赔偿投资者损失的相关工作，主动履行生效裁决、判决所确定应由本所承担的赔偿责任和义务。”

（3）会计师、验资机构、验资复核机构毕马威承诺

“本所为江苏鑫华半导体科技股份有限公司首次公开发行股票出具的报告如有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

（4）评估机构承诺

“如因发行人为本次公开发行制作出具文件所引用的本公司资产评估报告专业结论有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本机构未能勤勉尽责的给投资

者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

（5）其他验资机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）承诺

“本所承诺为江苏鑫华半导体科技股份有限公司本次发行并上市所制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本所为发行人本次发行并上市所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”

四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

（一）落实投资者关系管理相关规定的安排

公司采取多种措施，保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。公司建立了保障投资者权益尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利的制度。

1、信息披露制度和流程

为确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，公司第二届董事会第六次会议审议通过的《信息披露管理制度》，对信息披露的内容、信息披露的程序、信息披露的管理、信息披露的记录、资料保管及保密措施等进行了详细的规定。

《信息披露管理制度》规定，公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书负责协调执行信息披露事务管理制度，组织和管理信息披露事务管理部门具体承担公司信息披露工作。依法披露的信息应当通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布信息，并送达监管部门备案。信息公告由董事会秘书负责对外发布，未经董事会书面授权，其他董事、高级管理人员，不得对外发布任何有关公司的重大信息。

2、投资者沟通渠道的建立情况

为建立公司与投资者的良好沟通平台，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、

稳定、和谐的良性互动关系，公司第二届董事会第六次会议审议通过的《投资者关系管理工作细则》，对投资者关系管理的内容、方式、组织和实施进行了详细的规定。

《投资者关系管理工作细则》规定，董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，证券投资部是公司投资者关系管理的专职部门，负责公司投资者关系管理的相关事务。为方便与投资者进行沟通交流，公司将通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。

3、未来开展投资者关系规划

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，确保更好地为投资者提供服务，公司将根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司与投资者关系工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程（草案）》《投资者关系管理工作细则》的规定，通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

（二）股利分配决策程序

股利分配决策程序具体情况请参见本招股说明书之“第九节、二、发行人的股利分配政策”相关内容。

（三）股东投票机制的建立情况

公司2025年第五次临时股东会审议通过的《股东会议事规则》、公司2025年第六次临时股东会审议通过的《公司章程（草案）》等制度建立了中小投资者单独计票等机制，对法定事项规定了采取网络投票方式召开股东会进行审议表决，充分保证了股东权利。

五、股东会、董事会、监事会/审计委员会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

（一）股东会

公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《股东会议事规则》，股东严格按照《公司章程》和《股东会议事规则》的规定行使权利、履行义务，股东会依法规范运行。

自股份公司成立以来，公司股东会会议通知、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整，股东会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责，决议合法有效。股东会制度在规范公司运作过程中发挥了积极的作用。

（二）董事会

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立了董事会，对股东会负责。董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 4 名。公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《董事会议事规则》。董事会规范运行，董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。

自股份公司成立以来，公司董事会会议通知、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责，决议合法有效。董事会制度在规范公司运作过程中发挥了积极的作用。

（三）监事会/审计委员会

自股份公司成立至 2025 年 11 月，公司设立监事会，对股东会负责。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，职工代表监事 1 名。公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《监事会议事规则》。监事会规范运行，监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。

自股份公司成立至 2025 年 11 月，公司监事会会议通知、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整，监事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责，决议合法有效。监事会制度在规范公司运作过程中发挥了积极的作

用。

2025 年 11 月，公司根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，对公司治理结构进行了调整，取消设置监事会，由审计委员会作为公司内部监督机构承接监事会职权。公司审计委员会按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定规范运作，有效履行了监督职责。

（四）独立董事

公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职资格、提名、选举和更换、特别职权、独立意见、行使职权的保障等均作出了明确详尽的规定。截至本招股说明书签署日，公司董事会成员共 11 名，独立董事 4 名，占董事会人数三分之一以上，并有一名会计专业人士，符合相关规定。公司独立董事具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性和任职条件。

自公司独立董事制度建立以来，独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关制度的要求，积极出席公司董事会会议，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，对完善公司的法人治理结构，建立健全内部控制制度，保护中小股东利益，促进公司的规范运作等方面起到积极的作用。

（五）董事会秘书

公司制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任职资格、董事会秘书的职权范围、董事会秘书的任免等内容作出了详细明确的规定。

公司董事会秘书自被聘任以来，严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《董事会秘书工作细则》等相关规定，在信息披露及保密事务、投资者关系管理、股东资料管理以及公司股东会和董事会会议的筹备和召开等方面发挥了重要作用。

六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会根据相应的《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》开展工作。专门委员会对董事会负责，为董事会决策提供咨询意见。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。目前各董事会专门委员会的构成情况如下：

董事会专门委员会	召集人	其他委员
审计委员会	林爱梅	石瑛、许军、安帅、舒恺
战略委员会	聂崑	蒋文武、舒恺
提名委员会	蒋阳波	安帅、张昊玟、林爱梅、许军
薪酬与考核委员会	石瑛	蒋文武、蒋阳波

公司各专门委员会自设立以来，严格按照法律法规、《公司章程》及各专门委员会的工作细则履行相关职责，规范运行。

七、募集资金具体运用情况

（一）10,000 吨/年高纯电子级多晶硅产业集群项目

1、项目概述

项目名称：10,000 吨/年高纯电子级多晶硅产业集群项目

实施主体：内蒙古鑫华半导体科技有限公司

项目投资额：282,832.22 万元

本项目拟采用最新改良西门子法工艺，建设 1 万吨高纯电子级多晶硅产能，同时配套完善的公用工程和辅助设施。项目建成后，将有效提升公司在高端半导体材料领域的供应能力与技术水平，支撑公司持续拓展市场空间、优化产品结构，进一步巩固公司在高纯电子级硅材料领域的领先地位。

2、投资概算

本项目预计总投资 282,832.22 万元，项目投资预算具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	占比
1	新增土地款	15,096.15	5.34%
2	新增固定资产投入	242,771.57	85.84%
3	基本预备费	5,157.35	1.82%
4	借款利息	6,771.84	2.39%
5	铺底流动资金	13,035.31	4.61%
合计		282,832.22	100.00%

3、项目选址

本项目拟在呼和浩特市赛罕区金桥开发区实施。

4、项目实施规划

本项目建设期为 24 个月，具体建设规划及进度如下表：

项目	建设期第 1 年				建设期第 2 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
编制并上报可行性研究报告								
特种设备采购								
长周期设备采购								
工程设计								
人员招聘及培训								
土建及结构施工								
设备材料采购								
设备安装与调试								
试生产								
竣工验收								

5、募集资金运用涉及履行审批、核准或备案程序

2023 年 6 月 2 日，本项目已取得呼和浩特市赛罕区工业和信息化局下发的《变更项目备案告知书》，项目代码为 2205-150105-07-05-722098。

6、项目环保情况

项目建成后生产过程中产生的主要污染物有少量的废水、废气、固体废物和噪声。项目实施过程中公司将采取相应措施对污染物进行环保处理并达到国家环

保规定的排放标准，减少对环境造成的影响。

公司生产过程将采取有效的污染防治措施，经治理后实现达标排放，对环境无不良影响。本次募集资金建设投资项目已取得编号为“呼环政批字〔2022〕175号”和“内环表〔2023〕202号”的环境影响报告书批复文件。

7、募集资金运用涉及新取得土地或房产

项目建设分主副厂区，主厂区地点位于内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开发区世纪十七路南，内蒙古鑫华已取得该地块“蒙（2022）呼和浩特市不动产权第0048792号”产权证书，土地面积150,561.93平方米。副厂区地点位于内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开发区金电路以东、阿木尔南街以北，内蒙古鑫华已取得该地块“蒙（2022）呼和浩特市不动产权第0074479号”产权证书，土地面积65,959.78平方米。

8、项目涉及与他人合作的具体情况

该项目实施主体为内蒙古鑫华。2022年4月，公司召开第二次临时股东大会，决定与TCL科技合资建厂，启动10,000吨/年高纯电子级多晶硅产业集群项目。

截至本招股说明书签署日，内蒙古鑫华注册资本180,000万元，其中鑫华半导体认缴出资额108,000万元，TCL科技子公司天津硅石认缴出资额72,000万元，双方已按照各自认缴出资比例等比例实缴出资。

（二）1,500吨/年超高纯电子级多晶硅项目

1、项目概述

项目名称：1,500吨/年超高纯多晶硅项目

实施主体：内蒙古鑫华半导体科技有限公司

项目投资额：40,025.46万元

本项目拟对厂区现有的工艺装置等进行适应性技术改造，并购置核心设备，以扩大超高纯电子级多晶硅的生产规模。项目建成后，将形成年产超高纯电子级多晶硅及副产品合计1,500吨的产能，有助于公司充分发挥在技术与质量方面的

优势，进一步拓展市场规模、提升市场占有率，同时推动产品线延伸，持续巩固公司在半导体高纯硅材料领域的行业领先地位。

2、投资概算

本项目预计总投资 40,025.46 万元，项目投资预算具体情况如下：

单位：万元

序号	名称	金额（万元）	投资比例
1	建设投资	37,265.03	93.10%
1.1	工程费用	32,951.99	82.33%
1.1.1	建筑工程费	428.59	1.07%
1.1.2	设备购置费	26,027.00	65.03%
1.1.3	安装工程费	6,496.40	16.23%
1.2	工程建设其他费用	2,203.70	5.51%
1.3	预备费	2,109.34	5.27%
1.3.1	基本预备费	2,109.34	5.27%
2	铺底流动资金	2,760.42	6.90%
3	项目总投资	40,025.46	100.00%

3、项目选址

本项目拟在呼和浩特市赛罕区金桥开发区实施。

4、项目实施规划

本项目建设期为 36 个月，具体建设规划及进度如下表：

项目	建设期第 1 年				建设期第 2 年				建设期第 3 年			
	Q1	Q2	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
场地建设												
设备购置与安装调试												
员工招聘与培训												
试生产运行												

注：Q 表示季度，Q1 表示第 1 季度，Q2 表示第 2 季度，以此类推。

5、募集资金运用涉及履行审批、核准或备案程序

2025 年 2 月 25 日，本项目已取得呼和浩特市赛罕区工业和信息化局下发的《项目备案告知书》，项目代码为 2502-150105-07-02-815129。

6、项目环保情况

项目建成后生产过程中产生的主要污染物有少量的废水、废气、固体废物和噪声。项目实施过程中公司将采取相应措施对污染物进行环保处理并达到国家环保规定的排放标准，减少对环境造成的影响。

公司生产过程将采取有效的污染防治措施，经治理后实现达标排放，对环境无不良影响。2025年6月23日，本项目已取得呼和浩特市生态环境局出具的呼环政批字〔2025〕30号环境影响报告书批复文件。

7、募集资金运用涉及土地或房产

本募投项目实施地点在原有内蒙古鑫华厂区内，不涉及新增土地或房产。

8、项目涉及与他人合作的具体情况

该项目实施主体为内蒙古鑫华。

截至本招股说明书签署日，内蒙古鑫华注册资本180,000万元，其中鑫华半导体认缴出资额108,000万元，TCL科技子公司天津硅石认缴出资额72,000万元，双方已按照各自认缴出资比例等比例实缴出资。

天津硅石承诺，在发行人根据各阶段投资方案的资金需求对内蒙古鑫华进行增资时，天津硅石将按照与发行人对内蒙古鑫华增资的同等价格，并依据届时其持有的内蒙古鑫华股权比例，以现金方式同比例投入相应资金，履行同步增资义务。

（三）1,500吨/年区熔用多晶硅项目

1、项目概述

项目名称：1,500吨/年区熔用多晶硅项目

实施主体：江苏鑫华半导体科技股份有限公司

项目投资额：50,870.33万元

本项目拟通过对现有工艺装置实施技术改造，并购置关键核心设备，以扩大区熔用多晶硅的生产能力。项目建成后，将新增区熔用多晶硅及其副产品（含生产损耗）合计年产1,500吨，显著提升高端产品的稳定供应能力，有力支撑区熔

用多晶硅的国产化替代进程，进一步巩固并增强公司在半导体高纯硅材料领域的市场地位与核心竞争力。

2、投资概算

本项目预计总投资 50,870.33 万元，项目投资预算具体情况如下：

单位：万元

序号	名称	金额（万元）	投资比例
1	建设投资	47,853.42	94.07%
1.1	工程费用	42,896.10	84.32%
1.1.1	建筑工程费	1,426.50	2.80%
1.1.2	设备购置费	34,308.00	67.44%
1.1.3	安装工程费	7,161.60	14.08%
1.2	工程建设其他费用	2,249.32	4.42%
1.3	预备费	2,708.00	5.32%
1.3.1	基本预备费	2,708.00	5.32%
2	铺底流动资金	3,016.92	5.93%
3	项目总投资	50,870.33	100.00%

3、项目选址

本项目拟在江苏省徐州经济技术开发区实施。

4、项目实施规划

本项目建设期为 24 个月，具体建设规划及进度如下表：

项目	建设期第 1 年				建设期第 2 年			
	Q1	Q2	Q2	Q3	Q1	Q2	Q3	Q4
场地及生产装置改造								
设备购置与安装调试								
员工招聘与培训								
试生产运行								

注：Q 表示季度，Q1 表示第 1 季度，Q2 表示第 2 季度，以此类推。

5、募集资金运用涉及履行审批、核准或备案程序

2025 年 2 月 25 日，本项目已取得徐州经济技术开发区管委会下发的《江苏省投资项目备案证》，项目代码为 2502-320371-89-02-481283。

6、项目环保情况

项目建成后生产过程中产生的主要污染物有少量的废水、废气、固体废物和噪声。项目实施过程中公司将采取相应措施对污染物进行环保处理并达到国家环保规定的排放标准，减少对环境造成的影响。

公司生产过程将采取有效的污染防治措施，经治理后实现达标排放，对环境无不良影响。2025 年 3 月 28 日，本项目已取得徐州经济技术开发区行政审批局出具的徐开行环（2025）2 号环境影响报告书批复文件。

7、募集资金运用涉及土地或房产

本募投项目实施地点在原有发行人厂区内，不涉及新增土地或房产。

（四）高纯硅材料研发基地项目

1、项目概述

项目名称：高纯硅材料研发基地项目

实施主体：江苏鑫华半导体科技股份有限公司

项目投资额：20,388.05 万元

本项目拟通过建设研发基地，购置先进的研发及检测设备，并依托公司硅+高纯的技术特征,开展高纯硅基类电子特气及半导体级高纯硅基材料的研究开发工作。项目成功实施后有助于公司形成互补的多元化产品体系，实现协同效应，为公司业务的可持续发展赋能。

2、投资概算

本项目预计总投资 20,388.05 万元，项目投资预算具体情况如下：

单位：万元			
序号	名称	合计	投资比例
1	建设投资	16,966.70	83.22%
1.1	工程费用	15,323.50	75.16%
1.1.1	建筑工程费	3,491.41	17.12%
1.1.2	设备购置费	11,143.50	54.66%
1.1.3	安装工程费	688.59	3.38%

序号	名称	合计	投资比例
1.2	工程建设其他费用	682.82	3.35%
1.3	预备费	960.38	4.71%
1.3.1	基本预备费	960.38	4.71%
2	研发费用	3,421.35	16.78%
2.1	研发人员薪酬	1,368.00	6.71%
2.2	材料费	2,053.35	10.07%
3	项目总投资	20,388.05	100.00%

3、项目选址

项目建设地点位于：江苏省徐州经济技术开发区杨山路 66 号。

4、项目实施规划

本项目建设期为 24 个月，具体建设规划及进度如下表：

项目	建设期第 1 年				建设期第 2 年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
场地装修改造								
设备购置与安装调试								
人员招聘与培训								
项目研发								

注：Q 表示季度，Q1 表示第 1 季度，Q2 表示第 2 季度，以此类推。

5、募集资金运用涉及履行审批、核准或备案程序

2025 年 12 月 4 日，高纯硅基类电子特气研发项目已取得徐州经济技术开发区管委会下发的《江苏省投资项目备案证》（2512-320371-89-01-455234）；2026 年 2 月 9 日，半导体级高纯硅材料研发基地项目已取得徐州经济技术开发区管委会下发的《江苏省投资项目备案证》（ 2602-320371-89-03-745251）。

6、项目环保情况

项目建成后生产过程中产生的主要污染物有少量的废水、废气、固体废物和噪声。项目实施过程中公司将采取相应措施对污染物进行环保处理并达到国家环保规定的排放标准，减少对环境造成的影响。

公司生产过程将采取有效的污染防治措施，经治理后实现达标排放，对环境

无不良影响。高纯硅基类电子特气研发项目和半导体级高纯硅材料研发基地项目分别预计于 2026 年一季度和 2026 年二季度取得相关批复。

7、募集资金运用涉及土地或房产

本募投项目实施地点在原有发行人厂区内，不涉及新增土地或房产。

（五）补充流动资金

1、项目概述

结合公司所处行业发展概况、公司自身业务发展规划、经营特点和财务状况等因素，公司拟使用募集资金 20,000 万元用于补充流动资金。

2、补充流动资金的必要性及合理性

（1）公司核心业务快速发展对流动资金的需要

发行人作为国内电子级多晶硅领域的代表性企业，目前处于高速发展时期，充足的流动资金有利于公司保持行业的领先地位。随着公司业务规模的扩大和募投项目的逐渐达产，公司对营运资金的需求将大幅增加。

（2）公司持续研发投入对流动性资金的需求

公司主营业务为电子级多晶硅的研发、生产与销售，属于资本、技术密集型行业。公司需要通过持续的研发投入来维持竞争优势，因此公司需要充足的流动资金以支持公司持续研发创新的需求。

（3）优化公司财务结构、增强公司抗风险能力

本次发行股票募集资金部分用于补充流动资金，可进一步优化公司的财务结构、降低资产负债率，有利于降低公司的财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，保障公司稳定、持续、健康发展。

3、补充流动资金的具体安排

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司募集资金管理制度对补充的流动资金进行管理，使用时将严格按照相关法规和制度要求履行相应的审批程序，根据业务发展需要合理运用。